

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

上市地点：上海证券交易所



北京兆易创新科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）

发行股份及支付现金 购买资产交易对方名称	通讯地址
上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1101 室
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢
北京华创芯原科技有限公司	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1501
上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	上海市徐汇区瑞平路 275 号保利西岸中心 C 座 20 楼
烟台民和志威投资中心（有限合伙）	北京市东城区东直门外大街 39 号院 2 号楼 4 层
募集配套资金交易对方名称	通讯地址
杭州名建致真投资管理有限公司等不超过 10 名特定投资者	详见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份募集配套资金之交易对方概况”

独立财务顾问



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年四月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关监督管理部门的批准和核准。监督管理部门对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

交易对方声明

根据相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威，已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：

本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大重组的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。

公司本次发行股份募集配套资金的交易对方名建致真，已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：

本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等)，本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送本承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报送本承诺人的账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。

相关证券服务机构声明

本次资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易方案概述

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，旨在整合境外优质的存储芯片设计领域资产，使本公司由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商，有助于做大做强我国集成电路存储产业。具体交易方案为兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100%股权，同时拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施，但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，经交易双方友好协商，标的资产的交易价格由交易双方在具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的标的资产截至评估基准日的评估值基础上进行协商一致确定。

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，各方协商一致确定本次交易标的资产的交易价格为 650,000.00 万元。其中股份支付对价为 495,238.66 万元，现金支付对价为 154,761.34 万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 158.30 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。本次发行股份及支付现金购买资产预计共需发行 31,284,816 股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。

定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将作相应调整。此外，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不再调整。

如果本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格发生调整，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量也将做出相应处理。

（二）募集配套资金

为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，本公司拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。

定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，则本次募集配套资金的发行价格将按上交所的相关规则作出相应调整。

本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。

本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易中的现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。募集配套资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	拟投入募集配套资金金额
1	支付本次交易现金对价	154,761.00
2	eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目	20,000.00
3	支付交易相关的中介费用	8,239.00
合计		183,000.00

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足或未能实施完成，上市公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次交易的合规情况

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易中，标的资产为北京矽成 100%股权，交易价格为 650,000.00 万元。此外，本次重大资产重组前 12 个月，公司投资了立而鼎科技（深圳）有限公司、深圳市硅格半导体股份有限公司、忆正科技（武汉）有限公司和 Everspin Technologies, Inc 等集成电路设计行业公司。

上述被投资公司所处行业亦为集成电路设计行业，与本次交易标的公司北京矽成属于相同或相近的行业，因此可以认定为同一或者相关资产，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。

根据兆易创新经审计的 2016 年度财务数据、标的公司和前次交易被投资企业经审计的 2016 年度备考合并财务数据及交易作价情况，相关财务指标占比情况计算如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易 金额孰高	营业收入	资产净额与交 易金额孰高
本次交易-标的公司	650,000.00	213,639.22	650,000.00
前次交易-立而鼎科技	639.62	190.66	639.62
前次交易-硅格半导体	100.00	33.32	100.00
前次交易-忆正科技	2,204.33	343.00	2,204.33
前次交易-Everspin Technologies, Inc	3,336.90	901.27	3,336.90
合计	656,280.85	215,107.48	656,280.85
上市公司 2016 年财务数据	166,965.03	148,894.82	127,853.57
财务指标占比	393.06%	144.47%	513.31%
是否构成重大资产重组	是	是	是

注 1：上市公司的财务指标均取自其经审计的 2016 年度合并财务报表；标的公司以及前次交易被投资企业的财务指标中，资产总额、资产净额指标系根据《重组管理办法》的相关规定，取各指标与本次交易标的或前次投资的交易价格孰高值；标的公司营业收入指标取自标的公司 2016 年度备考合并利润表；前次交易被投资企业的营业收入按照上市公司持股比例乘以各被投资公司 2016 年经审计的营业收入计算得出。

注 2：上市公司对 Everspin Technologies, Inc 的投资金额为 500 万美元，按照关于该投资总经理办公会会议决议日的人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币 3,336.90 万元。

根据上表，本次交易拟购买的标的资产的交易价格和标的公司资产总额的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上，拟购买的标的资产的价格和标的公司归属于母公司股东的净资产的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净资产的比例达到 50%以上，且超过人民币 5,000 万元，标的公司最近一个会计年度营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 50%以上。根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的情形，因此需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（二）本次交易不构成重组上市

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富

得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

1、关于朱一明与香港赢富得之间的一致行动关系

（1）一致行动关系承诺的具体内容和时间限制

根据香港赢富得于 2013 年 4 月 15 日出具的《保持一致行动的承诺函》(以下简称“《承诺函》”), 承诺“自本《承诺函》出具之日起, 在兆易创新的股东大会审议议案时, 本公司作为股东行使表决权时将与朱一明保持一致; 在兆易创新的董事会审议议案时, 本公司会要求本公司推荐的董事行使表决权时亦将与朱一明保持一致。在持有兆易创新股份期间, 本公司不会谋求对兆易创新的实际控制地位, 不会与朱一明之外的其他股东签署一致行动协议或类似保持一致行动的承诺函”。

根据香港赢富得于 2017 年 3 月 10 日出具的《关于确认一致行动关系的声明与承诺函》，承诺“1.在持有兆易创新股份期间，本公司将遵守《保持一致行动的承诺函》，与朱一明保持一致行动关系；2.本承诺函一经作出即不可撤销，且本公司愿意承担因违反上述承诺而对上市公司造成的实际损失。”

基于上述，根据《招股书》、上述《承诺函》等文件资料，香港赢富得出具的承诺为不可撤销承诺，其承诺其在持有兆易创新股份期间与朱一明保持一致行动关系，不存在其他时间限制。

（2）关于是否可能因香港赢富得撤回承诺或减持，导致公司控制权不稳定

1) 香港赢富得的股东构成情况

根据《招股书》，香港赢富得的股东主要是公司外籍员工以及在朱一明创业初期为原 GigaDevice Semiconductor Inc.或公司提供过帮助的人员，其中，公司外籍员工共计持有香港赢富得 70.889%的股权。此外，公司董事、副总经理舒清明持有香港赢富得 57.739%的股权，为香港赢富得的控股股东。

2) 香港赢富得的股份锁定情况

公司股票于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。根据《招股书》，香

港赢富得承诺，“本公司所持公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份”。

香港赢富得控股股东、上市公司董事、副总经理舒清明承诺，“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份”。上述承诺为舒清明作为上市公司董事及高级管理人员根据《公司法》等法律法规作出的惯常承诺，不涉及股份转让的对象。此外，香港赢富得、舒清明与公司实际控制人之间未就未来股份转让达成任何协议或类似安排。

综上所述，结合香港赢富得的股东构成、香港赢富得及舒清明的股份锁定及承诺、公司股份新发行上市等客观及实际情况，香港赢富得确认不会撤回承诺，其所持股份在锁定期（至 2019 年 8 月 18 日）内无法转让或减持，且锁定期届满后短期内大量减持股份的可能性较小。

2、本次交易不构成重组上市

根据中国证监会上市部《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，“在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。”

本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，朱一明直接持有兆易创新 9.31%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.08%及 0.70%股份；香港赢富得持有兆易创新 7.97%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 20.06%，为兆易创新的控股股东和实际控制人，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更，因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（三）本次交易构成关联交易

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，上海承裕、屹唐投资在本次交易完成后将成为上市公司持股比例 5%以上股东，且上述事项预计

在十二个月内完成；发行股份募集配套资金的交易对方中，名建致真系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理朱一明控制的企业。

由上述，根据《重组管理办法》、《上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。在董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决；独立董事就有关议案进行了事前审查及认可，并发表了独立意见；在股东大会审议本次交易事项时，将提请关联股东回避表决。

三、支付方式以及募集配套资金安排

（一）发行股份购买资产方案

1、交易对方

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威。

2、标的资产的定价依据及交易价格

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，经交易双方友好协商，标的资产的定价以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日（即 2016 年 9 月 30 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商一致，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，标的资产的交易价格确定为 650,000 万元。

3、发行股票的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。”

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日，即 2017 年 2 月 14 日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 158.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。其中，董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格将进行相应调整。此外，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不再调整。

5、支付方式

本次交易的支付方式为：上市公司以发行股份作为对价向交易对方购买标的公司 76.19%的股权，以现金作为对价向交易对方购买标的公司剩余 23.81%股权。

按照本次标的的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 495,238.66 万元，发行数量共计 31,284,816 股，向交易对方支付的现金对价共计 154,761.34 万元，具体如下：

股东姓名	持股比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票支付 数量 (股)
			股份对价 (万元)	股份对价 占比	现金 (万元)	现金对 价占比	
上海承裕	43.17%	280,621.64	224,497.31	45.33%	56,124.33	36.27%	14,181,763
屹唐投资	37.16%	241,555.54	175,823.25	35.50%	65,732.29	42.47%	11,106,964
华创芯原	11.96%	77,718.36	44,813.64	9.05%	32,904.72	21.26%	2,830,931
民和志威	3.92%	25,501.97	25,501.97	5.15%	-	-	1,610,989
闪胜创芯	3.79%	24,602.50	24,602.50	4.97%	-	-	1,554,169
总计	100.00%	650,000.00	495,238.66	100.00%	154,761.34	100.00%	31,284,816

上表中，上市公司以现金作为对价向上海承裕和屹唐投资购买的标的公司股权包括上海承裕和屹唐投资于 2016 年 12 月分别受让的标的公司 4.09%股权和 10.10%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。

6、滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

7、锁定期安排

根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和发行股份及支付现金购买资产的交易对方出具的《股份锁定承诺函》，本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方的股份锁定期具体安排如下：

（1）业绩承诺方¹

如业绩承诺方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，业绩承诺方按照下列公式计算的股份可以转让或交易（即解锁，下同）：业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价）/发行价格²。同时，业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

¹根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，因华创芯原及民和志威在本次交易项下获得的交易对价（含股份对价及现金对价）因华创芯原于 2017 年 4 月将其所持有的标的公司部分股权转让予民和志威而发生调整，各方确认，于“锁定期安排”项下，在计算各方可解锁股份时，相关公式中的“业绩承诺方获得的交易对价”、“业绩承诺方获得的现金对价”均应按华创芯原向民和志威转让股权前（即截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日）各交易对方所持标的公司出资额对应的交易对价计算，下同。

²如按此公式计算为负数，则视为可解锁的股份数为零，下同。

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可再解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可再解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年的累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例 / 发行价格 - 第一期解锁股份数

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格 - 第一期解锁股份数

第三期，在 2019 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在 2017 年至 2019 年累计实现净利润达到累计承诺净利润的 90%或以上，则业绩承诺方剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。

为确定各期可解锁股份数量，《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经交易双方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司年度报告披露届满 30 日后解锁相应数量的股份。

如业绩承诺方取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其相应部分的新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届

满之日或其在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。

（2）民和志威

如民和志威取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

华创芯原及民和志威在本次交易项下获得的交易对价（含股份对价及现金对价）将因华创芯原股权转让发生调整。各方确认，在按《发行股份及支付现金购买资产协议》第二条第 3 款第（7）项“锁定期安排”计算各方可解锁股份时，相关公式中的“业绩承诺方获得的交易对价”、“业绩承诺方获得的现金对价”均应按华创芯原股权转让前（即截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日）各交易对方所持标的公司出资额对应的交易对价计算。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

非经上市公司同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如果非经上市公司同意业绩承诺方转让该等股份，业绩承诺方应按《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定承担相应的违约责任。

8、上市地点

本次非公开发行股票拟在上交所上市交易。

9、决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）发行股份募集配套资金

本次拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。名建致真不参与发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且本次募集配套资金最终发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

1、本次募集配套资金的发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括名建致真在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10 名特定投资者。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

2、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金所发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

3、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定投资者非公开发行股份的方式。

4、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

总量。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。其中，名建致真不参与本次发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

5、发行数量

本次募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。本次募集配套资金最终发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。

6、募集配套资金用途

本次配套融资资金拟用于支付本次交易现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。如本次配套资金募集不足或未能实施完成，公司将通过自筹资金的方式解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。总体用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	拟投入募集配套资金金额
1	支付本次交易现金对价	154,761.00
2	eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目	20,000.00
3	支付交易相关的中介费用	8,239.00
合计		183,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际需求及资金需求，按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

7、滚存未分配利润安排

公司在本次发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

8、锁定期安排

本次交易上市公司拟向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金，其中名建致真所认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得转让。

本次发行完成后至锁定期满之日止，由于上市公司分配股票股利、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

本次所认购的上市公司股份锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、上交所届时有效的相关规定。

9、上市地点

本次非公开发行股票拟在上交所上市交易。

10、决议有效期

与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、标的资产的评估情况及相关盈利承诺

（一）评估情况

本次重大资产重组标的资产的定价以具有证券业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估确定的评估值为依据。根据评估机构以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日正式出具的评估报告，北京矽成 100%股权的评估值为 580,858.47 万元，评估增值率为 10.21%。标的资产的评估值详情参见“第五章 标的资产评估情况”。

（二）相关盈利承诺及业绩补偿

兆易创新与本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署了《盈利补偿协议》及其补充协议，主要内容如下：

1、业绩承诺期限

本次交易中，业绩承诺方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即 2017 年、2018 年和 2019 年。如本次交易未能在 2017 年度实施完毕或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，双方协商后签署补充协议予以确认。

2、业绩承诺净利润数及实际利润数

（1）根据评估报告，经双方协商及确认，上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯作为业绩承诺方，其承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。

若本次交易未能在 2017 年度交割及实施完毕，则业绩承诺方的业绩承诺期及承诺净利润数将作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由双方另行协商并签署补充协议。

（2）双方同意，标的公司业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，为实际净利润数。在计算实际利润数时，不考虑：1）标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；2）标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

（3）上市公司在业绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实现的实际净利润数，以及该等净利润与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。双方理解并确认，以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

就标的公司业绩承诺期内各年度实际净利润数的累计数与承诺净利润数的

累计数相关差额部分，由业绩承诺方根据《盈利补偿协议》及补充协议的有关约定进行补偿。

3、盈利补偿及其方案

（1）补偿原则

业绩承诺期届满后，若标的公司实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的90%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿；否则，业绩承诺方应就实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行补偿。业绩承诺方有权选择以现金或股份或现金与股份相结合的方式补偿。

（2）利润补偿方式的计算

1) 现金补偿金额及股份补偿数量：

应补偿金额=（承诺净利润累计数－实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×标的资产交易作价

应补偿股份数量=（补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

“发行价格”为上市公司本次交易项下发行股份购买标的资产的发行价格；
“标的资产交易作价”为上市公司为购买标的资产而向业绩承诺方支付的对价。

业绩承诺方业绩补偿总额以标的资产交易作价的50%为限，如有超出部分，业绩承诺方无需进一步补偿。业绩承诺方中各方应补偿金额及/或应补偿股份数量按其截至《盈利补偿协议》签署日各自持有标的公司的出资额占业绩承诺方合计持有标的公司的出资额的比例分别计算。

2) 若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量；若上市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按《盈利补偿协议》第四条第2款公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

（3）标的公司收购 ISSI 导致的资产增值摊销及相关所得税费用在承诺期及后续期对利润实现的影响

1) 盈利承诺期内，标的公司因收购 ISSI 导致的资产增值摊销及相关所得税

费用对承诺期净利润的影响如下表所示：

单位：万元

项 目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
PPA 摊销对税前利润的影响金额	7,818.66	6,793.29	6,416.32
PPA 摊销对所得税的影响金额	1,025.03	758.44	677.50
PPA 摊销对净利润的影响金额	6,793.63	6,034.86	5,738.82
考虑 PPA 摊销影响后的承诺净利润	23,106.37	38,165.14	51,461.18
不考虑 PPA 摊销影响的净利润	29,900.00	44,200.00	57,200.00

注：盈利预测期 PPA 摊销及相关税费的人民币影响金额按照 2016 年 9 月 30 日人民币汇率中间价 1 美元=6.6778 元人民币折算

盈利承诺期内，2017 年度、2018 年度和 2019 年度 PPA 摊销对标的公司备考合并报表净利润的影响金额分别为 6,793.63 万元、6,034.86 万元和 5,738.82 万元人民币。

2) 利润承诺期的后续期间，标的公司收购 ISSI 导致的 PPA 摊销及相关所得税费用对后续期的影响额如下表所示：

单位：万元

年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
PPA 摊销对税前利润的影响金额	6,393.55	6,359.08	5,952.88
PPA 摊销对所得税的影响金额	673.63	667.77	625.98
PPA 摊销对当年净利润的影响额	5,719.92	5,691.31	5,326.90

注：后续期 PPA 摊销及相关税费的人民币影响金额按照 2016 年 9 月 30 日人民币汇率中间价 1 美元=6.6778 元人民币折算

2020 年至 2022 年，PPA 及相关所得税费用对标的公司备考报表的净利润经营金额分别为 5,719.92 万元、5,691.31 万元和 5,326.90 万元人民币。预计截至 2022 年底，因前次收购产生的无形资产评估增值部分全部摊销完毕，2023 年及之后不影响净利润水平。预计 2023 年及以后年度，固定资产 PPA 及相关税费对标的公司合并报表净利润的影响金额为约为 42.87 万元人民币/年。

（4）标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用

标的主要经营实体 ISSI 于 2007 年开始实施股权激励计划，包括股票期权、股票增值权、限制性股票和红股等多种方式。因 ISSI 私有化收购完成后，其股票不具有二级市场交易价格，ISSI 将剩余未实施的股权激励计划金额

全部转化为现金激励计划，该部分已经转为现金激励计划的股权激励费用将根据员工的在职时间及表现分期实施。盈利预测期内，标的公司该股权激励事项对费用及相关所得税费用的影响如下表所示：

单位：万元

项 目	2017 年度	2018 年度
股权激励费用对税前利润的影响金额	3,806.35	2,938.23
股权激励费用对所得税的影响金额	1,065.78	839.40
股权激励费用对净利润的影响金额	2,740.57	2,098.83

注：盈利预测期 PPA 摊销及相关税费的人民币影响金额按照 2016 年 9 月 30 日人民币汇率中间价 1 美元=6.6778 元人民币折算

如上表所示，2017 年和 2018 年标的公司预计将分别支出 570 万美元和 440 万美元用于支付前述股权激励转为现金激励计划的相关费用，按照 2016 年 9 月 30 日人民币汇率中间价折算，2017 年和 2018 年标的公司因实施股权激励对税前利润的影响金额分别为 3,806.35 万元和 2,938.23 万元，对所得税费用的影响金额分别为 1,065.78 万元和 839.40 万元。

（5）标的公司盈利承诺较报告期净利润水平增长情况、原因及合理性分析

报告期内，标的公司扣除 PPA 摊销及其相关所得税费用前后的净利润情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
归母净利润-未扣除 PPA 摊销影响	14,055.40	5,905.54	1,564.04
扣非后归母净利润-未扣除 PPA 摊销影响	12,379.03	5,919.32	-2,572.71
PPA 摊销对净利润的影响金额	7,117.76	6,713.52	6,621.25
归母净利润-扣除 PPA 摊销影响	19,496.79	12,632.83	4,048.54

2016 年度，标的公司归属于母公司所有者的净利润为 14,055.40 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,379.03 万元，扣除 PPA 摊销及相关所得税的影响后，2016 年全年实现扣非后归母净利润 19,496.79 万元。2017 年，标的公司承诺实现扣非后归母净利润为 29,900.00 万元，较 2016 年全年预计扣非后归母净利润增长 53.36%，增幅较大。主要是基于以下因素：

1) 私有化收购完成后，标的公司主营业务发展趋势良好

标的公司于 2015 年 12 月完成对 ISSI 的私有化收购，主要经营实体 ISSI 由一家纳斯达克上市公司转变为由上海承裕、屹唐投资等中国投资机构 100% 持股的私有化公司，从而更好地对接中国这一全球集成电路市场的主要增长地区，把握中国集成电路产业快速发展带来的机遇。

①中国集成电路产业快速发展

经过十年“创芯”发展，我国集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为主体，制造业为重点的产业格局。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2015 年规模达到 3,609.81 亿元人民币，受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及外资企业加大在华投资影响，过去三年行业销售规模增速为 19.72%、20.20%、16.21%，行业市场增速明显高于全球水平。

作为我国集成电路产业中发展最快速的集成电路设计行业，同样实现了高于全球其他地区平均增长速度的高速成长。受益于近年来全球范围内消费电子产品的普及以及人们生活中越来越高程度的电子化趋势，我国集成电路市场具备庞大的内生增长动力。同时越来越多受过高等教育且具备专业素质的集成电路产业基层设计人员形成了充足的人才供给市场，加之较欧美成熟市场相对较低的人力成本，我国目前的集成电路产业环境为劳动密集型的集成电路设计企业提供了快速发展的通道和契机。对标的公司而言，其存储芯片产品在低功耗、低成本、高集成、高安全方面具有显著的优势，在面对中国集成电路产业的快速发展阶段下，依托其综合优势将获得较强的盈利能力。

②标的公司积极开拓国内市场业务，已取得一定成效

标的公司下属经营实体与海外合作伙伴保持长期良好的合作关系，四大产品 DRAM、SRAM、FLASH 和 ANALOG 在专用领域内拥有客户充分的认可。自 2015 年被中资财团收购以后，标的公司下属经营实体积极开展拓展中国市场的战略，并取得一定效果，在国内的汽车电子应用领域，标的公司已成功进入高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车行驶电子化配套系统、车载显示及触控集成解决方案等前沿应用领域市场。同时，标的公司在网络通讯领域市场，凭借低延迟动态随机存储技术等高质量、长生命周期的产品已经进入国内客户的测试验证阶

段，未来能逐步替代美系及日系供应商产品。此外，标的公司在用于极端环境下的高可靠性存储芯片领域具备了工业级和汽车产品的研发基础，相关高可靠性产品正处于良好的研究与推动阶段，得到了国内客户的关注和支持。目前标的公司已与国内多家知名专用领域电子经销商合作洽谈，达成初步意向合作协议，预计未来标的公司具有竞争优势的 DRAM、SRAM、FLASH 和 ANALOG 产品能在汽车电子、网络通讯等领域为标的公司带来预测收益的增长。

③前次收购完成后，标的公司主营业务发展稳中向好

自 2015 年 12 月完成收购后，标的公司主营业务经营状况良好。2016 年，标的公司共实现营业收入 213,639.22 万元，较 2015 年增长 10.36%。标的公司完成收购后首年的经营情况为后续的发展奠定了良好的基础。

2) 业绩承诺期标的公司税务筹划效果将逐渐显现

出于税务结构优化考虑，北京矽成于 2016 年 11 月完成内部股权架构调整，ISSI Cayman 和 Si En Cayman 由 ISSI 子公司调整为 ISSI 兄弟公司。随着架构调整的搭建完成，标的公司有望实现税务结构在全球范围内的优化分布，进而有效降低标的公司综合所得税税率，从而提升标的公司的净利润水平。

综上所述，标的公司未来三年扣除 PPA 摊销及相关所得税费用的影响后的盈利承诺净利润较报告期备考报表净利润水平增幅较大，主要是基于标的公司营业收入的增长潜力以及税务架构调整完成后综合税率显著下降等因素，承诺净利润的增长具有合理性及可实现性。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司主营业务的影响

上市公司与标的公司均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。主要产品方面，本次交易前，上市公司主营产品以 NOR FLASH 等非易失性存储芯片为主，标的公司则以 DRAM 和 SRAM 等易失性存储芯片为主。本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。

报告期内，上市公司和标的公司均具有良好的盈利表现。根据半导体协会数据，2012 年以来兆易创新为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业。2016 年 8 月上市后，公司成为 A 股市场中少数的半导体存储行业上市公司之一，在我国本土电子产业中的存储芯片市场优势明显。

标的公司的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，标的公司积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次收购完成后，兆易创新将与北京矽成在现有的客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，借助彼此在国内和海外市场积累的研发实力和优势地位，实现上市公司业务上的有效整合。同时，通过存储芯片产品品类的扩充，以及产品适用领域逐渐迈入专用级应用市场，上市公司产品的市场占有率将迎来进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。

此外，本次交易收购北京矽成将为上市公司引进存储芯片研发设计领域的优秀研发人员以及国际化管理团队，为上市公司进一步快速发展和国际化纵深发展注入动力。本次交易完成后，上市公司与北京矽成将在员工激励、培训、管理等多方面相互形成正向反馈，提升上市公司和北京矽成的整体运营效率。

（二）本次交易对公司盈利能力的影响

本次交易前，兆易创新 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度归属于母公司所有者净利润分别为 9,812.25 万元，15,778.26 万元和 17,642.76 万元。本次交易拟收购资产北京矽成最近三年备考合并财务报表归属于母公司股东的净利润分别为 1,564.04 万元、5,905.54 万元和 14,055.40 万元，扣除非经常性损益后的归母净利润分别为-2,572.71 万元、5,919.32 万元和 12,379.03 万元。

根据《盈利补偿协议》及补充协议，本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。若考虑标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销以及因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响后，盈利承诺期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 20,365.80 万元、

36,066.31 万元和 51,461.18 万元。本次交易完成后，上市公司盈利规模将大幅增加。

上市公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，本次交易完成后，兆易创新将整合并购双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与标的资产相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。

（三）本次交易对公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司的总股本为 10,000.00 万元，朱一明为公司控股股东和实际控制人。本次交易上市公司拟向北京矽成全体股东发行 3,128.48 万股股份，本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 13,128.48 万元（不考虑发行股份募集配套资金部分）。本次交易完成前后公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
朱一明	12,219,000	12.22%	12,219,000	9.31%
香港赢富得	10,459,500	10.46%	10,459,500	7.97%
友容恒通	2,724,825	2.72%	2,724,825	2.08%
万顺通合	924,000	0.92%	924,000	0.70%
上海承裕	-	-	14,181,763	10.80%
屹唐投资	-	-	11,106,964	8.46%
华创芯原	-	-	2,830,931	2.16%
民和志威	-	-	1,610,989	1.23%
闪胜创芯	-	-	1,554,169	1.18%
重组前的其他股东	73,672,675	73.67%	73,672,675	56.12%
合计	100,000,000	100.00%	131,284,816	100.00%

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

在不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，本次交易完成后，朱一明直接持有兆易创新 9.31%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.08%及 0.70%股份；香港赢富得持有兆易创新 7.97%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 20.06%，仍为公司控股股东和实际控制人，因此本次交易将不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次交易对公司同业竞争的影响

本次交易并未导致兆易创新控股股东和实际控制人发生变更，朱一明仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，北京矽成旗下的存储芯片业务将整体注入上市公司。目前，朱一明未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及标的公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及标的公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争的问题。

本次交易完成后，为从根本上避免和消除控股股东及实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东及实际控制人朱一明作出承诺避免同业竞争。此外，本次交易完成后，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，也作出承诺避免同业竞争。

（五）本次交易对公司关联交易的影响

本次交易前，上市公司与北京矽成及其股东之间不存在关联关系，亦不存在关联交易。本次交易完成后，标的资产北京矽成将作为上市公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，上市公司将新增关联方。

本次交易完成后，上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理

理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人、本次交易新增关联方和上市公司的关联交易，朱一明、上海承裕及屹唐投资分别就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

（六）本次交易对公司治理结构和独立性的影响

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对本公司实际控制人的控制权不会产生重大影响，亦不会对现有的公司治理结构产生不利影响。

本次交易完成后，公司各项经营活动（包括但不限于采购、销售、技术、商标等）对控股股东、实际控制人以及其他第三方不存在重大依赖。

六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的审批程序

1、上市公司的决策过程

2017年2月13日，上市公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2017年2月24日，上市公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2017年4月17日，上市公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2、标的公司决策过程

本次交易的方案已经北京矽成股东会议审议通过。

3、交易对方决策过程

本次交易的方案已经全部交易对方的内部权力机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，截至本报告书出具日，本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、兆易创新股东大会审议通过本次交易方案；
- 2、中国证监会核准本次交易事项；
- 3、本次交易涉及的相关事项尚需通过 CFIUS 的安全审查；
- 4、本次交易涉及的相关事项尚需通过台湾投审会的审查。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的有关约定，本次交易涉及事项需通过 CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会的审查，该 2 项审查为本次交易交割的前提条件。

本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

七、公司股票停牌前股价存在异常波动的说明

公司股票于 2016 年 9 月 19 日起开始停牌，并于 2016 年 10 月 10 日起进入重大资产重组停牌程序。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证电子指数（代码：950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：

日期	兆易创新价格 (元/股)	上证电子指数 (点)	上证综指 (点)

2016年8月18日	33.49	5,797.78	3,104.11
2016年9月14日	177.97	5,593.19	3,002.85
涨跌幅	431.41%	-3.53%	-3.26%

注：由于兆易创新股票上市交易仅 20 个交易日，因此将兆易创新股票停牌前第 20 个交易日的收盘价作为计算波动幅度的基数。

公司 A 股股票股价在上述期间内上涨幅度为 431.41%，扣除上证电子指数下跌 3.53%因素后，波动幅度为 434.94%；扣除上证综指下跌 3.26%因素后，波动幅度为 434.67%。

综上，剔除大盘因素后，公司股价在公司因本次重大资产重组事宜停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%，达到 128 号文第五条的相关标准。

本次交易，公司已采取了相关保密措施，包括公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。

根据本次重组相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内人员买卖公司股票的情况，相关人员已出具声明和承诺，不涉及内幕交易、市场操纵等禁止交易行为（详情参见“第十三章 其他重要事项”之“六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况”）。

根据 128 号文的规定，中国证监会可能会对公司重组停牌前的股价波动进行调查，调查期间将暂缓审核公司的行政许可申请。因此，公司本次交易能否按正常进度审核、以及能否通过审核，均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方作出的重要承诺

本次重组相关方作出的重要承诺如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容
关于信息真实、准确和完整的承诺	发行股份及支付现金购买资产交易对方	本承诺人作为本次交易的交易对方，现就本次重组提供信息及文件资料等相关事项作出承诺如下： 1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或

承诺事项	承诺方	承诺内容
		原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大重组的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 3. 如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向上交所和中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。 本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
	上市公司	本承诺人现就本次重组提供信息及文件资料等相关事项作出承诺如下： 1. 本承诺人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 3. 本承诺人保证，本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将促使本承诺人的控股股东/实际控制人、董事、监事、高级管理人员不以任何方式转让其在本承诺人拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本承诺人董事会，由董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报

承诺事项	承诺方	承诺内容
		送其本人的身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。 本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
	上市公司董事、监事、高级管理人员	本承诺人现就本次重组提供信息及文件资料等相关事项作出承诺如下： 1.本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 3.本承诺人保证，本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。 本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
	募集配套资金交易对方（名建致真）	本承诺人作为本次重组项下募集配套资金的股份认购方，现就本次重组提供信息及文件资料等相关事项作出承诺如下： 1.本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		3.如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和中登公司报送本承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和中登公司报送本承诺人的账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。
关于合法、合规及诚信的声明及承诺	上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员	本承诺人现就本次重组相关事项作出声明及承诺如下： 1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到上交所公开谴责。
关于标的资产完整权利的承诺	发行股份及支付现金购买资产交易对方	本承诺人作为本次重组项下的交易对方，就本次重组项下标的公司/标的资产等有关情况作出承诺如下： 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或重大争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有标的公司相应股权，不存在通过协议、信托或其他任何方式代他人持有或为他人持有标的公司股权的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的公司股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权（无论是现在或将来）根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的公司股权，从而获取标的资产或标的资产对应的利润分配权。 5.本承诺人没有向法院或者政府主管部门申请破产、清算、解散、接管或者其他足以导致标的公司终止或者丧失经营能力的情况，也没有第三方采取有关上述各项的行动或提起有关法律或行政程序。
关于本次重组有关事项的声明及承诺函	标的公司	作为本次重组项下的标的公司，本承诺人现作出声明及承诺如下： 截至本函出具日： 1.本公司及子公司自设立起至今均守法经营，在登记或核准（如有）的经营范围内开展业务活动，不存在实质违反法律、法规从事经营活动导致对公司产生重大不利影响的情况。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		2.本公司及子公司拥有的自有土地/自有土地使用权和房屋/房屋所有权权属清晰、使用的租赁土地和房屋均已与出租人签署相关租赁协议，本公司及子公司可以合法占有及使用相关物业资产，不存在重大产权纠纷或潜在纠纷。 3.本公司及子公司的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押等强制性措施的情形，公司使用主要经营性资产不存在法律障碍。 4.除已向上市公司披露的情形外，本公司及子公司不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在对外担保或为关联方提供担保的情形。 5.除已向上市公司披露的情形外，本公司及子公司近三年不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权利等原因而产生的侵权之债。 6.本公司及子公司近三年不存在因违反工商、税务、社保等方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。 7.本公司及子公司不存在尚未了结或可预见的、足以影响本公司存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案件。 8.本公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税款。
关于本次重组有关事项的声明及承诺函	募集配套资金交易对方（名建致真）	本承诺人作为本次重组项下募集配套资金的股份认购方，就本次重组相关事项作出声明及承诺如下： 1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于认购资金来源情况 本承诺人用以认购本次募集配套资金的全部资金来源合法合规，为本承诺人的自有资金或自筹资金，本承诺人拥有完全、有效的处分权，本承诺人将根据与上市公司签署的《股份认购协议》有关约定，及时足额支付全部认购资金。 本承诺人参与本次募集配套资金不存在接受他人委托投资或股份代持的情形，不包含任何杠杆融资或分级收益或其他结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况。且认购资金未直接或间接来源于上市公司，亦未直接或间接来源于上市公司的董事、监事、高级管理人员及其他关联方。 3.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人的实际控制人朱一明先生系上市公司第一大股东及实际控制人，并担任上市公司董事长及总经理职务，除上述关联关系外，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上的股东及本次重组的其他各方均不存在关联关系或一致行动关系。 截至本函出具日，除业务关系外，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		4.关于合法合规性情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 5.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律责任。

除上述与本次交易相关出具的承诺事项外，相关各方长期履行的承诺事项情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容
关于股份锁定的承诺函	发行股份及支付现金购买资产交易对方（上海承裕、屹唐投资和闪胜创芯）	本承诺人现就本次重组涉及的股份锁定事宜，在此作出承诺如下： 1.如本承诺人取得新增股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同)，对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间(以工商变更登记完成之日起算，下同)已超过 12 个月，则本承诺人在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，本承诺人按照下列公式计算的股份可以转让或交易(即解锁，下同)：本承诺人可解锁的股份数=(本承诺人获得的交易对价*50% - 本承诺人获得的现金对价)/发行价格。同时，本承诺人根据业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下： 第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺利润的 90%，则本承诺人可再解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，本承诺人可再解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=(本承诺人获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例)/发行价格 第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则本承诺人可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%或以上，本承诺人可解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=本承诺人获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年的累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例 / 发行价格 - 第一期解锁股份数

承诺事项	承诺方	承诺内容
		第三期，在 2019 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在 2017 年至 2019 年累计实现净利润达到累计承诺净利润的 90%或以上，则本承诺人剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。 前述《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经上市公司与业绩承诺方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，本承诺人可自上市公司年度报告披露届满 30 日后解锁相应数量的股份。 2.如本承诺人取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本承诺人相应部分的新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日或本承诺人在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不得转让。 3.本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易规则的规则办理。 4.若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。 5.如无特殊声明，本承诺函中使用但未定义的词语应与本承诺人与上市公司及其他相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》中的相同词语做相同解释。
	发行股份及支付现金购买资产交易对方（华创芯原）	本承诺人现就本次重组涉及的股份锁定事宜，在此作出承诺如下： 1.如本承诺人取得新增股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同)，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间(以工商变更登记完成之日起算，下同)已超过 12 个月，则本承诺人在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，本承诺人按照下列公式计算的股份可以转让或交易(即解锁，下同)：本承诺人可解锁的股份数=(本承诺人获得的交易对价*50% - 本承诺人获得的现金对价)/发行价格。同时，本承诺人根据业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下： 第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺利润的 90%，则本承诺人可再解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，本承诺人可再解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=(本承诺人获得的交易对价*50% - 本承诺人获得的现金对价 + 本承诺人获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例)/ 发行价格 第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则本承诺人可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年

承诺事项	承诺方	承诺内容
		的累计承诺净利润的 90%或以上，本承诺人可解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=(本承诺人获得的交易对价*50% - 本承诺人获得的现金对价+本承诺人获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例)/ 发行价格 - 第一期解锁股份数。 第三期，在 2019 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在 2017 年至 2019 年累计实现净利润达到累计承诺净利润的 90%或以上，则本承诺人剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。 前述《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经上市公司与业绩承诺方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，本承诺人可自上市公司年度报告披露届满 30 日后解锁相应数量的股份。 2.如本承诺人取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本承诺人相应部分的新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日或本承诺人在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不得转让。 3.本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。 4.若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。 5.如无特殊声明，本承诺函中使用但未定义的词语应与本承诺人与上市公司及其他相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》中的相同词语做相同解释。
	发行股份及支付现金购买资产交易对方（民和志威）	本承诺人现就本次重组涉及的股份锁定事宜，在此作出承诺如下： 1.如本承诺人取得新增股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同)，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间(以工商变更登记完成之日起算，下同)已超过 12 个月，则本承诺人在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本承诺人取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。 2.本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。 3.若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。 4.如无特殊声明，本承诺函中使用但未定义的词语应与本承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容
		人与上市公司及其他相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中的相同词语做相同解释。
	募集配套资金交易对方（名建致真）	本承诺人作为本次重组项下募集配套资金的股份认购方，现就股份锁定事宜出具承诺如下： 1.就上市公司在本次重组中向本承诺人发行的全部股份，本承诺人承诺自本次发行完成之日起 36 个月内不得交易或转让。 本次重组完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。 2.锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上交所的规则办理。 3.若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。
关于减少及规范关联交易的承诺函	控股股东及实际控制人朱一明	本承诺人作为兆易创新的控股股东及实际控制人，特承诺如下： 1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与兆易创新及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与兆易创新及其控制企业的关联交易损害兆易创新及其他股东的合法权益。 3.在持有上市公司股份期间，不利用控股股东地位及影响谋求兆易创新及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与兆易创新及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再作为兆易创新的控股股东及实际控制人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给兆易创新或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
	上海承裕、屹唐投资	为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，本承诺人作为本次重组项下的交易对方，特此承诺如下： 1.本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他

承诺事项	承诺方	承诺内容
		企业将尽可能避免或减少与兆易创新及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与兆易创新及其控制企业的关联交易损害兆易创新及其他股东的合法权益。 3.在持有上市公司股份期间，不利用股东地位及影响谋求兆易创新及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再持有上市公司 5%以上股份，本承诺始终有效。若因违反上述承诺而给兆易创新或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
关于避免同业竞争的承诺	控股股东及实际控制人朱一明	就避免同业竞争事项，本承诺人承诺如下： 1.本承诺人目前未直接或间接地从事任何与兆易创新及标的公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。 2.本承诺人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与兆易创新及标的公司相同或类似的业务，以避免与兆易创新及标的公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。 3.如果本承诺人有同兆易创新或标的公司主营业务相同或类似的业务机会（以下简称“业务机会”），应立即通知兆易创新，并尽其最大努力，按兆易创新可接受的合理条款与条件向兆易创新提供上述业务机会。无论兆易创新是否放弃该业务机会，本承诺人均不会自行从事、发展、经营该等业务。 4.本承诺人保证，本承诺人全资拥有或拥有 50%股权以上子公司（兆易创新及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺。本承诺人将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 5.本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本承诺人不再作为兆易创新的实际控制人； （2）兆易创新股票终止在上海证券交易所上市。
	上海承裕及其实际控制人、屹唐投资及其实际控制人	为了保障兆易创新及标的公司的合法权益，本承诺人特就避免与兆易创新同业竞争事宜作出承诺如下： 为保障上市公司及标的公司的利益，本次交易完成后，本承诺人承诺，于三年业绩承诺期内(本承诺人持有上市公司股份低于 5%的，承诺自本承诺人持股比例首次低于 5%之日即终止)：(1) 不以任何方式直接或间接地控制从事与上市公司、标的公司现有主营业务(简称“现有业务”)相同业务活动的任何实体；(2) 亦不会在标的公司及其下属公司招揽标的公司的雇员(含在本协议生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员)、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。若发生此种行为，则上市公司有权在不超过本承诺人因此种行为所获利金额的限额内要求本承诺人支付赔偿。本承诺人将尽合理努力促使标的公司核心管理人员一并作出以上承诺(核心管理人员不竞争相应期限为其在标的公司任职

承诺事项	承诺方	承诺内容
		期间及其离职后两年内); 且(3)在现有业务之外, 未来上市公司、标的公司从事新的主营业务(简称“新业务”, 即以上上市公司在指定信息披露媒体上披露的为准, 该等业务占上市公司合并报表营业收入的 5%或以上), 本承诺人亦将不会以任何方式直接或间接的控制从事新业务的实体, 但在上市公司披露某项业务已构成其新业务前本承诺人已从事的新业务不受此限。 为本条之目的, “现有业务”是指存储芯片、微处理器及其衍生产品的研发、技术支持和销售; “控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十(50%)的有表决权股份, 或拥有任命或选举其过半数董事的权力, 但是以财务投资为目的进行投资活动, 不论持股比例是否超过 50%, 亦不论是否向被投资公司委派或提名董事, 不直接或间接参与被投资公司业务经营及管理, 均不视为控制。 尽管有上述承诺, 在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之前, 本承诺人已经进行的投资不受上述限制。
关于保证上市公司独立性的承诺	控股股东及实际控制人朱一明	一、关于上市公司人员独立 1.保证兆易创新的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在兆易创新工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。 2.保证兆易创新的财务人员独立, 不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3.保证兆易创新的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。 4.保证本承诺人推荐出任兆易创新董事、监事的人选都通过合法的程序进行, 本承诺人不干预兆易创新董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 二、关于上市公司财务独立 1.保证兆易创新建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。 2.保证兆易创新具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3.保证兆易创新及其子公司能够独立做出财务决策, 本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预兆易创新的资金使用、调度。 4.保证兆易创新及其子公司独立在银行开户, 不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。 5.保证兆易创新及其子公司依法独立纳税。 三、关于上市公司机构独立 1.保证兆易创新依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构。 2.保证兆易创新的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)独立行使职权。 3.保证兆易创新及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开, 不存在机构混同的情形。 4.保证兆易创新及其子公司独立自主地运作, 本承诺人不会超

承诺事项	承诺方	承诺内容
		越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 四、关于上市公司资产独立、完整 1.保证兆易创新具有独立、完整的经营性资产。 2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用兆易创新的资金、资产及其他资源。 3.保证不以兆易创新的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。 五、关于上市公司业务独立 1.保证兆易创新拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少兆易创新与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；杜绝非法占用兆易创新资金、资产的行为；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与兆易创新及其控制企业的关联交易损害兆易创新及其他股东的合法权益。 3.除本承诺人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》所述情形外，保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与兆易创新主营业务直接相竞争的业务。 本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预兆易创新的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证兆易创新在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。 除非本承诺人不再作为兆易创新的控股股东及实际控制人，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给兆易创新及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。
关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	控股股东及实际控制人朱一明	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，本人作为兆易创新的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺： 在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
	上市公司董事、高级管理人员	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次交易若发生摊薄即期回报情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施制定了《北京兆易创新科技股份有限公司关于发行股份

承诺事项	承诺方	承诺内容
		及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》。作为公司董事/高级管理人员，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，本人对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺： 1. 本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益； 2. 本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束； 3. 本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4. 本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）； 5. 本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务

上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《重组管理办法》等相关法律、法规的规定对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，上市公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本

报告书在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易聘请国泰君安作为上市公司独立财务顾问出具独立财务顾问报告，聘请金杜律师出具法律意见书，聘请具有证券业务资格的中联评估进行评估并出具相关报告，聘请具有证券业务资格的中兴华会计师进行审计并出具相关报告。根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（三）网络投票安排

公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，以充分保护中小股东行使股东权利。在本次重组完成后，公司将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立性的原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作。

（四）资产定价公允性

标的资产北京矽成 100%股权于 2016 年 9 月 30 日的评估值为 580,858.47 万元，与标的资产归属于母公司所有者权益的账面值为 527,046.21 万元相比，增值率为 10.21%。经交易双方友好协商，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，交易价格确定为 650,000.00 万元。交易各方以标的资产最终的评估值作为确定标的资产交易价格的依据，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，资产作价公允、合理，不会损害上市公司及全体股东的利益。

（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、备考审阅报告反映的每股收益变化情况

根据中兴华会计师出具的上市公司备考审阅报告，假设兆易创新于 2015 年

年初已完成本次重组，本次交易对兆易创新的每股收益影响情况如下：

项目	2016 年		2015 年	
	交易前	交易后	交易前	交易后
每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89
稀释每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89

注：每股收益计算中不考虑配套募集资金发行股份的影响。分子为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分母为加权平均股本数。

2015 年，本次交易完成前后的每股收益指标基本保持不变。2016 年，随着标的公司主营业务收入的增长以及期间费用率的同比下降，在人民币汇率贬值的放大效应下，本次交易完成后上市公司的每股收益指标较本次交易前以及 2015 年同比均得到较大提升。

2、本次重组对上市公司预期每股收益的影响

本次重大资产重组中，上市公司发行股份购买资产拟向上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威发行股份数量为 31,284,816 股，不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本规模将由目前的 100,000,000 股增加至 131,284,816 股。

基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本次重大资产重组在 2017 年完成）主要财务指标，关于测算过程的主要假设说明如下：

（1）以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（2）假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），本次重大资产重组最终完成时间以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）假设宏观经济环境、集成电路芯片行业的情况没有发生重大不利变化；

（4）不考虑配套融资发行股份的数量，假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为 31,284,816 股，未扣除本次重组相关的发行及中介费用的影响；

（5）根据北京矽成未来经营期的净现金流量的预测结果表，标的公司 2017 年预测净利润为 3,378.11 万美元，按照评估基准日（2016 年 9 月 30 日）人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币 22,558.35 万元。假设以该预测净利润作为标的公司 2017 年扣非后净利润指标进行测算；

（6）根据上市公司 2016 年度报告财务数据，假设上市公司 2017 年度经营业绩与 2016 年度的实际经营数据相同；上述测算不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

（7）假设 2016 年、2017 年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

（8）公司经营环境未发生重大不利变化；

（9）不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响。

经测算，公司本次重大资产重组前后每股收益指标具体影响如下：

项目	2016 年	2017 年	
		重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)
发行在外的普通股加权平均数 (万股)	8,333.33	10,000.00	11,564.24
扣除非经常性损益后归属于母 公司净利润(单位: 万元)	15,073.94	15,073.94	26,353.11
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(单位: 元/股)	1.81	1.51	2.28
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益(单位: 元/股)	1.81	1.51	2.28

基于上述假定，2017 年上市公司重组完成前扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2016 年减少 0.30 元/股，主要系上市公司于 2016 年 8 月完成首次公开发行股票并上市，IPO 完成后上市公司 2016 年末的股本由年初的 7,500 万股增加至 10,000 万股导致 2016 年发行在外的普通股加权平均数较小所致。

本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较发行前增长 11,279.18 万元，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后的每股收益为 2.28 元/股，较 2017 年重组完成前的每股收益增加 0.77 元/股，增幅达 51.18%，重组后上市公司盈利能力将显

著增强。

综上，本次交易完成后，不存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

3、上市公司填补摊薄即期回报并增强公司持续回报能力的具体措施

在前述假设条件下，本次重大资产重组不会摊薄上市公司即期回报。若因经营环境等的变化导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

（1）加强收购整合，提升盈利能力

本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司对标的资产的整合，力争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。上市公司将帮助标的企业尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。

（2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

（3）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公

公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

（4）加强募集资金的管理和运用

本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合独立财务顾问和保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

4、公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司本次重组关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（1）全体董事、高级管理人员承诺

本次重大资产重组完成后，全体公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1. 本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；

2. 本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；

3. 本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4. 本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

5. 本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。”

（2）公司控股股东、实际控制人承诺

公司的控股股东和实际控制人朱一明先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

十、独立财务顾问的保荐人资格

本公司聘请国泰君安证券担任本次交易的独立财务顾问，国泰君安证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）除本次重大资产重组所涉及的行政审批不确定性外，本报告书根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出特别说明。提醒投资者认真阅读本报告书第十二章披露的风险提示内容，注意投资风险。

（二）公司提示投资者应到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本次重大资产重组报告书（草案）的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价公司本次重大资产重组交易时，除本报告书提供的其它各项资料外，还应特别关注下述各项风险因素。

一、本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括兆易创新股东大会审议通过本次交易方案；中国证监会核准本次交易事项；通过 CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会审查等。其中，CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会审查为本次交易交割的前提条件。

截至本报告书出具日，上述审批事项尚未完成。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意本次交易的审批风险。

（二）交易的终止风险

公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止本次交易的风险。

2017 年 2 月 13 日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威以及北京矽成签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议有效期限自签署之日起 10 个月届满，除非各方协商一致同意延长前述期限。

此外，如有权监管机构对协议的内容和履行提出异议从而导致协议的重要原则条款无法得以履行以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则经各方书面协商一致后发行股份及支付现金购买资产协议可以终止或解除。在本次交易过程中，交易各方可能需根据中国证监会等监管机构的要求不断完善交易

方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

综上，提请投资者注意本次交易可能终止的风险。

（三）上市公司股票停牌前价格波动异常的风险

根据中国证监会 128 号文第五条规定，公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证电子指数（代码：950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）波动情况进行了自查比较。公司 A 股股票股价在上述期间内上涨幅度为 431.41%，扣除上证电子指数下跌 3.53% 因素后，波动幅度为 434.94%；扣除上证综指下跌 3.26% 因素后，波动幅度为 434.67%。综上，剔除大盘因素后，公司股价在公司因本次重大资产重组事宜停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%，达到 128 号文第五条的相关标准。

本次交易进程中，公司已采取了相关保密措施，同时根据本次重组相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在买卖公司股票的情况的自查范围内人员已出具声明和承诺，不涉及内幕交易、市场操纵等禁止交易行为（详情参见“第十三章 其他重要事项”之“六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况”）。

根据 128 号文的规定，中国证监会可能会对公司重组停牌前的股价波动进行调查，调查期间将暂缓审核公司的行政许可申请。因此，公司本次交易能否按正常进度审核、以及能否通过审核，均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

（四）标的公司业绩承诺不能达标的风险

根据上市公司与业绩承诺方上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。

经上市公司与业绩承诺方协商一致，标的公司业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为实际净利润数。在计算实际利

润数时，不考虑：1、标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；2、标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

在标的公司业绩承诺期的每一年度《专项审核报告》出具后，若标的资产在盈利补偿期间内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数低于承诺净利润累计数的 90%，业绩承诺方应对上市公司进行补偿。

上述业绩承诺系业绩承诺方基于标的公司目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。因此本次交易存在承诺期内标的公司实现的实际净利润达不到承诺净利润的风险。

（五）业绩补偿不足的风险

根据上市公司与本次交易业绩承诺方上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，双方约定若标的公司在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数达到承诺净利润累计数的 90%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿。同时，在计算标的公司在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数时，不考虑：1、标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；2、标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

此外，在充分考虑业绩承诺方对标的公司未来经营的作用、未来承担的业绩补偿责任和风险、标的公司对上市公司的战略意义等因素的基础上，上市公司与业绩承诺方约定了业绩补偿的最高限额，即业绩承诺方业绩补偿总额以标的资产交易作价的 50%为限，如有超出部分，业绩承诺方无需进一步补偿。若标的公司在承诺期间累计实现的净利润低于承诺净利润数的 90%，则各业绩承诺方在向上市公司支付其最高限额的补偿后，无须再对上市公司进行额外的股票或现金补偿。

提请投资者关注相关业绩补偿不足的风险。

（六）收购整合风险

在发展过程中，上市公司已建立了高效的管理体系和经营管理团队。本次交易完成后，公司的资产、业务规模和范围都将有较大幅度的增长，企业规模增长对企业经营管理提出更高的要求。

本次收购属于对同行业优质资产的整合，上市公司对于标的公司所处行业的特点和发展规律有深入了解，积累了大量发展经验。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，上市公司与标的公司仍需在企业文化、团队管理、销售渠道、客户资源等方面进行进一步的融合。但是，本次交易完成后，上市公司能否对标的公司实施有效整合，以及本次交易能否充分发挥协同效应，均存在不确定性，进而可能影响本次收购的最终效果。

本次交易完成后，标的公司北京矽成在管理经营、销售扩展、产品研发领域等个方面将继续保持其独立性，现有的管理团队、销售组织架构、研发技术人员将不会因本次重组而发生变化。鉴于标的公司在经历前次私有化收购后，经营业绩仍保持稳健增长的良好态势，同时继续保持与原主要客户之间的稳定合作关系和紧密联系，未影响消费者的购买意向。本次重组因受标的公司被上市公司收购的影响而导致客户购买意向降低的可能性较小。但是，考虑到标的公司的主要经营活动在美国和台湾等境外地区开展，主要客户亦广泛分布于欧美及亚太地区，不排除本次收购本次交易会影响部分客户消费意向，从而导致对标的公司未来经营业绩产生不利影响的可能性，提请投资者关注相关风险。

（七）募集配套资金未能实施或者募集金额低于预期的风险

本次交易中，本公司拟向名建致真等不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 183,000.00 万元，其中 154,761.00 万元用于支付标的资产现金对价，20,000.00 万元用于 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目的建设，剩余募集配套资金用于支付本次交易相关的中介费用。

受标的资产经营情况、财务状况变化、监管机构政策以及资本市场影响，若本次募集配套资金金额不足乃至募集失败，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决本次收购交易标的的现金对价、本次交易相关的中介费

用及拟筹建项目所需资金需求。若公司以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式筹集所需资金，将给公司带来一定的财务风险和融资风险，提请投资者注意相关风险。

（八）商誉减值风险

本次交易属于非同一控制下的企业合并，上市公司对本次合并成本与评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。本次交易，标的公司的交易作价为 650,000.00 万元，相较于北京矽成截至 2016 年末归属于母公司股东权益增加 101,853.43 万元。考虑标的公司因前次收购 ISSI 100%股权产生商誉 239,950.02 万元。本次交易完成后，上市公司因本次交易导致合并资产负债表中商誉新增金额较高，达 341,803.44 万元。

根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失，进而对公司未来利润产生不利影响，提请广大投资者注意。

（九）本次交易后上市公司每股收益摊薄的风险

本次交易完成后，上市公司最近一期备考报表的每股收益均较交易前的每股收益指标得到增厚。如本报告书重大事项提示之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”中所测算，本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后的每股收益为 2.28 元/股，较 2017 年重组完成前的每股收益增加 0.77 元/股，增幅达 51.18%，重组后上市公司盈利能力将显著增强。交易完成后，不存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

但是，鉴于前述测算的假设条件依赖于对上市公司和标的公司所处行业的发展前景及自身经营状况的判断，存在实际实现的盈利水平与假设条件存在较大差异的可能性，且本次重组的最终完成时间也存在不确定性，因此本次重大资产重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险。提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

（十）上市公司净资产收益率面临被摊薄的风险

本次交易完成前，上市公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的加权平均净资产收益率分别为 25.78%、31.92%和 21.18%。因为上市公司报告期各期末的净资产规模相对较小，所以净资产收益率水平保持较高水平。本次交易完成后，上市公司的净资产将在现有基础上出现较大幅度的增加。虽然标的公司的盈利能力较强，本次交易完成后上市公司的盈利能力将显著提升。但是因为标的公司的净资产规模较大，报告期内标的公司的净资产收益率低于上市公司的水平。

本次交易完成后，若上市公司经营业绩未能有与净资产规模同等幅度的增长，未来一定期间内上市公司的净资产收益率将面临被摊薄的风险，提请投资者注意。

二、标的资产相关风险

（一）行业周期性风险

标的公司北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片的研发和销售，属于集成电路产业的上游环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。全球范围内，集成电路产业规模一直保持稳步增长趋势，随着新的技术进步导致旧技术产品逐渐淘汰，作为集成电路行业不断地追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，以此产生了集成电路行业特有的周期性波动特点，且行业周期性波动频率要较经济周期更为频繁，在经济周期的上行或下行过程中，都可能出现相反的集成电路产业周期。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则标的公司的经营业绩可能受到负面影响，提请投资者注意行业周期性波动的风险。

（二）人才流失风险

标的公司北京矽成作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成标的公司拥有行业领先地位的重要保障。目前，北京矽成拥有高素质的稳定管理设计团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素，本次交易方案向标的公司管理团队和核心技术人员提供了较为合

适的激励机制，然而随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，若没有跟进相适应的激励机制，则管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面可能出现下降，或产生人员流失、经营运作不利、盈利水平下滑等不利影响，提请投资者注意相关风险。

截至本报告书出具日，相关方尚未就标的公司核心技术人员长期服务的履约期限形成具体安排，该事项将在本次交易获得中国证监会审批通过、本次交易具体实施之前确定。若届时无法及时明确上述安排，则本次交易完成后，标的公司及其下属企业核心技术人员将没有明确履约期限，上市公司可能面临核心技术人员流失风险。提请投资者注意相关风险。

（三）供应商风险

标的公司北京矽成采用 Fabless 模式，即无晶圆生产线集成电路设计模式，作为集成电路设计领域内通常采用的经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中，由供应商的供货所产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障标的公司的采购需求，存在不确定的风险。同时随着行业中晶圆代工厂和封装测试厂在不同产品中产能的切换，以及产线的升级，或带来的标的公司采购单价的变动，若代工服务的采购单价上升，会对标的公司的毛利率造成下滑的影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件，也会影响晶圆代工和封装测试厂向标的公司的正常供货。提请投资者注意相关风险。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。我国政府目前已通过一系列法律法规及产业政

策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，陆续颁布了一系列法律法规及政策，拟从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业企业的发展。2015 年颁布的《中国制造 2025》中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点支持的领域。政府对集成电路产业的支持政策为我国各类型的高新科技集成电路企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响。提请投资者注意相关风险。

（五）标的公司股权及资产质押风险

截至本报告书出具日，上海承裕、华创芯原所持有的标的公司股权存在质押情形，具体为上海承裕持有的 43.173% 标的公司股权中 39.087% 的股权质押予亦庄国投，华创芯原持有的标的公司 15.034% 股权，全部质押予亦庄国投。上海承裕和华创芯原已分别作出承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除相应质押，确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。亦庄国投亦出具《关于解除标的资产质押的说明与承诺函》，承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。

因亦庄国投为上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原私有化收购 ISSI 交易的并购贷款提供连带责任保证，北京矽成将上海闪胜 100% 股权质押予亦庄国投以提供反担保。截至本报告书出具日，上述股权质押尚未解除。根据北京矽成的说明，其承诺于本次交易申报文件提交中国证监会前解除前述股权质押。

在上海承裕、华创芯原与亦庄国投相关方协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，上述股权及资产质押不会对本次重组的实施构成障碍。但如出质人与质权人无法就解除质押事宜协商一致，或相关方未能正常履行相关承诺，则上述质押存在无法及时解除的风险。

（六）标的资产的估值风险

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元，截至本次评估基准日 2016 年 9 月 30 日的北京矽成归属于母公司净资产账面值 527,046.21 万元，评估增值 53,812.26 万元，增值率 10.21%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照估值的相关规定，勤勉、尽责，但由于评估和估值工作是基于一定的假设前提，如未来情况较预期发生较大变化，可能存在资产估值与实际情况不符的风险。此外，预估值可能与最终评估或估值结果存在一定差异，本次交易标的资产最终作价也将以评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，经交易双方协商确定。提请投资者注意相关估值风险。

（七）标的资产交易定价较评估值存在溢价的风险

本次交易中，拟购买资产的交易价格以中联评估采用收益法对标的公司进行评估的评估值为依据，由交易各方协商确定。根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元，而交易对方最终协商确定标的资产的交易价格为 650,000.00 万元，相比收益法评估后的 100%股权价值 580,858.47 万元溢价 69,141.53 万元，增值率 11.90%。

本次交易作价相较于评估值存在溢价，系交易双方综合考虑了本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，具体考虑如下：

1、汇率变动

北京矽成 100%股权按照收益法评估的归属于母公司股东权益价值为 86,983.51 万美元，按照本次评估基准日 2016 年 9 月 30 日人民币的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日被评估企业股东权益价值为 580,858.47 万人民币。

2、协同效应

兆易创新和北京矽成同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售区域、销售客户、技术研发等多方面都有较强的协同效应。通过本次重组，上市公司将快速由单一的 Flash 产品提供商转变为 DRAM 和 SRAM 以及 Flash 全品类存储芯片提供商，销售区域扩充至欧美、亚太等全球主要国家和地区。

就上市公司层面，在产品销售协同方面，本次重组将优化上市公司的销售渠道及客户结构。整合后，凭借上市公司和标的公司在不同行业领域的市场优势，上市公司的 FLASH 类非易失性存储芯片产品中包括了 Serial NOR Flash、Serial NAND Flash、SLC (ONFi) NAND、eMMC5.1 等优势产品，将通过北京矽成已建立的客户群体获得在专用领域的市场开拓机会和收入增长，为产品的市场占有率提供更大的提升空间。

在销售费用协同方面，上市公司原有产品销售业务覆盖范围主要以国内消费电子市场为主，重组后，上市公司可以共享北京矽成凭借多年来在全球存储芯片市场不断的开拓下积累的全球销售网络，在海外销售网络获得高速、有效的和海外客户对接的机会。同时销售渠道整合共享后，上市公司在海外聘请销售人员、开拓销售渠道的费用将会得到一定程度的降低。

就本次交易对上市公司产品销售和销售费用的协同效应，以及对标的公司的负协同效应，中联评估出具了《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司股权所涉及的协同效应估值报告》（中联评咨字[2017]第 494 号）。根据该报告，北京兆易创新科技股份有限公司与北京矽成半导体有限公司于 2016 年 9 月 30 日估值基准日时点可辨认的协同效应投资价值的估值区间为 24,037.35 万元~54,425.49 万元。

本次交易标的资产作价相对评估值的溢价综合考虑了本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响。但是，该等协同效应投资价值能否顺利体现并覆盖本次交易的相应溢价存在不确定性，提请投资者充分关注由此带来的风险。

（八）外汇风险

标的公司下属实际经营主体大多注册在境外，主要经营活动也在境外开展，日常经营活动中涉及美元、台币、欧元等外币，而且境外的子公司根据其经营所处的主要经济环境以其本国货币作为记账本位币。一方面，各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给标的公司未来运营带来汇兑风险；另一方面，随着人民币日趋国际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对美元等货币的汇率变化将导致标的公司及上市公司合并财务报表的外币折算风险。

（九）标的公司编制备考财务报表相关风险

本次交易前，北京矽成作为投资性主体，除持有上海闪胜及其下属子公司的股权外，自身未开展经营活动。2015年12月7日，标的公司通过下属全资子公司闪胜科技收购了ISSI全部已发行股票，并开始将其纳入合并财务报表，本次收购前后北京矽成的主要资产负债、利润构成均发生了重大变化。因此，标的公司假设北京矽成及其下属子公司上海闪胜和闪胜科技等均已于2014年1月1日设立完成并完成了对ISSI的全资收购，在此基础上编制了标的公司备考财务报告。

鉴于标的公司的备考合并财务报表，并非北京矽成实际经营情况的反映，如2015年度北京矽成实际仅承担2015年12月开始合并ISSI财务报表之后的经营业绩。此外，由于备考合并财务报表的编制基础具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，也未完全真实反映收购ISSI已于2014年1月1日完成的情况下标的公司于2016年12月31日和2015年12月31日及2014年12月31日的合并财务状况以及2014至2016年度的合并经营成果，提请广大投资者注意。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策的调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易相关的内外部审批工作尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出

现波动，从而给投资者带来一定的风险。公司提醒投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

（二）其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

公司声明	1
交易对方声明	2
相关证券服务机构声明	4
重大事项提示	5
一、本次交易方案概述	5
二、本次交易的合规情况	7
三、支付方式以及募集配套资金安排	11
四、标的资产的评估情况及相关盈利承诺	18
五、本次交易对上市公司的影响	24
六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序	28
七、公司股票停牌前股价存在异常波动的说明	29
八、本次交易相关方作出的重要承诺	30
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	42
十、独立财务顾问的保荐人资格	48
十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项	48
重大风险提示	50
一、本次交易相关的风险	50
二、标的资产相关风险	55
三、其他风险	60
目 录.....	62
释 义.....	67
一、一般释义	67
二、专业释义	71
第一章 本次交易概况	73
一、本次交易的背景	73
二、本次交易的目的	77
三、本次交易方案	79
四、本次交易构成重大资产重组	87

五、本次交易不构成重组上市	88
六、本次交易构成关联交易	90
七、本次交易对上市公司的影响	90
八、本次交易的报批事项	94
第二章 上市公司基本情况	96
一、上市公司基本情况	96
二、历史沿革及股本变动情况	96
三、最近三年控制权变动情况	99
四、重大资产重组情况	99
五、主营业务发展情况	99
六、主要财务数据及财务指标	99
七、上市公司控股股东和实际控制人情况	100
八、最近三年合法合规情况	102
第三章 交易对方基本情况	103
一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况	103
二、发行股份募集配套资金之交易对方概况	143
三、交易对方之间的关联关系	145
四、交易对方与上市公司关联关系情况	147
五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况	147
六、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明	148
七、交易对方及其主要管理人员诚信情况	148
八、交易对方穿透情况	148
第四章 标的资产情况	150
一、标的公司基本情况	150
二、标的公司的主营业务发展情况	198
三、标的公司主要会计政策及相关会计处理	228
四、标的公司主要财务指标以及非经常性损益的构成情况	233
第五章 标的资产评估情况	236
一、北京矽成 100%股权评估的基本情况	236

二、收益法评估具体情况	238
三、市场法评估具体情况	256
四、董事会对本次交易标的资产评估的合理性及定价的公允性分析	261
五、独立董事对本次交易评估相关事项的独立意见	273
第六章 发行股份情况	275
一、发行股份购买资产并募集配套资金具体情况	275
二、本次发行股份募集配套资金情况说明	280
三、上市公司发行股份前后主要财务数据	297
四、本次发行股份前后上市公司的股权结构	298
第七章 本次交易主要合同	299
一、发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议	299
二、盈利补偿协议及其补充协议	310
三、股份认购协议及其补充协议	314
第八章 交易的合规性分析	318
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定	318
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定	322
三、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形	326
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定	326
第九章 管理层讨论与分析	328
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	328
二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析	336
三、交易标的最近三年的财务状况分析	365
四、标的公司盈利能力分析	382
五、标的公司现金流量分析	407
六、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务相关指标的影响分析	410
第十章 财务会计信息	430
一、北京矽成最近三年合并备考财务报告	430
二、上市公司备考合并财务报告	433

三、ISSI 最近三年财务数据	436
第十一章 同业竞争与关联交易	444
一、报告期内交易标的关联交易情况	444
二、本次交易构成关联交易	447
三、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争情况	448
四、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况	448
五、本次交易完成后，规范关联交易及避免同业竞争的措施	449
第十二章 风险因素	453
一、本次交易相关的风险	453
二、标的资产相关风险	458
三、其他风险	463
第十三章 其他重要事项	464
一、交易完成后上市公司资金、资产占用与担保情况	464
二、上市公司负债情况	464
三、上市公司最近十二个月内资产交易情况	464
四、本次交易对上市公司治理机制的影响	464
五、公司停牌前股价存在异常波动的说明	464
六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况	466
七、利润分配政策与股东回报计划	468
八、关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明	472
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	473
第十四章 本次交易的有关中介机构情况	480
一、独立财务顾问	480
二、法律顾问	480
三、审计机构	480
四、评估机构	481
第十五章 本次交易相关各方的声明	482

一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明	482
二、独立财务顾问声明	483
三、法律顾问声明	484
四、审计机构声明	485
五、评估机构声明	486
第十六章 备查文件及备查地点	487
一、备查文件	487
二、备查地点	488

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

兆易创新、本公司、上市公司、公司	指	北京兆易创新科技股份有限公司
交易标的、标的公司、北京矽成	指	北京矽成半导体有限公司
标的资产	指	北京矽成半导体有限公司 100%股权
发行股份及支付现金购买资产、本次购买	指	兆易创新向北京矽成全体股东发行股份及支付现金购买其持有的北京矽成 100%的股权
发行股份募集配套资金、募集配套资金、配套融资	指	兆易创新向名建致真等不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次重大资产重组、本次交易	指	上述的发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产之交易对方	指	北京矽成全体股东，即上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威
发行股份募集配套资金之交易对方	指	名建致真等不超过 10 名特定投资者
交易对方	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之交易对方
业绩承诺方	指	上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯
控股股东、实际控制人	指	朱一明
香港赢富得	指	InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）
友容恒通	指	北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）
万顺通合	指	北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）
常州新能聚	指	常州新能聚实业投资有限公司
中晶投资	指	中晶投资管理（上海）有限公司
立而鼎科技	指	立而鼎科技（深圳）有限公司
硅格半导体	指	深圳市硅格半导体股份有限公司
忆正科技	指	忆正科技（武汉）有限公司
Everspin Technologies	指	Everspin Technologies, Inc
上海承裕	指	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙），为北京矽成股东
屹唐投资	指	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙），为北京矽成股东
华创芯原	指	北京华创芯原科技有限公司，为北京矽成股东
民和志威	指	烟台民和志威投资中心（有限合伙），为北京矽成股东
闪胜创芯	指	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙），为北京矽成股东

华清闪胜	指	北京华清闪胜科技有限公司，为北京矽成原股东
承裕投资	指	上海承裕投资管理有限公司
武岳峰浦江	指	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）
武岳峰集成电路	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
仟品投资	指	仟品（上海）股权投资管理有限公司
兴南科技	指	北京兴南科技产业投资中心（有限合伙），为屹唐投资曾用名
亦庄国投	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
屹唐国际	指	屹唐（北京）国际投资管理有限公司
亦庄产投	指	北京亦庄国际产业投资管理有限公司
战新基金	指	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
北京经开区国资办、经开区国资办	指	北京经济技术开发区国有资产管理办公室
移动硅谷	指	北京亦庄移动硅谷有限公司
北京集成电路投资中心	指	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）
华清豪威	指	北京华清豪威科技有限公司
海淀园创业服务中心	指	中关村科技园区海淀园创业服务中心
紫光通信	指	北京紫光通信科技集团有限公司
紫荆华融	指	北京紫荆华融股权投资有限公司
集成电路产投	指	北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司
中芯晶圆	指	中芯晶圆股权投资（上海）有限公司
清芯华创	指	北京清芯华创投资管理有限公司
民和德元	指	烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）
青岛金控	指	青岛城投金控股股权投资管理有限公司
青岛海丝	指	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）
拉萨民和	指	拉萨民和投资管理有限公司
联发科软件	指	联发科软件（上海）有限公司
联发软件设计	指	联发软件设计（深圳）有限公司
晨思电子	指	上海晨思电子科技有限公司
名建致真	指	杭州名建致真投资管理有限公司
北京闪胜	指	北京闪胜投资有限公司，为北京矽成原名
上海闪胜	指	上海闪胜集成电路有限公司
闪胜科技	指	Uphill Technology Inc.
ISSI、芯成半导体	指	Integrated Silicon Solution, Inc.
ISSI Cayman	指	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.

Si En Cayman	指	Si En Integration Holdings Limited
ISSI SH	指	芯成半导体（上海）有限公司
ICSI TW	指	硅成集成电路股份有限公司，Integrated Circuit Solution Inc.
Chingis	指	常忆科技股份有限公司，Chingis Technology Corporation
Apex Achieve	指	Apex Achieve International Limited
Offshore Incorporations	指	Offshore Incorporations (Cayman) Limited
Active Minds	指	Active Minds International Limited
Analog Circuit	指	Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.
兆易有限	指	北京兆易创新科技有限公司
外滩科技	指	深圳市外滩科技开发有限公司，兆易创新全资控股子公司
GSI	指	GSI Technology, Inc.
UMI	指	United Memories, Inc.
Longitude	指	Longitude Licensing Limited
赛普拉斯	指	Cypress Semiconductor
三星	指	Samsung Electronics
海力士	指	SK hynix
美光	指	美光科技有限公司
华邦电子	指	华邦电子股份有限公司
南亚科技	指	南亚科技股份有限公司
南亚塑胶	指	南亚塑胶公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
力晶科技	指	力晶科技股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
税务总局	指	国家税务总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
前次收购、私有化收购	指	2015 年 12 月 7 日，北京矽成通过全资子公司以每股 23 美元的价格完成对 ISSI 全部已发行股票的收购并交割完成
CFIUS	指	Committee on Foreign Investment in the United States 美国外资投资委员会
台湾投审会	指	台湾地区经济部投资审议委员会
预案、《预案（修订稿）》	指	《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

本报告书、《报告书（草案）》	指	《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	兆易创新与交易对方于 2017 年 2 月 13 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》或《补充协议》	指	兆易创新与交易对方于 2017 年 2 月 24 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》或《补充协议二》	指	兆易创新与交易对方于 2017 年 4 月 17 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》
《盈利补偿协议》	指	兆易创新与业绩承诺方于 2017 年 2 月 13 日签署的《盈利补偿协议》
《盈利补偿协议之补充协议》	指	兆易创新与业绩承诺方于 2017 年 4 月 17 日签署的《盈利补偿协议之补充协议》
《审计报告》	指	《北京矽成半导体有限公司 2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度备考合并财务报表审计报告》和《北京矽成半导体有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审计报告》
《审阅报告》	指	《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告》
业绩承诺期	指	2017 年度、2018 年度和 2019 年度
承诺净利润数/承诺利润数	指	业绩承诺方承诺标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元
实际净利润累计数	指	业绩承诺期内各年度实际净利润数的累计数
承诺净利润累计数	指	业绩承诺期内各年度承诺净利润数的累计数
评估基准日	指	2016 年 9 月 30 日
交割日	指	《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的有关资产交割的先决条件全部得到满足后，各方协商确定的日期
过渡期间	指	自评估基准日 2016 年 9 月 30 日（不含基准日当日）至资产交割日（含交割日当日）
最近三年、报告期	指	2014 年、2015 年及 2016 年
最近两年	指	2015 年及 2016 年
PPA	指	purchase price allocation，指会计准则规定的非同一控制下企业合并成本在取得的可辨认资产、负债和或有负债之间的分配
US GAAP	指	美国会计准则，Generally Accepted Accounting Principles
IPO	指	首次公开发行股票
国泰君安、独立财务顾问、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
金杜律师、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
中联评估、评估机构	指	中联资产评估集团有限公司
中兴华会计师、会计师、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算公司、中登公司	指	中国登记结算有限责任公司上海分公司
纳斯达克	指	纳斯达克全国市场(NASDAQ National Market)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《北京兆易创新科技股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
128 号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文）
招股书	指	《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
元/万元/亿元	指	元/万元/亿元人民币

二、专业释义

集成电路	指	一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的电路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
Fabless 模式	指	无晶圆生产线集成电路设计模式。指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器芯片
SRAM	指	Static Random Access Memory，即静态随机存取存储器芯片
FLASH	指	FLASH Memory，一般简称 FLASH，即闪存芯片
ANALOG	指	Analog Chip，即集成电路模拟芯片
EDO/FP DRAM	指	传统 DRAM
SDR SDRAM	指	同步动态随机存储器
DDR SDRAM	指	双倍速率同步动态随机存储器

DDR2 SDRAM	指	双倍速率二代同步动态随机存储器
DDR3 SDRAM	指	双倍速率三代同步动态随机存储器
DDR4 SDRAM	指	双倍速率四代同步动态随机存储器
mSDR SDRAM	指	移动型同步动态随机存储器
mDDR SDRAM	指	移动型双倍速率动态随机存储器
LPDDR2 SDRAM	指	低功耗双倍速率二代同步动态随机存储器
Asynch SRAM	指	异步静态随机存储器
Pseudo SRAM	指	假静态随机存储器
HyperRAM	指	高速自刷新动态随机存储器
Synch SRAM	指	同步静态随机存储器
QUAD/QUADP	指	四倍数据速率静态随机存取存储器
DDR-II/DDR-IIP	指	双倍速率双倍同步静态随机存储器
RLDRAM2	指	降低延迟二代动态随机存储器
RLDRAM3	指	降低延迟三代动态随机存储器
NOR FLASH	指	代码型闪存芯片
NAND FLASH	指	数据型闪存芯片
Serial NOR FLASH	指	序列式 NOR FLASH
Parallel NOR FLASH	指	并列式 NOR FLASH
HyperFLASH	指	高速闪存
Pfusion Embedded	指	嵌入式闪存
LED	指	发光二极管
LED Drivers	指	LED 驱动芯片
Amplifier/Headphone Driver	指	功放驱动芯片
Sensor	指	传感芯片
RCL	指	汽车后组合灯
CHMSL	指	汽车中央高位刹车灯
Backlog	指	在手订单
ADAS	指	高级驾驶辅助系统

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）我国集成电路产业发展迅速

集成电路产业作为信息技术产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。

国家高度重视集成电路产业的发展，自 2000 年以来，相继出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《集成电路产业“十二五”发展规划》、《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策文件，从政策、资金等方面大力扶持国内集成电路产业，推动国内集成电路产业的快速发展。

在市场推动和政策支持下，近年来我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2015 年销售规模达到 3,609.81 亿元，受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及智能手机等消费电子产品的普及，2013 年至 2015 年行业销售规模增速为 19.72%、20.20%、16.21%，行业市场增速明显高于全球水平。

（二）新形势下，我国集成电路产业发展既面临巨大的挑战，也迎来难得的机遇

虽然我国集成电路产业从发展初期至今已经取得了较大进步，但是产业中仍然存在持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求脱节等突出问题，产业发展水平与先进国家和地区相比依然存在较大差距。同时在高端集成电路产品领域，对进口依赖程度仍旧较高，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有

力支撑。我国集成电路产业发展正面临巨大的挑战。

当前，全球集成电路产业正面临先进制程技术节点的突破瓶颈，以及长期大额投入后对利润回报的考验，整体产业正进入阶段性调整变革时期。一方面，全球市场格局处于加快调整，龙头企业投资规模继续攀升，市场份额加速向优势企业集中。另一方面，随着移动智能终端及芯片呈现的爆发式增长，以及云计算、物联网、大数据等新业态进入成长期，面对我国坐拥的全球规模最大的集成电路产品需求，整体市场规模将在未来继续保持快速增长。这一新形势下，我国集成电路产业迎来了难得的发展机遇。

（三）存储芯片是信息系统的基础核心芯片，是我国集成电路产业重点发展的方向之一

存储芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品类型之一，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺。

根据万得数据显示，2016 年，全球存储芯片销售额为 711.09 亿美元，占全球芯片总销售额 25.90%，随着现代信息科技化社会数据存储需求的进一步提升，包括产品更替（例如：移动终端、汽车电子产品等）速度的加快，和新兴市场（例如：云计算、大数据、物联网等新业态）的蓬勃发展，预计未来占比将进一步提升。

存储芯片市场规模巨大，广泛应用于国民生活的方方面面，也对国防军工、工业商业有重要意义，是不可或缺的基础元器件之一。《中国制造 2025》中也明确提出，自主化生产先进存储芯片、大容量存储芯片是未来中国大力发展集成电路的关键方向之一。

就我国而言，自 2013 年以来，每年集成电路已经超过石油成为我国进口金额最大进口产品，而存储芯片是我国集成电路四大产品类型中自给率最低的部分，是我国进口金额最大的集成电路产品。一方面，我国存储芯片的设计、制造整体上相对世界先进水平存在较大差距。另一方面，我国国产存储芯片市场替代空间巨大，存储芯片设计、制造企业面临良好的市场机遇。在存储芯片制造领域，近年我国相继启动了长江存储等国家重点项目，力求尽快缩小与世界先进水平的差距。在存储芯片设计领域，NOR FLASH 领域涌现出以兆易创新为首的具有优

秀设计能力的企业，但在整体层面，以及 DRAM、SRAM 等细分领域，仍缺乏具有国际影响力的企业。为了填补国内空白，推进资源整合、培育具有国际竞争力的存储芯片设计大型企业是我国集成电路产业跻身世界先进水平梯队的重要标志。

（四）兆易创新是国内 FLASH 存储芯片设计领域龙头企业

兆易创新于 2012 年 12 月由兆易有限整体变更设立，于 2016 年 8 月 18 日在上交所首发上市。公司主营业务为 FLASH 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。产品广泛应用于手持移动终端、消费电子产品、物联网终端、个人电脑及周边、汽车工控等领域。公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业；根据半导体协会数据，2012 年以来，兆易创新已连续数年成为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业，也是最大的串行 NOR FLASH 设计企业。

在存储芯片产品按品种分类时，可以分为：DRAM、SRAM、NOR FLASH、NAND FLASH 等。其中 DRAM、NAND FLASH 和 SRAM 产品占据了目前全球存储芯片的绝大部分市场，NOR FLASH 产品市场规模趋稳而 NAND 产品由于技术更替正迎来加速成长期。

兆易创新在完成上市后，已迈上了一个新的发展平台。公司在持续现有业务的良好发展态势下，保持和扩大 NOR FLASH 设计领域的领先优势之余，进一步积极做大做强 NAND FLASH 研发设计业务，力争把握存储芯片国产化、工业智能化等因素带来的集成电路产业进一步跨越式快速发展的机遇，全面强化公司在国内外集成电路产业的布局。同时由于存储芯片市场历史悠久且竞争激烈，对于一家芯片设计企业的设计经验、工艺节点、供应链管理、成本控制和客户关系都很大的挑战，需要经历漫长的发展期才可以占据一定市场地位。兆易创新作为国内为数不多在全球存储芯片细分领域占据较高地位的 NOR FLASH 龙头企业，已经打好了坚实的发展基础。公司拟通过对行业内拥有存储研发技术积累和较强行业地位的优质资产进行并购重组等方式，进行有协同效应的产业收购和企业兼并，进一步加快产业优质资源的有效整合，实现自身业务的快速发展和国内存储芯片领域技术储备的快速提升。

（五）标的公司在全球 DRAM、SRAM 领域处于行业领先地位

北京矽成系一家注册于北京的有限责任公司，为控股型公司，自身尚未开展具体业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 成立于 1988 年 10 月，于 1995 年 2 月在美国纳斯达克上市，于 2015 年 12 月被北京矽成私有化收购并退市。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。

北京矽成及其下属公司的主营业务为集成电路存储芯片（及其衍生产品）的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售。集成电路存储芯片业务是标的公司最核心业务，报告期内占收入的比重超过 95%，主要产品包括各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH 存储芯片产品，其产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域。标的公司存储芯片产品在 DRAM、SRAM 领域保持全球领先地位，根据第三方机构 IHS 统计，2016 年上半年，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第八位，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际一流厂商一同处于行业领先地位。同时，北京矽成拥有一批优质客户，包括汽车领域的 Delphi、Valeo、TRW，工业领域的 Siemens、Schneider、Honeywell、GE、ABB 和三菱等，多年来关系稳定。

（六）上市公司与标的公司之间具有较强的协同效应

兆易创新和北京矽成同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售区域、销售客户、技术研发等多方面都有较强的协同效应。在产品方面，本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，从原本以 NOR FLASH 和 NAND FLASH 闪存为主的非易失性存储芯片产品结构扩充至涵盖了 DRAM、SRAM、NOR FLASH 和 NAND FLASH 等各类型易失性及非易失性存储芯片的全品类产品结构。在销售方面，本次重组将优化上市公司的销售渠道及客户结构，一方面，上市公司和标的公司在境内、境外拓展的经验和客户，有助于双方在优势行业领域的进一步发展；另一方面，可凭借上市公司和标的公司在不同行业领域的市场优势，打开 DRAM、SRAM 等易失性存储芯片在消费电子领域以及 FLASH 等非易失性存储芯片在专用领域的市场空间，为产品的市场占有率提供更大的提升空间，并在销

售渠道整合共享后，降低一定的销售成本。在技术研发方面，本次重组不仅为上市公司带来宝贵的 DRAM、SRAM 等专利技术，填补国内存储领域空白，同时在吸收富有多年研发经验的标的公司研发团队后，能进一步强化上市公司的存储芯片综合研发实力，在双方团队的配合下，为现有研发项目的费用投入带来压缩空间。

综合而言，本次重组中由上市公司和标的公司之间产生的协同效应将助力上市公司从国内领先、国际知名的闪存芯片供应商，快速迈入国际领先的全品类存储芯片供应商的行列，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。

二、本次交易的目的

（一）顺应国家产业整合思路，做大做强存储芯片产业

集成电路产业作为国民经济和社会发展的基础性和战略性产业，已经渗透到人民生活、经济生产和国防安全等的方方面面。我国集成电路行业 2015 年的销售规模已达 3,609.81 亿元人民币，自 2013 年至 2015 年三年行业的年化复合增长率为 19.96%，显著高于同一时期下全球行业 4.66% 的平均增速水平。集成电路产业的重心正逐步向亚洲，特别是中国大陆地区转移。中国大陆作为全球集成电路市场的主要增长地区，其产业在全球的地位将迎来快速的提升，在产业链日渐成熟的当下，我国集成电路产业的发展将迎来宝贵的机遇。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的思想，为了推动集成电路产业重点突破和整体提升，集成电路企业需要加强与境外研发机构的合作，加大针对海外优秀企业家和高素质技术、管理团队的引进力度，完善鼓励创新创造的分配激励机制，以此扩大国际合作、整合国际资源、拓展国际市场，实现我国集成电路产业的跨越式发展。

目前在国际集成电路产业产能饱和的当下，我国集成电路产业仍面临国内产能匮乏的现状，因此参考国际市场的规划和布局，我国集成电路产业拥有巨大的扩展空间。在我国产业扩张需求强烈之际，遵循产业整合思路进行的同行业之间的并购是最为快速有效的解决方式。首先，集成电路企业通过对外并购重组可以获得先进的研发技术、知识产权和专利以及经验丰富的技术和管理人员，从而获

得研发成本的降低和研发周期的缩短，提高自主创新能力。其次，对于企业的经营规模、行业地位、市场占有率，通过产业的并购可以得到大幅提升，发挥规模化效益，寻求利益最大化。

集成电路存储产业具有明显的阈值特征。全新的产品从设计到实现收入需要经历较长的研发周期及经验积累，以及繁复的质量认证，而由于行业显著的激烈竞争和规模效应，导致在收入达到一定规模前，较难为企业带来实际的盈利效果。因此，完全通过自主研发填补国内存储芯片领域的空白是一个漫长而挑战重重的道路。而通过同行业并购和产业整合，可以快速聚集已经具有盈利能力的先进技术和资源，提升企业竞争力，形成行业龙头的集聚效应。通过人才的汇集和产业联盟的形成，将可以加速存储产业的发展，做大做强我国整体集成电路存储产业。

（二）优化上市公司产品结构，强化上市公司行业地位

上市公司自成立以来，一直致力于集成电路闪存芯片及衍生产品的研发、技术支持和销售，在全球 NOR FLASH 市场位于行业前列。目前公司的产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、办公设备、汽车工控等领域。

上市公司一直积极贯彻国家存储芯片国产化战略，持续进行闪存芯片核心技术的研发，同时保持行业新兴堆叠闪存设计方向的关注与尝试。此外，凭借自身在非易失性存储领域的行业地位，充分发挥产品优势和地域优势，努力开拓客户市场以及适合自身产品的垂直领域市场，在消费电子、移动终端、物联网终端市场中赢得更多的市场份额。

标的公司主要经营的集成电路芯片产品中，以 DRAM、SRAM 等易失性存储芯片为主要核心产品。其产品在专用领域市场拥有较好的口碑，被广泛使用于汽车级和工业级应用领域，通过多年在汽车电子、工业制造和消费电子等领域的业务积累，积累了丰富的行业经验。作为拥有国际领先水平的存储芯片设计公司，同专用领域内的国际一流客户保持着良好的合作关系。

本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在产品类型、产品市场、客户结构、技术研发等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。通过本次交易，上市公司将快速成为国内第一家同时拥有主流易失性和非易失性存

储芯片核心研发、设计和销售能力的全品类存储芯片设计企业。在产品市场方面，本次交易将会进一步加强和丰富公司产品在从通用类的移动终端、个人电脑等消费电子市场领域到汽车电子、工业制造等专用领域的适用性，进一步开拓国内、海外的市场份额。在客户结构方面，本次交易将为公司带来更多和国际一流客户合作的机会，进一步成为世界范围内有影响力的存储芯片设计企业，强化公司在行业中的竞争优势。在技术研发方面，在吸收具有多年研发经验的北京矽成研发团队后，上市公司的存储芯片综合研发实力将进一步强化，上市公司将能更好地立足本土，着眼全球，开拓新兴的市场机会。

（三）提高上市公司盈利能力及抗风险能力

本次交易完成后，上市公司的经营状况、研发能力、资产质量将得到进一步的提升，同时上市公司的持续盈利能力以及未来发展空间也会借由本次并购的助力，更上一个台阶。对来自于存储行业周期、供应链保障、宏观经济周期的风险，上市公司将受益于产品结构优化及更多供应商的产能保障等因素，在抗风险能力上得到进一步加强，从而为上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益带来更有力的保障。

三、本次交易方案

（一）本次交易方案概述

本次交易的方案为兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100%股权，同时拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施，但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。

（二）发行股份及支付现金购买资产

1、交易对方

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威。

2、标的资产的定价依据及交易价格

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，经交易双方友好协商，标的资产的定价以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日（即 2016 年 9 月 30 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商一致，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，标的资产的交易价格确定为 650,000 万元。

3、发行股票的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。”

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日，即 2017 年 2 月 14 日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 158.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的

90%。其中，董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格将进行相应调整。此外，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不再调整。

5、支付方式

本次交易的支付方式为：上市公司以发行股份作为对价向交易对方购买标的公司 76.19%的股权，以现金作为对价向交易对方购买标的公司剩余 23.81%股权。

按照本次标的的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 495,238.66 万元，发行数量共计 31,284,816 股，向交易对方支付的现金对价共计 154,761.34 万元，具体如下：

股东姓名	持股比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票支付 数量(股)
			股份对价 (万元)	股份对价 占比	现金 (万元)	现金对 价占比	
上海承裕	43.17%	280,621.64	224,497.31	45.33%	56,124.33	36.27%	14,181,763
屹唐投资	37.16%	241,555.54	175,823.25	35.50%	65,732.29	42.47%	11,106,964
华创芯原	11.96%	77,718.36	44,813.64	9.05%	32,904.72	21.26%	2,830,931
民和志威	3.92%	25,501.97	25,501.97	5.15%	-	-	1,610,989
闪胜创芯	3.79%	24,602.50	24,602.50	4.97%	-	-	1,554,169
总计	100.00%	650,000.00	495,238.66	100.00%	154,761.34	100.00%	31,284,816

上表中，上市公司以现金作为对价向上海承裕和屹唐投资购买的标的公司股权包括上海承裕和屹唐投资于 2016 年 12 月分别受让的标的公司 4.09%股权和 10.10%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。

6、滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

7、锁定期安排

根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和发行股份及支付现金购买资产的交易对方出具的《股份锁定承诺函》，本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方的股份锁定期具体安排如下：

（1）业绩承诺方

如业绩承诺方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，业绩承诺方按照下列公式计算的股份可以转让或交易（即解锁，下同）：业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价）/发行价格。同时，业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可再解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可再解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017年和2018年的累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例 / 发行价格 - 第一期解锁股份数

华创芯原可解锁的股份数=(业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017年和2018年累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例) / 发行价格 - 第一期解锁股份数

第三期，在2019年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在2017年至2019年累计实现净利润达到累计承诺净利润的90%或以上，则业绩承诺方剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。

为确定各期可解锁股份数量，《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起30日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经交易双方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司年度报告披露届满30日后解锁相应数量的股份。

如业绩承诺方取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则其相应部分的新增股份自本次发行完成之日起36个月届满之日或其在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。

（2）民和志威

如民和志威取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过12个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起12个月内不得交易或转让；对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起36个月届满之日前不得转让。

华创芯原及民和志威在本次交易项下获得的交易对价（含股份对价及现金对价）将因华创芯原股权转让发生调整。各方确认，在按《发行股份及支付现金购买资产协议》第二条第3款第（7）项“锁定期安排”计算各方可解锁股份时，相关公式中的“业绩承诺方获得的交易对价”、“业绩承诺方获得的现金对

价”均应按华创芯原股权转让前（即截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日）各交易对方所持标的公司出资额对应的交易对价计算。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

非经上市公司同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如果非经上市公司同意业绩承诺方转让该等股份，业绩承诺方应按《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定承担相应的违约责任。

8、上市地点

本次非公开发行股票拟在上交所上市交易。

9、决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）发行股份募集配套资金

本次拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。名建致真不参与发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且本次募集配套资金最终发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

1、本次募集配套资金的发行对象

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括名建致真在内的符合中国证

监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10 名特定投资者。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

2、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金所发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

3、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定投资者非公开发行股份的方式。

4、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。其中，名建致真不参与本次发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

5、发行数量

本次募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。本次募集配套资金最终发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行

数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。

6、募集配套资金用途

本次配套融资资金拟用于支付本次交易现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。如本次配套资金募集不足或未能实施完成，本公司将通过自筹资金的方式解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。总体用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	拟投入募集配套资金金额
1	支付本次交易现金对价	154,761.00
2	eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目	20,000.00
3	支付交易相关的中介费用	8,239.00
合计		183,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际需求及资金需求，按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

7、滚存未分配利润安排

公司在本次发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

8、锁定期安排

本次交易上市公司拟向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金，其中名建致真所认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得转让。

本次发行完成后至锁定期满之日止，由于上市公司分配股票股利、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

本次所认购的上市公司股份锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监

会、上交所届时有效的相关规定。

9、上市地点

本次非公开发行股票拟在上交所上市交易。

10、决议有效期

与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、本次交易构成重大资产重组

本次交易中，标的资产为北京矽成 100%股权，交易价格为 650,000.00 万元。此外，本次重大资产重组前 12 个月，公司投资了立而鼎科技（深圳）有限公司、深圳市硅格半导体股份有限公司、忆正科技（武汉）有限公司和 Everspin Technologies, Inc 等集成电路设计行业公司。

上述被投资公司所处行业亦为集成电路设计行业，与本次交易标的公司北京矽成属于相同或相近的行业，因此可以认定为同一或者相关资产，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。

根据兆易创新经审计的 2016 年度财务数据、标的公司和前次交易被投资企业经审计的 2016 年度备考合并财务数据及交易作价情况，相关财务指标占比情况计算如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	营业收入	资产净额与交易金额孰高
本次交易-标的公司	650,000.00	213,639.22	650,000.00
前次交易-立而鼎科技	639.62	190.66	639.62
前次交易-硅格半导体	100.00	33.32	100.00
前次交易-忆正科技	2,204.33	343.00	2,204.33
前次交易-Everspin Technologies, Inc	3,336.90	901.27	3,336.90
合计	656,280.85	215,107.48	656,280.85
上市公司 2016 年财务数据	166,965.03	148,894.82	127,853.57
财务指标占比	393.06%	144.47%	513.31%
是否构成重大资产重组	是	是	是

注 1：上市公司的财务指标均取自其经审计的 2016 年度合并财务报表；标的公司以及

前次交易被投资企业的财务指标中，资产总额、资产净额指标系根据《重组管理办法》的相关规定，取各指标与本次交易标的或前次投资的交易价格孰高值；标的公司营业收入指标取自标的公司 2016 年度备考合并利润表；前次交易被投资企业的营业收入按照上市公司持股比例乘以各被投资公司 2016 年经审计的营业收入计算得出。

注 2：上市公司对 Everspin Technologies, Inc 的投资金额为 500 万美元，按照关于该投资总经理办公会会议决议日的人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币 3,336.90 万元。

根据上表，本次交易拟购买的标的资产的交易金额和标的公司资产总额的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上，拟购买的标的资产的交易金额和标的公司归属于母公司股东的净资产的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净资产的比例达到 50%以上，且超过人民币 5,000 万元，标的公司最近一个会计年度营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 50%以上。根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及《重组管理办法》规定的上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的情形，因此需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

1、关于朱一明与香港赢富得之间的一致行动关系

（1）一致行动关系承诺的具体内容和时间限制

根据香港赢富得于 2013 年 4 月 15 日出具的《保持一致行动的承诺函》(以下简称“《承诺函》”)，承诺“自本《承诺函》出具之日起，在兆易创新的股东大会审议议案时，本公司作为股东行使表决权时将与朱一明保持一致；在兆易创新的董事会审议议案时，本公司会要求本公司推荐的董事行使表决权时亦将与朱一明保持一致。在持有兆易创新股份期间，本公司不会谋求对兆易创新的实际控制地位，不会与朱一明之外的其他股东签署一致行动协议或类似保持一致行动的承诺函”。

根据香港赢富得于 2017 年 3 月 10 日出具的《关于确认一致行动关系的声明与承诺函》，承诺“1.在持有兆易创新股份期间，本公司将遵守《保持一致行动的承诺函》，与朱一明保持一致行动关系；2.本承诺函一经作出即不可撤销，且本公司愿意承担因违反上述承诺而对上市公司造成的实际损失。”

基于上述，根据《招股书》、上述《承诺函》等文件资料，香港赢富得出具的承诺为不可撤销承诺，其承诺其在持有兆易创新股份期间与朱一明保持一致行动关系，不存在其他时间限制。

（2）关于是否可能因香港赢富得撤回承诺或减持，导致公司控制权不稳定

1) 香港赢富得的股东构成情况

其中，香港赢富得的股东主要是公司外籍员工以及在朱一明创业初期为原 GigaDevice Semiconductor Inc.或公司提供过帮助的人员，其中，公司外籍员工共计持有香港赢富得 70.889%的股权。此外，公司董事、副总经理舒清明持有香港赢富得 57.739%的股权，为香港赢富得的控股股东。

2) 香港赢富得的股份锁定情况

公司股票于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。根据《招股书》，香港赢富得承诺，“本公司所持公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份”。

香港赢富得控股股东、上市公司董事、副总经理舒清明承诺，“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份”。上述承诺为舒清明作为上市公司董事及高级管理人员根据《公司法》等法律法规作出的惯常承诺，不涉及股份转让的对象。此外，香港赢富得、舒清明与公司实际控制人之间未就未来股份转让达成任何协议或类似安排。

综上所述，结合香港赢富得的股东构成、香港赢富得及舒清明的股份锁定及承诺、公司股份新发行上市等客观及实际情况，香港赢富得确认不会撤回承诺，其所持股份在锁定期（至 2019 年 8 月 18 日）内无法转让或减持，且锁定期届满后短期内大量减持股份的可能性较小。

2、本次交易不构成重组上市

根据中国证监会上市部《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，“在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。”

本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，朱一明直接持有兆易创新 9.31%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.08%及 0.70%股份；香港赢富得持有兆易创新 7.97%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 20.06%，为兆易创新的控股股东和实际控制人，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更，因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、本次交易构成关联交易

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，上海承裕、屹唐投资在本次交易完成后将成为上市公司持股比例 5%以上股东，且上述事项预计在十二个月内完成；发行股份募集配套资金的交易对方中，名建致真系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理朱一明控制的企业。

由上述，根据《重组管理办法》、《上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。在董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决；独立董事就有关议案进行了事前审查及认可，并发表了独立意见；在股东大会审议本次交易事项时，关联股东已回避表决。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对公司主营业务的影响

上市公司与标的公司均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。主要产品方面，本次交易前，上市公司主营产品以 NOR

FLASH 等非易失性存储芯片为主，标的公司则以 DRAM 和 SRAM 等易失性存储芯片为主。本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。

报告期内，上市公司和标的公司均具有良好的盈利表现。根据半导体协会数据，2012 年以来兆易创新为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业。2016 年 8 月上市后，公司成为 A 股市场中少数的半导体存储行业上市公司之一，在我国本土电子产业中的存储芯片市场优势明显。

标的公司的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，标的公司积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次收购完成后，兆易创新将与北京矽成在现有的客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，借助彼此在国内和海外市场积累的研发实力和优势地位，实现上市公司业务上的有效整合。同时，通过存储芯片产品品类的扩充，以及产品适用领域逐渐迈入专用级应用市场，上市公司产品的市场占有率将迎来进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。

此外，本次交易收购北京矽成将为上市公司引进存储芯片研发设计领域的优秀研发人员以及国际化管理团队，为上市公司进一步快速发展和国际化纵深发展注入动力。本次交易完成后，上市公司与北京矽成将在员工激励、培训、管理等多方面相互形成正向反馈，提升上市公司和北京矽成的整体运营效率。

（二）本次交易对公司盈利能力的影响

本次交易前，兆易创新 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度归属于母公司所有者净利润分别为 9,812.25 万元，15,778.26 万元和 17,642.76 万元。本次交易拟收购资产北京矽成最近三年备考合并财务报表归属于母公司股东的净利润分别为 1,564.04 万元、5,905.54 万元和 14,055.40 万元，扣除非经常性损益后的归母净利润分别为-2,572.71 万元、5,919.32 万元和 12,379.03 万元。

根据《盈利补偿协议》及补充协议，本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和

57,200.00 万元。若考虑标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销以及因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响后，盈利承诺期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 20,365.80 万元、36,066.31 万元和 51,461.18 万元。本次交易完成后，上市公司盈利规模将大幅增加。

上市公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，本次交易完成后，兆易创新将整合并购双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与标的资产相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。

（三）本次交易对公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司的总股本为 10,000.00 万元，朱一明为公司控股股东和实际控制人。本次交易上市公司拟向北京矽成全体股东发行 3,128.48 万股股份，本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 13,128.48 万元（不考虑发行股份募集配套资金部分）。本次交易完成前后公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
朱一明	12,219,000	12.22%	12,219,000	9.31%
香港赢富得	10,459,500	10.46%	10,459,500	7.97%
友容恒通	2,724,825	2.72%	2,724,825	2.08%
万顺通合	924,000	0.92%	924,000	0.70%
上海承裕	-	-	14,181,763	10.80%
屹唐投资	-	-	11,106,964	8.46%
华创芯原	-	-	2,830,931	2.16%
民和志威	-	-	1,610,989	1.23%
闪胜创芯	-	-	1,554,169	1.18%
重组前的其他股东	73,672,675	73.67%	73,672,675	56.12%
合计	100,000,000	100.00%	131,284,816	100.00%

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富

得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

在不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，本次交易完成后，朱一明直接持有兆易创新 9.31%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.08%及 0.70%股份；香港赢富得持有兆易创新 7.97%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 20.06%，仍为公司控股股东和实际控制人，因此本次交易将不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次交易对公司同业竞争的影响

本次交易并未导致兆易创新控股股东和实际控制人发生变更，朱一明仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，北京矽成旗下的存储芯片业务将整体注入上市公司。目前，朱一明未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及标的公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及标的公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争的问题。

本次交易完成后，为从根本上避免和消除控股股东及实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东及实际控制人朱一明作出承诺避免同业竞争。此外，本次交易完成后，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，也作出承诺避免同业竞争。

（五）本次交易对公司关联交易的影响

本次交易前，上市公司与北京矽成及其股东之间不存在关联关系，亦不存在关联交易。本次交易完成后，标的资产北京矽成将作为上市公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，上市公司将新增关联方。

本次交易完成后，上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人、本次交易新增关联方和上市公司的关联交易，朱一明、上海承裕及屹唐投资分别就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

（六）本次交易对公司治理结构和独立性的影响

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对本公司实际控制人的控制权不会产生重大影响，亦不会对现有的公司治理结构产生不利影响。

本次交易完成后，公司各项经营活动（包括但不限于采购、销售、技术、商标等）对控股股东、实际控制人以及其他第三方不存在重大依赖。

八、本次交易的报批事项

（一）本次交易已经履行的审批程序

1、上市公司的决策过程

2017年2月13日，上市公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2017年2月24日，上市公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2017年4月17日，上市公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2、标的公司决策过程

本次交易的方案已经北京矽成股东会议审议通过。

3、交易对方决策过程

本次交易的方案已经全部交易对方的内部权力机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，截至本报告书披露之日，本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、兆易创新股东大会审议通过本次交易方案；
- 2、中国证监会核准本次交易事项；
- 3、本次交易涉及的相关事项尚需通过 CFIUS 的安全审查；
- 4、本次交易涉及的相关事项尚需通过台湾投审会的审查。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的有关约定，本次交易涉及事项需通过 CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会的审查，该 2 项审查为本次交易交割的前提条件。

本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称：	北京兆易创新科技股份有限公司
英文名称：	Gigadevice Semiconductor（Beijing） Inc.
股票简称：	兆易创新
股票代码：	603986
注册资本：	10,000 万元
社会统一信用代码	91110108773369432Y
成立日期：	2012 年 12 月 28 日
法定代表人：	朱一明
注册地址：	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室
办公地址：	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室
邮政编码：	100083
电话号码：	010-82881768
传真号码：	010-82881768
互联网网址：	www.gigadevice.com
经营范围：	微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、历史沿革及股本变动情况

（一）上市公司设立情况

公司系由兆易有限整体变更设立。

经 2012 年 12 月 19 日发起人创立大会批准，兆易有限原有股东作为发起人，以兆易有限截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产 245,566,077.10 元中的 7,500 万元折为股份公司的股份共计 7,500 万股，每股面值 1 元，其余转为资本公积金的方式整体变更为股份有限公司。2012 年 11 月 8 日，中瑞岳华对发起人上述股份制改制情况进行审验并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0315 号《验资报告》。2012 年 12 月 28 日，发行人在北京工商局办理完成工商变更登记手续。

本公司设立时，各发起人的持股比例如下：

股东姓名	所持股份（万股）	股权比例（%）
朱一明	1,221.90	16.29
讯安投资有限公司	1,058.45	14.11
香港赢富得有限公司	1,045.95	13.95
启动中海创业投资有限公司	891.75	11.89
香港泰若慧有限公司	662.07	8.83
盈富泰克创业投资有限公司	582.68	7.77
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	317.54	4.23
北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）	272.48	3.63
北京启迪创业孵化器有限公司	252.44	3.37
IPV 资本有限公司	231.09	3.08
北京腾业联合创业投资合伙企业（有限合伙）	180.46	2.41
越超有限公司	159.08	2.12
北京中海创业投资有限公司	154.18	2.06
上海华芯创业投资企业	132.31	1.76
北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）	92.40	1.23
天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）	88.21	1.18
同方华清投资管理有限公司	46.59	0.62
上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	44.10	0.59
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	44.10	0.59
北京中海厚德投资管理中心（有限合伙）	22.23	0.30
合 计	7,500.00	100.00

（二）首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2016]1643 号文核准，本公司于 2016 年 8 月 12 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格 23.26 元，募集资金净额 51,652.93 万元。发行后，本公司注册资本变更为 10,000 万元。经上交所“自律监管决定书[2016]215 号”文批准，本公司于 2016 年 8 月 18 日在上交所主板挂牌上市，股票简称“兆易创新”，股票代码“603986”。

本公司首次公开发行股票并上市后，股权结构如下：

股东姓名	所持股份（万股）	股权比例（%）

股东姓名	所持股份（万股）	股权比例（%）
朱一明	1,221.90	12.22
讯安投资有限公司	1,058.45	10.58
香港赢富得有限公司	1,045.95	10.46
启迪中海创业投资有限公司	891.75	8.92
香港泰若慧有限公司	662.07	6.62
盈富泰克创业投资有限公司	582.68	5.83
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	317.54	3.18
北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）	272.48	2.72
北京启迪创业孵化器有限公司	252.44	2.52
IPV 资本有限公司	231.09	2.31
北京腾业联合创业投资合伙企业（有限合伙）	180.46	1.80
越超有限公司	159.08	1.59
北京中海创业投资有限公司	154.18	1.54
上海华芯创业投资企业	132.31	1.32
北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）	92.40	0.92
天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）	88.21	0.88
同方华清投资管理有限公司	46.59	0.47
上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	44.10	0.44
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	44.10	0.44
北京中海厚德投资管理中心（有限合伙）	22.23	0.22
社会公众股	2,500.00	25.00
合 计	10,000.00	100.00

（三）上市以后的历次股本变化情况

上市后，兆易创新未发生股本变动事项。

2017 年 4 月，公司披露 2016 年度利润分配预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），预计实际分配现金红利总额为 5,300 万元，占公司 2016 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.04%，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。若公司实施该预案，

总股本将由 10,000 万股增加至 20,000 万股。

三、最近三年控制权变动情况

自 2013 年 1 月 1 日至本报告书出具之日，上市公司控股股东和实际控制人均为朱一明，均未发生变动。

四、重大资产重组情况

自 2013 年 1 月 1 日至本报告书出具之日，上市公司未发生重大资产重组情况。

五、主营业务发展情况

上市公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。

公司的主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。上述产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

自成立以来，公司一直致力于上述集成电路产品的产品定义、研发、质量管理、运营和销售，主营业务及主要产品未发生重大变化。

报告期内，上市公司主营业务经营状况良好，业务规模继续保持增长。上市公司 2014 年实现营业收入 94,672.32 万元，较 2013 年增长 20.02%；实现利润总额 11,294.98 万元，较 2013 年增长 50.51%；归属于上市公司股东的净利润 9,812.25 万元，较 2013 年增长 45.69%。上市公司 2015 年实现营业收入 118,878.02 万元，较 2014 年增长 25.57%；实现利润总额 18,124.48 万元，较 2014 年增长 60.46%；归属于上市公司股东的净利润 15,778.26 万元，较 2014 年增长 60.80%。2016 年度，上市公司实现营业收入 148,894.82 万元，较 2015 年增长 25.25%，实现利润总额 18,576.65 万元，较 2015 年增长 2.49%，归属于上市公司股东的净利润 17,642.76 万元，较 2015 年增长 11.82%。

六、主要财务数据及财务指标

根据瑞华会计师审计的兆易创新 2015 年、2016 年财务报表，上市公司最近两年主要财务指标（按合并报表口径）如下表：

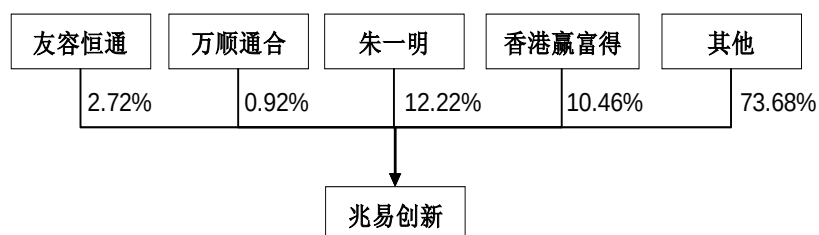
单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	166,965.03	89,979.92
负债总额	39,052.64	32,916.56
归属上市公司股东所有者权益	127,853.57	57,127.89
资产负债率	23.39%	36.58%
项 目	2016 年度	2015 年度
营业收入	148,894.82	118,878.02
营业利润	16,206.52	16,308.70
利润总额	18,576.65	18,124.48
归属母公司所有者的净利润	17,642.76	15,778.26
经营活动产生的现金流量净额	8,361.27	21,718.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,121.44	-4,735.84
筹资活动产生的现金流量净额	52,059.85	-1,450.08
现金及现金等价物净增加额	45,181.06	15,793.19
毛利率	26.72%	28.67%
基本每股收益（元/股）	2.12	2.10

七、上市公司控股股东和实际控制人情况

（一）上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图

截至本报告书出具日，上市公司股权结构图情况如下：



朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

其中，为进一步确保朱一明在公司股票上市交易后的实际控制地位，香港赢

富得于 2013 年 4 月 15 日出具《保持一致行动的承诺函》，承诺：“自本《承诺函》出具之日起，在兆易创新的股东大会审议议案时，本公司作为股东行使表决权时将与朱一明保持一致；在兆易创新的董事会审议议案时，本公司会要求本公司推荐的董事行使表决权时亦将与朱一明保持一致。在持有兆易创新股份期间，本公司不会谋求对兆易创新的实际控制地位，不会与朱一明之外的其他股东签署一致行动协议或类似保持一致行动的承诺函。”

根据香港赢富得于 2017 年 3 月 10 日出具的《关于确认一致行动关系的声明与承诺函》，香港赢富得承诺“1.在持有兆易创新股份期间，本公司将遵守《保持一致行动的承诺函》，与朱一明保持一致行动关系；2.本承诺函一经作出即不可撤销，且本公司愿意承担因违反上述承诺而对上市公司造成的实际损失。”

（二）上市公司控股股东基本情况

截至本报告书出具日，上市公司控股股东为朱一明，直接持有本公司 12.22% 的股份。

姓名	朱一明	性别	男	国籍	中国
身份证号	3209231972072****X	取得其他国家或地区的居留权		无	
住址	北京市海淀区西三旗				
通讯地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A12 层				
最近三年任职情况	自 2013 年至今担任兆易创新董事长兼总经理、友容恒通执行事务合伙人、万顺通合执行事务合伙人、外滩科技执行董事、NOVOMEM INC. 总经理、芯技佳易微电子（香港）科技有限公司董事				
任职单位存在产权关系	持有兆易创新 12.22% 股份				

（三）上市公司实际控制人情况

截至本报告书出具日，朱一明直接持有兆易创新 12.22% 股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72% 及 0.92% 股份；香港赢富得持有兆易创新 10.46% 股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的实际控制人。朱一明的基本情况详见“第二章 上市公司基本情况”之“七、上市公司控股股东和实际控制人情况”之“（二）上市公司控股股东基本情况”。

八、最近三年合法合规情况

截至本报告书出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年诚信情况良好，不存在被证券交易所公开谴责的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。

第三章 交易对方基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威；本次发行股份募集配套资金之交易对方为包括名建致真在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10 名特定投资者。

一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况

截至本报告书出具日，各股东持有北京矽成的股权比例如下：

序号	交易对方	持有北京矽成股权情况	
		出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	22,435.46	43.17
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	19,312.16	37.16
3	北京华创芯原科技有限公司	6,213.52	11.96
4	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	1,966.95	3.79
5	烟台民和志威投资中心（有限合伙）	2,038.86	3.92
合计		51,966.949	100.00

（一）上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）

1、上海承裕基本情况

中文名称：上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海承裕投资管理有限公司（委派代表：朱慧）

成立日期：2015 年 07 月 21 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：上海市嘉定区工业区兴顺路 558 号 7 幢 545 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1101 室

统一社会信用代码：91310114350937792Y

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2015年7月21日，上海承裕由承裕投资和武岳峰浦江共同设立，设立时合伙人认缴出资额为1,001.00万元。2015年7月21日，上海市嘉定区市场监督管理局出具《准予合伙企业登记决定书》，准予上海承裕登记。

上海承裕设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承裕投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.10
2	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	99.90
合计			1,001.00	100.00

2015年8月31日，上海承裕总认缴出资额变更为96,432.50万元，其中承裕投资认缴出资额变更为5.00万元，武岳峰浦江退出上海承裕合伙，武岳峰集成电路加入上海承裕合伙，认缴出资额为96,427.50万元。

本次变更完成后，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承裕投资管理有限公司	普通合伙人	5.00	0.01
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	96,427.50	99.99
合计			96,432.50	100.00

2016年2月1日，上海承裕总认缴出资额变更为106,432.50万元，其中北京青禾投资基金（有限合伙）加入上海承裕合伙，认缴出资额为10,000.00万元。

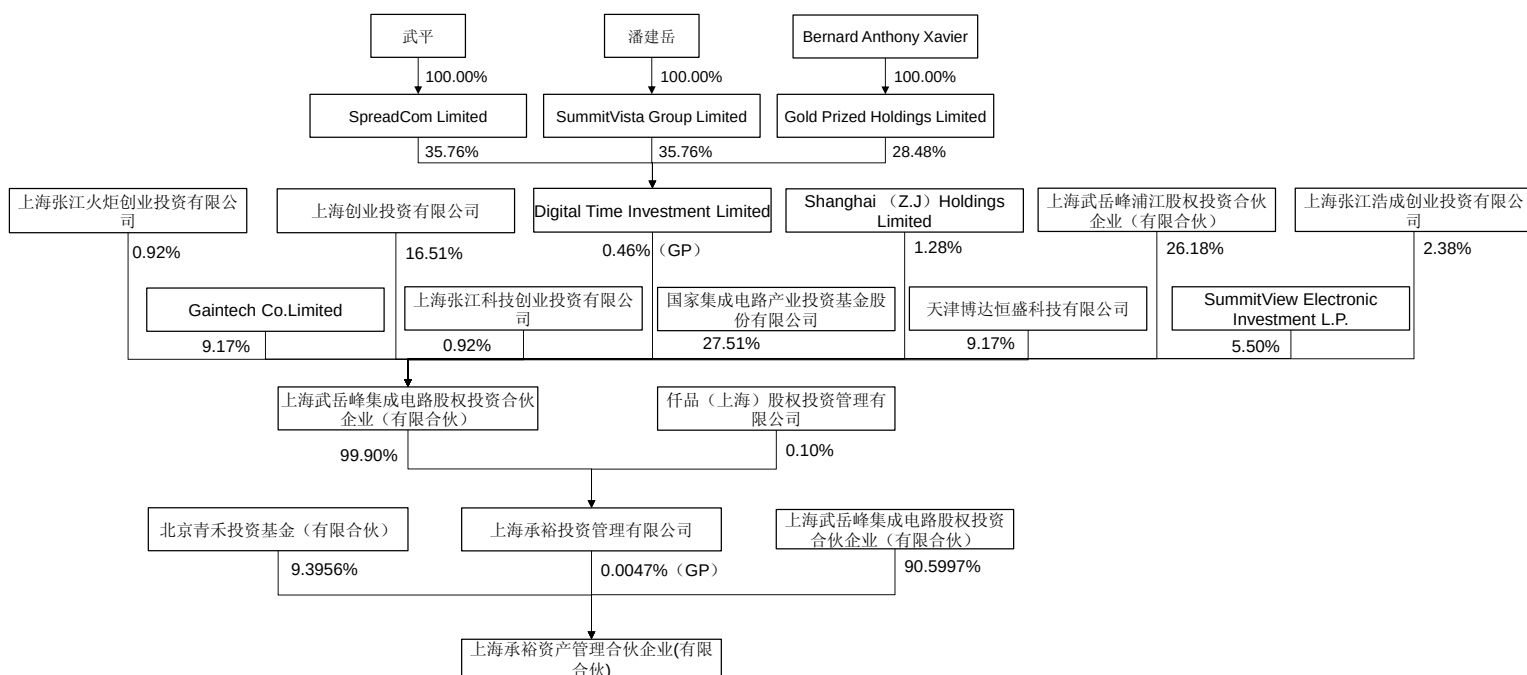
至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承裕投资管理有限公司	普通合伙人	5.00	0.0047
2	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	96,427.50	90.5997
3	北京青禾投资基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	9.3956
合计			106,432.50	100.00

本次变更完成后，截至本报告书出具日，武岳峰集成电路和青禾投资出资已实缴到位，承裕投资尚未实际出资，上海承裕出资情况未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，上海承裕的产权结构及控制关系如下：



4、合伙人的基本情况

（1）执行事务合伙人

1) 承裕投资的基本情况

中文名称：上海承裕投资管理有限公司

法定代表人：朱慧

成立日期：2015 年 06 月 19 日

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3818 号 2 幢 1218 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1101 室

企业法人营业执照注册号：310114002925816

组织机构代码：34217692-X

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，企业营销策划，创业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2015年6月19日，经上海市嘉定区市场监督管理局批准，承裕投资由武岳峰浦江及朱慧出资设立，设立时注册资本为1,000.00万元。

至此，承裕投资的股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	999.00	货币	99.90
2	朱慧	1.00	货币	0.10
合计		1,000.00	-	100.00

2015年9月10日，武岳峰浦江与武岳峰集成电路签署《股权转让协议》，约定武岳峰浦江将所持承裕投资99.90%股权转让予武岳峰集成电路；同日，朱慧与仟品投资签署《股权转让协议》，约定朱慧将所持承裕投资0.10%股权转让予仟品投资。截至本报告书出具日，上述股权转让的工商变更登记手续正在办理中。

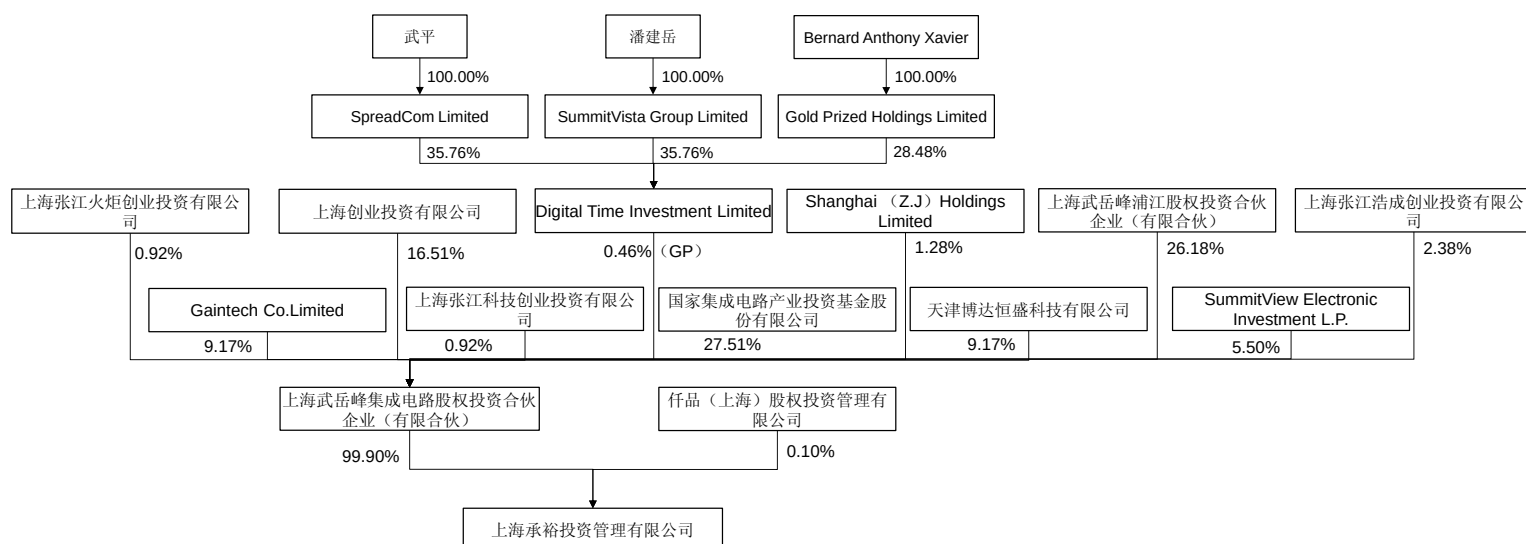
至此，承裕投资的股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	999.00	货币	99.90
2	仟品（上海）股权投资管理有限公司	1.00	货币	0.10
合计		1,000.00	-	100.00

本次变更完成后，承裕投资股权结构未发生变更。

3) 产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，承裕投资的产权结构及控制关系如下：



4) 控股股东基本情况

中文名称：上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：Digital Time Investment Limited（委派代表：潘建岳）

成立日期：2015 年 08 月 03 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2196 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 1101 室

统一社会信用代码：91310000351127927X

经营范围：股权投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5) 最近三年主营业务发展情况

承裕投资主营业务为投资管理，投资咨询，创业投资，实业投资等。

6) 最近两年主要财务数据

承裕投资自 2015 年 6 月 19 日设立以来，尚未开展实际业务，因此暂无经营数据。

7) 对外投资情况

截至本报告书出具日，承裕投资除为上海承裕执行事务合伙人外，承裕投资

并未对外投资其他企业。

（2）有限合伙人

1) 武岳峰集成电路

武岳峰集成电路的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“（一）上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）”之“4、合伙人的基本情况”。

2) 青禾投资

中文名称：北京青禾投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人：北京风尚欣和投资基金管理有限公司（委派代表：马慧）

成立日期：2014 年 10 月 13 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-8

企业法人营业执照注册号：110000018009641

组织机构代码：31803295-0

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、最近三年主营业务发展情况

上海承裕系于 2015 年 7 月 21 日成立，主要业务为投资、投资管理、咨询等。

6、最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	3,145,420,541.58	2,300,007,925.49

总负债	1,569,409,056.80	1,250,603,628.08
所有者权益	1,576,011,484.78	1,049,404,297.41
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	605,979,660.83	0.00
营业利润	527,087,787.37	-7,290,302.59
净利润	527,116,787.37	-7,290,302.59

注：以上财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，上海承裕除持有北京矽成 43.17%股权外，对外投资情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)	19,200.00	43.38	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）

1、屹唐投资基本情况

中文名称：北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司（委派代表：张文冬）

成立日期：2015 年 05 月 26 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 309 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢

统一社会信用代码：911103023482925854

经营范围：投资、投资咨询、投资管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

屹唐投资原名北京兴南科技产业投资中心（有限合伙）。2015年5月26日，兴南科技由亦庄产投和战新基金共同设立，设立时合伙人出资额为70,000万元。

2015年6月30日，兴南科技出具《合伙人出资确认书》，确认全体合伙人于该日出资到位。

屹唐投资设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.00143
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	69,999.00	99.99857
合计			70,000.00	100.00

2015年6月5日，经合伙人大会决定，兴南科技中文名称由“北京兴南科技产业投资中心（有限合伙）”变更为“北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）”。兴南科技于2015年6月15日获得北京市工商局开发区分局核发的《名称变更通知》，并完成工商变更登记手续。

2015年8月3日，经合伙人大会决定，同意屹唐国际作为普通合伙人入伙，亦庄产投退伙；同意将屹唐投资的认缴出资额由70,000.00万元变更为80,000.00万元，其中普通合伙人屹唐国际认缴出资额1.00万元，有限合伙人战新基金认缴出资额79,999.00万元。屹唐投资合伙人由原来的亦庄产投、战新基金变更为屹唐国际、战新基金；屹唐投资出资额由原来的70,000.00万元变更为80,000.00万元，其中屹唐国际出资1.00万元，战新基金出资79,999.00万元。同日，屹唐国际和战新基金签订了《合伙协议》。2015年8月4日，屹唐国际、亦庄产投和战新基金三方签订了《入伙协议书》。2015年8月5日，屹唐投资获得北京市工商局开发区分局核发的《准予变更登记通知书》，并于同日完成工商变更登记手续。

2015年12月30日，屹唐投资出具《合伙人出资确认书》，确认全体合伙人于该日出资到位。

至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	屹唐（北京）国际投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.00125
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	79,999.00	99.99875
合计			80,000.00	100.00

2016年10月1日，经合伙人大会决定，同意亦庄产投作为普通合伙人入伙，屹唐国际退伙。屹唐投资合伙人由原来的屹唐国际、战新基金变更为亦庄产投、战新基金，其中亦庄产投出资1.00万元，战新基金出资79,999.00万元，由屹唐投资于2016年10月1日出具《出资确认书》确认出资到位。同日，亦庄产投和战新基金签订了《合伙协议》，屹唐国际、亦庄产投和战新基金三方签订了《入伙协议书》。2016年10月11日，屹唐投资获得北京市工商局开发区分局核发的《准予变更登记通知书》，并于同日完成工商变更登记手续。

至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.00125
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	79,999.00	99.99875
合计			80,000.00	100.00000

2017年3月，经合伙人大会决定，同意将屹唐投资的认缴出资额由80,000.00万元变更为135,770.3512万元，其中普通合伙人亦庄产投认缴出资额1.00万元，有限合伙人战新基金认缴出资额135,769.3512万元。2017年3月，亦庄产投和战新基金签订了《合伙协议》，并于2017年3月10日完成工商变更登记手续。

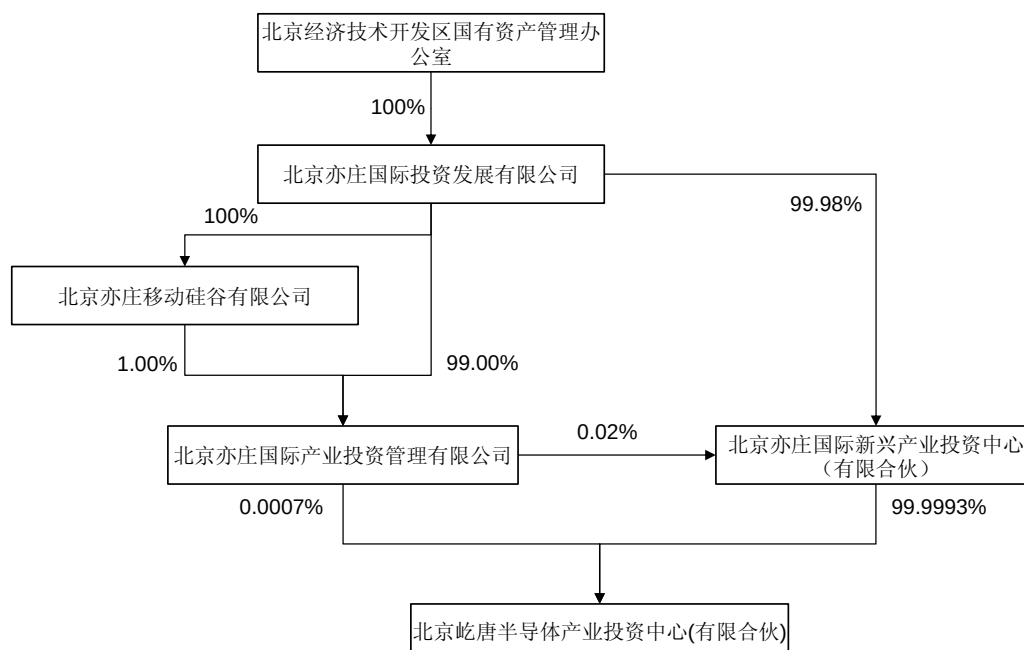
至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0007
2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	135,769.3512	99.9993
合计			135,770.3512	100.0000

本次变更完成后，屹唐投资合伙人出资情况未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，屹唐投资的产权结构及控制关系如下：



4、合伙人的基本情况

(1) 执行事务合伙人

1) 亦庄产投的基本情况

中文名称：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

法定代表人：张建勋

成立日期：2013年2月20日

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢6层608

办公地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号61幢

统一社会信用代码：91110302062801030J

经营范围：投资管理；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应

的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2013年2月20日,亦庄产投由亦庄国投及移动硅谷出资设立,设立时注册资本为1,000万元。2013年1月14日,亦庄国投出具《授权书》,同意亦庄产投在北京市工商局开发区分局进行工商注册,并使用包含“亦庄”二字的企业名称。

亦庄产投设立时股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	900.00	货币	90.00
2	北京亦庄移动硅谷有限公司	100.00	货币	10.00
合计		1,000.00	-	100.00

2015年10月19日,亦庄产投召开2015年度第三次股东会会议,审议通过亦庄产投增加注册资本的议案,同意亦庄国投增资9,000.00万元,出资时间为2016年12月31日。经与经开区国资办确认,鉴于亦庄产投股东移动硅谷亦为亦庄国投全资子公司,此次增资不需开展资产评估工作,亦庄国投此次将采用平价增资。

本次增资后,亦庄产投注册资本为10,000万元,其中亦庄国投出资9,900万元,占注册资本的99%,移动硅谷出资100万元,占注册资本的1%。2015年12月25日,本次增资完成工商变更登记手续。

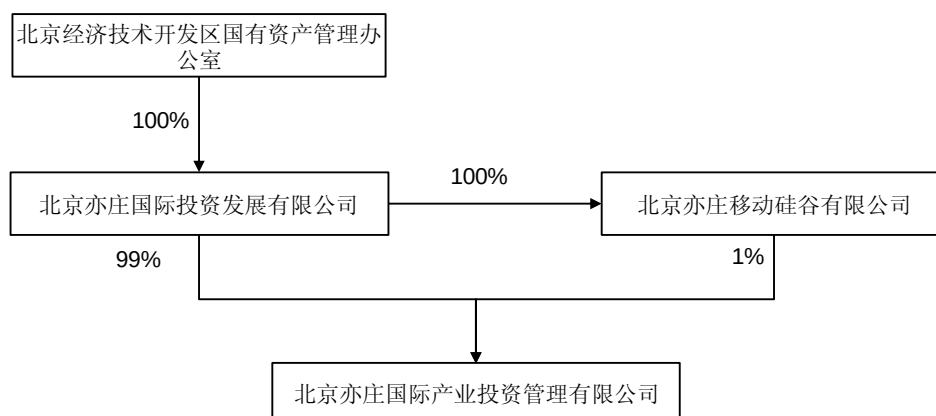
至此,亦庄产投股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	9,900.00	货币	99.00
2	北京亦庄移动硅谷有限公司	100.00	货币	1.00
合计		10,000.00	-	100.00

本次变更完成后,亦庄产投股权结构未发生变更。

3) 产权结构及控制关系

截至本报告书出具日,亦庄产投的产权结构及控制关系如下:



4) 控股股东基本情况

中文名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

法定代表人：芦永忠

成立日期：2009 年 02 月 06 日

注册资本：959,396.98 元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢

办公地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢

统一社会信用代码：91110302684355290F

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5) 最近三年主营业务发展情况

亦庄产投主要业务为基金投资，包括私募股权基金投资和母基金投资等。

6) 最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	158,076,672.18	113,763,049.20
总负债	32,918,265.91	5,597,549.17
所有者权益	125,158,406.27	108,165,500.03

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	57,553,855.87	32,100,000.00
营业利润	23,884,601.56	13,431,649.07
净利润	16,992,906.24	10,557,513.07

注：亦庄产投 2015 年财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计。

7) 对外投资情况

截至本报告书出具日，亦庄产投除为屹唐投资普通合伙人外，其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	股权比例	经营范围
1	北京屹唐华睿投资管理有限公司	1,250.00	30.00%	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	北京屹唐赛盈基金管理有限公司	1,000.00	20.00%	非证券业务的投资管理；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	北京红土屹唐股权投资管理中心（有限合伙）	100.00	25.00%	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2022 年 03 月 02 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产

				业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
4	北京中基联盟管理咨询有限公司	80.00	12.50%	企业管理咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	烟台民和昊虎投资中心（有限合伙）	90,000.00	1.64%	以自有资金对股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	北京屹唐华创投资管理有限公司	1,000.00	30.00%	投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7	拉萨经济技术开发区屹唐禾源投资管理中心（有限合伙）	1,914.75	5.22%	投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理 and 保险资产管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
8	北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）	10,001.00	0.01%	投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9	北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）	25,001.00	0.004%	投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
10	北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）	260,000.00	0.0004%	投资、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金

				不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11	屹唐鑫创（北京）投资管理有限公司	200.00	49.00%	投资管理、投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
12	屹唐资本（北京）投资管理有限公司	100.00	100.00%	投资管理、投资与资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
13	北京芯动能投资管理有限公司	1,000.00	15.00%	投资管理、资产管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
14	屹唐（北京）国际投资管理有限公司	10.00	100.00%	投资管理、资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
15	博泰方德（北京）资本管理有	980.00	69.39%	投资管理、资产管理；投资咨询；股权投资（不得从事下列业务：1、发放贷

	限公司			款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
16	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	1,000,200.00	0.02%	投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）有限合伙人

中文名称：北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司（委派代表：王晓波）

成立日期：2013 年 4 月 8 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 6 层 610

办公地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢

统一社会信用代码：91110302064879624C

经营范围：投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，除投资北京矽成和闪胜创芯外，屹唐投资并未开展实

际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	2,105,571,515.50	1,659,348,558.05
总负债	865,774,391.89	865,652,717.03
所有者权益	1,239,797,123.61	793,695,841.02
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	1,994,952.97	255,170.00
营业利润	-53,898,717.41	-6,304,158.98
净利润	-53,898,717.41	-6,304,158.98

注：屹唐投资 2015 年财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，屹唐投资除持有北京矽成 37.16%股权外，对外投资情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)	19,200.00	37.34	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）北京华创芯原科技有限公司

1、华创芯原基本情况

中文名称：北京华创芯原科技有限公司

法定代表人：陈智斌

成立日期：2015 年 07 月 01 日

注册资本：10.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院 1 幢 2 层 2076 号

办公地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1501

企业法人营业执照注册号：110108019407330

组织机构代码: 34842279-X

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2015 年 7 月 1 日，华创芯原由北京集成电路投资中心出资设立，设立时注册资本为 10 万元。同日，华创芯原取得了北京市工商局海淀分局核发的注册号为 110108019407330 的《企业法人营业执照》。

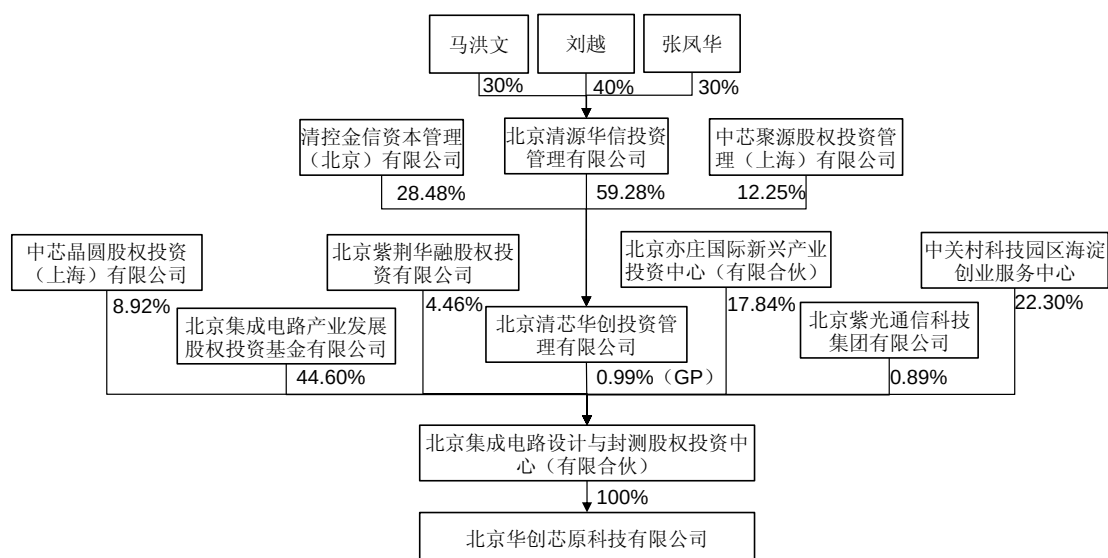
华创芯原设立时股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	10.00	货币	100.00
合计		10.00	-	100.00

华创芯原股权结构近三年未发生变更。

3、 产权及控制关系

截至本报告书出具日，华创芯原的产权结构及控制关系如下：



4、控股股东基本情况

(1) 北京集成电路投资中心的基本情况

中文名称：北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京清芯华创投资管理有限公司（委派代表：刘越）

成立日期：2014 年 09 月 25 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1502 室

办公地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1501 室

统一社会信用代码：9111010831792288XB

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2014 年 9 月 25 日，北京集成电路投资中心由北京清芯华创投资管理有限公司、北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、中芯晶圆股权投资（上海）有限公司、北京紫荆华融股权投资有限公司、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京紫光通信科技集团有限公司共同以货币资金出资设立，设立时注册资本为 39,390.00 万元，其中北京清芯华创投资管理有限公司以货币资金出资 390.00 万元，占注册资本的 0.99%，北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司以货币资金出资 13,000.00 万元，占注册资本的 33.00%，中芯晶圆股权投资（上海）有限公司以货币资金出资 10,000.00 万元，占注册资本的 25.39%，北京紫荆华融股权投资有限公司以货币资金出资 5,000.00 万元，占注册资本的 12.69%，中关村科技园区海淀园创业服务中心以货币资金出资 10,000.00 万元，占注册资本的 25.39%，北京紫光通信科技集团有限公司以货币资金出资 1,000.00 万元，占注册资本的 2.54%。2014 年 9 月 17 日，上述各方签订了《合伙协议》。

北京集成电路投资中心设立时合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京清芯华创投资管理有限公司	普通合伙人	390.00	0.99
2	北京集成电路产业发展股权投资 基金有限公司	有限合伙人	13,000.00	33.00
3	中芯晶圆股权投资（上海）有限公 司	有限合伙人	10,000.00	25.39
4	北京紫荆华融股权投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	12.69
5	中关村科技园区海淀园创业服务 中心	有限合伙人	10,000.00	25.39
6	北京紫光通信科技集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.54
合计			39,390.00	100.00

2015年11月，经合伙人大会决定，同意战新基金、华清豪威和杨龙忠作为有限合伙人入伙，其中战新基金认缴出资额为20,000.00万元，华清豪威认缴出资额为100,000.00万元，杨龙忠认缴出资额为10,000.00万元；同意将华创投资总认缴出资额变更为2,210.00万元，海淀园创业服务中心总认缴出资额变更为25,000.00万元，北京集成电路产业投资基金总认缴出资额变更为50,000.00万元。北京集成电路投资中心出资额由原来的39,390.00万元变更为223,210.00万元。

至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京清芯华创投资管理有限公司	普通合伙人	2,210.00	0.99%
2	北京集成电路产业发展股权投资 基金有限公司	有限合伙人	50,000.00	22.40%
3	中芯晶圆股权投资（上海）有限公 司	有限合伙人	10,000.00	4.48%
4	北京紫荆华融股权投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	2.24%
5	中关村科技园区海淀园创业服务 中心	有限合伙人	25,000.00	11.20%
6	北京紫光通信科技集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.45%
7	北京亦庄国际新兴产业投资中心 （有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	8.96%
8	北京华清豪威科技有限公司	有限合伙人	100,000.00	44.80%
9	杨龙忠	有限合伙人	10,000.00	4.48%
合计			223,210.00	100.00

2016年11月，经合伙人大会决定，同意华清豪威、杨龙忠退伙；同意将华创投资总认缴出资额变更为1,110.00万元。北京集成电路投资中心出资额由原来的223,210.00万元变更为112,110.00万元。当月，华创投资、北京集成电路股权

投资基金、中芯晶圆、紫荆华融、海淀园创业服务中心、紫光通信签订了《合伙协议》。2016年11月，北京集成电路投资中心出具《合伙人出资确认书》，确认全体合伙人已出资到位。2016年11月15日，北京集成电路投资中心完成工商变更登记手续。

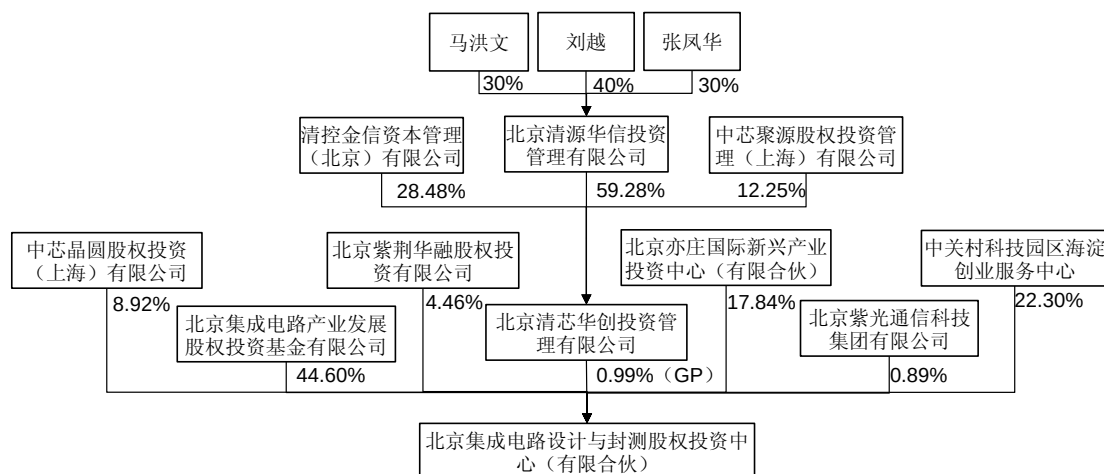
至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京清芯华创投资管理有限公司	普通合伙人	1,110.00	0.99
2	北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司	有限合伙人	50,000.00	44.60
3	中芯晶圆股权投资（上海）有限公司	有限合伙人	10,000.00	8.92
4	北京紫荆华融股权投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.46
5	中关村科技园区海淀园创业服务中心	有限合伙人	25,000.00	22.30
6	北京紫光通信科技集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.89
7	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	17.84
合计			112,110.00	100.00

本次变更完成后，北京集成电路投资中心合伙人出资情况未发生变更。

（3）产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，北京集成电路投资中心的产权结构及控制关系如下：



（4）合伙人的基本情况

1) 执行事务合伙人

①清芯华创的基本情况

中文名称：北京清芯华创投资管理有限公司

法定代表人：刘越

成立日期：2014 年 01 月 28 日

注册资本：2,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1501

企业法人营业执照注册号：110108016730338

组织机构代码：09242166-1

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2）有限合伙人

①中芯晶圆的的基本情况

中文名称：中芯晶圆股权投资（上海）有限公司

法定代表人：邱慈云

成立日期：2014 年 02 月 27 日

注册资本：120,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢 2 层 227 室

统一社会信用代码：91310000087838761E

经营范围：股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】

②集成电路产投的基本情况

中文名称：北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司

法定代表人：李妍

成立日期：2014 年 07 月 29 日

注册资本：900,900 万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-32 室

企业法人营业执照注册号：110000017648503

组织机构代码：30658201-5

经营范围：非证券业务的投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）

③紫荆华融的基本情况

中文名称：北京紫荆华融股权投资有限公司

法定代表人：雷霖

成立日期：2013 年 12 月 16 日

注册资本：80,900 万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 A2302

企业法人营业执照注册号：110108016573298

组织机构代码：08549669-X

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者

承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

④紫光通信的基本情况

中文名称：北京紫光通信科技集团有限公司

法定代表人：赵伟国

成立日期：2010 年 02 月 08 日

注册资本：100,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区双清路清华大学东门外清华国际科技交流中心八层 801 室

企业法人营业执照注册号：110000012625630

组织机构代码：55144529-2

经营范围：销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑤中关村海淀园创业服务中心的基本情况

中文名称：中关村科技园区海淀园创业服务中心

法定代表人：赵新良

开办资本：2,984 万元人民币

单位性质：事业单位

注册地址：北京市海淀区上地信息路 26 号

举办单位：中关村科技园区海淀园管理委员会

事业单位法人证书号：111010800067

⑥战新基金的基本情况

战新基金的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“（二）北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）”之“4、合伙人的基本情况”。

（5）最近三年主营业务发展情况

北京集成电路投资中心主要业务为投资管理和资产管理等。

（6）最近两年主要财务数据

北京集成电路投资中心最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	1,101,935,178.09	955,544,546.41
总负债	256,699.98	32,672,006.32
所有者权益	1,101,678,478.11	922,872,540.09
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-
营业利润	-17,139,308.78	868,351.10
净利润	-17,139,308.78	868,351.10

注：北京集成电路投资中心 2015 年财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计。

（7）对外投资情况

截至本报告书出具日，北京集成电路投资中心除为华创芯原控股股东外，其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	股权比例	经营范围
1	北京华创芯盛科技有限公司	3.00	99.99%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2	北京忆芯科技有限公司	1,000.00	3.26%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发后的产品，经济贸易咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

				营活动。)
3	上海箬箕技术有限公司	600.00	1.25%	集成电路芯片、软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的开发、设计；生物识别技术的开发及相关技术咨询服务，集成电路芯片（类）电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品中，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	北京麦哲科技有限公司	58.3333	14.29%	开发、生产计算机图片识别及文字识别软、硬件产品；技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5	安集微电子科技（上海）有限公司	3,983.1285	0.91%	集成电路用相关材料的研究、设计、生产，销售自产产品，并提供相关的技术服务与技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6	北京文安智能技术股份有限公司	4,000.00	6.52%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7	北京豪威科技有限公司	110,000.00 万美元	3.54%	半导体技术研发、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8	上海晟矽微电子股份有限公司	4,080.7624	9.17%	集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9	上海韦尔半导体股份有限公司	37,440.00	0.69%	集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	2,835.00	2.04%	集成电路的设计咨询、研发、测试、销售及相关技术服务；自营和代理各种货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11	中芯集成电路（宁波）有限公司	35,500.00	8.45%	半导体集成电路芯片、集成电路相关产品、光掩膜的开发、设计、测试、技术服务及销售；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）
12	北京集创北方科技股份有限公司	14,874.6325	0.95%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、灯具、五金交电、自行车开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13	无锡帝科电子材料科技有限公司	2,129.0336	3.95%	平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料的技术研究、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	博通集成电路（上海）有限公司	2,868.5880	1.08%	集成电路的研发、设计；软件的设计、开发、制作，销售自产产品，提供相关技术服务；集成电路芯片和软件产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，除投资北京矽成和闪胜创芯外，华创芯原并未开展实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

华创芯原最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	816,249,907.78	846,986,911.51
总负债	480,150,000.00	480,150,000.00
所有者权益	336,099,907.78	366,836,911.51
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-

营业利润	-30,750,866.73	-1,163,088.49
净利润	-30,737,003.73	-1,163,088.49

注：华创芯原 2015 年财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，华创芯原除持有北京矽成 11.96%股权外，华创芯原其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	15.10	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（四）上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）

1、闪胜创芯基本情况

中文名称：上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：联发科软件（上海）有限公司（委派代表：HAI WANG）

成立日期：2016 年 02 月 23 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢二层 D298 室

办公地址：上海市徐汇区瑞平路 275 号保利西岸中心 C 座 20 楼

统一社会信用代码：91310000MA1K38785N

经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2016 年 2 月 23 日，闪胜创芯由联发科软件、联发软件设计、上海承裕、屹唐投资、华创芯原、华清闪胜共同设立，设立时合伙人出资额为 19,200.00 万元。

闪胜创芯设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	联发科软件（上海）有限公司	普通合伙人	320.00	1.67
2	联发软件设计（深圳）有限公司	普通合伙人	320.00	1.67
3	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,220.00	27.19
4	北京华创芯原科技有限公司	有限合伙人	2,900.00	15.10
5	北京华清闪胜科技有限公司	有限合伙人	2,900.00	15.10
6	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,540.00	39.27
合计			19,200.00	100.00

2016年12月27日，华清闪胜与上海承裕、屹唐投资和民和志威分别签订《财产份额转让协议》，约定华清闪胜将其在闪胜创芯中7,880,460.00元、19,486,840.00元、1,632,700.00元的认缴份额分别转让给上海承裕、屹唐投资和民和志威，转让对价分别为7,880,460.00元、19,486,840.00元、1,632,700.00元。同日，联发科软件、联发软件设计、上海承裕、屹唐投资、华创芯原和民和志威签订了《合伙协议》。

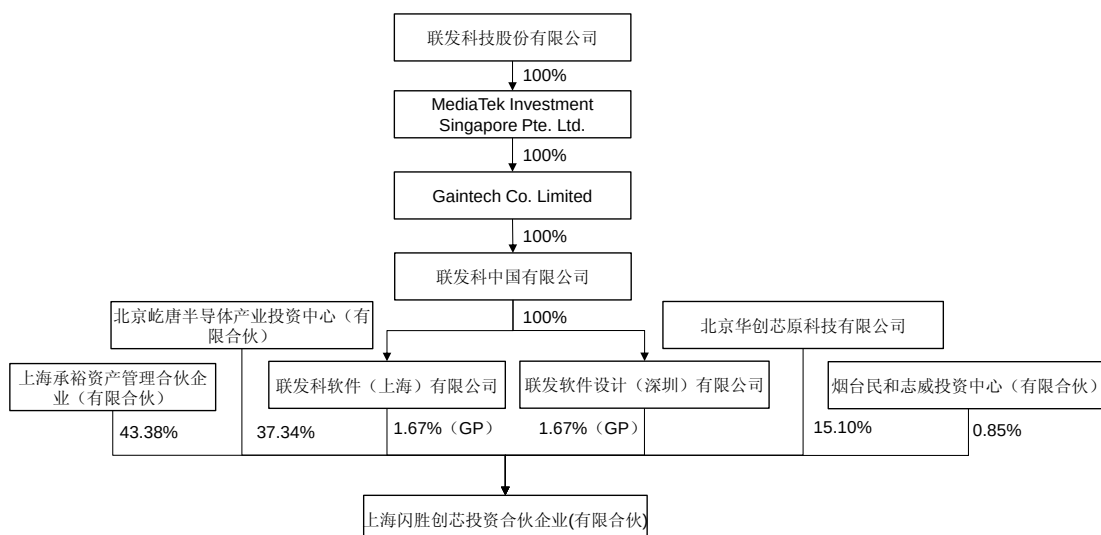
至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	联发科软件（上海）有限公司	普通合伙人	320.00	1.67
2	联发软件设计（深圳）有限公司	普通合伙人	320.00	1.67
3	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	7,168.684	37.34
4	北京华创芯原科技有限公司	有限合伙人	2,900.00	15.10
5	烟台民和志威投资中心（有限合伙）	有限合伙人	163.27	0.85
6	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,328.046	43.38
合计			19,200.00	100.00

本次变更完成后，闪胜创芯合伙人出资情况未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，闪胜创芯的产权结构及控制关系如下：



注：上海承裕、屹唐投资、华创芯原和民和志威的产权结构及控制关系请参见交易对方相应章节。

4、合伙人的基本情况

（1）执行事务合伙人

1) 联发科软件的基本情况

中文名称：联发科软件（上海）有限公司

法定代表人：HAI WANG

成立日期：2009 年 12 月 07 日

注册资本：29,700 万元人民币

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

办公地址：上海市徐汇区瑞平路 275 号保利西岸中心 C 座 20 楼

统一社会信用代码：9131000069876516XE

经营范围：计算机软件制作，电子产品、通讯产品的研发，销售自产产品并提供相关配套服务；上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

联发科软件原名上海晨思电子科技有限公司。2009 年 12 月 7 日，晨思电子由晨星软件出资设立，设立时注册资本为 100 万元。2009 年 11 月 25 日，上海金信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上金内验字[2009]064 号《验资报告》，确认截至 2009 年 11 月 24 日，晨思电子已经收到股东认缴的注册资本 100 万元，出资形式为货币资金。

晨思电子设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	晨星软件研发（深圳）有限公司	100.00	货币	100.00
合计		100.00	-	100.00

2012 年 2 月 17 日，晨思电子唯一股东晨星软件做出股东决定，同意晨星软件向晨思电子增资 800.00 万元。2012 年 2 月 27 日，上海中创海佳会计师事务所有限公司出具了中创海佳验字（2012）0013 号《验资报告》，确认截至 2012 年 2 月 27 日，晨思电子已经收到股东认缴的新增注册资本 800 万元，出资形式为货币资金，变更后的累计注册资本为 900 万元，实收资本为 900 万元。

晨思电子增资后股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	晨星软件研发（深圳）有限公司	900.00	货币	100.00
合计		900.00	-	100.00

2014 年 6 月 20 日，晨思电子唯一股东晨星软件做出股东决定，同意将其所持晨思电子 100%股权转让给联发科中国，同意晨思电子注册资本由 900.00 万元增至 29,700.00 万元，投资总额为 89,100.00 万元，同意公司性质由内资企业转制为台港澳法人独资企业。同日，晨星软件与联发科中国签订《股权转让协议》，双方同意晨星软件以 900.00 万元的价格转让其所持晨思电子 100%股权给联发科中国。2014 年 8 月 14 日，上海市商务委员会出具《市商务委关于同意外资并购上海晨思电子科技有限公司的批复》沪商外资批[2014]3029 号，同意上述股权转让事项，并于 2014 年 8 月 20 日核发《台港澳侨投资企业批准证书》。2014 年 9 月 17 日，晨思电子获得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》，并于同日完成工商变更登记手续。

至此，晨思电子的股东出资情况如下：

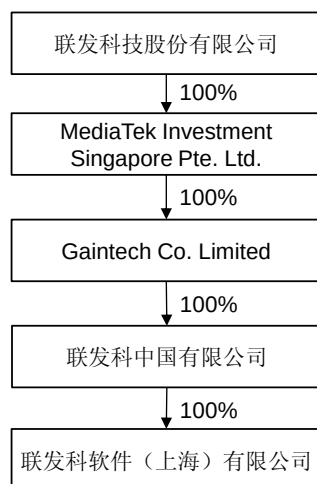
序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	联发科中国	29,700.00	货币	100.00
合计		29,700.00	-	100.00

2015 年 11 月 10 日，晨思电子唯一股东联发科中国做出股东决定，同意公司名称由“上海晨思电子科技有限公司”变更为“联发科软件（上海）有限公司”。2015 年 11 月 20 日，联发科软件获得上海市工商局自由贸易试验区分局核发的《准予变更登记通知书》，并于同日完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，截至本报告书出具日，联发科软件股权结构未发生变更。

3) 产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，联发科软件的产权结构及控制关系如下：



4) 控股股东基本情况

中文名称：联发科中国有限公司

成立日期：2014 年 09 月 07 日

企业性质：有限责任公司

注册地址：RMS 2006-8 20/F TWO CHINACHEM EXCHANGE SQUARE 338 KING'S ROAD NORTH POINT HK

登记号码：38378293-000-09-14-A

5) 最近三年主营业务发展情况

联发科软件主营业务为计算机软件制作，电子产品、通讯产品的研发、销售

等。

6) 最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	932,055,949.96	918,595,422.79
总负债	637,203,217.36	634,803,608.88
所有者权益	294,852,732.60	283,791,813.91
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	245,440,000.00	243,822,794.73
营业利润	4,468,227.75	7,344,030.79
净利润	11,060,918.69	11,021,304.26

注：联发科软件 2015 年财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计。

7) 对外投资情况

截至本报告书出具日，联发科软件除担任闪胜创芯普通合伙人外，联发科软件其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	珠海市源潭信息技术有限公司	20,190.00	0.4953	依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

(2) 其他合伙人

1) 上海承裕

上海承裕的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“(一) 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）”。

2) 屹唐投资

屹唐投资的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“(二) 北京屹唐投资产业投资中心（有限合伙）”。

3) 华创芯原

华创芯原的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“(三) 北京华创芯原科技有限公司”。

4) 民和志威

民和志威的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“（五）烟台民和志威投资中心（有限合伙）”。

5) 联发软件设计

中文名称：联发软件设计（深圳）有限公司

法定代表人：HAI WANG

成立日期：2003 年 10 月 14 日

注册资本：9,000 万美元

企业性质：外商独资企业

注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 11#楼 10-12 层

统一社会信用代码：91440300752547690E

经营范围：开发、设计消费性电子产品的软件；提供相关技术咨询；销售自行开发的软件；自有房屋租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^高清晰度多媒体接口（HDMI）测试。

5、最近三年主营业务发展情况

闪胜创芯系于 2016 年 2 月 23 日成立。截至本报告书出具日，除投资北京矽成外，闪胜创芯并未开展实际经营业务。

6、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	192,052,443.41
总负债	2,570.00
所有者权益	192,049,873.41
项目	2016 年度
营业收入	0.00
营业利润	49,873.41

净利润	49,873.41

注：以上财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，闪胜创芯除持有北京矽成 3.79%股权外，并未对外投资其他企业。

（五）烟台民和志威投资中心（有限合伙）

1、民和志威基本情况

中文名称：烟台民和志威投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：韩冰）

成立日期：2016 年 03 月 21 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 28 号科技大厦 347 室

办公地址：北京市东城区东直门外大街 39 号院 2 号楼 4 层

统一社会信用代码：91370600MA3C7P7K8Q

经营范围：以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2016 年 3 月 21 日，民和志威由拉萨民和投资管理有限公司和烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）共同设立，设立时合伙人出资额为 30,000 万元。其中，民和德元出资 1,500 万元，拉萨民和出资 28,500 万元。

2016 年 3 月 17 日，民和志威出具《认缴出资确认书》，确认全体合伙人于该日出资到位。

民和志威设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,500.00	5.00
2	拉萨民和投资管理有限公司	有限合伙人	28,500.00	95.00
合计			30,000.00	100.00

2016年12月26日，民和德元、青岛金控和青岛海丝签订《入伙协议》，约定青岛金控作为普通合伙人、青岛海丝作为有限合伙人入伙。同日，三方签订《合伙协议》，民和志威总认缴出资额变更为6,287.373万元，其中民和德元认缴出资额为277.50万元，青岛金控认缴出资额为5.55万元，青岛海丝认缴出资额为6,004.323万元。

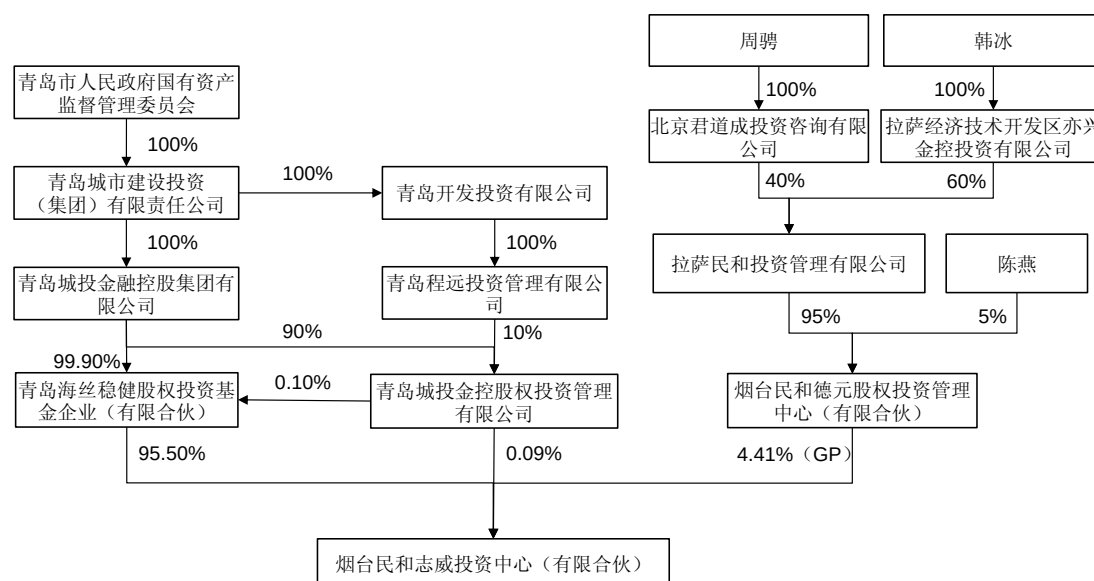
本次变更完成后，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	277.50	4.41
2	青岛城投金控股股权投资管理有限公司	普通合伙人	5.55	0.09
3	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	6,004.323	95.50
合计			6,287.373	100.00

本次变更完成后，民和志威合伙人出资情况未发生变更。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，民和志威的产权结构及控制关系如下：



4、合伙人的基本情况

（1）执行事务合伙人

1) 民和德元的基本情况

中文名称：烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：拉萨民和投资管理有限公司（委派代表：韩冰）

成立日期：2016 年 02 月 03 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 28 号科技大厦 349 室

办公地址：北京市东城区东直门外大街 39 号院 2 号楼 4 层

统一社会信用代码：91370600MA3C6BYR3K

经营范围：以自有资金对股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2016 年 2 月 3 日，民和德元由韩冰和拉萨民和投资管理有限公司共同设立，设立时合伙人出资额为 1,000 万元。其中，拉萨民和出资 850 万元，韩冰出资 150 万元。

2016 年 2 月 1 日，民和德元出具《认缴出资确认书》，确认全体合伙人于该日出资到位。

民和德元设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	韩冰	普通合伙人	150.00	15.00
2	拉萨民和投资管理有限公司	有限合伙人	850.00	85.00
合计			1,000.00	100.00

2016 年 5 月 10 日，经合伙人大会决定，同意将陈燕作为有限合伙人入伙，认缴出资份额为 45.15 万元；同意韩冰退伙；同意拉萨民和认缴出资额由 850 万

元变更为 857.85 万元；同意民和德元认缴出资额由 1,000 万元变更为 903 万元。同日，拉萨民和和陈燕签订了《入伙协议》，分别出具了同意陈燕入伙、韩冰退伙的《入伙同意书》和《退伙同意书》，并重新签订了《合伙协议》。2016 年 5 月 13 日，民和德元获得烟台市工商局开发区分局核发的《准予登记通知书》，并于同日完成工商变更登记手续。

2016 年 5 月 10 日，民和德元出具《认（实）缴出资确认书》，确认全体合伙人于该日出资到位。

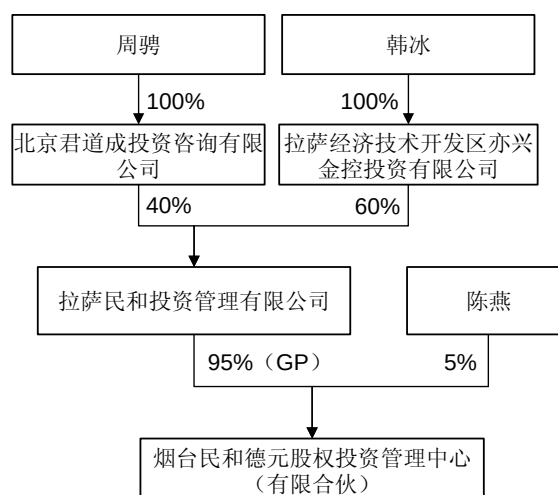
至此，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈燕	普通合伙人	45.15	5.00
2	拉萨民和投资管理有限公司	有限合伙人	857.85	95.00
合计			903.00	100.00

本次变更完成后，民和德元合伙人出资情况未发生变更。

3) 产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，民和德元的产权结构及控制关系如下：



4) 执行事务合伙人的基本情况

中文名称：拉萨民和投资管理有限公司

法定代表人：韩冰

成立日期：2015 年 12 月 24 日

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 4 栋 1 单元 1-1 号

统一社会信用代码：91540091MA6T13BLX5

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

5) 最近三年主营业务发展情况

民和德元主要业务为股权投资。

6) 最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	28,311,177.15
总负债	14,784,937.52
所有者权益	13,526,239.63
项目	2016 年度
营业收入	1,018,628.28
营业利润	-4,580.37
净利润	-3,760.37

注：以上财务数据未经审计；民和德元于 2016 年设立，因此仅披露最近一年财务数据。

7) 对外投资情况

截至本报告书出具日，民和德元除为民和志威普通合伙人外，民和德元的其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	烟台民和启君 投资中心（有限 合伙）	25,000.00	17.20	以自有资金对股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	烟台清芯民和 志威中心（有限	33,000.00	1.00	以自有资金对股权进行投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融

	合伙)			资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	烟台民和久信投资中心（有限合伙）	25,000.00	1.00	以自有资金对股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	北京民和祥投资管理中心（有限合伙）	30,000.00	1.00	投资管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2026年12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	烟台民和泰泰投资中心（有限合伙）	4,000.00	15.00	以自有资金对股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	上海民颐投资中心（有限合伙）	8,000.00	5.00	实业投资，投资咨询、财务咨询、商务信息咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7	青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	100,000.00	5.00	从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）有限合伙人

1）拉萨民和的基本情况

拉萨民和的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方”之“（四）烟台民和志威投资中心（有限合伙）”之“4、合伙人的基本情况”。

5、最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，除投资北京矽成和闪胜创芯外，民和志威并未开展实际经营业务。

6、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	56,711,402.35
总负债	159,315.00
所有者权益	56,552,087.35
项目	2016 年度
营业收入	0.00
营业利润	-1,302.65
净利润	-1,302.65

注：以上财务数据未经审计；民和志威于 2016 年设立，因此仅披露最近一年财务数据。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，民和志威除持有北京矽成 3.92%股权外，其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	0.85	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行股份募集配套资金之交易对方概况

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括名建致真在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10 名特定投资者。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

（一）杭州名建致真投资管理有限公司

1、名建致真基本情况

中文名称：杭州名建致真投资管理有限公司

法定代表人：朱一明

成立日期：2017 年 01 月 18 日

注册资本：5,000 万元人民币

企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

注册地址：上城区宋城路 5 号 146 室

办公地址：上城区宋城路 5 号 146 室

统一社会信用代码：91330102MA28LKB238

经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2017 年 1 月 18 日，名建致真由朱一明和李蕊彤出资设立，设立时注册资本为 5,000.00 万元。同日，名建致真取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330102MA28LKB238 的《营业执照》。

名建致真设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱一明	4,950.00	货币	99.00
2	李蕊彤	50.00	货币	1.00
合计		5,000.00	-	100.00

2017 年 2 月 8 日，名建致真召开 2017 年度第一次股东会会议，审议通过股权转让及修改公司章程的议案，同意李蕊彤将其认缴的 1.00% 股份转让予朱正，并修改公司章程。同日，李蕊彤和朱正签署《股权转让协议》。2017 年 2 月 15 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

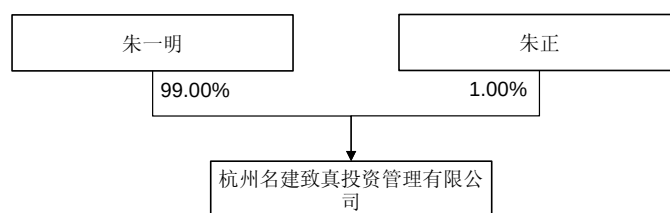
至此，名建致真股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱一明	4,950.00	货币	99.00
2	朱正	50.00	货币	1.00
合计		5,000.00	-	100.00

本次变更完成后，名建致真股权结构未发生变更。

3、产权及控制关系

截至本报告书出具日，名建致真的产权结构及控制关系如下：



4、控股股东基本情况

朱一明的基本情况详见“第二章 上市公司基本情况”之“七、上市公司控股股东和实际控制人情况”之“（二）上市公司控股股东基本情况”。

5、最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，名建致真尚未开展实际业务。

6、最近两年主要财务数据

名建致真设立于 2017 年 1 月 18 日，成立未满一个完整会计年度，暂无经营数据。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，名建致真不存在对外投资情况。

（二）其他不超过 9 名特定投资者

除名建致真外，公司拟向符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 9 名特定投资者，通过询价方式非公开发行股票募集配套资金。

三、交易对方之间的关联关系

截至本报告书出具日，交易对方之间不存在关联关系。

交易对方之间存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款所述的有关经济利益关系，具体如下：

1、关联方担保及反担保关系。为私有化收购之目的，上海承裕、华创芯原、华清闪胜于 2015 年 11 月 19 日与屹唐投资关联方亦庄国投签署《股权质押反担

保合同》，因亦庄国投为上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原私有化收购 ISSI 交易的并购贷款提供连带责任保证，上海承裕、华创芯原、华清闪胜分别将其所持北京矽成相应股权质押予亦庄国投以提供反担保。截至本报告书出具日，除华清闪胜因转让所持北京矽成全部股权而解除相关股权质押外，上海承裕所持北京矽成 39.087% 股权、华创芯原所持北京矽成 15.034%³仍质押予亦庄国投。

2、共同投资关系。上海承裕、屹唐投资、华创芯原及华清闪胜作为有限合伙人，与作为普通合伙人的联发科软件及联发软件设计于 2016 年 2 月合伙出资设立闪胜创芯。

3、关联方间接参股/出资关系。屹唐投资的有限合伙人战新基金作为有限合伙人，持有华创芯原股东北京集成电路投资中心、上海承裕合伙人承裕投资股东武岳峰浦江少数合伙财产份额/出资。

尽管存在上述经济利益关系，但基于以下原因和事实，交易对方之间不构成一致行动人：

1、前述关联方担保及反担保，系为私有化交易目的，作为交易对方收购资金来源中的银团并购贷款的保障措施。该等安排作为私有化交易融资方案组成部分，由亦庄国投为上海承裕、华创芯原、华清闪胜提供连带责任保证；上海承裕、华创芯原及华清闪胜向亦庄国投支付担保费及以股权质押提供反担保。该等安排具有商业合理性，亦是市场一般惯例，具有特定背景及专项性质。同时，作为北京矽成的股东，各交易对方均单独享有表决权，任一方不因前述担保及反担保安排而在北京矽成经营管理及决策层面形成任何一致默契或行动安排。

2、前述共同投资，系标的公司业务发展、资本运作及引入战略投资者的特定安排，由屹唐投资、上海承裕、华创芯原、华清闪胜等与联发科软件及联发软件设计合伙设立闪胜创芯并持有北京矽成相关股权。闪胜创芯的合伙事务由执行事务合伙人联发科软件执行，有限合伙人不参与管理或控制闪胜创芯的经营和事务。因此，上海承裕、屹唐投资、华创芯原及民和投资虽对闪胜创芯有共同投资，但不参与闪胜创芯合伙事务及重大事项决策，也不存在对闪胜创芯合伙事务的共

³ 2017 年 4 月 14 日，华创芯原与民和志威签署《关于北京矽成半导体有限公司之股权转让协议》，华创芯原将其持有的北京矽成 3.077% 股权转让予民和志威。该等股权上的质押解除登记程序尚待办理，下同。

同决策。

3、前述关联方间接参股/出资，系私募基金的正常投资行为，战新基金作为亦庄国投下属母基金运作平台，其主营业务为投资、资产管理及投资咨询等，包括投资其他公司或合伙企业。因此，其作为有限合伙人，对北京集成电路投资中心及武岳峰浦江的投资，属于经营范围内的投资行为。此外，根据相关合伙协议，战新基金不参与北京集成电路投资中心及武岳峰浦江的合伙事务及项目投资决策、未委派相关管理人员，不会对北京集成电路投资中心、武岳峰浦江及其控制的交易对方的重大事项决策产生决定性影响。

4、交易对方为不同的产业投资基金或投资机构，其作为财务投资人，代表不同投资人利益，具有各自独立的投资策略、投资模式和决策导向，不存在形成一致行动关系的主观意图和必要动机。在持有北京矽成相关股权期间，交易对方均独立行使股东权利及进行重大事项表决，不存在委托表决权等体现一致行动关系的事实、协议或其他安排，任一交易对方对标的公司经营及重大事项决策均无单一及决定性影响。

5、交易对方均已出具书面文件，就不达成有关一致行动关系、保持上市公司控制权稳定等事项作出相关声明及承诺；其中，上海承裕、屹唐投资进一步确认双方之间不存在未来转让本次交易所获上市公司股份(锁定期届满后)的意向或类似安排。

四、交易对方与上市公司关联关系情况

本次发行股份及支付现金的交易对方中，上海承裕、屹唐投资在本次交易完成后将成为上市公司持股比例 5%以上股东，且上述事项预计在十二个月内完成；发行股份募集配套资金的交易对方中，名建致真系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理朱一明控制的企业。除上述情形关系外，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况

截至本报告书出具日，本次交易的交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况。

六、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

截至本报告书出具日，本次交易的交易对方已分别出具承诺函，承诺该企业及其主要管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

七、交易对方及其主要管理人员诚信情况

截至本报告书出具日，本次交易的交易对方及其主要管理人员已出具承诺函，承诺其不存在有未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所纪律处分等不诚信情况。

八、交易对方穿透情况

上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威穿透至自然人、国有资产管理部/国有单位、股份有限公司及境外公司并剔除重复出资人后，共计120人，具体情况如下表所示：

序号	交易对方	穿透后最终出资人数量	备注
1	上海承裕	90	武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier、李国文、沈正宁、马砚秋、杜旭玉、郭广昌、梁信军、汪群斌、王水福、陈夏鑫、王天飞、欧阳凌霄、钱进、徐锟、任文泽、许月娟、赵关龙、倪信才、李水荣、李国庆、李永庆、王旭林、胡柏藩、崔欣荣、梁晓东、梁黎斌、张平一、石程、石观群、王学闻、袁益中、胡柏刻、胡梅友、陈世林、梁碧源、梁新中、王正江、余斌、胡季强、蔡芍英、解学军、冯晓刚、高瑞昌、门士伟、胡北、叶剑锋、陈德良、朱啸虎、杨志伟、韩思婷、邹婧、李磊、冀青、李凤娟、李玉山、万誉、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、上海国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海市嘉定区集体资产管理委员会、上海市嘉定区国有资产管理委员会、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财政厅、盐城市人民政府、嘉兴市国有资产管理委员会、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、中关村科技园区海淀园创业服务中心、浙江清华长三角研究院、嘉兴市投资基金管理中心、杭州市科学技术委员会、清华大学、浙江大学、兰溪市康大投资发展公司(集体企业)、国家集成电路产业投资基

			金股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、长江证券股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司、德邦证券股份有限公司、龙树资本管理股份有限公司、Digital Time Investment Limited、Gaintech Co.Limited、Shanghai (Z.J) Holdings Limited 及 Summit View Electronic Investment L.P.
2	屹唐投资	1	北京经济技术开发区国有资产管理办公室
3	华创芯原	34	刘越、张风华、马洪文、祝信标、黄飞、邱忠乐、赵森、孙玉望、王心然、乌岚、张莉、徐慧勇、徐海麟、劳燕燕、倪菊媛、汪桂荣、沈正宁、林童、姜明明、张洋、赵伟国、李义、李禄媛、李国文、秦岭、中关村科技园区海淀园创业服务中心、盐城市人民政府、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、清华大学、中关村发展集团股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、长安国际信托股份有限公司及 Semiconductor Manufacturing International Corporation
4	民和志威	4	陈燕、周骋、韩冰及青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
5	闪胜创芯	1	联发科技股份有限公司
合计		120（剔除重复）	

第四章 标的资产情况

本次交易的标的资产为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威等交易对方合计持有的北京矽成 100%股权。标的公司北京矽成及其下属子公司上海闪胜及闪胜科技均为交易对方为收购 ISSI 而出资设立的公司，北京矽成及其主要子公司的情况如下：

一、标的公司基本情况

（一）标的公司概况和历史沿革

1、北京矽成

（1）基本情况

公司名称：北京矽成半导体有限公司

法定代表人：许伟

成立日期：2014 年 11 月 02 日

注册资本：51,966.949 万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 715 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52-1 幢 3 层

统一社会信用代码：91110302318129402G

经营范围：设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）历史沿革

1) 设立（2014 年 11 月）

北京矽成原名北京闪胜投资有限公司。北京闪胜由外滩科技、常州新能聚及

中晶投资出资设立，注册资本为 1,000 万元。北京闪胜设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	深圳市外滩科技开发有限公司	400.00	货币	40.00
2	常州新能聚实业投资有限公司	300.00	货币	30.00
3	中晶投资管理（上海）有限公司	300.00	货币	30.00
合计		1,000.00	-	100.00

2014 年 11 月 2 日，北京闪胜取得了北京市工商行政管理局核发注册号为 110302018124675 的《营业执照》。

2）第一次股权转让（2015 年 3 月）

2015 年 3 月 6 日，经北京闪胜第一届第三次股东会决议，同意外滩科技将其对北京闪胜的 400 万元认缴出资额在原有股东间进行转让，其中转让予中晶投资 200 万元认缴出资额、转让予常州新能聚 200 万元认缴出资额，常州新能聚及中晶投资分别支付外滩科技 20 万元出资额转让款（对应 20 万元实收资本）。同日，外滩科技与中晶投资、常州新能聚签署了《出资转让协议》。

本次股权转让完成后，北京闪胜的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	常州新能聚实业投资有限公司	500.00	货币	50.00
2	中晶投资管理（上海）有限公司	500.00	货币	50.00
合计		1,000.00	-	100.00

2015 年 3 月 11 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

3）第二次股权转让（2015 年 9 月）

2015 年 9 月 1 日，经北京闪胜第二届第二次股东会会议决议，同意中晶投资将其对北京闪胜的 406.25 万元认缴出资额转让予上海承裕、将其对北京闪胜的 93.75 万元认缴出资额出资转让予屹唐投资，同意常州新能聚将其对北京闪胜的 187.50 万元认缴出资额转让予屹唐投资、将其对北京闪胜的 156.25 万元认缴出资额出资转让予华清闪胜及将其对北京闪胜 156.25 万元认缴出资额出资转让予华创芯原。同日，中晶投资、常州新能聚与上海承裕、屹唐投资、华清闪胜及华创芯原之间签署了关于北京闪胜股权转让的《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	406.25	货币	40.63
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	281.25	货币	28.13
3	北京华清闪胜科技有限公司	156.25	货币	15.63
4	北京华创芯原科技有限公司	156.25	货币	15.63
合计		1,000.00	-	100.00

2015 年 9 月 10 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

4）第一次增资（2015 年 11 月至 2016 年 7 月）

2015 年 11 月 12 日，经北京闪胜第三届第三次股东会会议决议通过，同意北京闪胜注册资本由 1,000 万元增加至 50,000 万元，其中上海承裕认缴的出资额增加至 20,312.50 万元、屹唐投资认缴的出资额增加至 14,062.50 万元、华清闪胜认缴的出资额增加至 7,812.50 万元及华创芯原认缴的出资额增加至 7,812.50 万元。2015 年 11 月 30 日，上述出资实缴到位。

本次增资完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	20,312.50	货币	40.63
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	14,062.50	货币	28.13
3	北京华清闪胜科技有限公司	7,812.50	货币	15.63
4	北京华创芯原科技有限公司	7,812.50	货币	15.63
合计		50,000.00	-	100.00

2016 年 7 月 27 日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

5）第二次增资（2016 年 8 月）

2016 年 1 月 11 日，经北京闪胜第四届第一次股东会会议决议，同意北京闪胜注册资本由 50,000 万元增加至 51,966.949 万元，同意增加股东闪胜创芯，增加的注册资本 1,966.949 万元全部由闪胜创芯认缴。2016 年 8 月 26 日，上述出资实缴到位。

本次增资完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	20,312.5000	货币	39.09
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	14,062.5000	货币	27.06
3	北京华清闪胜科技有限公司	7,812.5000	货币	15.03
4	北京华创芯原科技有限公司	7,812.5000	货币	15.03
5	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	1,966.9490	货币	3.79
合计		51,966.9490	-	100.00

2016年8月8日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

6) 公司名称及营业范围变更（2016年11月）

2016年8月19日，北京市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（(京开)名称变核(内)字[2016]第 0037860 号），预先核准公司名称为“北京矽成半导体有限公司”。

2016年11月7日，北京矽成召开股东会会议，全体股东一致同意公司名称变更为“北京矽成半导体有限公司”；公司经营范围变更为“设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，并相应修改公司章程。

2016年11月30日，本次公司名称及营业范围变更的工商变更登记手续办理完毕。

7) 第三次股权转让（2016年12月）

2016年12月27日，北京矽成召开第四届第六次股东会会议，全体股东一致同意：股东华清闪胜将其持有的北京矽成 10.10%的股权转让给屹唐投资，将其持有的北京矽成 4.09%的股权转让给上海承裕，并将其持有的北京矽成 0.85%的股权转让给民和志威。公司其他股东均同意本次股权转让，并放弃其优先购买权。

2016年12月27日，华清闪胜分别与屹唐投资、上海承裕和民和志威签署

《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

本次股权转让完成后，北京矽成的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)	22,435.4620	货币	43.17
2	北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)	19,312.1603	货币	37.16
3	北京华创芯原科技有限公司	7,812.5000	货币	15.03
4	上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)	1,966.9490	货币	3.79
5	烟台民和志威投资中心(有限合伙)	439.8777	货币	0.85
合计		51,966.9490	-	100.00

8) 第四次股权转让（2017 年 4 月）

2017 年 4 月 14 日，北京矽成召开股东会会议，全体股东一致同意华创芯原将其持有的北京矽成 3.0769% 股权，即 15,989,830.46 元出资以 200,000,000 元的价格转让予民和志威，其他股东均放弃相应优先购买权，并相应修改公司章程。同日，华创芯原与民和投资签署《关于北京矽成半导体有限公司之股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

截至本报告书出具日，北京矽成尚待办理上述股权转让的工商变更登记手续。该等股权转让完成后，北京矽成的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)	22,435.4620	货币	43.17
2	北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)	19,312.1603	货币	37.16
3	北京华创芯原科技有限公司	6,213.5170	货币	11.96
4	上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)	1,966.9490	货币	3.79
5	烟台民和志威投资中心(有限合伙)	2,038.8607	货币	3.92
合计		51,966.9490	-	100.00

本次变更完成后，北京矽成之股权结构未发生变化。

(3) 最近三年主营业发展情况

北京矽成是交易对方为收购 ISSI 而出资的公司，前次收购完成后，公司主

营业务通过 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及其下属子公司开展，除此之外暂无其他实际经营业务。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

北京矽成主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

（5）北京矽成对外投资情况

截至本报告书出具日，北京矽成对外投资情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	证照编号	业务性质	成立时间	注册地	股东名称	持股比例（%）
1	上海闪胜集成电路有限公司	96,000 万元人民币	913100003510082079	贸易	2015 年 7 月 27 日	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 1270 室	北京矽成半导体有限公司	100
2	Uphill Technology Inc.	50,000 股	OI-303532	控股	2015 年 8 月 27 日	OffshoreIncorporations (Cayman) Limited, P. O. Box 31119, Grand Pavilion, HibiscusWay, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands.	上海闪胜集成电路有限公司	100
3	Integrated Silicon Solution, Inc.	1,000 股	2339695	贸易	1993 年 6 月 10 日	1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801	Uphill Technology Inc.	100
4	Si En Integration Holdings Limited	6,000,000 股不可赎回的有投票权投资人股；及 8,050,750 股可赎回的有投票权员工股	142978	控股	2004 年 12 月 14 日	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands	Uphill Technology Inc.	100
5	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	100 股	265305	制造	2012 年 1 月 3 日	MaplesCorporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street,George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.	Uphill Technology Inc.	100

6	Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.	1,000 股 A 类股、1,073 股 B 类股	311090	贸易	2016 年 5 月 3 日	Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands	Uphill Technology Inc.	51.76
							Integrated Silicon Solution, Inc.	48.24
7	Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.	1,000 股 A 类股、1,042 股 B 类股	311091	贸易	2016 年 5 月 3 日	Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands	Uphill Technology Inc.	51.03
							Integrated Silicon Solution, Inc.	48.97
8	硅成集成电路股份有限公司	新台币 380,000 元	22099630	贸易	1990 年 9 月 10 日	新竹市光复路 2 段 2 巷 49-2 号 3 楼	Integrated Silicon Solution, Inc.	92.50
							Winston Inc.	2.87
							Sofwin Inc.	2.81
							硅成集成电路股份有限公司	0.09
9	Winston Inc.	1,000 万股	C2506289	控股	2013 年 4 月 17 日	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305	Integrated Silicon Solution, Inc.	100
10	Sofwin Inc.	1,000 万股	C2506290	控股	2013 年 4 月 17 日	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305	Integrated Silicon Solution, Inc.	100
11	Enable Korea Co., Ltd	50,000,000 万韩元	214-87-63148	贸易	2014 年 11 月 11 日	韩国京畿道城南市盆唐区城南大路 69,710 号	Integrated Silicon Solution, Inc.	100
12	Chingis Technology Corporation	60 万股	C1948880	产品开发	1995 年 9 月 20 日	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305	Integrated Silicon Solution, Inc.	100
13	英属开曼群岛商硅成科技股份有限公司（分公司）	5 万美元	53665841	贸易	2013 年 2 月 22 日	新北市汐止区新台五路 1 段 106 号 7 楼	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	100
14	芯成积体电路（香港）有限公司	20,410 股	353307	贸易	1997 年 1 月 5 日	Unit 801-5, 8/F., Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	99.9951
15	ISSI Hong Kong Holding Limited	71,365,753 股	1173155	控股	2007 年 10 月 5 日	Unit 5-6, 7/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	100

16	Integrated Silicon Solution, Inc (Singapore) Pte. Limited	1 股	201308246K	贸易	2013 年 3 月 28 日	51 Bukit Batok Crescent #08-33 Unity Centre Singapore 658077	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	100
17	ISSI Japan Godo Kaisha	1,000 万日元	-	贸易	1999 年 10 月 1 日	东京都新宿区西新宿六丁目 14 番 1 号新宿 GREEN TOWER BUILDING 18 层	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	100
18	Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.	50,000 美元	454903734829	贸易	2016 年 10 月 28 日	Offshore Incorporations (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands	Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.	100
19	Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.	50,000 美元	606168412058	贸易	2016 年 10 月 28 日	Offshore Incorporations (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands	Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.	100
20	矽恩微电子（厦门）有限公司	70 万美元	91350200769267863D	产品研发	2005 年 3 月 23 日	厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 8 楼	Si En Integration Holdings Limited	100
21	Enchida International Limited	10,000 股	957358	贸易	2005 年 3 月 21 日	Unit A, 2/F., Trust Tower, 68 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	Si En Integration Holdings Limited	100
22	芯成半导体（上海）有限公司	1,791.25 万美元	913100006074199240	产品开发	2000 年 9 月 15 日	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 25 号全幢	ISSI Hong Kong Holding Limited	100

注 1：出于税务结构优化考虑，北京矽成于 2016 年 11 月完成内部股权架构调整，ISSI Cayman 和 Si En Cayman 由 ISSI 子公司调整为 ISSI 兄弟公司；注 2：截至本报告书出具日，ISSI 子公司 Winston Inc.和 Sofwin Inc.已经停业。

2、上海闪胜

（1）基本情况

公司名称：上海闪胜集成电路有限公司

法定代表人：朱慧

成立日期：2015 年 7 月 27 日

注册资本：96,000.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 1270 室

统一社会信用代码：913100003510082079

经营范围：集成电路及芯片的设计、研发，通讯设备、电子产品、计算机硬件的设计、研发，计算机软件的设计、研发、制作，并提供上述相关领域内的技术咨询、技术服务及技术转让，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，集成电路、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）历史沿革

1）设立（2015 年 7 月）

2015 年 7 月 27 日，北京闪胜出资设立了上海闪胜并制定了上海闪胜的《公司章程》，注册资本为 5,000.00 万元，北京闪胜为唯一的出资人。

2015 年 7 月 27 日，上海闪胜就公司设立办理了工商登记，领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》。

上海闪胜设立之时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京闪胜投资有限公司	5,000.00	货币	100.00
合计		5,000.00	-	100.00

2）第一次增资（2015 年 11 月）

2015 年 11 月 10 日，上海闪胜注册资本增至 96,000.00 万元，均由北京闪胜以货币资金形式增资。

至此，上海闪胜的股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	北京闪胜投资有限公司	96,000.00	货币	100.00
合计		96,000.00	-	100.00

本次变更完成后，上海闪胜的股权结构未发生过变更。

（3）最近三年主营业务发展情况

上海闪胜系为收购 ISSI 而通过北京矽成出资设立的公司，主营业务通过 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及其下属子公司开展，除此之外暂无其他实际经营业务。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

上海闪胜主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

（5）上海闪胜对外投资情况

截至本报告书出具日，除闪胜科技及其下属子公司外，上海闪胜不存在其他对外投资情况。

3、闪胜科技

（1）基本情况

公司名称：Uphill Technology Inc.

董事：许伟

成立日期：2015 年 8 月 27 日

股本：50,000 股普通股

企业性质：有限责任公司

注册地址：Offshore Incorporations (Cayman) Limited, P. O. Box 31119, Grand Pavilion, HibiscusWay, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands.

公司编号：OI-303532

经营范围：无明确限制

（2）历史沿革

1) 设立（2015 年 8 月）

2015 年 8 月 27 日,OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 及上海闪胜设立闪胜科技, OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 持有 1 股普通股, 上海闪胜持有 49,999 股普通股。

2) 第一次股权转让 (2015 年 8 月)

2015 年 8 月 27 日,OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 将其持有的闪胜科技 1 股普通股转让予上海闪胜。

本次股权转让完成后, 闪胜科技的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	股本	出资比例 (%)
1	上海闪胜集成电路有限公司	50,000.00	100.00
合计		50,000.00	100.00

本次股权转让完成后, 闪胜科技的股权结构未发生过变更。

(3) 最近三年内主营业务情况

截至本报告书出具日, 闪胜科技主营业务通过 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及其下属子公司开展, 除此之外暂无其他实际经营业务。

(4) 主要资产、负债及对外担保情况

闪胜科技主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“(三) 标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

(5) 闪胜科技对外投资情况

截至本报告书出具日, 除 ISSI、ISSI Cayman 和 Si En Cayman 及上述公司的下属子公司外, 闪胜科技不存在其他对外投资情况。

4、ISSI

(1) 基本情况

公司名称: Integrated Silicon Solution, Inc.

成立日期: 1993 年 6 月 10 日⁴

⁴ 根据 ISSI 的说明, ISSI 最初在美国加利福尼亚州注册并随后在美国特拉华州重新注册,

注册的股本：1,000 股普通股，每股面值 0.001 美元

发行的股本：100 股普通股

注册地址： 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801

公司编号：2339695

经营范围：在特拉华州普通公司法下可经营任何合法业务。

（2）历史沿革

1）设立（1993 年 6 月）

ISSI 设立于 1993 年 6 月 10 日。

2）首次公开发行股票及上市（1995 年 2 月）

1995 年 2 月 3 日，ISSI 完成首次公开发行股票申报后，其股票于纳斯达克上市。ISSI 公开发行上市的 345 万股普通股股票中，包括 ISSI 发行的 150 万股新股、部分原股东公开转让的 150 万股股票以及承销商被授予的 45 万股普通股股票配售选择权。首次公开发行股票及上市完成后，ISSI 的股份总数为 16,593,187 股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Wearnes Technology Pte, Ltd. (beneficially owned by Chun Win Wong)	10.7%
2	Other Selling Stockholders, each owning less than 1% of the outstanding Common Stock prior to the offering	7.0%
3	Joseph Liu	5.0%
4	International Venture Capital Investment Corporation (beneficially owned by Lip Bu Tan)	4.3%
5	Jimmy Lee	3.1%
6	Chiu-Tzu Yao	2.9%
7	Shuhbin King	2.8%
8	United Microelectronics Corporation	2.4%
9	Hou-Teng Lee	2.0%
10	Kong-Yeu Han	1.8%
11	Hung-Liang Hsieh	1.6%
12	Vision Holdings, Ltd.	1.6%

本报告中 ISSI 的成立时间为其重新注册的时间。

13	Shin-Sheng Lin	1.3%
14	Ming-Kang Hsu	1.1%
15	其他公众股东	52.4%

3) 发行股份合并 Nexcom Technology, Inc. （1997 年 12 月）

1997 年 12 月 3 日, ISSI 发行 772,693 万股普通股股份, 换股吸收合并 Nexcom Technology, Inc.。上述合并交易完成后, 截至 1998 年 12 月 1 日, ISSI 的股份总数为 19,417,827 股, 其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Jimmy Lee	2.5%
2	Chun Win Wong	2.9%
3	Kong-Yeu Han	2.2%
4	Lip-Bu Tan	2.0%
5	其他公众股东	90.4%

4) 公开发行股票（2000 年 1 月至 2000 年 3 月）

2000 年 1 月至 3 月期间, ISSI 公开发行 3,795,000 股普通股股票（包括授予承销商 49.5 万股普通股股票的超额配售选择权）。上述公开发行股票完成后, 截至 2000 年 12 月 12 日, ISSI 的股份总数为 25,833,848 股, 其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Pilgrim Baxter & Associates	5.9%
2	Dreyfus Corporation	5.4%
3	Jimmy Lee	1.6%
4	Chun Win Wong	1.4%
5	Lip Bu Tan	1.0%
6	其他公众股东	84.7%

5) 发行股份收购 Purple Ray, Inc.（2002 年 2 月至 2003 年 8 月）

2002 年 2 月 13 日, ISSI 发行 438,281 股普通股股份, 用于收购 Purple Ray, Inc.。上述收购交易完成后, 截至 2002 年 12 月 10 日, ISSI 的股份总数为 27,576,761 股, 其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Berger, LLC	12.4%
2	Dreyfus Corporation	8.7%
3	Fidelity Management & Research	6.2%
4	Jimmy Lee	1.7%
5	其他公众股东	71%

2003年8月7日,ISSI 额外发行 8,241 股普通股股份,用于完成对 Purple Ray, Inc.的后续收购。截至 2003 年 12 月 31 日,ISSI 的股份总数为 28,889,442 股,其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Barclays Global Investors	6.6%
2	Jimmy Lee	2.1%
3	Gary Fischer	1.1%
4	其他公众股东	90.2%

6) 公开发行股票(2004 年 1 月至 2004 年 3 月)

2004 年 1 月至 3 月期间,ISSI 公开发行 6,025,000 股普通股股票。上述公开发行股票完成后,截至 2004 年 12 月 6 日,ISSI 的股份总数为 36,256,285 股,其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	State Street Research & Management Company	7.6%
2	Jimmy Lee	1.8%
3	其他公众股东	90.6%

7) 发行股份收购 Chingis 部分股权(2014 年)

2014 年,ISSI 修改公司章程并授权 ISSI 发行 324 股第一级可赎回优先股股票,用于收购彼时控股子公司 Chingis 全部剩余股权。截至 2015 年 4 月 20 日,ISSI 的股份总数为 31,659,170 股,其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	Starboard Value LP	9.7%
2	Royce and Associates	7.9%
3	Donald Smith & Co, Inc.	6.4%

序号	股东名称	持股比例(%)
4	Dimensional Fund Advisors LP	6.2%
5	BlackRock Fund Advisors LP	6.2%
6	Jimmy Lee	1.1%
7	Kong-Yeu Han	1.1%
8	James Han	1.1%
9	其他公众股东	60.3%

8）私有化收购（2015 年）

2015 年，闪胜科技向 ISSI 全体股东收购 ISSI 100%股权，ISSI 从纳斯达克退市。私有化收购完成后，闪胜科技持有 ISSI 100%股权，系 ISSI 单一股东。私有化收购的具体情况如下：

①私有化收购进程

2015 年 3 月 12 日，武岳峰浦江、京存技术、北京集成电路投资中心、华清基业与北京闪胜签署《关于北京闪胜投资有限公司之投资协议》，约定各方以其关联方（即上海承裕、屹唐投资、华创芯原、华清闪胜）共同投资北京闪胜，并通过北京闪胜私有化收购 ISSI。

2015 年 3 月 12 日，ISSI 董事会批准北京闪胜与 ISSI 达成的《合并协议与计划》。根据收购交易方案，北京闪胜于美国特拉华州设立并购子公司，以 19.25 美元/股的价格通过反向三角并购的方式对 ISSI 进行私有化收购；私有化收购完成后，ISSI 吸收合并并购子公司，并作为北京闪胜的间接全资子公司继续存续，ISSI 停止上市，其全部流通股股份（但根据特拉华州普通公司法而享有且适当行使现金选择权的股东所持有的股份除外）进行撤销，并转化为 19.25 美元/股的现金请求权。

2015 年 3 月 12 日，ISSI 与北京闪胜签署《合并协议》；2015 年 4 月 28 日，ISSI 与北京闪胜及并购子公司签署《合并协议的补充协议一》，就 ISSI 下属部分中国台湾资产的交割事宜及安排进行约定；2015 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 18 日及 2015 年 6 月 22 日，ISSI 与北京闪胜及并购子公司分别签署《合并协议的补充协议二》、《合并协议的补充协议三》、《合并协议的补充协议四》及《合并协议的补充协议五》，同意将私有化收购的交易对价依次提高至

20 美元/股、21 美元/股、22 美元/股及 23 美元/股。

2015 年 6 月 29 日，ISSI 召开特别股东大会，审议通过《合并协议》及其全部补充协议。

2015 年 12 月 7 日，私有化收购完成交割相关事宜，ISSI 成为北京闪胜间接全资子公司。

②私有化收购涉及的境内外审批/监管程序

2015 年 11 月 2 日，北京闪胜就私有化收购相关事宜通过 CFIUS 安全审查。

2015 年 11 月 24 日，ISSI 就私有化收购涉及的中国台湾业务相关事宜取得台湾投审会的批准。

2015 年 11 月 24 日，国家发展和改革委员会出具《项目备案通知书》（发改办外资备[2015]382 号），同意对上海闪胜收购 ISSI 全部股权项目予以备案。

2015 年 11 月 24 日，中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具沪境外投资[2015]N00918 号文件，同意上海闪胜的境外投资相关事宜；2015 年 11 月 24 日，中国(上海)自由贸易试验区管理委员会向上海闪胜核发《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3100201500919 号)。

2015 年 11 月 27 日，上海浦东发展银行金桥支行出具《业务登记凭证》，经国家外汇管理局上海市分局同意，办理上海闪胜跨境资金汇付相关事宜。

2015 年 12 月 14 日，ISSI 向美国证券交易委员会提交退市证书及通知，正式退市。

③私有化收购涉及的股东诉讼

2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 8 日，ISSI 股东 Richard Wilson III、Matthew Sciabacucchi 及 Kathy Guerra 分别提起股东代表诉讼，主张 ISSI 董事在私有化收购过程中违反了董事勤勉义务，请求撤销私有化收购安排。2015 年 5 月，法院裁定就前述三起诉讼进行合并审理。2015 年 9 月 24 日，法院驳回上述诉讼案件的诉讼请求。

私有化收购完成后，ISSI 的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资方式	出资比例（%）
1	Uphill Technology Inc.	1.00	货币	100.00
合计		1.00	-	100.00

私有化收购完成后，ISSI 的股权结构未发生过变更。

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，ISSI 的主营业务为存储芯片类产品的研发和运营。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

ISSI 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

（5）ISSI 对外投资情况

截至本报告书出具日，除 Winston Inc.、Sofwin Inc.、硅成集成电路股份有限公司、Enable Korea Co., Ltd、Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.、Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.及上述公司的下属子公司外，ISSI 不存在其他对外投资情况。

5、ISSI Cayman

（1）基本情况

公司名称：Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.

董事：John M. Cobb、Kong-Yeu Han

成立日期：2012 年 1 月 3 日

股本：100 股普通股

企业性质：有限责任公司

注册地址：Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.

公司编号：265305

经营范围：开曼群岛法律不禁止的任何业务

（2）历史沿革

1）设立（2012 年 1 月）

2012 年 1 月 3 日, Maples Corporate Services Limited 及 ISSI 设立 ISSI Cayman, Maples Corporate Services Limited 持有 1 股普通股、ISSI 持有 1 股普通股。

ISSI Cayman 设立时, ISSI Cayman 的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	Maples Corporate	1	普通股
2	ISSI	1	普通股

2）股权转让（2012 年 1 月）

2012 年 1 月 3 日, Maples Corporate Services Limited 将其持有的 1 股普通股转让予 ISSI。

3）重新发行股份（2015 年 7 月）

2015 年 7 月 16 日, ISSI Cayman 重新发行股份, ISSI Cayman 总股本变更为 100 股普通股, ISSI 持有 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

4）股权转让（2016 年 10 月）

2016 年 10 月 17 日, ISSI 将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予 Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.。上述股权转让完成后, Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.持有 ISSI Cayman 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

5）股权转让（2016 年 12 月）

2016 年 12 月 6 日, Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予 Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.。上述股权转让完成后, Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.持有 ISSI Cayman 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

2016 年 12 月 6 日, Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予闪胜科技。上述股权转让完成后, 闪胜科技持有 ISSI Cayman 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，ISSI Cayman 的主营业务为存储芯片类产品的销售。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

ISSI Cayman 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

（5）ISSI Cayman 对外投资情况

截至本报告书出具日，除 Integrated Silicon Solution, Inc (Singapore) Pte. Limited、英属开曼群岛商硅成科技股份有限公司（分公司）、芯成积体电路(香港)有限公司、ISSI Hong Kong Holding Limited、ISSI Japan Godo Kaisha 及上述公司的下属子公司外，ISSI Cayman 不存在其他对外投资情况。

6、Si En Cayman

（1）基本情况

公司名称：Si En Integration Holdings Limited

董事：Kong-Yeu Han、Jimmy Shueh-Mien Lee

成立日期：2004 年 12 月 14 日

股本：6,000,000 股不可赎回的有投票权投资人股（“投资人股”）；及 8,050,750 股可赎回的有投票权员工股（“员工股”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

公司编号：142978

经营范围：开曼群岛法律不禁止的任何业务

（2）历史沿革

1) 设立（2004 年 12 月）

2004 年 12 月 14 日，Sai Luen Ting、Shan Guan、Apex Achieve International Limited、Offshore Incorporations (Cayman) Limited 设立 Si En Cayman，其中 Sai Luen Ting 持有 4,111,110 股员工股、Shan Guan 持有 3,288,889 股员工股、Apex Achieve International Limited 持有 6,000,000 股投资人股、Offshore Incorporations (Cayman) Limited 持有 1 股员工股。Si En Cayman 设立完成后，Si En Cayman 股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	Sai Luen Ting	4,111,110	员工股
2	Shan Guan	3,288,889	员工股
3	Apex Achieve	6,000,000	投资人股
4	Offshore Incorporations	1	员工股

2) 股权转让（2007 年 8 月）

2007 年 8 月 15 日，Apex Achieve International Limited 将其持有的 150,000 股投资人股转让予 Jianliang Xu、150,000 股投资人股转让予 Qifang Yuan。

上述股权转让完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	Sai Luen Ting	4,111,110	员工股
2	Shan Guan	3,288,889	员工股
3	Apex Achieve	5,700,000	投资人股
4	Jianliang Xu	150,000	投资人股
5	Qifang Yuan	150,000	投资人股
6	Offshore Incorporation	1	员工股

3) 股权转让、股份发行及股份回购（2011 年 1 月）

2011 年 1 月 13 日，Offshore Incorporations (Cayman) Limited 将其持有的 1 股员工股转让予 Sai Luen Ting。

2011 年 1 月 13 日，Sai Luen Ting 将其持有的 100,000 股员工股转让予 Qifang Yuan、50,000 股员工股转让予 Dandan Wu Daniel、200,000 股员工股转让予 Xi Jia Ding、250,000 股员工股转让予 Andrew Hua Ting、50,000 股员工股转让予 De Xu、266,667 股员工股转让予 Active Minds International Limited。

2011 年 1 月 13 日, Shan Guan 将其持有的 100,000 股员工股转让予 Ming Duenn Ni、将其持有的 50,000 股员工股转让予 Dandan wu Danie、将其持有的 330,000 股员工股转让予 Cindy Guan, 将其持有的 50,000 股员工股转让予 De Xu; 将其持有的 333,333 股员工股转让予 Active Minds International Limited。

2011 年 1 月 15 日, Active Minds International Limited 认购 Si En Cayman 发行的 1,200,000 股员工股。

上述股权转让完成后, Si En Cayman 的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	Sai Luen Ting	3,194,444	员工股
2	Shan Guan	2,425,556	员工股
3	Apex Achieve	5,700,000	投资人股
4	Jianliang Xu	150,000	投资人股
5	Qifang Yuan	150,000	投资人股
		100,000	员工股
6	Dandan Wu Daniel	100,000	员工股
7	Xi Jia Ding	200,000	员工股
8	Andrew Hua Ting	250,000	员工股
9	De Xu	100,000	员工股
10	Active Minds	1,800,000	员工股
11	Ming Duenn Ni	100,000	员工股
12	Cindy Guan	330,000	员工股

2011 年 1 月 26 日, Si En Cayman 回购 Active Minds International Limited 持有的 549,250 股员工股。

2011 年 1 月 31 日, Sai Luen Ting 将其持有的 3,194,444 股员工股、Shan Guan 将其持有的 2,425,556 股员工股、Apex Achieve International Limited 将其持有的 5,700,000 股投资人股、Jianliang Xu 将其持有的 150,000 股投资人股、Qifang Yuan 将其持有的 150,000 股投资人股及 100,000 股员工股、Dandan Wu Daniel 将其持有的 100,000 股员工股、Xi Jia Ding 将其持有的 200,000 股员工股、Andrew Hua Ting 将其持有的 250,000 股员工股、De Xu 将其持有的 100,000 股员工股、Ming Duenn Ni 将其持有的 100,000 股员工股、Cindy Guan 将其持有的 330,000 股员工

股、Active Minds International Limited 将其持有的 1,250,750 股员工股转让予 ISSI。

上述回购及股权转让完成后，ISSI 持有 Si En Cayman 8,050,750 股员工股及 600,000,000 股投资人股。

4) 股权转让（2016 年 10 月）

2016 年 10 月 17 日，ISSI 将其持有的 600,000,000 股投资人股及 8,050,750 股员工股转让予 Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.。

上述股权转让、股份发行及股份回购完成后，Si En 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.	6,000,000	投资人股
2	Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.	8,050,750	员工股

5) 股权转让（2016 年 12 月）

2016 年 12 月 6 日，Integrated Analog Solution (Cayman), Inc. 将其持有的 600,000,000 股投资人股及 8,050,750 股员工股转让予 Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.。

2016 年 12 月 6 日，Analog Circuit Solution (Cayman), Inc. 将其持有的 6,000,000 股投资人股及 8,050,750 股员工股转让予闪胜科技。

上述股权转让、股份发行及股份回购完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	Uphill Technology Inc.	6,000,000	投资人股
2	Uphill Technology Inc.	8,050,750	员工股

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，Si En Cayman 的主营业务为 ANALOG 产品的研发、销售和运营。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

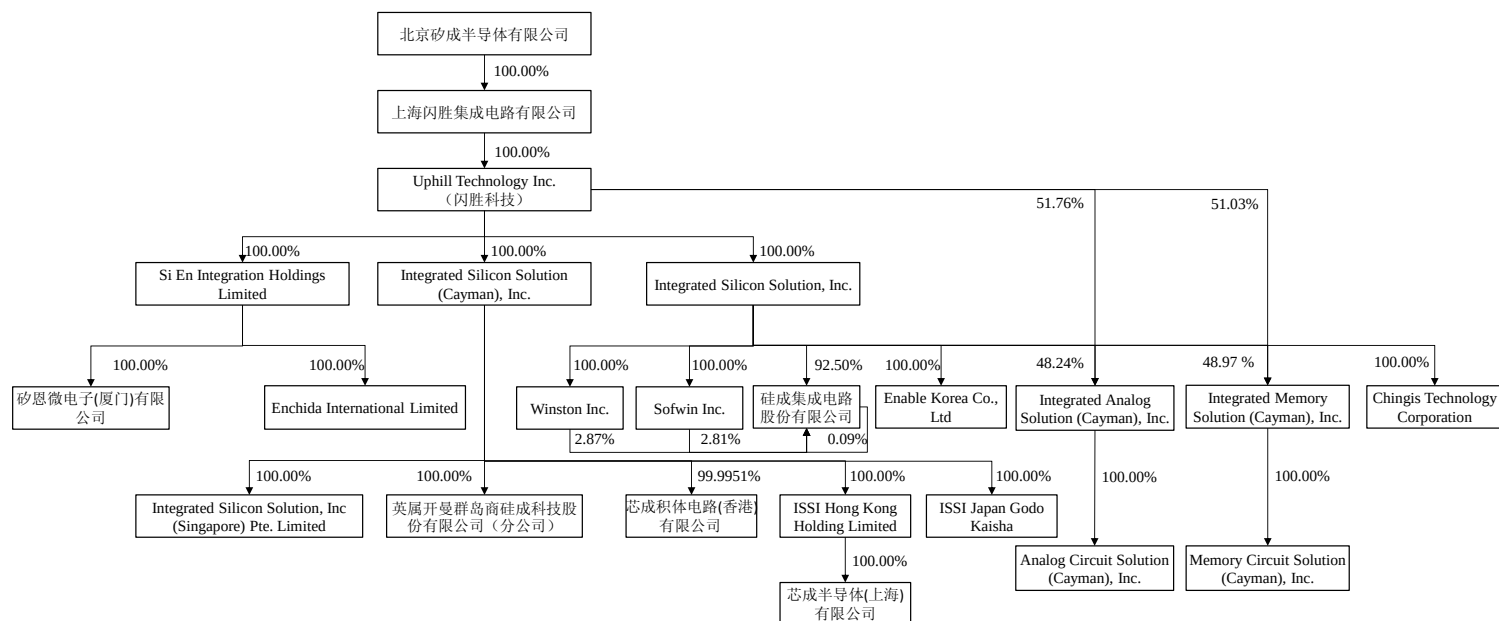
Si En Cayman 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中合并披露。

（5）Si En Cayman 对外投资情况

截至本报告书出具日，除矽恩微电子(厦门)有限公司、Enchida International Limited 及上述公司的下属子公司外，Si En Cayman 不存在其他对外投资情况。

（二）标的公司产权结构及控制关系

1、产权关系图



注 1：上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威的产权关系图请参见“第三章 交易对方基本情况”相应章节；北京矽成下属子公司上海闪胜、闪胜科技、ISSI、ISSI Cayman 和 Si En Cayman 详细情况请参见“第四章 标的资产情况”相应章节

注 2：ISSI 持有 Integrated Analog Solution (Cayman), Inc. 1,000 股 A 类普通股，闪胜科技持有 1,073 股 B 类普通股；ISSI 持有 Integrated Memory Solution (Cayman), Inc. 1,000 股 A 类普通股，闪胜科技持有 1,042 股 B 类普通股，上图仅显示股份比例

2、控股股东及实际控制人

截至本报告书出具日，北京矽成之全部股东为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威，其持有北京矽成股权的比例分别为 43.17%、37.16%、11.96%、3.79%及 3.92%，北京矽成无控股股东及实际控制人。

3、标的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或其他相关投资协议

北京矽成公司章程中存在可能对本次交易产生影响的条款如下：“除非取得全体股东的事先书面同意外，任一股东不得以任何方式将其所持公司的股权处置（包括但不限于直接或间接进行出售、赠予、质押、设定产权负担或以其他方式

加以处分，以下统称“转让”）给股东以外的第三方。”

经北京矽成分别于 2017 年 2 月 13 日和 2017 年 4 月 17 日召开的股东会审议通过，北京矽成全体股东同意本次收购事宜，并同意放弃优先购买权，因此上述条款不再对本次交易产生影响。

北京矽成不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。北京矽成及其子公司不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。

4、标的公司原高管和核心人员的安排

截至本报告书出具日，根据本次交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易涉及北京矽成股东变动，不涉及北京矽成聘用人员劳动关系的调整变更。

（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产的权属情况

截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成的固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	21,101.33	6,089.01	15,012.32
机器设备	53,658.27	38,446.21	15,212.06
家具设备	2,030.83	1,470.52	560.31
合计	76,790.44	46,005.74	30,784.70

（1）房屋所有权

1）已取得房屋所有权证的房屋

截至本报告书出具日，北京矽成其子公司已取得房屋所有权证的房屋情况如下表所示：

序号	房屋所有权人	相关证书编号	用途	房屋座落	建筑面积 (m²)
1	芯成半导体 (上海)有限公司	沪房地浦字(2014)第 055674 号	厂房	锦绣东路 2777 弄 25 号全幢	2,871.41

2	芯成半导体（上海）有限公司	苏房权证园区字第00502286号	非住宅	苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心1幢1703室	898.76
3	ISSI	--	--	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA	5,166.52
4	ICSI TW	088 汐建电字第 018441 号	工业用	新北市汐止区吴天段 00639-000 建号	585.38

2) 房屋租赁情况

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司的房屋租赁情况如下表所示：

序号	承租人	出租人	座落地址	租赁期限	租赁面积 (平方米)	租赁用途	房屋权属证书/证明文件
1	芯成半导体(上海)有限公司	夏橙	武汉市光谷中心花园A栋写字楼14层10号	2017.04.07-2019.04.06	54.96	办公场所	武房权证湖字第2011012649号
2	芯成半导体(上海)有限公司	张伟	南京市建邺区奥体大街130号02幢1703	2015.11.16-2017.11.15	76.81	办公场所	宁房权证建转字第517888号
3	芯成半导体(上海)有限公司	上海华虹置业有限公司	上海市浦东新区锦绣东路2777弄	2015.03.01-2018.02.28	18.5	机房	沪房地浦字(2013)第055639号
4	矽恩微电子(厦门)有限公司	厦门软件产业投资发展有限公司	厦门火炬高新区软件园创新大厦A区#801、803、804	2015.02.08-2018.02.07 [注1]	357.47 378.25 473.69	办公场所	厦国土房证第00938701号
5	芯成半导体(上海)有限公司	尤永寿	深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼4206	2016.09.01-2019.08.31	303.75	办公场所	深房地字第3000664963号
6	北京矽成	北京亦庄移动硅谷有限公司 [注2]	北京市经济开发区景园北街2号52-1幢3层	2016.07.11-2019.07.10	514	办公场所	X京房权证开字第009873号
7	ISSI	Nor'wood Limited, Inc.,	2060 Briargate Parkway, Suite 315, Colorado Springs, CO	2014.04.03-2019.04.30	约496.66	办公场所	--
8	ICSI TW	长春藤建设股份有限公司	新竹市光复路二段二巷49-2号49-3号	2016.08.01-2018.07.31	约764.5	办公场所	建物登记第二类誊本
9	Enable Korea Co., Ltd	Sungdo Energy 株式会社	京畿道城南市盆唐区城南大路69709号	2016.12.24-2018.12.24	约160.1	办公场所	--

10	Enable Korea Co., Ltd	Victek 株式会社	京畿道城南市盆唐区城南大路 69 710 号	2016.11.16-2018.11.15	约 714.22	办公场所	--

注 1：第 4 项租赁合同到期后，若租赁双方无异议，合同则自动按年顺延两次。

注 2：第 6 项合同项下房屋所有权人为亦庄国投，北京亦庄移动硅谷有限公司享有使用权及租赁权。

上述租赁房屋的主要用途为办公场所，其租赁成本较低，可替代性较强，相关公司可根据实际情况及需求采取续租或承租其他类似场所等灵活处理方式；该等租赁房屋不存在难以搬迁的大型仓储、运输等设备，搬迁成本与难度较小，对标的公司的业务经营不存在重大不利影响。

就前述第 1 至 2 项租赁期限将于 2017 年内届满的租赁房屋，标的公司正在与出租方协商续租事宜，其中第 1 项租赁期限已续展。

标的公司并不从事具体生产，如前所述，上述租赁房屋的主要用途为办公场所，鉴于租赁房屋的租赁成本低、可替代性强、搬迁成本与难度较小等，标的公司及其下属公司通常在相关租赁期限届满前，结合实际经营情况及需要、租赁成本等客观因素，选择续租或承租其他类似场所。标的公司及其下属公司就租赁房屋的选择及续租与否具有一定灵活性，相关租赁房屋到期后续期亦不存在可合理预见的重大法律障碍。

（2）无形资产

1) 土地使用权

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司拥有土地共计 4 宗(根据土地所处地域，可指土地使用权或土地所有权)，具体情况如下：

序号	使用权人	取得方式	相关证书编号	用途	土地座落	终止日期	使用权面积(m²)	备注
1	芯成半导体(上海)有限公司	出让	沪房地浦字(2014)第 055674 号	工业用地	锦绣东路 2777 弄 25 号全幢	2053.06.05	约 574[注]	--
2	芯成半导体(上海)有限公司	出让	苏工园国用(2013)第 71033 号	商务金融用地	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 1 幢 1703 室	2049.05.31	128.53[注]	--

3	ISSI	购买	--	--	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA	--	约 11,533.54	作为向 Bank of the West 500 万美元借款的担保
4	ICSI TW	买卖	088 汐电字第 026131 号	建筑用地	新北市汐止区昊天段 1086-0000 地号	--	约 49.86 [注]	--

注：上述第 1、2、4 宗土地面积为相关公司拥有的自有房产所占土地的对对应面积。

根据标的公司提供的相关文件资料及说明，上述未标明证号及土地用途的自有土地，为 ISSI 拥有的位于美国的自有土地，该自有土地未有记载相关物业信息的权属证书；根据标的公司提供的经登记的转让证书（Grand Deed）及初步产权报告（Preliminary Title Report），该自有土地为 ISSI 购买取得。该自有土地权属清晰，未标明证号及土地用途不属于权利瑕疵情形，亦不会对标的公司占有及使用构成不利影响。

2) 知识产权

① 商标

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司已注册的商标情况如下表所示：

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
1	芯成半导体(上海)有限公司	芯成	11789281	9 (中国类号)	2014.05.07-2024.05.06
2	芯成半导体(上海)有限公司	ISSI	11789282	9 (中国类号)	2014.05.07-2024.05.06
3	矽恩微电子(厦门)有限公司		5771536	9 (中国类号)	2009.09.28-2019.09.27
4	矽恩微电子(厦门)有限公司	矽恩微電子	5771537	9 (中国类号)	2009.09.28-2019.09.27
5	ISSI	e ² Logic	4159505	9、35、42、45 (国际类号)	2012.06.19-2018.06.19
6	ISSI	e ² Flash	4159506	9、35、42、45 (国际类号)	2012.06.19-2018.06.19
7	ISSI	ISSI	1625813	9 (国际类号)	2010.12.04-2020.12.04
8	ISSI	pFusion	4016287	35、40、42 (国际类号)	2011.08.23-2017.08.23

9	ISSI Cayman	pFlash	3545257	9、42 (国际类号)	2008.12.09-2018.12.08
10	ICSI TW		00941401	009 (中国台湾类号)	2001.05.16-2021.05.15
11	ICSI TW		00729958	009 (中国台湾类号)	1996.10.01-2026.09.30
12	ICSI TW	矽成	00723534	009 (中国台湾类号)	2016.08.01-2026.07.31

其中，上述第 5、6、8、9 项注册商标将于 2017 或 2018 年到期，标的公司将于有效期届满前予以续展。

②软件著作权

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司并未拥有任何软件著作权。

③域名

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司取得的域名如下表所示：

序号	所有人	域名	注册/生效日期	到期日期
1	ISSI	issi.com	1998.09.18	2026.09.17
2	ISSI	issi-test.com	2001.09.10	2026.09.10
3	ISSI	issiusa.com	1994.10.14	2026.10.13
4	Winston Inc.	winston-inc.com	2012.01.09	2017.06.08

注：截至本报告书出具日，winston-inc.com 已停止使用。

④专利

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司已注册的专利情况如下表所示：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家
1	芯成半导体(上海)有限公司	发明	地址转变检测电路	ZL201110153158.9	2015.03.11	中国
2	芯成半导体(上海)有限公司	发明	一种用于非易失性存储器的平衡对称式读出放大电路	ZL03116628.8	2009.07.29	中国
3	芯成半导体(上海)有限公司	发明	进入 ASRAM 芯片内部测试模式的电路	ZL201110158152.0	2015.04.01	中国
4	芯成半导体	发明	进入 ASRAM 芯片内部测试	ZL201110158151.6	2015.03.11	中

	(上海)有限公司		模式的方法			国
5	芯成半导体(上海)有限公司	发明	闪存的擦除方法、读取方法及编程方法	ZL201310473408.6	2016.08.17	中国
6	芯成半导体(上海)有限公司	发明	混合结构的存储器阵列及其制备方法	ZL201410284354.3	2016.09.07	中国
7	芯成半导体(上海)有限公司	发明	Circuit and Method for Testing a Memory Device	US9373417B2	2016.01.21	美国
8	芯成半导体(上海)有限公司	发明	Circuit and Method for Controlling Internal Test Mode Entry of an Asram Chip	US9287008B2	2016.03.15	美国
9	芯成半导体(上海)有限公司	发明	Address Transition Detecting Circuit	US9171609B2	2015.10.27	美国
10	芯成半导体(上海)有限公司	发明	Methods for Erasing, Reading and Programming Flash Memories	US9263141B2	2016.02.16	美国
11	矽恩微电子(厦门)有限公司	发明	一种连续图像播放 LED 显示屏驱动芯片	ZL201210003072.2	2014.07.30	中国
12	矽恩微电子(厦门)有限公司	发明	一种 SPRAM 全双工通信控制电路	ZL201210023020.1	2015.11.18	中国
13	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种连续图像播放 LED 显示屏驱动芯片	ZL201220004394.4	2012.09.26	中国
14	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种消除 LED 阵列扫描残影的系统	ZL201120521901.7	2012.09.12	中国
15	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	用于大功率 LED 驱动的通用开关分段调光电路	ZL201020146765.3	2010.12.29	中国
16	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种 LED 显示屏	ZL201020532976.0	2011.05.18	中国
17	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	用于大功率 LED 驱动的通用温度补偿电路	ZL200820145833.7	2009.08.19	中国
18	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	使用超薄四方扁平及管脚微缩结构封装的集成电路	ZL200920137165.8	2010.03.24	中国
19	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种 IC 参数校正电路	ZL201320688397.9	2014.06.18	中国
20	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种三维全彩 LED 自动呼吸驱动芯片	ZL201320160462.0	2013.10.30	中国

	司					
21	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种无静态功耗的芯片打线选择电路	ZL201320541004.1	2014.03.26	中国
22	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	无需环路补偿的高PFC恒流控制装置及电压变换器	ZL201320226998.8	2013.12.25	中国
23	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种SPRAM全双工通信控制电路	ZL201220032779.1	2012.09.26	中国
24	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种无静态电流的上电复位信号产生电路	ZL201520418468.2	2015.11.18	中国
25	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	亮度线性变化自行调节的LED扫描阵列驱动芯片	ZL201520799177.2	2016.03.02	中国
26	矽恩微电子(厦门)有限公司	实用新型	一种汽车阅读灯LED驱动芯片	ZL201620028983.4	2016.08.31	中国
27	矽恩微电子(厦门)有限公司	发明	CONTROL DEVICE FOR USE WITH SWITCHING CONVERTERS	US9276459B2	2016.03.01	美国
28	矽恩微电子(厦门)有限公司	发明	应用电荷泵的高压LDO	ZL201510473212.6	2015.12.23	中国
29	矽恩微电子(厦门)有限公司	发明	METHOD FOR COMPENSATING TIMING ERRORS OF REAL-TIME CLOCKS	US9304498B2	2016-04-05	美国
30	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Erase and program control State machines for flash memory	5978275	1999.11.02	美国
31	ISSI/Microchip Technology Incorporated	Utility	Adaptive quantization method and apparatus for an OFDM receiver	7756222	2010.07.13	美国
32	ISSI	Utility	Multiple location repair word line redundancy circuit	5774471	1998.06.30	美国
33	ISSI	Utility	Driver circuit for use with a sensing amplifier in a memory	5844428	1998.12.01	美国
34	ISSI	Utility	Fuse tunable, RCgenerated pulse generator	5852379	1998.12.22	美国
35	ISSI	Utility	Address enable circuit in synchronous SRAM	5848022	1998.12.08	美国
36	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	High voltage charge transfer stage	5886566	1999.03.23	美国
37	ISSI	Utility	Method for reducing stray Conductive material near vertical surfaces in semiconductor manufacturing	5888894	1999.03.30	美国

			processes			
38	ISSI/ Winbond Electronics Corporation	Utility	Method and apparatus for operating functions relating to memory and/or applications that employ memory in accordance with available power	5889721	1999.03.30	美国
39	ISSI	Utility	Method and apparatus for controlling memory address hold time	5940337	1999.08.17	美国
40	ISSI	Utility	System and method for a flexible memory controller	5933385	1999.08.03	美国
41	ISSI	Utility	Apparatus and method for minimizing address hold time in asynchronous SRAM	5943288	1999.08.24	美国
42	ISSI	Utility	Voltage regulator for a voltage pump in a DRAM	5955914	1999.09.21	美国
43	ISSI	Utility	Method of and apparatus for increasing load resistance within an SRAM array	5986922	1999.11.16	美国
44	ISSI/ Winbond Electronics Corporation	Utility	Flash memory array having well contact structures	5973374	1999.10.26	美国
45	ISSI	Utility	Smart five volt generator operable from different power supply voltages	6002604	1999.12.14	美国
46	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Divided bit line system for nonvolatile memory devices	5973961	1999.10.26	美国
47	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Method and apparatus for providing accessible device information in digital memory devices	5991194	1999.11.23	美国
48	ISSI	Utility	Multiple row address strobe DRAM architecture to improve bandwidth	6026466	2000.02.15	美国
49	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Byteprogrammable flash memory having counters and secondary storage for disturb control during program and erase operations	6005810	1999.12.21	美国
50	ISSI	Utility	Method of reducing dielectric damage due to charging in the fabrication of stacked gate structures	6133602	2000.10.17	美国
51	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Row decoder for nonvolatile memory having a low-voltage power supply	5999479	1999.12.07	美国
52	ISSI	Utility	Guaranteed dynamic pulse generator	6028814	2000.02.22	美国
53	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Fast on-chip current measurement circuit and method for use with memory array circuits	6031777	2000.02.29	美国

54	ISSI	Utility	DRAM repair apparatus and method	6046945	2000.04.04	美国
55	ISSI	Utility	System and method for a low voltage charge pump with large output voltage range	6064251	2000.05.16	美国
56	ISSI	Utility	High density self- aligned antifuse	6087677	2000.07.11	美国
57	ISSI	Utility	Self-aligned storage node definition in a DRAM that exceeds the photolithography limit	6074910	2000.06.13	美国
58	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Leakage improved charge pump for nonvolatile memory device	6069519	2000.05.30	美国
59	ISSI	Utility	Fast redundancy scheme for high density, high speed memories	6108250	2000.08.22	美国
60	ISSI	Utility	Apparatus and method for preventing accidental writes from occurring due to simultaneous address and write enable transitions	6101133	2000.08.08	美国
61	ISSI/Winbond Electronics Corporation	Utility	Architecture and method for performing page write/verify in a flash memory chip	6122197	2000.09.19	美国
62	ISSI	Utility	Interleaved stitch using segmented word lines	6141236	2000.10.31	美国
63	ISSI	Utility	Data sense arrangement for random access memory	6157587	2000.12.05	美国
64	ISSI	Utility	Integrated circuit memory with a bus transceiver	6170041	2001.01.02	美国
65	ISSI	Utility	Method for fabricating stacked capacitor for a dynamic random access memory	6184152	2001.02.06	美国
66	ISSI	Utility	Method for fabricating tunnel window in EEPROM cell with reduced cell pitch	6171907	2001.01.09	美国
67	ISSI	Utility	Apparatus and method of reducing the pre-charge time of bit lines in a random access memory	6292416	2001.09.18	美国
68	ISSI	Utility	Ultra low power voltage translation circuitry and its application in a TTL-to-CMOS buffer	6359470	2002.03.19	美国
69	ISSI	Utility	Pulse delay circuit with stable delay	6353349	2002.03.05	美国
70	ISSI	Utility	Associated content storage system	6925524	2005.08.02	美国
71	ISSI	Utility	Prefix match search scheme	6928430	2005.08.09	美国

72	ISSI	Utility	Stacked capacitor for double-poly flash memory	8329533	2012.12.11	美国
73	ISSI	Utility	Glitch free input transition detector	9319038	2016.04.19	美国
74	ISSI	Utility	Glitch-free input transition detector	8890575	2014.11.18	美国
75	ISSI	Utility	Auto-trimming of internally generated voltage level in an integrated circuit	8929158	2015.01.06	美国
76	ISSI	Utility	Memory device implementing reduced ECC overhead	9280418	2016.03.08	美国
77	ISSI	Utility	Memory device with multiple cell write for a single input-output in a single write cycle	9177650	2015.11.03	美国
78	ISSI	Utility	Erase algorithm for flash memory	9336893	2016.05.10	美国
79	ISSI	Utility	Erase algorithm for flash memory	9099192	2015.08.04	美国
80	ISSI	Utility	Auto low current programming method without verify	9117549	2015.08.25	美国
81	ISSI	Utility	Reference current circuit with temperature coefficient correction	9293215	2016.03.22	美国
82	ISSI	Utility	Flash memory device with sense- amplifier-bypassed trim data read	9349472	2016.05.24	美国
83	ISSI	Utility	Reference current generation in resistive memory device	9202561	2015.12.10	美国
84	ISSI	Utility	Method for improving sensing margin of resistive memory	9324426	2016.04.26	美国
85	ISSI	Utility	Resistive memory device implementing selective memory cell refresh	9373393	2016.06.21	美国
86	ISSI	Utility	High speed sequential read method for flash memory	9496046	2016.11.15	美国
87	ISSI	Utility	Low power high speed program method for multi-time programmable memory device	9543016	2017.01.10	美国
88	ISSI	Utility	Non-volatile programmable memory having a buffering capability and method of operation thereof	5862099	1999.01.19	美国
89	ISSI	Utility	System and method for a high speed, high voltage latch for memory devices	5812463	1998.09.22	美国
90	ISSI	Utility	Local row decoder for sector-erase Fowler-Nordheim tunneling based flash memory	5886923	1999.03.23	美国

91	ISSI	Utility	Charge pump system with improved programming current distribution	5982223	1999.11.09	美国
92	ISSI	Utility	High performance random access memory with multiple local I/O lines	6137746	2000.10.24	美国
93	ISSI	Utility	双多晶硅快闪记忆体之堆叠式电容器	ZL201110049659.2	2014.01.22	中国
94	ISSI	Utility	Auto low current programming method without verify	9514806	2016.12.06	美国
95	ISSI	Utility	Resistive memory device implementing selective memory cell refresh	9496030	2016.11.15	美国
96	ISSI	Utility	Large Entity Patent	6025214	2000.02.15	美国
97	ISSI	Utility	Patent Application	92901055.1	1995.05.03	欧洲
98	ISSI Cayman	Utility	使用多晶硅底控制闸极之PMOS 快闪记忆体	ZL201010220014.6	2013.03.14	中国
99	Chingis Technology Corporation	Utility	Integrated program verify page buffer	5903497	1999.05.11	美国
100	Chingis Technology Corporation	Utility	Microcontroller virtual memory system and method	6542955	2003.04.01	美国
101	Chingis Technology Corporation	Utility	Method and apparatus for switching nodes between multiple potentials	5943265	1999.08.24	美国
102	Chingis Technology Corporation	Utility	Low voltage low capacitance flash memory array	7505325	2009.03.17	美国
103	Chingis Technology Corporation	Utility	Method to incorporate non-volatile memory and logic components into a single sub-0.3 micron fabrication process for embedded non-volatile memory	5723355	1998.03.03	美国
104	Chingis Technology Corporation	Utility	Nonvolatile memory solution using single-poly pFlash technology	7078761	2006.07.18	美国
105	Chingis Technology Corporation	Utility	Nonvolatile memory solution using single-poly pFlash technology	7339229	2008.03.04	美国
106	Chingis Technology Corporation	Utility	Sensing scheme for non-volatile memories	5798967	1998.08.25	美国
107	Chingis Technology Corporation	Utility	Boosted voltage driver	5952851	1999.09.14	美国
108	Chingis Technology Corporation	Utility	Negative voltage level shift circuit	5696728	1997.12.09	美国
109	Chingis Technology	Utility	Page buffer having negative voltage level shifter	5973967	1999.10.26	美

	Corporation					国
110	Chingis Technology Corporation	Utility	PMOS single-poly non-volatile memory structure	5761121	1998.06.02	美国
111	Chingis Technology Corporation	Utility	Non-volatile memory array architecture	5801994	1998.09.01	美国
112	Chingis Technology Corporation	Utility	PMOS non-volatile latch for storage of redundancy addresses	5781471	1998.07.14	美国
113	Chingis Technology Corporation	Utility	Row decoder circuit for PMOS non-volatile memory cell which uses electron tunneling for programming and erasing	5796656	1998.08.18	美国
114	Chingis Technology Corporation	Utility	Adaptive frequency compensation technique	5889440	1999.03.30	美国
115	Chingis Technology Corporation	Utility	PMOS memory array having OR gate architecture	5909392	1999.06.01	美国
116	Chingis Technology Corporation	Utility	Non-volatile latch having PMOS floating gate memory cells	5943268	1999.08.24	美国
117	Chingis Technology Corporation	Utility	Sense amplifier with improved bit line initialization	5982693	1999.11.09	美国
118	Chingis Technology Corporation	Utility	Single poly non-volatile memory having a PMOS write path and an NMOS read path	6166954	2000.12.26	美国
119	Chingis Technology Corporation	Utility	Method and apparatus for switching a well potential in response to an output voltage	6204721	2001.03.20	美国
120	Chingis Technology Corporation	Utility	Memory device having automatic protocol detection	6851014	2005.02.01	美国
121	Chingis Technology Corporation	Utility	High speed sense amplifier for memory output	6940315	2005.09.06	美国
122	Chingis Technology Corporation	Utility	Non-volatile memory architecture to improve read performance	7009880	2006.03.07	美国
123	Chingis Technology Corporation	Utility	Redundant memory content substitution apparatus and method	7193895	2007.03.20	美国
124	Chingis Technology Corporation	Utility	Nonvolatile PMOS Two Transistor Memory Cell And Array	ZL98124648.6	1998.10.08	中国
125	Chingis Technology Corporation	Utility	Electrically Programmable Read Only Memory array	5280660	2013.05.31	日本
126	Chingis Technology Corporation	Utility	Nonvolatile PMOS Two Transistor Memory Cell And Array	380266	2003.04.02	韩国

27	Chingis Technology Corporation	Utility	Low Voltage Low Capacitance Flash Memory Array	7505325	2009.03.17	美国
28	ENABLE KOREA CO.,LTD	--	保障内部回路初始化的通电信号的发生装置及其方法	H03K 17/22 H03K 3/00	2014.12.16	韩国
29	ENABLE KOREA CO.,LTD	--	存储装置的自动刷新周期检测装置及其方法	G11C 29/00 G01R 19/00	2013.05.03	韩国

⑤集成电路布图设计

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司尚在使用中的集成电路布图设计如下表所示：

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
1	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.08500623.8	MS04	2008.11.20	2008.01.01	2007.08.25	自首次投入商业利用日起 10 年
2	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.08500622.X	MS02	2008.11.20	2008.01.02	2007.07.25	自首次投入商业利用日起 10 年
3	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.08500619.X	AU12	2008.11.20	2008.08.17	2008.06.25	自首次投入商业利用日起 10 年
4	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.08500618.1	AU08	2008.11.20	2008.01.17	2007.07.18	自首次投入商业利用日起 10 年
5	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.08500617.3	TH01ID08E	2008.11.20	2008.09.25	2008.06.09	自首次投入商业利用日起 10 年
6	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500103.4	MS18A	2011.03.11	2009.10.21	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
7	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500102.6	AU06A	2011.03.11	2009.08.28	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
8	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500101.8	PM01	2011.02.25	2009.10.30	2008.11.30	自首次投入商业利用日起 10 年
9	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500100.X	MS13	2011.02.25	2009.10.30	2008.10.31	自首次投入商业利用日起 10 年
10	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500099.2	AU26	2011.02.25	2009.09.25	2007.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
11	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500098.4	PM04	2011.02.25	2010.12.14	2010.04.11	自首次投入商业利用日起 10 年

12	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500097.6	MS19	2011.02.25	2010.10.28	2010.06.11	自首次投入商业利用日起 10 年
13	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500096.8	MS31	2011.02.25	2010.10.28	2010.07.30	自首次投入商业利用日起 10 年
14	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500095.X	AU22	2011.02.25	2010.07.28	2010.06.01	自首次投入商业利用日起 10 年
15	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500094.1	MS11	2011.02.25	2009.12.15	2008.12.01	自首次投入商业利用日起 10 年
16	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500093.3	TH04	2011.02.25	2009.11.26	2009.10.01	自首次投入商业利用日起 10 年
17	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500092.5	DX01	2011.02.25	2009.11.26	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
18	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500091.7	AU11	2011.02.25	2010.09.13	2008.06.01	自首次投入商业利用日起 10 年
19	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500090.9	AU29	2011.02.25	2010.09.13	2010.01.04	自首次投入商业利用日起 10 年
20	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500089.5	MS23	2011.02.25	2010.07.28	2009.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
21	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500088.7	MS21	2011.02.25	2010.07.28	2010.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
22	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500033.X	AU30	2011.02.25	2010.09.13	2010.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
23	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500701.6	AU28	2011.07.12	--	2010.01.31	自登记申请日起 10 年
24	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500700.8	DX02	2011.07.12	2011.04.30	2010.08.30	自首次投入商业利用日起 10 年
25	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500699.0	MS38	2011.07.12	2011.07.15	2010.12.01	自登记申请日起 10 年
26	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500698.2	MS35	2011.07.12	2011.07.01	2010.07.31	自首次投入商业利用日起 10 年
27	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.11500687.4	MS26	2011.07.12	2011.06.26	2010.11.01	自首次投入商业利用日起 10 年
28	矽恩微电子(厦门)有限	BS.1150098.6	AU31	2011.07.12	2011.05.30	2010.10.31	自首次投入商业利用日

	公司						起 10 年
29	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.11500695.8	AU20	2011.07.12	2011.05.21	2010.07.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
30	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.11500694.X	AU17	2011.07.12	--	2010.06.01	自登记申请 日起 10 年
31	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.11500934.5	MS16	2011.09.16	2011.08.25	2010.02.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
32	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.11500935.3	Ms21B	2011.09.16	2011.08.01	2010.09.30	自首次投入 商业利用日 起 10 年
33	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.11500933.7	MS12	2011.09.16	2011.08.10	2010.03.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
34	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500344.7	AU43A	2012.03.16	2012.02.05	2011.12.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
35	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500343.9	AU33	2012.03.16	2012.03.01	2011.09.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
36	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500342.0	MS53A	2012.03.16	2012.02.15	2011.12.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
37	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500341.2	MS41	2012.03.16	2012.02.21	2010.11.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
38	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500340.4	AU41A	2012.03.16	2012.02.15	2011.11.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
39	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500339.0	AU38A	2012.03.16	2011.06.01	2011.06.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
40	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500338.2	MS11B	2012.03.16	2012.03.01	2012.03.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
41	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.12500337.4	MS36	2012.03.16	2012.02.10	2011.12.01	自首次投入 商业利用日 起 10 年
42	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.13500280.X	MS59A	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请 日起 10 年
43	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.13500277.X	MS45A	2013.04.08	--	2011.07.01	自登记申请 日起 10 年
44	矽恩微电子 (厦门)有限公司	BS.13500278.8	MS49A	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请 日起 10 年

45	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.13500279.6	PM07	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请日起 10 年
46	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.145501191	MS55A	2014.05.30	--	2013.06.30	自登记申请日起 10 年
47	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.145501183	MS51	2014.05.30	--	2013.07.31	自登记申请日起 10 年
48	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.145501175	MS47	2014.05.30	--	2013.05.31	自登记申请日起 10 年
49	矽恩微电子(厦门)有限公司	BS.145501167	PM09A	2014.05.30	--	2013.06.30	自登记申请日起 10 年

注：上述集成电路布图设计中，第 1、2、4、10 项均已实际停止使用。

截至本报告书出具日，标的公司相关下属公司对拥有的已到期及即将到期的域名、以及保护期已届满或将于 1 年内届满的集成电路布图设计均已实际停止使用；标的公司及其下属公司将对有效期将于 2017 至 2018 年届满的注册商标予以适时续展，预计该等注册商标的续展不存在重大实质性法律障碍。鉴于此，前述有效期/保护期届满或临近届满的知识产权不会对标的公司具体产品及生产经营构成重大不利影响。

2、权利限制及其他情形

（1）标的公司股权

截至本报告书出具日，上海承裕、华创芯原所持有的标的公司股权存在质押情形，具体为上海承裕持有的 43.173% 标的公司股权中 39.087% 的股权质押予亦庄国投，华创芯原持有的标的公司 15.034% 股权，全部质押予亦庄国投。上海承裕和华创芯原已分别作出承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除相应质押，确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。上海承裕、华创芯原将尽快与亦庄国投就质押解除事宜协商一致。

根据亦庄国投提供的说明及承诺，其承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。

（2）标的公司主要资产

截至本报告书出具日，ISSI 位于 1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 的土地已抵押予 West of Bank，用于担保 West of Bank 向 ISSI 提供的 500 万美元贷款。

因亦庄国投为上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原私有化收购 ISSI 交易的并购贷款提供连带责任保证，北京矽成将上海闪胜 100%股权质押予亦庄国投以提供反担保。截至本报告书出具日，上述股权质押尚未解除。根据北京矽成的说明，其承诺于本次交易申报文件提交中国证监会前解除前述股权质押。

除上述情况外，截至本报告书出具日，北京矽成股权及相关资产权属清晰，不存在被冻结、查封或设定质押等限制或禁止转让的情形；不存在涉及未决诉讼、未决仲裁及司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

3、对外担保情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在对外担保的情况。

4、主要负债

截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成的总负债为 52,746.94 万元，主要为应付账款、应付职工薪酬等流动负债。北京矽成的主要负债情况具体请参见“第九章 管理层讨论分析”之“三、交易标的最近三年的财务状况分析”。

5、特许经营权的情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在拥有特许经营权的情况，北京矽成的主营业务亦不需要专门的生产经营资质。

6、授权许可的情况

截至本报告书出具日，北京矽成被许可情况如下表所示：

序号	协议相关方	协议名称	授权范围	有效期
1	ISSI、ProMOS Technologies Inc.	《License Agreement》	ProMOS Technologies Inc.对 ISSI 授权 63nm 1Gb DDR2、63nm 1Gb DDR3 及 63nm 1Gb mobile DDR 产品	2017.12.31
2	ISSI(包括其台湾实体、香港实体、中国实体、韩国实体)、ZMOS Technology, Inc.	《Product License Agreement》	ZMOS Technology, Inc. 授权 ISSI 在其产品中安装 512M Mobile DDR/SDR SDRAM	长期有效

3	ISSI 及其关联方、Jade Sky Technologies, Inc.	《License and Distribution Agreement》	Jade Sky Technologies, Inc.向 ISSI 授权 JST301 产品	长期有效
4	ISSI、Triune Systems, LLC	《Licensing Agreement》	Triune Systems, LLC 向 ISSI 授权 Class-D Audio Power Amplifier for automotive and consumer electronic applications 产品	长期有效
5	ISSI、Blue Sage Communications, Inc.	《Licensing and Services Agreement》	Blue Sage Communications, Inc.向 ISSI 授权用于 ISSI DDR3 memory based Internet Protocol Forwarding Solution 的 Blue Sage Software Solution	长期有效
6	ISSI 及其下属企业、Spansion LLC	《Patent Cross License Agreement》	Spansion LLC 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权半导体相关产品的设计及制造涉及的专利	长期有效
7	ISSI 及其下属企业、Spansion LLC	《Development and License Agreement》	Integrated Silicon Solution, Inc 对 Spansion LLC 授权 64Mb HyperRAM 产品及其他 HyperRAM 产品	截至 ISSI 向 Spansion LLC 停止提供服务
8	ISSI 及其下属企业、Spansion LLC	《Technology and Product License Agreement》	Spansion LLC 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权 HyperBus 技术、MirrorBit 技术及 HyperFlash 产品	自合同生效之日其 15 年
9	ISSI、International Business Machines Corporation	《Technology License Agreement》	International Business Machines Corporation 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权有关 SRAM design in IBM 65nm technology 技术涉及的部分知识产权	长期有效
10	ISSI、International Business Machines Corporation	《License Agreement》	合同双方相互授权 SRAM design in IBM 65nm technology 技术涉及的部分知识产权	全部授权专利的权利期限届满后
11	ISSI、TargetChip Technology Ltd.	《Product License Agreement》	TargetChip Technology Ltd.对 ISSI 授权 15M high speed SRAM project for Huali 40nm process 产品	协议生效后 5 年或 ISSI 停止销售授权产品后
12	ISSI、International Green Chip (Tianjin) Co.	《IP Licensing and Service Agreement》	International Green Chip (Tianjin) Co. 对 ISSI 授权“Cores” Deserializer	长期有效

			and other technology	
13	ISSI、Nanya Technology Corporation	《Development Services Agreement》	Nanya Technology Corporation 对 ISSI 授权 Custom semiconductor DRAM and fabrication of final product wafers 的设计相关的知识产权	长期有效
14	ISSI、Genusion, Inc.	《Memorandum of Understanding》、《Development Agreement》	Genusion, Inc. 对 ISSI 授权“1T B4-Flash” technology and the development of certain flash memory 相关的部分专利及知识产权	--
15	ISSI 及其关联方、DRAMTechnologies LLC	《Settlement and Patent License Agreement》	DRAMTechnologies LLC 对 ISSI 授权 semiconductor integrated circuit devices and semiconductor memory devices 涉及的 25 项美国专利	全部授权专利的权利期限届满后
16	ISSI、Micron Technology Inc.	《Trademark and Content License Agreement》	Micron Technology Inc. 对 ISSI 授权“RLDRAM”商标；ISSI 对 Micron Technology Inc. 授权“ISSI”商标	协议生效后 7 年
17	ISSI、Green Mountain Semiconductor	《Independent Contractor Services Agreement》	Green Mountain Semiconductor 对 ISSI 授权 semiconductor memory components 产品使用的知识产权	协议生效后 18 个月
18	ISSI 及其关联方、DRAM Memory Technologies LLC	《Settlement and Patent License Agreement》	DRAM Memory Technologies LLC 对 ISSI 授权 semiconductor memory devices 产品涉及的 43 项美国专利	全部授权专利的权利期限届满后
19	ISSI 及其关联方、James B. Goodman	《Settlement and Non-Exclusive License Agreement》	James B. Goodman 对 ISSI 授权专利编号为 6,243,315、4,617,624 及 6,257,911 的美国专利	全部授权专利的权利期限届满后
20	ISSI 及其下属公司、Mitsubishi	《Mitsubishi/ISSI Cross License Agreement》	合同双方相互授权 semiconductors and flash memory devices 的设计及制造相关的专利	全部覆盖 SRAM, Flash, embedded SRAM, and embedded Flash devices 的授权专利的权利期限届满；或协议生效后 5 年；或专利授权后 5 年

21	ISSI、Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation	《ISSI & SMIC Product License Agreement》	ISSI 对 Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation 授权 45nm 256Mb NOR flash memory 产品相关的知识产权	2017.12.31
22	ISSI 及其关联方、North Star Innovations Inc.	《Settlement and Patent License Agreement》	North Star Innovations Inc.对 ISSI 授权专利编号为 5,875,143、6,798,074、6,875,635,及 5,892,777 的美国专利及其他相关专利	全部授权专利的权利期限届满后
23	ISSI、MOSAID Technologies Incorporated	《Patent Portfolio License Agreement》	MOSAID Technologies Incorporated 对 ISSI 授权与 integrated circuit products including RAMs, such as DRAM and PSRAM 相关的专利	2018.05.01
24	ISSI、MOSAID Technologies Incorporated	《Exclusive Patent Licensing Agreement》	ISSI 对 MOSAID Technologies Incorporated 授权专利编号为 5,375,097、5,550,783、5,559,752、5,731,606、5,774,471 及 6,137,746,的美国专利及其他相关专利	2018.05.01
25	ISSI、MOSAID Technologies Incorporated	《Patent Purchase Agreement》	ISSI、MOSAID Technologies Incorporated 对 ISSI 授权与集成电路产品相关的 12 项美国专利及 1 项中国专利	--
26	ISSI、Cadence Design Systems, Inc.	《Software License and Maintenance Agreement》	Cadence Design Systems, Inc.对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权电子工程设计软件(包括 Virtuoso Analog Design Environment, Virtuoso Schematic Editor, Virtuoso Layout Suite, Virtuoso Analog HSPICE Interface, and Incisive Enterprise Simulator)	长期有效
27	ISSI Cayman、Xi'an Semiconductors Co. Ltd.	《Memorandum of Understanding》	2Gb DDR2 and 2Gb DDR3 (x4x8x16) in 38nm at PowerChip Technology Corporation (PTC) DRAM designs	长期有效
28	ISSI Cayman、Xi'an Semiconductors Co. Ltd.	《Memorandum of Understanding》	1Gb DDR3 (x8 and x16, two products) in 45nmnm at PowerChip Technology Corporation (PTC)	长期有效

			DRAM designs	
29	ISSI Cayman、力积电股份有限公司	《产品许可协议书》	力积电股份有限公司对 ICSI TW 授权 F63 256Mb DDR-2 DRAM 产品的使用、制造、销售、委托销售、进出口	长期有效
30	ISSI Cayman、力积电股份有限公司	《产品许可协议书》	力积电股份有限公司对 ICSI TW 授权 F63 512Mb DDR-2 DRAM 产品的使用、制造、销售、委托销售、进出口	长期有效

其中，约定控制权变化条款的相关许可授权协议情况如下表所示：

序号	协议双方	协议名称	授权范围	签署日期
1	Integrated Silicon Solution, Inc.及其下属企业、Spansion LLC	《Patent Cross License Agreement》	Spansion LLC 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权半导体相关产品的设计及制造涉及的专利	2014.3.24
2	Integrated Silicon Solution, Inc.及其关联方、Spansion LLC	《Development and License Agreement》	Integrated Silicon Solution, Inc 对 Spansion LLC 授权 64Mb HyperRAM 产品及其他 HyperRAM 产品	2014.10.7
3	Integrated Silicon Solution, Inc.及其下属企业、Spansion LLC	《Technology and Product License Agreement》	Spansion LLC 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权 HyperBus 技术、MirrorBit 技术及 HyperFlash 产品	2014.12.12
4	Integrated Silicon Solution, Inc.、International Business Machines Corporation	《Techonology License Agreement》	International Business Machines Corporation 对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权有关 SRAM design in IBM 65nm technology 技术涉及的部分知识产权	2011.12.22
5	Integrated Silicon Solution, Inc.、Cadence Design Systems, Inc.	《Software License and Maintenance Agreement》	Cadence Design Systems, Inc.对 Integrated Silicon Solution, Inc 授权电子工程设计软件(包括 Virtuoso Analog Design Environment, Virtuoso Schematic Editor, Virtuoso Layout Suite, Virtuoso Analog HSPICE Interface, and Incisive Enterprise Simulator)	2010.7.2

根据标的公司提供的说明及确认，截至本报告书出具日，就前述第 1 至 3 项协议，标的公司已与合同相对方 Spansion LLC 进行洽谈，双方正在就重新签署

相关协议事宜进行谈判，按过往行业惯例和双方过往谈判经验，应可达成合理共识；就前述第 4 至 5 项协议，按过往行业惯例，合同相对方将于本次交易生效后及交割前提供其对本次交易及/或授权许可续期（如需）的同意，预计取得该等同意及/或续期无实质障碍。鉴于此，上述授权协议的续期不存在可合理预见的重大法律障碍。

上述许可授权协议在标的公司主营产品中使用的范围如下表所示：

序号	协议双方	协议名称	主营产品中使用的范围
1	Integrated Silicon Solution, Inc 及其下属企业、Spansion LLC	《Patent Cross License Agreement》	NOR Flash 产品
2	Integrated Silicon Solution, Inc 及其关联方、Spansion LLC	《Development and License Agreement》	HyperRAM 产品
3	Integrated Silicon Solution, Inc 及其下属企业、Spansion LLC	《Technology and Product License Agreement》	NOR Flash 产品
4	Integrated Silicon Solution, Inc、International Business Machines Corporation	《Techonology License Agreement》	QUAD SRAMs 产品
5	Integrated Silicon Solution, Inc、Cadence Design Systems, Inc.	《Software License and Maintenance Agreement》	该授权涉及设计软件，与标的公司主营产品无直接关系

根据标的公司提供的说明及确认，标的公司 2016 年上述授权合同对应产品的收入占 2016 年收入的比重不超过 4%；截至本报告书出具日，上述授权合同对应产品的收入对标的公司主营业务收入不构成重大影响。

若相关授权合同续期发生障碍，则北京矽成预计将就所签订的相关许可授权协议所涉及的产品收入支付一定比例的授权费用。鉴于相关授权合同对应产品的收入对标的公司主营业务收入不构成重大影响，则因相关授权合同未能续期支付的授权费用对标的公司生产经营和本次评估亦不构成重大影响。

（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

1、未决诉讼、仲裁

截至本报告书出具日，除下列涉诉案件或争议事项外，北京矽成及其下属公司近两年内不存在其他尚未了结或已知的重大诉讼、仲裁。

（1）ISSI 与 GSI 之间诉讼

2015 年，GSI 向美国加利福尼亚法院起诉 ISSI 及 UMI，主张 ISSI 及 UMI 侵犯 GSI 商业秘密、不正当竞争及故意损害商业利益。2015 年 9 月，法院判决 ISSI 胜诉，无须赔偿 GSI；判决 UMI 赔偿 GSI 约 100 万美元。2015 年 12 月 28 日，UMI 提起上诉。

2016 年 1 月 22 日，ISSI 与 GSI 达成《保密和解协议及相互谅解》，约定双方互不再就前述事宜提起诉讼、上诉或提出相关请求，该等协议系双方间争议完全及最终的解决方案。同日，ISSI 与 GSI 向法院提交和解通知，法院将仅就 GSI 与 UMI 之间的请求予以审理。

（2）ISSI 与 Longitude 之间知识产权争议

根据 ISSI 的董事会报告，Longitude 主张 ISSI 侵犯其三项独家授权专利，该等专利系 Longitude Semiconductor S.a.r.l 所有，并排他性授权 Longitude。2017 年 3 月 8 日，ISSI、ISSI Cayman 及 Longitude 达成《专利组合授权协议》，ISSI 获得相关专利的非排他性授权，自 2017 年 3 月 8 日起 7 年内，有权制造、使用、销售相关集成电路产品，ISSI 一次性支付 28 万美元，Longitude 及 Longitude Semiconductor S.a.r.l 不再就 ISSI 制造、使用、销售相关被授权的集成电路产品提出诉求或提起诉讼。

（3）与 Polaris Innovations Ltd.之间知识产权争议

根据 ISSI 的董事会报告，Wi-lan Inc.要求 ISSI 支付 100 万美元以取得 Wi-lan Inc.对 ISSI“Qimonda”专利组合的授权。截至本报告书出具日，ISSI 正在与 Wi-lan Inc.子公司 Polaris Innovations Ltd.就前述事项进行谈判。

2、行政处罚情况

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司不存在因违反工商、税务、社保等方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

3、关联方非经营性资金占用情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在资金被关联方非经营性占用的情况。

4、为关联方提供担保的情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在为关联方提供担保的情况。

（五）本次交易涉及的债权债务转移情况

本次交易不涉及标的公司债权债务转移，标的公司及其下属企业对其现有的债权债务在本次交易完成后依然以其自身的名义享有或承担。

（六）涉及立项、环保等有关报批事项

本次交易不涉及立项、环保等报批事项。

（七）标的公司最近三年增资、股权转让及资产评估或估值情况

1、最近三年增资情况

最近三年北京矽成共进行过 2 次增资，具体情况如下表所示：

序号	增资时间	增资方	认缴出资额 (万元)	增资价格 (元/出资额)
1	2015.11.12	上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原	49,000.00	9.96
2	2016.1.11	闪胜创芯	1,966.949	9.76

第一次增资系扩充标的公司资本金，以满足收购 ISSI 的资金需求；第二次增资主要为引进战略投资者闪胜创芯，为标的公司业务发展及资本运作提供帮助，该次增资定价基于各方对于标的公司价值的判断采用协商的方式确定。

关于前述增资的具体内容请参见本章“一、标的公司基本情况”之“（一）标的公司概况和历史沿革”之“1、北京矽成”之“（2）历史沿革”之“1）设立及历次股权变动情况”。

前述两次增资已经履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情形。

2、最近三年的股权转让情况

最近三年北京矽成共进行过 4 次股权转让，其中前两次转让系收购 ISSI 前标的公司的股权结构调整，后两次转让发生于收购 ISSI 后，具体情况如下表所示：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (元/出资额)
1	2015.3.6	外滩科技	中晶投资、	400.00	1

			常州新能聚		
2	2015.9.1	中晶投资、常州新能聚	上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原	1,000.00	1
3	2016.12.27	华清闪胜	上海承裕、屹唐投资	7,372.81	10.25
			民和志威	439.90	12.25
4	2017.4.9	华创芯原	民和志威	1,598.97	12.51

第一次股权转让系原有股东间的转让，中晶投资和常州新能源以 1 元/出资额的价格受让了外滩科技对北京矽成之全部出资额并按照外滩科技实缴出资额 40 万元支付了股权转让的对价；

第二次股权转让系国内财团为收购 ISSI 做出的特定安排，即上海承裕、屹唐投资、华清闪胜及华创芯原等四方以 1 元/出资额的价格受让了北京矽成之全部出资额并按照原股东实缴出资额 100 万元支付了股权转让的对价，各股东将按照各自认缴的出资比例履行余下的出资义务；

第三次股权转让系华清闪胜出于退出目的做出的安排，即将其持有的北京矽成 10.10%的股权转让给屹唐投资，将其持有的北京矽成 4.09%的股权转让给上海承裕，并将其持有的北京矽成 0.85%的股权转让给民和志威，均系溢价转让。华清闪胜转让其持有的标的公司 15%股权的定价分成两类：第一类定价适用于转让给上海承裕和屹唐投资的股权，因为股权受让方都是标的公司的股东，属于内部股权转让，该类股权的定价估值基本为前次私有化收购的成本加资金成本，合计 53.28 亿；第二类定价适用于转给第三方民和志威的股权，该笔股权转让因为是市场型股权转让，所以定价较高，北京矽成整体定价为 63.64 亿元。

第四次股权转让系华创芯原出于提前获得退出收益目的做出的安排，即将其持有的北京矽成 3.08%的股权转让给民和志威，系溢价转让，转让价格与本次交易标的资产的交易价格一致。

关于前述股权转让的具体内容请参见本章“一、标的公司基本情况”之“（一）标的公司概况和历史沿革”之“1、北京矽成”之“（2）历史沿革”之“1）设立及历次股权变动情况”。

前述股权转让履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程

的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情形。

3、最近三年资产评估、改制情况

最近三年北京矽成及其子公司不存在进行整体资产评估和改制情况。

（八）拟购买资产为股权时的说明

1、北京矽成不存在出资不实或影响其合法存续的情况

北京矽成为依法设立并有效存续的有限责任公司，其历次股权变动已履行了必要的审批或确认程序。交易对方上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威承诺其已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。

2、本次交易拟购买资产为控股权

本次交易上市公司拟购买北京矽成 100%的股权，属于控股权。

3、本次交易符合北京矽成股权转让前置条件

北京矽成现行有效的公司章程中对于股权转让事项规定如下：

“除非取得全体股东的事先书面同意外，任一股东不得以任何方式将其所持公司的股权处置（包括但不限于直接或间接进行出售、赠予、质押、设定产权负担或以其他方式加以处分，以下统称“转让”）给股东以外的第三方”。

2017 年 2 月 10 日和 2017 年 4 月 17 日，北京矽成分别召开股东会审议并通过全体股东将合计持有的北京矽成 100%股权对外转让。

二、标的公司的主营业务发展情况

（一）主营业务情况

1、业务概况

本次兆易创新拟购买的标的公司为北京矽成。北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。

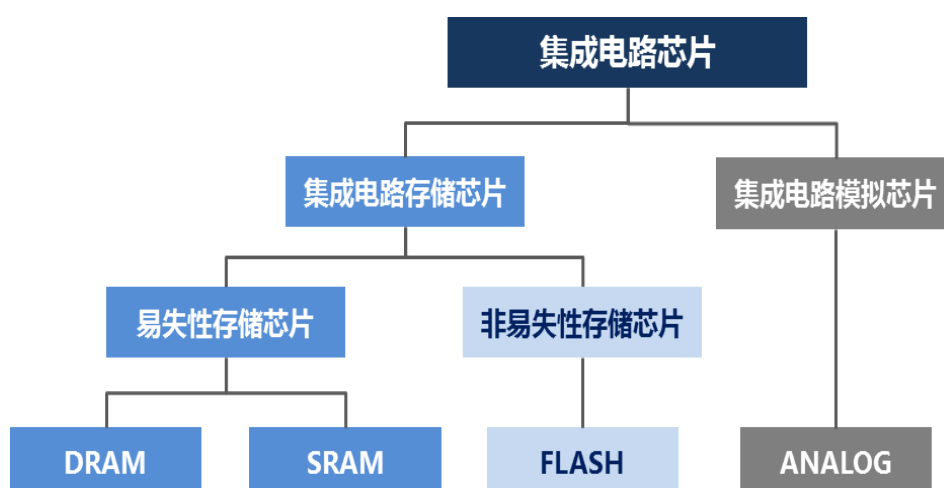
ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。

标的公司的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片（ANALOG）的研发和销售。集成电路存储芯片产品中，易失性存储芯片产品是标的公司的核心业务，报告期内占收入的比重超过 95%，其中包括了动态随机存储器芯片（DRAM）和静态随机存储器芯片（SRAM），非易失性存储芯片产品有闪存芯片（FLASH）。标的公司的产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用，标的公司通过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验。

DRAM 和 SRAM 的收入占标的公司的销售收入占比最高，根据第三方机构 IHS 统计，2016 年全年，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第八位，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际一流厂商一同处于行业领先地位。

2、主要产品或服务类型及用途

标公司的主要产品为集成电路存储芯片和集成电路的模拟芯片，产品分为四大类别，分别为 DRAM、SRAM、FLASH 以及 ANALOG，具体分类如下图：



（1）DRAM 产品

标的公司 DRAM 产品主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域开发。涵盖 16M、64M、128M 到 1G、2G 的多种容量规格，能够满足工业等级和车规

等级产品的要求，具备在极端环境下稳定工作以及节能降耗等特点。

报告期内，标的公司主要 DRAM 产品及用途情况如下表所示：

产品类别	细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
DRAM	EDO/FP DRAM	普通型 3.3_4M/16M	工业、消费
	SDR SDRAM	普通型 3.3V_16M/64M/128M/256M/512M	工业、消费
		车规型 3.3V_16M/64M/128M/256M/512M	汽车
	DDR SDRAM	普通型 2.5V_128M/256M/512M	工业、消费
		车规型 2.5V_256M/512M	汽车
	DDR2 SDRAM	普通型 1.8V_256M/512M/1G/2G	工业、消费
		车规型 1.8V_256M/512M/1G/2G	汽车
	DDR3 SDRAM	普通型 1.5V_1G/2G/4G/8G	工业、消费
		普通型 1.35V_1G/2G/4G/8G	工业、消费
		车规型 1.5V_1G/2G/4G/8G	汽车
		车规型 1.35V_1G/2G/4G/8G	汽车
	DDR4 SDRAM	普通型 1.2V_4G	工业、消费
		车规型 1.2V_4G;	汽车
	mSDR SDRAM	节能型 1.8/2.5/3.3V_32M/64M/128M/256M/512M	工业、消费
		车规节能型 1.8/2.5/3.3V_32M/64M/128M/256M/512M	汽车
	mDDR SDRAM	节能型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G	工业、消费
		车规节能型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G	汽车
	LPDDR2 SDRAM	节能型 1.2/1.8V_256M/512M/1G/2G/4G	工业、消费
		车规节能型 1.2/1.8V_256M/512M/1G/2G/4G	汽车

（2）SRAM 产品

标的公司 SRAM 产品品类丰富，从传统的 Synch SRAM、Asynch SRAM 产品到行业前沿的高速 SRAM 产品均拥有自主研发专利。通过多年的积累，SRAM 产品面对客户在高速、低功耗等不同性能需求中，逐渐赢得客户的认可。

报告期内，标的公司主要 SRAM 产品及用途情况如下表所示：

产品类别	细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
SRAM	Asynch SRAM	高速型 5V_64K/256K/512K/1M/4M	工业、汽车
		低功耗型 5V_256K/1M/4M/8M	工业、汽车
		高速低功耗型 256K/512K/1M/2M/3M/4M/8M/16M/ 32M	工业、汽车
		节能型 256K/1M/2M/4M/8M/16M	工业
		车规型 256K/1M/2M/4M/8M/16M/32M	汽车
	Pseudo SRAM	普通型 1.7-1.95V_8M/16M/32M/64M	工业
		普通型 2.7-3.6V_8M/16M/32M/64M	工业
		车规型 1.7-1.95V_8M/16M/32M/64M	汽车
		车规型 2.5-3.6V_8M/16M	汽车
		车规型 2.7-3.6V_16M/32M/64M	汽车
	HyperRAM	1.7-1.95V_64M/128M/216M	工业、汽车、医疗
		2.7-3.6V_64M/128M/216M	工业、汽车、医疗
	Synch SRAM	流水式 2.5/3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业
		流水式 1.8V_36M/72M	工业
		直通式 2.5/3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业
		直通式 1.8V_36M/72M	工业
		无停顿式 2.5/3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业
		无停顿式 1.8V_36M/72M	工业
	Automotive Synch	车规型 2.5/3.3V_4M/9M/18M/36M/72M	汽车
		车规型 1.8V_72M	汽车
	QUAD/QUADP	18M/36M/72M	工业、消费
	DDR-II/DDR-IIP	18M/36M/72M	工业、消费
	RLDRAM2	288M/576M	通讯
	RLDRAM3	576M/1G/2G	通讯

（3）FLASH 产品

标的公司 FLASH 类产品包括了目前全球主流的 NOR FLASH 存储芯片和 NAND FLASH 存储芯片，其中 NOR FLASH 存储芯片产品具有串口型和并口型两种设计结构，以及从 256K 至 1G 的多种容量规格，NAND FLASH 存储芯片主

攻 4G 大容量规格，公司的 FLASH 产品主要应用于汽车和工业领域。除产品销售收入外，标的公司还有少量面向消费市场的专利授权费收入。

报告期内，标的公司主要 FLASH 产品或服务及用途情况如下表所示：

产品类别	细分产品名称	细分产品（服务）规格	产品适用领域
FLASH	Serial NOR FLASH	1.65-1.95V_2M/4M/8M/16M/32M/64M/128M/256M	工业、汽车
		2.3-3.6V_256K/512K/1M/2M/4M/8M/16M/32M/64M/128M/256M	工业、汽车
		复式 SPI2.3-3.6V/1.65-1.95V_512M	工业、汽车
	Parallel NOR FLASH	2.7-3.6V_32M/256M/512M/1G	工业、汽车
	HyperFLASH	2.7-3.6V_128M/256M/512M	工业、汽车
		1.7-1.95V_128M/256M/512M	工业、汽车
	SLC NAND FLASH	普通型 2.7-3.6V_4G	工业
		普通型 1.7-1.95V_4G	工业
		车规型 2.7-3.6V_4G	汽车
		车规型 1.7-1.95V_4G	汽车
	Pfusion Embedded	向晶圆厂商及客户提供的嵌入式闪存专利技术的使用授权	消费

（4）ANALOG 产品

标的公司的 ANALOG 业务由子公司 SI EN Cayman 经营，产品包括 LED 驱动芯片（LED Drivers）、功放驱动芯片（Amplifier/Headphone Driver）、传感芯片（Sensor）、车规模拟芯片（Automotive）等。

报告期内，标的公司主要 ANALOG 产品或服务及用途情况如下表所示：

产品类别	细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
ANALOG	LED Drivers	FxLED 驱动	汽车、消费
		可调节高亮度 LED 驱动	汽车
		车用高亮度 LED 驱动	汽车
		线性高亮度 LED 驱动	汽车
		白光 LED 驱动	汽车
		汽车背光 LED 驱动	汽车
	Amplifier/Headphone Driver	AB 级音频功放	汽车
		D 级音频功放	汽车
		耳机驱动	汽车

		G 级扬声器功放	汽车
		K 级扬声器功放	汽车
	Sensor	手势传感器	汽车、消费
		电容触摸式传感器	汽车、消费
	Automotive	车规型音频	汽车
		车规型背光 LED 驱动	汽车
		车规型 DC/DC 转换	汽车
		车规型线性高亮度 LED	汽车
		车规型可调节高亮度 LED	汽车
		车规型 FxLED	汽车

（二）拟注入资产所处行业概况

1、标的公司所处行业的基本情况

标的公司主要业务为集成电路存储芯片的研发、技术支持和销售，根据《上市公司行业分类指引》，标的公司属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照《国民经济行业分类》，标的公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”之“集成电路设计”，行业代码“6550”。

2、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

中华人民共和国工业和信息化部是集成电路行业的主管部门，其主要职能为：拟定行业规划、产业发展战略和方针；制定行业技术政策、技术标准，以此推动重大技术发展和自主创新；推动相关科研成果产业化；引导企业结构和产业结构的调整，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是半导体行业的自律性组织，主要进行半导体行业研究、为会员单位提供指导与咨询服务、代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见、维护会员单位的合法权益、推动行业机制的完善等活动。中国半导体行业协会下设集成电路设计分会，该分会在促进我国集成电路设计业的发展方面发挥着重要的作用。

工信部和半导体协会构成了标的公司所处行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控政策的引导和行业协会的约束下，面向市场独立经

营，自主承担市场风险。

（2）行业主要法律法规和产业政策

集成电路产业是国家经济发展的支柱产业之一，产业发展程度是体现国家科技发展综合实力的重要因素。同时集成电路行业作为国防安全的支柱行业，得到国家的高度重视和大力支持。因此我国政府通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。在过去十年中，陆续颁布了一系列政策及法律法规，大力支持该行业的发展，主要政策及法律法规如下：

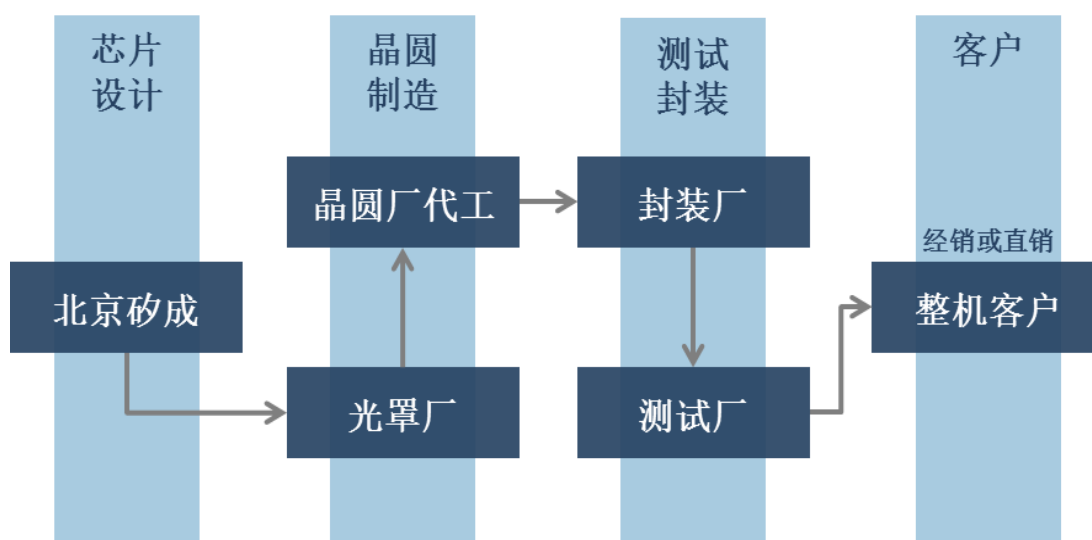
序号	颁布时间	法律法规	颁布部门	相关内容
1	2016年5月	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2012】27号）	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	落实了享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业的税收优惠工作
2	2015年5月	《中国制造2025》	国务院	为大力提升集成电路设计水平，将集成电路纳入“新一代信息技术产业”重点领域
3	2014年6月	《国家集成电路产业发展推进纲要》	国务院	提出着力发展集成电路设计业，以带动制造业的发展，持续推动先进生产线的任务。同时，引导国家产业投资基金资金进入集成电路行业
4	2013年2月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	发改委	将集成电路测试装备列入战略性新兴产业重点产品和服务
5	2012年7月	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	提出要大力提升高性能集成电路产品的自主研发能力，突破先进芯片制造技术，加强相关封装、测试等装备的研发，培育集成电路产业竞争优势
6	2012年4月	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	提出重点发展集成电路设计，着重提高高端芯片领域设计能力
7	2012年2月	《集成电路产业“十二五”发展规划》	工信部	为“十二五”期间集成电路的发展指明了方向
8	2011年6月	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	将集成电路列为优先发展的高技术产业化重点领域
9	2011年3月	《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》	十一届全国人大四次会议	提出大力发展包括集成电路产业在内的新一代信息技术产业
10	2011年1月	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	进一步落实鼓励集成电路产业发展的财税优惠政策、投融资政策、研究发展政策、人才政策等优惠政策
11	2010年10月	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	提出着力发展集成电路、高端软件、高端服务器等核心基础产业

		（国发【2010】 32号）		
12	2006年2月	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	将高端通用芯片及基础软件、极大规模集成电路制造技术及成套工艺作为16个重大专项，并在税收优惠、知识产权保护等方面提出了政策和措施
13	2001年10月	《集成电路布图设计保护条例实施细则》	国家知识产权局	进一步完善了《集成电路布图设计保护条例》实施细则
14	2001年3月	《集成电路布图设计保护条例》	国务院	为了鼓励集成电路技术创新，促进科学技术的发展，同时保护集成电路布图设计专有权
15	2000年6月	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	该政策对集成电路产业实施全面优惠，包括投资产业政策、出口政策、收入分配政策、融资政策、税收政策等方面，是集成电路产业的核心政策

（三）主要业务流程图

1、总体业务流程

标的公司作为专门从事集成电路设计行业的公司，采用无晶圆厂运营模式，在晶圆制造和测试、芯片封装和测试生产环节上由大型专业的独立第三方晶圆制造企业、独立第三方封装测试企业完成。标的公司在取得测试后晶圆或芯片成品后销售给客户。



2、标的公司总体业务流程说明

（1）研发部门技术人员通过系统设计和电路设计，根据芯片规格和芯片系统、逻辑和性能的设计要求制作成具体的物理图版。之后将设计好的物理图版交

付光罩厂制作光罩。

（2）标的公司委托晶圆厂代工制造晶圆，通过标的公司提供的由物理图版制成的光罩，晶圆代工厂在晶圆基片上逐层转移设计图形，最终制成成品晶圆。成品晶圆在经过晶圆测试工序后，在满足相应良品率的情况下，进一步成为合格的经测试后晶圆。相应的晶圆测试工序不会对成品晶圆产生物理变化。

（3）经测试后晶圆先由标的公司委托的封装厂进行封装加工，在经过切割之后挑选出良品晶粒，根据客户对芯片产品的不同规格及工艺要求，晶粒以不同形式进行封装后形成芯片。封装后芯片按照客户对产品性能的不同要求，进行耐用性、抗腐蚀性、耐高温性等得不同测试，通过各测试工序并达标后，产出成品芯片产品。

（4）通常情况下，标的公司按照整机客户在整机产品或其方案设计上的不同需求，采用向整机客户直接销售芯片产品，或通过经销商的客户积累和渠道优势向整机客户销售芯片产品。

（四）主要经营模式

标的公司定位于 Fabless 的经营模式，即无晶圆生产线集成电路设计经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售，没有自有生产车间，晶圆生产、芯片封装和测试均通过委托代工方式实现，因此标的公司需向晶圆代工厂采购晶圆，向封装厂、测试厂采购封装服务和测试服务。

1、采购/生产模式

在采购/生产环节，标的公司主要通过客户的订单以及市场对于芯片产品的未来需求预测向晶圆厂及封装测试厂商下订单，主要采购的产品为晶圆、封装服务和测试服务。

标的公司的采购/生产环节可以分为前端和后端两个环节，其中前端（front end）环节分为晶圆采购及测试环节，后端（back end）环节分为芯片封装、芯片测试环节。在前端环节中，采购产品分成两类：一类为成品晶圆，后续由标的公司委托第三方完成晶圆测试后，再进入后端的封装、测试加工环节，此类型采购数量占比较高；第二类是直接从晶圆厂采购已经完成测试工序的晶圆，即经测试后晶圆，之后再进入后端的第三方封装、测试加工环节，此类采购数量占比较少。

在后端环节中均为服务采购，分为封装服务采购和测试服务采购。由标的公司将前端采购的经测试后晶圆委托封装厂进行封装服务制成封装后芯片，再将封装后芯片交由测试厂完成最后的测试工序，最终出厂的为封测后芯片。

经过多年的合作，标的公司与主要的晶圆制造厂商、晶圆测试厂商、芯片封装厂商及芯片测试厂商建立起了长期而稳定的合作关系，能够保障产品及服务的稳定供应。

2、销售模式

标的公司的产品主要在欧洲、美洲及亚洲销售，其产品主要应用于汽车电子、工业制造等专用领域，由于整机客户所处的垂直行业大都属于高技术、高壁垒行业，对应工业级芯片产品的性能、表现及耐久度要求通常高于消费级产品，形成了两种销售模式，分别为直销模式和经销商模式。

（1）在直销模式下，客户结构大多由欧美的全球品牌整机厂商构成，此类客户群体在前期产品研发、方案设计以及后期技术支持上较其他厂商有更高要求，通常情况下，直销模式流程如下：

1）整机客户派专人作为销售代表直接和标的公司的市场部门、研发部门对接，就指定产品或方案提出具体要求。

2）双方针对技术细节深入讨论后交由研发部门做产品开发。

3）待产品开发完毕，样品通过客户的产品性能检测后，由对接整机客户的销售代表向标的公司的销售人员直接下订单。再由标的公司委托代工厂生产制造。

（2）在经销商模式下，标的公司的客户大多由全球级别的代理商组成，通过代理商对接，有效了解市场需求情况及整机厂商的产品要求。通常情况下，经销商模式流程如下：

1）整机客户通过代理商和标的公司开始对接，结合代理商对产品未来市场预测，对产品要求及解决方案进行讨论。

2）在标的公司完成产品开发和通过客户检测后，整机客户向标的公司发出产品需求预测，同时向代理商下订单。

3) 标的公司结合代理商订单量及整机客户的需求预测，委托代工厂生产制造。

整机客户通常只会选择一种采购方式和标的公司对接，在直销模式和经销商模式下，客户群体不会发生冲突，同时根据行业惯例，整机厂商亦不会轻易改变采购方式。

3、盈利模式

标的公司主要从事集成电路存储芯片的研发、销售以及部分技术专利的使用授权，利润主要来自于芯片产品的销售以及技术专利的授权使用费用。标的公司通过将前沿技术、行业经验、创新型人才有效结合，组织研究开发，转化为具有高经济价值的芯片产品和专利技术，形成两种盈利模式，分别为成本加成类盈利模式和授权收费类盈利模式。

占主要业务收入大部分的集成电路存储芯片研发、销售属于成本加成类盈利模式，标的公司通过向垂直行业的整机客户提供高性能、高可靠性的集成电路存储芯片产品，参考市场供需情况、客户订单数量、产品生产成本及合理利润空间确定产品市场价格，最终收获产品销售后利润。标的公司模拟芯片的盈利模式和存储芯片相同。

占主要业务收入小部分的技术专利使用授权属于授权收费类盈利模式，标的公司通过高学历且经验丰富的研发团队进行研究开发，积累技术专利。通过向有技术使用需求的整机客户或者晶圆制造厂商收取技术专利的使用费用获得利润回报。

4、结算模式

(1) 采购结算模式：标的公司对于代工厂大多采用月结 45 天或月结 60 天的方式结算采购款。

(2) 销售结算模式：在直销模式下，标的公司对于整机客户大多采用发货后月结方式结算销售款项。在经销商模式下，标的公司对于代理商采用待代理商向整机客户发货后月结的方式结算销售款。

（五）主营业务的经营情况

1、主要产品或服务销售收入情况

（1）按业务类型分类

最近三年，标的公司主营业务收入按照产品类型分类，可以分为存储芯片销售收入和模拟芯片销售收入，分类情况如下表：

单位：万元

产品分类	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
存储芯片	206,266.11	96.61%	187,552.91	97.10%	198,475.55	97.68%
模拟芯片	7,247.56	3.39%	5,610.34	2.90%	4,706.01	2.32%
合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

（2）按地域分类

最近三年，标的公司主营业务收入按照地域分类，情况如下表：

单位：万元

地域	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
欧洲	61,153.30	28.64%	50,195.66	25.99%	49,030.25	24.13%
中国香港	44,785.32	20.98%	35,660.34	18.46%	36,593.76	18.01%
美国	27,142.77	12.71%	23,422.78	12.13%	23,887.58	11.76%
中国台湾	26,775.37	12.54%	24,979.63	12.93%	29,064.25	14.30%
中国（大陆）	17,164.10	8.04%	20,643.40	10.69%	25,303.98	12.45%
日本	14,526.20	6.80%	16,441.19	8.51%	13,264.30	6.53%
亚太其他地区	13,525.96	6.33%	13,132.94	6.80%	14,918.61	7.34%
韩国	7,224.42	3.38%	8,108.34	4.20%	10,073.29	4.96%
北美其他地区	1,123.54	0.53%	446.66	0.23%	732.73	0.36%
南美	92.69	0.04%	132.32	0.07%	312.82	0.15%
合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

标的公司下属经营实体 ISSI 成立已逾 20 年，并已形成全球布局，主营业务覆盖了美国、欧洲、日本、中国、亚太等全球主要国家和地区。报告期内，标的公司主要收入来自于欧洲、美国、日本、中国香港、中国台湾等海外市场，来自

中国大陆的收入占比相对较低。受益于近年来全球汽车市场的蓬勃发展以及越来越高的电子化程度，凭借自身产品在专用领域的良好性能及高可靠度，标的公司来自于欧洲、中国香港和美国的主要地区市场收入占比均得到一定程度的提升。

2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司在中国大陆实现的收入占主营业务收入的比重分别为 12.45%、10.69%和 8.04%，境内销售收入占比相对较低，也与中国在全球集成电路市场的地位不符。北京矽成的主要经营实体 ISSI 在私有化完成前，是一家面向全球市场开展业务的美国纳斯达克上市公司，产品海外销售网络发达。同期，标的公司对中国存储芯片市场的开发程度有限。自前次私有化完成后，标的公司已逐步加强中国大陆客户和渠道的拓展。本次重组完成后，北京矽成可以共享上市公司发达的国内销售网络、研发技术和符合中国国情的经营理念，进一步加强针对国内市场需求的研发投入，加快在国内市场的发展速度。

中国大陆正处于消费电子产品的后普及时期，在产品差异化及消费升级等概念的带动下，新产品的出货仍将保持较高水平；同时，随着我国工业技术的进步、自有工业品牌的发展及新一轮工业自动化的背景下，各类集成电路产品将迎来较大的产品需求。此外在国家安全以及进口替代的国家战略推动下，作为国内厂商的标的公司在市场份额的拓展上将更为受益，随着标的公司在中国大陆业务的拓展，预计中国大陆的收入对主营业务收入的贡献将逐步提升。

（3）按终端市场分类

最近三年，标的公司主营业务收入按照终端市场分类，可以分为汽车市场、工业市场、信息通讯市场和消费电子市场，终端市场分布情况如下：

单位：万元

终端市场	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比
汽车	115,239.91	53.97%	100,212.77	51.88%	99,387.24	48.92%
工业	53,779.39	25.19%	47,305.52	24.49%	48,971.24	24.10%
信息通讯	20,450.49	9.58%	21,668.06	11.22%	28,370.84	13.96%
消费电子	24,043.87	11.26%	23,976.91	12.41%	26,452.24	13.02%
合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

从终端市场看，标的公司客户主要集中在汽车和工业市场，信息通讯和消费电子市场收入占比较小。近年来随着标的公司产品设计能力的提升以及同客户之

间的紧密合作，来自于专用领域的客户收入占比逐步增长，其中汽车市场客户收入占比在 2014 年、2015 年和 2016 年达到 48.92%、51.88%和 53.97%，报告期内逐年呈现明显上升趋势。

2、主要产品产销率

报告期内，标的公司主要产品的产销率情况如下表：

期间	2016 年度		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率
存储芯片	273,062,919	272,224,803	99.69%
模拟芯片	90,838,020	90,718,817	99.87%
合计	363,900,939	362,943,620	99.74%
期间	2015 年度		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率
存储芯片	250,848,683	250,193,610	99.74%
模拟芯片	89,768,992	89,768,992	100.00%
合计	340,617,675	339,962,602	99.81%
期间	2014 年度		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率
存储芯片	372,060,830	371,747,290	99.92%
模拟芯片	94,084,245	94,084,245	100.00%
合计	466,145,075	465,831,535	99.93%

2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司的集成电路芯片产品总体产销率分别为 99.93%、99.81%、99.74%，保持稳定良好的销售趋势。其中，标的公司 2015 年度存储芯片和模拟芯片的销售量较 2014 年度有所下降，主要原因来自于标的公司在 2015 年根据市场变化及客户需求，配合自身产品结构升级，削减了销售单价相对较低且产品毛利率较低的部分 FLASH 存储芯片类产品。

3、报告期内向前五客户的销售情况

报告期内，标的公司主要通过直销和经销商模式对外进行集成电路存储芯片以及集成电路模拟芯片的销售。2014 年、2015 年、2016 年，标的公司向前五大客户销售金额占当期营业收入总额的比例分别为 46.68%、45.98%和 48.08%。具体明细如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入总额比例	销售模式
2016 年度	1	Arrow	37,808.65	17.71%	经销商
	2	EBV	23,369.73	10.95%	经销商
	3	Avnet	19,325.17	9.05%	经销商
	4	DELPHI	11,737.65	5.50%	直销
	5	Sertek Incorporated	10,412.68	4.88%	直销
	合计		102,653.89	48.08%	
2015 年度	1	Arrow	32,447.30	16.80%	经销商
	2	EBV	23,878.74	12.36%	经销商
	3	Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd	11,379.01	5.89%	直销
	4	Sertek Incorporated	11,342.91	5.87%	直销
	5	Avnet	9,763.39	5.05%	经销商
	合计		88,811.35	45.98%	
2014 年度	1	Arrow	35,071.85	17.26%	经销商
	2	EBV	28,092.57	13.83%	经销商
	3	Panasonic Automotive Systems Dalian Co.,Ltd	13,170.21	6.48%	直销
	4	Sertek Incorporated	11,062.16	5.44%	直销
	5	KAGA	7,441.19	3.66%	直销
	合计		94,837.98	46.68%	

报告期内，标的公司不存在单个客户的销售比例超过 50%的情况，前五大客户中无标的公司关联方，标的公司董事、监事、高级管理人员和核心人员，主要关联方或持有标的公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有任何权益。

（六）主要原材料、能源的采购及供应情况

集成电路存储芯片产业经过几十年的发展，已经形成了两种成熟的经营模式，分别为 IDM 模式，即集成整合制造模式，指企业业务范围涵盖集成电路设计、制造、封装和测试等所有环节的经营模式；以及以垂直分工为主导的经营模

式，其中分为集成电路设计、晶圆生产、封装和测试。

标的公司采用 Fabless 经营模式，即无晶圆生产线集成电路设计经营模式，不从事具体生产，属于垂直分工为主导下的经营模式。该模式下，Fabless 企业通过委托代工方式将晶圆生产、封装和测试工序委托第三方晶圆代工厂、封装厂和测试厂代工，自身专门从事集成电路成存储芯片设计，在取得经测后成品芯片后向直销客户或经销商销售。Fabless 经营模式为企业带来四方面优势：一是轻资产优势，Fabless 企业不需要对昂贵的生产设备、生产技术研发进行资本投入，只需要在研发团队的组建和产品设计技术研发上有针对性的投入；二是聚焦核心竞争力优势，Fabless 企业在经营管理上无须对晶圆制造、封装和测试生产加工环节投入过多精力，使企业能专注于存储芯片产品的研发设计；三是灵活的销售优势，由于 Fabless 企业更专注于产品的研发环节，与终端客户之间沟通更为频繁，对市场的需求变化具有较高敏感性，能灵活快速的根据市场变化调整销售策略；四是优质供应商合作优势，Fabless 企业在和代工厂商合作过程中，能够根据自身产品的特征挑选具有最佳工艺制程，最高性价比的供应商，同时由于垂直分工为主导的经营模式下，存储芯片设计厂商和代工厂商之间均签署技术保密协议，保障了企业在挑选合适的优质供应商同时规避技术泄露的风险。

因此，Fabless 经营模式是全球集成电路产业中常见且成熟的经营模式，标的公司对外采购内容主要为晶圆代工、封装服务及测试服务，符合行业惯例。报最近三年，上述三项合计占当期主营业务成本均超过 80%。

1、标的公司委托生产加工情况

标的公司的委托生产加工为面向晶圆代工厂的晶圆代工、封装厂的封装服务和测试厂对封装后芯片的测试服务。报告期内，标的公司的上述采购情况如下表：

单位：万元

2016 年度		
项目	金额	占当期主营业务成本比例
晶圆代工采购	72,629.84	53.71%
封装服务采购	23,591.41	17.45%
测试服务采购	22,558.80	16.68%
合计	118,780.06	87.84%
2015 年度		

项目	金额	占当期主营业务成本比例
晶圆代工采购	66,987.73	52.95%
封装服务采购	21,704.40	17.15%
测试服务采购	20,697.27	16.36%
合计	109,389.39	86.46%
2014 年度		
项目	金额	占当期主营业务成本比例
晶圆代工采购	68,268.25	46.97%
封装服务采购	25,239.45	17.36%
测试服务采购	24,282.24	16.71%
合计	117,789.93	81.04%

注：采购额为主营业务成本中相关采购金额。

最近三年，标的公司来自于晶圆代工采购、封装服务采购、测试服务采购的合计采购金额占当期主营业务成本的比例分比为 81.04%、86.46%和 87.84%，其中 2016 年、2015 年的比例呈现出高于 2014 年比例的现象，主要原因来自于近年来随着存储芯片制造工艺制程的逐年进步，晶圆代工价格逐渐提升，在采购总额中占比逐渐提高。2014 年合计采购总额高于 2015 年的原因主要来自于 2014 年受到全球原材料价格上涨以及受制于全球存储芯片产能紧缺的影响，存储芯片的晶圆代工、封装、测试服务价格处于高位，随着 2015 年全球代工市场产能的扩充及原材料价格的回落，存储芯片代工价格在 2015 年度下降至低点，在 2016 年代工采购价格逐渐呈现合理的增长趋势。

2、标的公司能源供应情况

标的公司不直接从事生产活动，不采购生产所需要的能源。

3、报告期内向前五名供应商的采购情况

最近三年，标的公司主要对外采购为晶圆代工采购、封装服务采购和测试服务采购以及其他办公设备等。2014 年、2015 年、2016 年标的公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 86.62%、92.41%和 88.50%。具体明细如下：

单位：万元

时间	序号	供应商名称	金额	占当期采购

				总额比例
2016 年度	1	力晶科技股份有限公司	19,314.05	32.45%
	2	南亚科技股份有限公司	16,392.45	27.54%
	3	世界先进积体电路股份有限公司	6,794.23	11.41%
	4	中芯国际集成电路制造有限公司	7,894.50	13.26%
	5	武汉新芯集成电路制造有限公司	2,284.35	3.84%
	合计		52,679.59	88.50%
2015 年度	1	力晶科技股份有限公司	25,268.62	38.76%
	2	世界先进积体电路股份有限公司	13,544.20	20.78%
	3	南亚科技股份有限公司	12,706.35	19.49%
	4	中芯国际集成电路制造有限公司	6,859.49	10.52%
	5	台湾积体电路制造股份有限公司	1,868.31	2.87%
	合计		60,246.97	92.41%
2014 年度	1	力晶科技股份有限公司	21,612.22	31.28%
	2	韩国赛可有限公司	10,634.03	15.39%
	3	世界先进积体电路股份有限公司	8,566.92	12.40%
	4	中芯国际集成电路制造有限公司	7,070.05	10.23%
	5	南亚科技股份有限公司	3,890.53	5.63%
	合计		51,773.75	74.93%

注：为当期采购金额。

2015 年和 2016 年，标的公司向前五大供应商采购金额分别为 60,246.97 万元和 52,679.59 万元，占当期采购总额的比例分别为 92.41%和 86.62%，向前五大供应商采购金额占比呈现下降趋势的主要原因来自两方面：第一，受到全球代工市场产能的扩充及原材料价格的回落的影响，2016 年晶圆代工采购价格较 2015 年呈现回调趋势。第二，随着晶圆代工产能的逐渐补充，同时受益于多年来在行业内经营所带来的与供应商之间良好的合作关系，标的公司在 2016 年对于供应链进行了优化，强化了和主要供应商力晶科技和南亚科技等的合作关系，同时也扩展了更多晶圆代工厂的合作渠道，力晶科技的采购金额占比从 38.76%下降至 32.45%，使原本对于较大供应商的依赖程度进一步减轻，强化了自身在供应商中的议价能力，进而使采购金额总数有所下降。

报告期内，标的公司持有南亚科技股份的主体为北京矽成控股子公司 ICSI TW，主要情况如下：

2012年8月31日，北京矽成的下属公司 ICSI TW 分别与南亚科技及其子公司南亚塑胶签订股份认购协议和股权转让协议，分别认购南亚科技私募补办公开发行股票（普通股）190,588,235 股以及南亚塑胶转售的南亚科技普通股共计 486,000,000 元新台币。其中 ICSI TW 直接认购的南亚科技股份为私募补办公开发行股票（普通股），自协议签署之日后 42 个月内无法公开上市交易，至 2016 年，该部分股权锁定期届满，满足上市交易条件。标的公司已于 2014 年和 2016 年处置了持有的全部南亚科技的股权，并获得投资收益 5,024.09 万元和 1,594.94 万元。截至 2016 年末，标的公司不再持有南亚科技股份有限公司的股份。

报告期内，标的公司不存在单个供应商的采购比例超过 50%的情况，前五大供应商中无标的公司关联方。除以上情形外，标的公司董事、监事、高级管理人员和核心人员，主要关联方或持有标的公司 5%以上股份的股东并未在报告期内持有前五名供应商的任何权益。

4、境外生产经营情况

（1）标的公司境外经营情况

标的公司具有覆盖全球主要成熟市场的存储芯片销售网络，报告期内，境外地区销售占比五大地区分别为欧洲、中国香港、美国、中国台湾和日本。下表为报告期内，标的公司主营业务收入按不同地区分类情况：

单位：万元

地域	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
欧洲	61,153.30	28.64%	50,195.66	25.99%	49,030.25	24.13%
中国香港	44,785.32	20.98%	35,660.34	18.46%	36,593.76	18.01%
美国	27,142.77	12.71%	23,422.78	12.13%	23,887.58	11.76%
中国台湾	26,775.37	12.54%	24,979.63	12.93%	29,064.25	14.30%
中国（大陆）	17,164.10	8.04%	20,643.40	10.69%	25,303.98	12.45%
日本	14,526.20	6.80%	16,441.19	8.51%	13,264.30	6.53%
亚太其他地区	13,525.96	6.33%	13,132.94	6.80%	14,918.61	7.34%
韩国	7,224.42	3.38%	8,108.34	4.20%	10,073.29	4.96%
北美其他地区	1,123.54	0.53%	446.66	0.23%	732.73	0.36%

南美	92.69	0.04%	132.32	0.07%	312.82	0.15%
合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

（2）标的公司境外资产情况

标的公司在境外拥有的资产情况详见“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（三）标的公司股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产的权属情况”。

（七）安全生产及环境保护情况

1、安全生产情况

标的公司主要从事集成电路的设计，不涉及生产环节，相关生产环节通过委托加工的方式进行。

2、环保情况

标的公司经营不会产生废水、废气、废渣和噪声等，对环境不会产生污染。

（八）质量控制情况

1、质量控制体系

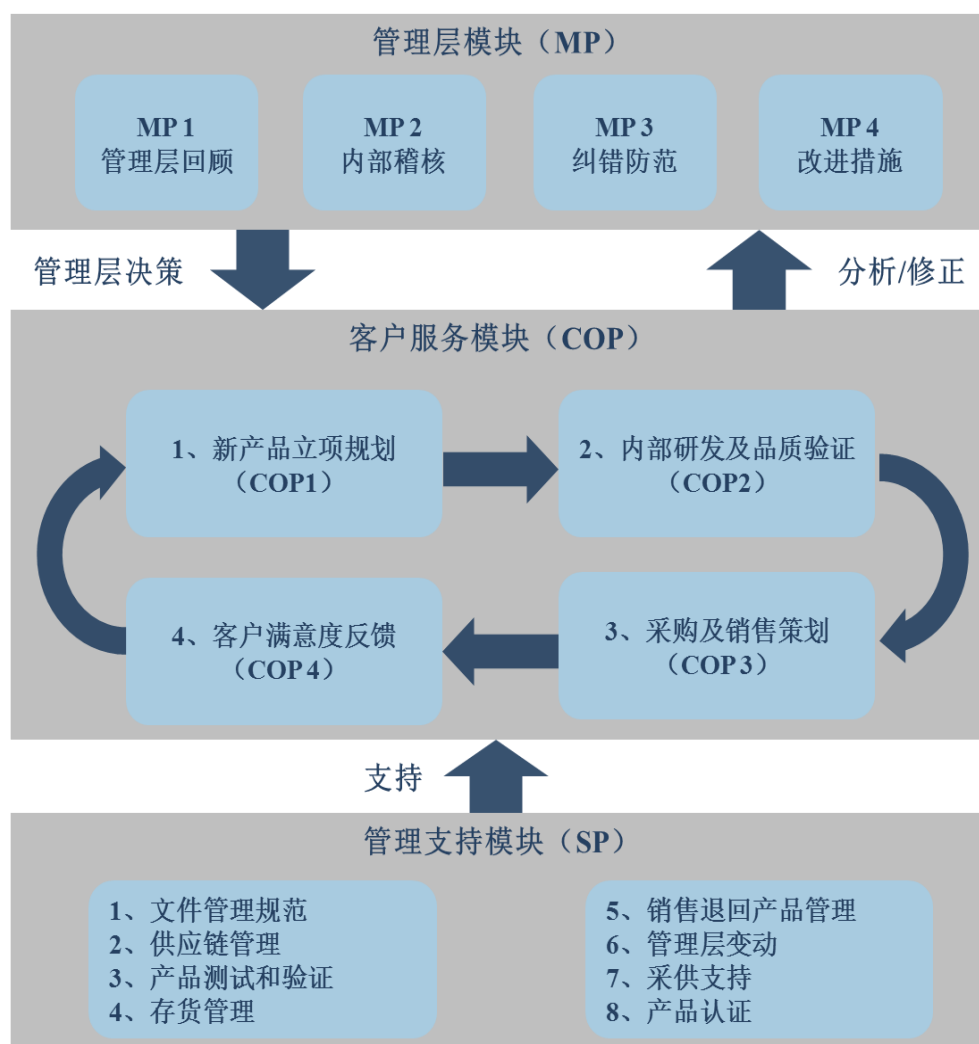
为保障产品质量达到各垂直行业的专业技术标准，满足各个客户要求，标的公司设立了品质保障部门（QRA），负责标的公司内部产品质量和可靠性的管理。品质保障部门同时结合标的公司的质量管理体系（QMS），对基于产品研发、晶圆代工、封装代工、测试代工、品质验证、及售后服务各环节形成的整套经营模式进行全程监控。

2、质量管理体系及构成

在内部质量监管系统方面，标的公司根据 ISO9001 和 TS16949 的标准开发了符合其经营特点的质量管理系统。品质保障部门在对标的公司内部各部门工作监管时，以质量管理体系作为工作活动的规范，确保各部门的工作符合要求。质量管理体系不仅局限于对标的公司内部工作活动的规范，还为晶圆厂和其他代工厂提供了产品质量的标准和依据。

标的公司的质量管理体系主要由三部分组成，分别为客户服务模块（COP）、

管理层模块（MP）和管理支持模块（SP）。其中核心模块为客户服务模块，本着以客户满意度为首的管理理念，在该模块中品质保障部门围绕从新产品立项规划、内部研发及品质验证、采购及销售策划到客户满意度反馈四个环节对产品的品质做到全范围的跟踪和监控。管理层模块和管理支持模块则是为了进一步加强客户服务环节中对产品质量的管理。标的公司的质量管理体系如下图所示：



3、质量控制措施

为确保产品的质量、部门的规范性和质量管理体系的有效性，标的公司制定了管理层模块和管理支持模块，作为加强质量管理体系的控制措施。

在管理层模块中，起着重要作用的有定期进行的内部稽核制度和管理层回顾会议。内部稽核制度是由经验丰富的资深稽核员牵头，每年会排定内部稽核计划，并严格按照计划进行稽核。对于不符合标准或者可以改善的情况，被稽核部门需要提出方案进行相应的改善。标的公司也会对产品定期安排质量与可靠度的定期

抽检，以确保产品的品质。同时，标的公司高层每季度也会联合各部门主管每季度召开管理层回顾讨论会议，旨在对报告中各个部门出现的问题进行分析及探讨改进的方案。

在管理支持模块中，品质保障部门不仅对内部的工作制定了相关规定，也对外部的供应链管理做到全程的管理。最为内部规定中最重要的文件管理规范，是通过结合标的公司自身特点，由市场、研发、销售、运营、行政等各部门联合制定的全套规范文件，该规范为各部门活动开展提供了流程依据，同时也记录和保存了各部门的报告，便于各部门间的查阅。对于外部提供代工服务的供应链，各部门每个月会联合对应供应商定期进行供应商审核会议，同时每年至少会对供应商排定一次年度稽核程序，根据每个供应商的产品品质、技术、产能、运输和成本进行评分，得分较低的供应商会被要求进行提高。

4、产品质量纠纷情况

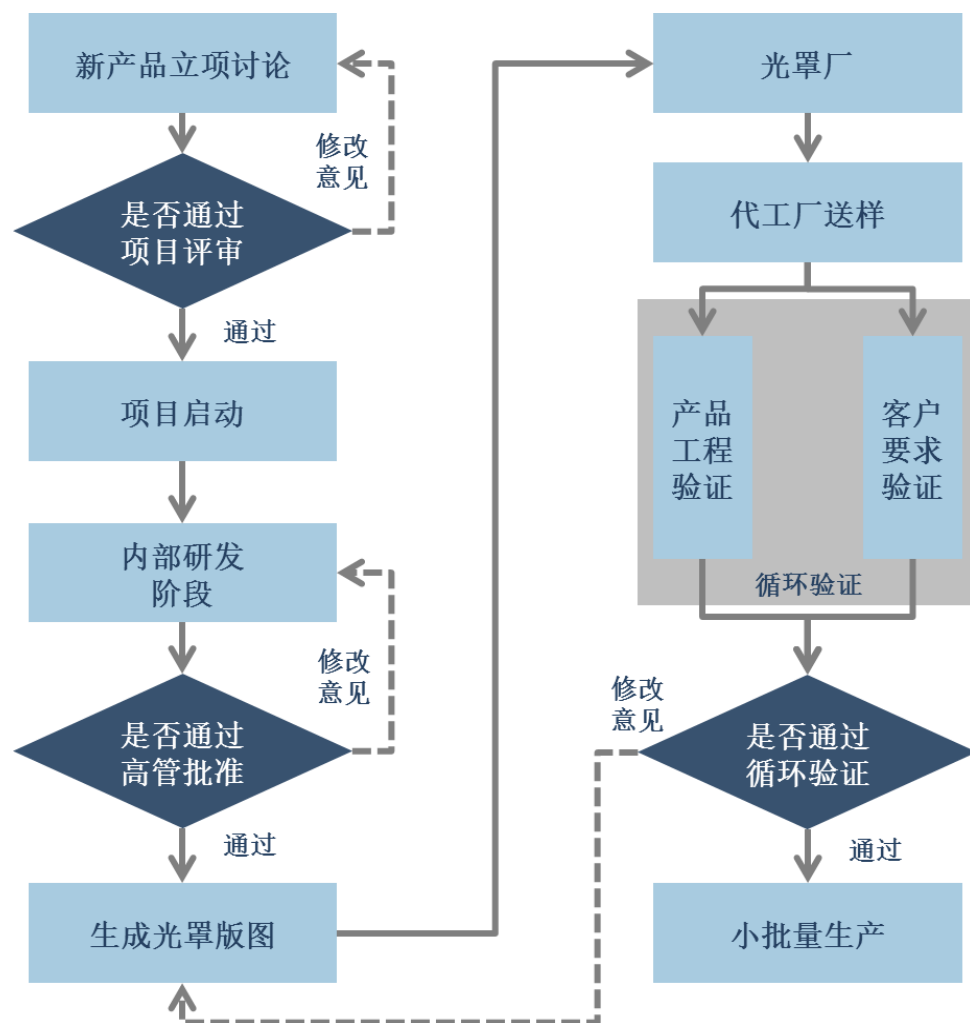
标的公司非常重视客户的满意程度，在产品品质的质量控制上建立了覆盖到各经营环节的监管规范及管理措施，多年来一直遵守严格的质量管理标准。报告期内，标的公司未发生过产品质量纠纷。

（九）标的资产研发情况及核心技术人员情况

1、研发模式

标的公司的主要产品集成电路存储芯片以及模拟芯片在产品质量和性能上有着较高的市场认可度，这受益于标的公司一整套科学、规范的研发流程。从最初的新产品立项讨论、设计标准检验，经过客户以及工程部对产品规格和性能的循环检验，直至最后产品开始小规模生产，标的公司缜密而严格的研发管理体系，确保了产品从设计到量产的过程中，每一个重要环节都得到有效的控制和管理，最终通过客户的不断验证，获得市场的认可。

标的公司的研发流程如下：



（1）立项讨论阶段

在新产品立项阶段，首先会由市场部搜集主要客户对于下一代产品的要求，在规格、性能、成本和需求量方面进行了解，同时综合技术发展趋势、竞争对手产品研究、未来市场供需预测等因素制作初步报告。之后在每月例行的产品规划会议中，市场部联合设计工程师根据讨论新产品的规划方向，制定新产品的产品规格和性能特征，再交由设计部门进行新产品的可行性分析，最终由设计团队负责人决定是否通过项目评审，启动项目。

（2）内部研发阶段

每个新产品项目将会被分配至不同产品线的设计工程团队中的不同设计小组，由设计小组组长、产品设计团队负责人、设计部门负责人分别对产品研发的日程进度以及阶段性成果做逐层向上的管控。同时对于研发进程中可能会遇到的技术障碍和难点问题，设计部有着灵活的协调研讨会议制度，通过协调研发部内

部资源，组织具有丰富经验的设计工程师互动讨论，促进项目研发工作的实施。

在设计工程师根据项目启动时指定的产品规格及性能特征基本完成新产品的开发设计后，会由技术工程师进行分析，评估在未来生产阶段最合适的代工晶圆厂。在通过技术工程师的评估环节后，市场部会对整个新厂品项目做完整的ROI分析，评估整个项目的投资回报情况。最后在得到项目决策委员会的高管批准后，生成产品的物理图版，交由光罩厂制作光罩。

（3）循环验证阶段

经过指定的晶圆代工厂生产以及封装厂、测试厂的加工，测试部及产品部将对代工厂送来的产品样品进行循环验证，循环验证主要分为两部分，分比为产品工程验证和客户要求验证：

1) 产品工程验证是由封装工程师和测试工程师在品质保障部门的可靠性工程师的协助下，对产品进行品质测试、特征测试、可靠性测试、压力测试、失效分析、阿尔法测试和贝塔测试等一系列严格而高标准的检测。

2) 客户要求验证是由产品工程师从产品的工作特征可靠性以及工艺稳定性性能的角度出发，检测新产品是否满足每一个客户对于芯片产品在整机组装后的工作表现，如果检测结果未达标，需要同客户一起分析可能的原因，并反馈给设计工程部。

若经过产品工程验证或客户要求验证后，有任何一项未达到产品的性能和特征要求或是未能满足客户的要求，设计工程师需要对产品设计或是工艺材料做重新调整，并对物理图版做修改，对收到的新样品再次进行产品工程验证及客户要求验证直至完全满足要求。

（4）小批量生产阶段

研究部门负责人和标的公司高管最终参考产品循环验证报告，同时结合市场部及质量控制部的意见，对产品是否投入生产阶段做决定性意见。在产品投入小批量生产一段时间，且良品率达到标的公司的标准后，产品会转入大批量生产。

2、主要产品研发项目进展情况

（1）截至 2016 年 12 月 31 日，DRAM 存储芯片业务主要产品研发进展情

况如下表所示：

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	研发方式
1	IS42/45S16400N	42nm 制程, 3.3V, 64MB (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
2	IS42/45S32200N	42nm 制程, 3.3V, 64MB (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
3	IS42/45S81600J	42nm 制程, 3.3V, 128MB (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	送样	自主研发
4	IS42/45S81800J	42nm 制程, 3.3V, 128MB (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	送样	自主研发
5	IS42/45S32400J	42nm 制程, 3.3V, 128MB (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
6	IS42/45S83200L	42nm 制程, 3.3V, 256MB (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
7	IS42/45S16160L	42nm 制程, 3.3V, 256MB (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
8	IS42/45S32800L	42nm 制程, 3.3V, 128MB (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
9	IS43/46TR81280 C	25nm 制程, 1.5V, 1Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
10	IS43/46TR81280 CL	25nm 制程, 1.35V, 1Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
11	IS43/46TR16640 C	25nm 制程, 1.5V, 1Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
12	IS43/46TR16640 CL	25nm 制程, 1.35V, 1Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
13	IS43/46TR85120 B	1.5V, 4Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
14	IS43/46TR85120 BL	1.35V, 4Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
15	IS43/46TR16256 B	1.5V, 4Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
16	IS43/46TR16256 BL	1.35V, 4Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
17	IS43/46TR81024 B	1.5V, 8Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
18	IS43/46TR81024 BL	1.35V, 8Gb (x8) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
19	IS43/46TR16512 B	25nm 制程, 1.5V, 8Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
20	IS43/46TR16512 BL	25nm 制程, 1.35V, 8Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
21	IS46TR8256ED	25nm 制程, 2Gb (x8) 容量, 满足 A1, A2, A3 等级要求	项目评审	自主研发

22	IS46TR16128ED	25nm 制程， 2Gb (x16) 容量，满足 A1, A2, A3 等级要求	项目评审	自主研发
23	IS46TR85120EC	25nm 制程， 4Gb (x8) 容量，满足 A1, A2, A3 等级要求	内部研发	自主研发
24	IS46TR16256EC	25nm 制程， 4Gb (x16) 容量，满足 A1, A2, A3 等级要求	内部研发	自主研发
25	IS43/46QR85120A	30nm 制程， 4Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	循环验证	自主研发
26	IS43/46QR85120AL	30nm 制程， 4Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	循环验证	自主研发
27	IS43/46QR8M001A	8Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
28	IS43/46QR8M001AL	8Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
29	IS43/46QR16512A	8Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
30	IS43/46QR16512AL	8Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
31	IS43/46QR8M002A	16Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
32	IS43/46QR8M002AL	16Gb (x8) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
33	IS43/46QR16M02A	16Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
34	IS43/46QR16M02AL	16Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
35	IS43/46LR16160H	38nm 制程， 1.8V， 256Mb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
36	IS43/46LR32800H	38nm 制程， 1.8V， 256Mb (x32) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
37	IS43/46LR166	1.8V， 1Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
38	IS43/46LR323	1.8V， 1Gb (x32) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
39	IS43/46LR16128B	38nm 制程， 1.8V， 2Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
40	IS43/46LR32640B	38nm 制程， 1.8V， 2Gb (x32) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
41	IS43/46LD16160B	38nm 制程， 1.2/1.8V， 256Mb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
42	IS43/46LD32800B	38nm 制程， 1.2/1.8V， 256Mb (x32) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
43	IS43/46LD16128B	38nm 制程， 1.2/1.8V， 2Gb (x16) 容量，满足 C、I、A1、A2 等级要求	循环验证	自主研发

44	IS43/46LD32640 B	38nm 制程, 1.2/1.8V, 2Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	小规模生产	自主研发
45	IS43/46LD16256 0A	38nm 制程, 1.2/1.8V, 4Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	送样	自主研发
46	IS43/46LD32128 A	38nm 制程, 1.2/1.8V, 4Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	小规模生产	自主研发
47	IS43/46LT16128 A	38nm 制程, 1.2V/1.8V, 2Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
48	IS43/46LT32640 A	38nm 制程, 1.2V/1.8V, 2Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
49	IS43/46LT16256 A	38nm 制程, 1.2V/1.8V, 4Gb (x16) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
50	IS43/46LT32128 A	38nm 制程, 1.2V/1.8V, 4Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
51	IS46TR8256ED	25nm 制程, 1.35V/1.5V, 2Gb (x8) 容量, 满足 A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
52	IS46TR16128ED	25nm 制程, 1.35V/1.5V, 2Gb (x16) 容量, 满足 A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
53	IS46TR85120EC	25nm 制程, 1.35V/1.5V, 4Gb (x8) 容量, 满足 A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
54	IS46TR16256EC	25nm 制程, 1.35V/1.5V, 4Gb (x16) 容量, 满足 A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
55	IS43/46LQ32640 A	25nm 制程, 1.1V/1.8V, 2Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
56	IS43/46LQ32128 A	25nm 制程, 1.1V/1.8V, 4Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发
57	IS43/46LQ32256 A	25nm 制程, 1.1V/1.8V, 8Gb (x32) 容量, 满足 C、I、A1、A2 等级要求	内部研发	自主研发

注：上表中产品等级要求中 C 为消费品等级、I 为工业（-40℃至 85℃）等级、A1 为汽车（-40℃至 85℃）等级、A2 为汽车（-40℃至 105℃）等级、A3 为汽车（-40℃至 125℃）等级。

（2）截至 2016 年 12 月 31 日，SRAM 存储芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示：

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	研发方式
1	IS62/65C25616E L	5V, 256K (x16) 容量, 满足 C、I、A1 等级要求	小规模生产	自主研发

2	IS62/65C5128EL	5V, 512K (x8) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
3	IS61/64WV51216EFA/BLL	5V, 512K (x16) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
4	IS61/64WV10248EFA/BLL	5V, 1M (x8) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
5	IS62/65WV51216EFA/BLL	5V, 512K (x16) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
6	IS62/65WV10248EFA/BLL	5V, 1M (x8) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
7	IS62/65WV102416FALL/BLL	5V, 1M (x16) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
8	IS62/65WV20488FALL/EBLL	5V, 2M (x8) 容量, 满足 C、I 等级要求	小规模生产	自主研发
9	IS66/67WVH32M8	63nm 制程, 32M (x8) 容量, 满足 I、A1、A2 等级要求	送样	自主研发
10	IS66/67WVH64M8	63nm 制程, 64M (x8) 容量, 满足 I、A1、A2 等级要求	送样	自主研发

注：上表中产品等级要求中 C 为消费品等级、I 为工业（-40℃至 85℃）等级、A1 为汽车（-40℃至 85℃）等级、A2 为汽车（-40℃至 105℃）等级。

（3）截至 2016 年 12 月 31 日，FLASH 存储芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示：

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	研发方式
1	IS25WE/LE256M	65nm 制程, 1.8/3V, 256MB 容量, 满足 E、E1、A1、A2、A3 等级要求	循环验证	自主研发
2	IS25WE/LP512M	65nm 制程, 1.8/3V, 512MB 容量, 满足 E、E1、A1、A2、A3 等级要求	循环验证	自主研发
3	IS25WP/LP512ME	45nm 制程, 1.8/3V, 512MB 容量, 满足 E、E1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
4	IS25WP/LP01GE	45nm 制程, 1.8/3V, 1GB 容量, 满足 E、E1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
5	IS29GL256 High/Low	65nm 制程, 3V, 256Mb 容量, 满足 E、A1、A2、A3 等级要求	送样	自主研发
6	IS26KL01GT	45nm 制程, 3V, 1Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
7	IS26KS01GT	45nm 制程, 1.8V, 1Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
8	IS26KL02GT	45nm 制程, 3V, 2Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发

9	IS26KS02GT	45nm 制程, 1.8V, 2Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
10	IS26KL04GT	45nm 制程, 3V, 4Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
11	IS26KS04GT	45nm 制程, 1.8V, 4Gb 容量, 满足 I、E、E1、A1、A1、A2、A3 等级要求	内部研发	自主研发
12	IS34/35ML01G081	3V, 1Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
13	IS34/35ML01G084	3V, 1Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
14	IS34/35MW01G084	1.8V, 1Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
15	IS34/35MW01G064	1.8V, 1Gb (x16) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
16	IS34/35ML02G081	3V, 2Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
17	IS34/35ML02G084	3V, 2Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
18	IS34/35MW02G084	1.8V, 2Gb (x8) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
19	IS34/35MW02G164	1.8V, 2Gb (x16) 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
20	IS37/38ML01G1	3V, 1Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	循环验证	自主研发
21	IS37/38ML01G4	3V, 1Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	循环验证	自主研发
22	IS37/38SMW01G1	1.8V, 1Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	循环验证	自主研发
23	IS37/38SMW01G4	1.8V, 1Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	循环验证	自主研发
24	IS37/38SML02G1	3V, 2Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
25	IS37/38SML02G4	3V, 2Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
26	IS37/38SMW02G1	1.8V, 2Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
27	IS37/38SMW02G4	1.8V, 2Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
28	IS37/38SML04G1	3V, 4Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
29	IS37/38SML04G4	Quad I/O 制程, 3V, 4Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
30	IS37/38SMW04G1	Quad I/O 制程, 1.8V, 4Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
31	IS37/38SMW04G4	Quad I/O 制程, 1.8V, 4Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发

32	IS37/38ML08G4	Quad I/O 制程, 3V, 8Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发
33	IS37/38SMW08 G4	Quad I/O 制程, 1.8V, 8Gb 容量, 满足 I、A1 等级要求	内部研发	自主研发

注：上表中产品等级要求中 I 为工业（-40℃至 85℃）等级、A1 为汽车（-40℃至 85℃）等级、A2 为汽车（-40℃至 105℃）等级、A3 为汽车（-40℃至 125℃）等级、E 为（-40℃至 105℃）等级、E1 为（-40℃至 125℃）等级。

（4）截至 2016 年 12 月 31 日，ANALOG 芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示：

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	研发方式
1	IS32LT3170	5-42V, 10-150mA, 满足汽车座舱照明灯、导航地图和顶灯要求	送样	自主研发
2	IS32LT3171	2.8-42V, 10-150mA, 满足汽车照明灯、紧急灯和尾灯要求	送样	自主研发
3	IS32LT3172	5-42V, 10-200mA, 满足汽车照明灯、紧急灯和尾灯要求	送样	自主研发
4	IS32LT3173	2.8-42V, 10-200mA, 满足汽车照明灯、紧急灯和尾灯要求	送样	自主研发
5	IS32LT3174	6-45V, 10-200mA, 满足汽车内部照明灯、导航地图和顶灯要求	送样	自主研发
6	IS32LT3181	6-45V, 10-75mA, 满足汽车 RCL、CHMSL、防雾灯和转向灯要求	送样	自主研发
7	IS32BL3556	4.75-40V, 100mA, 满足汽车照明、液晶显示和尾灯要求	送样	自主研发

3、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

标的公司作为半导体集成电路的设计公司，具有行业领先的研发实力，在全球主要科技发达地区地都有研发团队驻扎，主要分布在美国圣荷西、科罗拉多，韩国首尔，中国上海等地区。2015 年 9 月 10 日，标的公司将拥有台湾地区研发团队的全资子公司 Chingis Technology Corporation 转让给台湾联发科技股份有限公司，并于此之后向其采购产品的外包研发服务，保持稳定的研发投入。同时，标的公司在研发人员的培养与激励方面具有较为完善的制度支撑，经验丰富的研发团队是标的公司保持持续竞争力的主要来源。截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司共有研发人员 166 人，占员工总数比例为 39.15%。

（2）核心技术人员变动情况

标的公司高度重视研发技术人员的培养，以及核心技术团队的稳定性，各产

品研发团队核心成员的流动性较低。报告期内仅有一名核心研发人员离职。该研发人员系标的公司前任 ANALOG 研发团队负责产品测试的主管级工程师曹福兵，于 2014 年 6 月份离职，主要原因为标的公司出于对未来经营发展方向调整所产生的人员调整。

三、标的公司主要会计政策及相关会计处理

（一）收入的确认原则和计量方法

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关经济利益很可能流入；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用北京矽成货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二）标的公司的主要会计政策和会计估计与同行业或同类资产及上市公司之间差异情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，北京矽成所属行业为“C 制造业”下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。同行业上市公司中，大多与标的公司一样采用 Fabless（无生产线的集成电路设计企业）生产模式。

根据中兴华会计师出具的《北京矽成半导体有限公司 2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度备考合并财务报表审计报告》（中兴华专字（2017）第 010161 号），和《北京矽成半导体有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审计报告》（中兴华专字（2017）第 010162 号），北京矽成的会计政策和会计估计与同行业或同类型资产及上市公司不存在重大差异。

标的公司与上市公司对按信用风险组合计提坏账准备的应收款项存在一定差异，就该差异对净利润和净资产的影响说明如下：

1、兆易创新以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）		
其中：3 个月以内	-	-
3-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

2、北京矽成对于单项金额重大或者非重大的应收款项，经单独测试后不存在信用风险并且短期内可全额收回的款项计入确认收回组合，不计提坏账准备。

对单项金额重大的应收款项，北京矽成单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。同时，对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，等等。如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该差异对净利润及净资产无重大影响。

（三）财务报表编制基础及合并财务报表范围、变化情况及变化原因

北京矽成的备考合并财务报表包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日以及 2016 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年度的备考合并利润表和备考合并现金流量表，以及备考合并财务报表附注。

1、标的公司备考合并财务报表的编制基础

2015 年，北京矽成全资子公司闪胜科技与 ISSI 签署了并购协议，并最终每股 23 美元的收购价格收购 ISSI 全部已发行股票。上述交易由董事会于 2015 年 6 月 29 日批准，并于 2015 年 12 月 7 日完成交割。北京矽成备考合并财务报表系假设上述收购事项已于 2014 年 1 月 1 日完成，并于 2014 年 1 月 1 日纳入北京矽成的合并范围，即假设 2014 年 1 月 1 日，标的公司已持有 ISSI 100% 股权并持续经营。

北京矽成的备考合并财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、备考合并财务报表的编制方法

鉴于北京矽成收购 ISSI 100% 股权为非同一控制下企业合并，按照企业会计准则相关规定，北京矽成的备考合并财务报表按照非同一控制下的企业合并的要求编制。

鉴于 2014 年 1 月 1 日时北京矽成尚未实质控制 ISSI，在编制备考合并财务报表时，假设将实际交割日即 2015 年 12 月 7 日按照增值公允价值重新计价的部

分在考虑折旧摊销的基础上倒推回前次合并基准日 2014 年 1 月 1 日的 ISSI 账面净资产，作为备考合并财务报表的期初可辨认净资产的公允价值。

前次合并基准日备考合并财务报表之商誉，以 2015 年 12 月 7 日的商誉人民币 2,213,233,635.57 元作为备考合并财务报表商誉，并在此基础上考虑其在报告期内的后续计量。由于商誉并没有按照合并对价与 2014 年 1 月 1 日 ISSI 可辨认资产、负债的公允价值之间的差额确定，在编制备考合并报表时，产生的差额直接调整“归属于母公司股东权益”项目。

备考合并财务报表采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与北京矽成实际采用的会计政策、会计估计一致。

鉴于假设交易于 2014 年 1 月 1 日完成，其于 2015 年产生的并购交易成本以及中介费用应相应假设于 2014 年 1 月 1 日前发生，调整 2014 年 1 月 1 日“归属于母公司股东权益”项目。

ISSI 的有关可辨认资产、负债在 2014 年 1 月 1 日并入备考合并财务报表时，以其在 2015 年 12 月 7 日的公允价值考虑公允价值增值部分的折旧摊销后倒推确定。

3、标的公司备考合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并范围包括本公司及全部子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，纳入北京矽成合并报表范围的子公司包括：上海闪胜、Uphill Technology Inc.以及 ISSI 等 21 家子公司。

北京矽成的备考报表中假设前次收购于 2014 年 1 月 1 日已经完成，为前次收购设立的境内外实体于 2014 年 1 月 1 日也已经设立。基于该假设，截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成备考合并财务报表的合并范围具体如下：

序号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
1	上海闪胜集成电路有限公司	中国	中国	贸易	100%/直接	设立
2	Uphill Technology Inc.	开曼群岛	开曼群岛	控股	100%/直接	设立
3	Integrated Silicon Solution, Inc.	美国	美国	贸易	100%/直接	购买
4	Si En Integration Holdings Limited	开曼群岛	开曼群岛	控股	100%/间接	购买

5	Winston, Inc.	美国	美国	控股	100%/间接	购买
6	Sofwin, Inc.	美国	美国	控股	100%/间接	购买
7	Chingis Technology Corporation (U.S.)	美国	美国	控股	100%/间接	购买
8	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	制造	100%/间接	购买
9	硅成集成电路股份有限公司	中国台湾	中国台湾	贸易	98.27%/间接	购买
10	矽恩微电子（厦门）有限公司	中国	中国	产品研发	100%/间接	购买
11	Enchida International Limited	中国香港	中国香港	贸易	100%/间接	购买
12	Enable Korea Co, Ltd.	韩国	韩国	贸易	100%/间接	购买
13	Integrated Silicon Solution, Inc. (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡	贸易	100%/间接	购买
14	芯成积体电路（香港）有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100%/间接	购买
15	ISSI Hong Kong Holding Limited	中国香港	中国香港	控股	100%/间接	购买
16	ISSI Japan Godo Kaisha	日本	日本	贸易	100%/间接	购买
17	芯成半导体（上海）有限公司	中国	中国	产品开发	100%/间接	购买
18	Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	贸易	100%/间接	设立
19	Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	贸易	100%/间接	设立
20	Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	贸易	100%/间接	设立
21	Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	贸易	100%/间接	设立

4、合并财务报表范围的变化情况及变化原因

报告期内，北京矽成合并报表范围的变动情况如下：

（1）新设主体导致合并范围增加

2016年5月3日，北京矽成在开曼群岛新设成立两家全资子公司，分别为 Integrated Analog Solution (Cayman), Inc.（企业注册证书 338097065845）和 Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.（企业注册证书 661392752928），注册资本均为 5 万美金。

2016年10月28日，北京矽成再次在开曼群岛新设成立两家全资子公司，分别为 Analog Circuit Solution (Cayman), Inc.（企业注册证书 454903734829）和 Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.（企业注册证书 606168412058）。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述四家新设立的公司均未开展业务。

(2) 处置子公司导致合并范围减少

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点
Chingis Technology Corporation	15,354.29 万元	100%	转让	2015 年 9 月 10 日

(续)

子公司名称	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Chingis Technology Corporation	收到现金	7,189.91 万元	-2,008.41 万元

2015 年 9 月 10 日，北京矽成将全资子公司 Chingis 100%股权以 15,354.29 万元的价格转让给台湾联发科技股份有限公司，并获得股权转让利得合计 5,181.50 万元。自此，标的公司丧失对 Chingis 的控制权，自 2015 年 10 月起不再将 Chingis 纳入合并报表范围。

四、标的公司主要财务指标以及非经常性损益的构成情况

(一) 标的公司主要财务数据

根据中兴华出具的中兴华专字（2017）第 010161 号和中兴华专字（2017）第 010162 号《审计报告》，北京矽成最近三年经审计的合并备考报表的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

合并资产负债表	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	199,911.37	155,102.07	175,924.48
非流动资产	402,873.41	399,450.53	355,113.78
资产总计	602,784.78	554,552.60	531,038.26
流动负债	49,516.87	72,174.48	66,268.53
非流动负债	3,230.06	1,394.96	9,017.61
负债总计	52,746.94	73,569.43	75,286.13
所有者权益合计	550,037.84	480,983.17	455,752.12
合并利润表	2016年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	213,639.22	193,575.52	203,759.90
营业成本	198,737.54	185,672.16	202,713.31
营业利润	17,163.32	13,813.84	5,960.95
利润总额	17,623.64	13,796.96	6,008.64

净利润	14,287.25	6,142.05	1,725.56
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	14,055.40	5,905.54	1,564.04

报告期内，北京矽成备考合并财务报表层面的净利润规模分别为 1,725.56 万元、6,142.05 万元和 14,287.25 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 1,564.04 万元、5,905.54 万元和 14,055.40 万元，呈现逐年快速增长的态势。

（二）标的公司主要财务指标

根据中兴华出具的审计报告，北京矽成最近三年经审计的合并备考报表的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	4.04	2.15	2.65
速动比率	3.00	1.32	1.84
资产负债率	8.75%	13.27%	14.18%
息税折旧摊销前利润（万元）	32,229.40	31,293.13	19,756.83
利息保障倍数（EBITDA）	140.47	576.49	244.08
项目	2016年度	2015 年度	2014 年度
总资产周转率（次/年）	0.33	0.36	-
应收账款周转率（次/年）	5.82	6.80	-
存货周转率（次/年）	2.27	2.22	-

（三）标的公司非经常性损益情况

根据中兴华出具的审计报告，北京矽成最近三年经审计的合并备考报表的非经常损益明细如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	93.39	-16.88	-3.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,594.94	-	5,024.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目	366.93	-	51.22
小计	2,055.27	-16.88	5,071.78
所得税影响额	349.40	-2.87	862.20
少数股东权益影响额（税后）	29.51	-0.24	72.83
归母非经常性损益净额	1,676.36	-13.77	4,136.75
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	93.39	-16.88	-3.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,594.94	-	5,024.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	366.93	-	51.22
小计	2,055.27	-16.88	5,071.78
所得税影响额	349.40	-2.87	862.20
少数股东权益影响额（税后）	29.51	-0.24	72.83
归母非经常性损益净额	1,676.36	-13.77	4,136.75

非经常性损益具体分析参见“第九章 管理层讨论分析”之“四、标的公司盈利能力分析”之“（六）非经常性损益分析”。

第五章 标的资产评估情况

一、北京矽成 100%股权评估的基本情况

（一）评估结论

根据中联评估出具的中联评报字[2017]第 483 号《资产评估报告》，中联评估以持续使用和公开市场为前提，结合北京矽成的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用收益法和市场法两种方法对北京矽成的股东全部权益进行评估，最终选用收益法的评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成归属于母公司所有者权益的评估值为 580,858.47 万元。

1、收益法评估结果

截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成总资产账面价值为 579,755.01 万元，总负债账面价值为 50,932.44 万元，归属于母公司所有者权益的账面值为 527,046.21 万元，收益法评估后的股东权益价值为 580,858.47 万元，增值额为 53,812.26 万元，增值率为 10.21%。

2、市场法评估结果

截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成总资产账面价值为 579,755.01 万元，总负债账面价值为 50,932.44 万元，归属于母公司所有者权益的账面值为 527,046.21 万元，市场法评估后的股东全部权益价值为 587,166.74 万元，增值额为 60,120.52 万元，增值率为 11.41%。

3、收益法与市场法评估结果差异产生的原因分析

收益法评估结果与市场法评估结果相差 6,308.27 万元，差异率为 1.09%，两者差异微小。

一般而言，市场法是从整体市场的表现和未来的预期来评定企业的价值，而收益法是立足于企业本身的获利能力来预测企业的价值，两者是相辅相成的，市场法的结果是收益法结果的市场表现，收益法结果是市场法结果的坚实基础，是企业的内在价值。

市场法结果与收益法结果差异的主要原因在于市场法是企业某时点所反

映的外部市场价格，其结果会受到市场投资环境、投机程度、以及投资者信心等一些因素影响而波动相对剧烈，而收益法则是在评估人员对企业历史经营状况进行专业分析的基础上，对企业未来收益做出合理预测而得出的结论，相比市场法波动相对较小，体现了企业的内在价值；另一方面，市场法所选用的股票市值未能体现大股东真实变现所产生的各类变现成本，如大额抛售对每股价格的影响等，因此市场法结果高于收益法结果是符合实际情况的，两者结果是基本匹配的。

（二）评估结果与账面值比较变动情况及原因

截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成归属于母公司所有者权益的账面值为 527,046.21 万元，评估增值额为 53,812.26 万元，收益法评估增值率为 10.21%。北京矽成的收益法评估结果较其归属于母公司所有者权益账面值增值的主要原因是被评估企业预测收益的稳定增长，而推动其收益持续增长的动力既来自外部也来自内部，主要体现在以下几个方面：

1、中国半导体集成电路行业快速发展

2014 年 6 月 24 日国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》中提出“组织实施安全可靠关键软硬件应用推广计划，以重点突破、分业部署、分步实施为原则，推广使用技术先进、安全可靠的集成电路、基础软件及整机系统”。《国家集成电路产业发展推进纲要》开启了“国产化替代”的新纪元，相关部委也制定了具体的国产化替代计划。

根据半导体产业协会在 2016 年 2 月 2 日发布的数据显示，2015 年中国芯片市场的全年销售额同比增长约 7.70%，为全球销售额增长最高的地区。按照市场发展趋势，2016 年在政策利好、低容量存储器需求剧增的情况下，中国芯片行业已迈入快速发展期，产业链各个环节企业的业绩将迎来快速发展的机遇。标的公司的芯片产品在低功耗、低成本、高集成、高安全方面具有显著的优势，能够持续保持技术研发的力度和效果，并依托其技术优势以及行业内的领先地位，保障较强的盈利能力。

2. 汽车电子化带来集成电路专用领域市场机遇

北京矽成下属的经营子公司，已有 20 多年半导体行业经营历史，拥有专业的设计、研发团队，四大产品 DRAM、SRAM、FLASH 和 ANALOG 在专用领

域市场拥有良好长期的合作伙伴，合作对象包括德赛西威、德尔福、松下汽车电子等国内外知名汽车电子配套厂商，合作时间长，合作关系稳定。随着人们对汽车的安全性、舒适性、便利性以及智能化的要求日益提高，未来汽车将向安全、节能、联网及娱乐的方向发展，具备高级汽车驾驶辅助系统（ADAS）、无人驾驶（UA）、车联网（V2X）、新能源动力等功能和技术的新款车型正逐步将汽车引入电子化及智能化阶段。未来汽车作为以信息汇总、计算和传递为核心的综合交通工具，对信息存储的容量和处理速度提出了更高的要求。被评估企业在汽车专用领域市场拥有较高的收入占比，其存储芯片产品的核心竞争力在未来市场需求增长的情况下将进一步为其开拓新的市场份额。同时，受到汽车智能化趋势的影响，未来单车中搭载车规型集成电路产品的需求将明显提升，在汽车行驶电子化配套系统中的电子仪表盘、T-Box、Cluster 等细分应用，以及高集成度车载显示及触控系统、高可靠性电子器件等应用方向都存在更高电子化设计的需求。根据中投顾问产业研究中心的数据，2020 年汽车电子在整车中的成本将达到约 50%，而目前汽车电子的渗透率仅约为 30%。汽车行业的变革和汽车产品的升级，不仅为车规型存储芯片产品带来更大的市场需求，更是为集成电路专用领域市场的规模带来增长的空间。被评估企业作为在行业内拥有多年研发积累和市场经验的集成电路设计企业，恰逢经营发展的良好机遇。

通过以上分析，中联评估认为本次收益法预估结果有较大的增幅是建立在科学合理的预测基础之上的。收益法评估结果与账面值的差异反映了被评估对象账面未记录的我国集成电路行业本身的优势以及汽车电子化趋势带动的细分市场的机遇的价值，因此评估结果增值是合理的。

二、收益法评估具体情况

（一）收益预测的基础和假设

1、收益预测的基础

对北京矽成的收益预测是根据目前的经营状况和能力以及评估基准日后北京矽成的预期经营业绩及各项财务指标，考虑北京矽成主营业务类型目前的规模和发展前景，以及北京矽成管理层对企业未来发展规划、市场前景的预测等

基础资料，并遵循国家现行的法律、法规和企业会计制度的有关规定，本着客观求实的原则，采用适当的方法编制。

2、预测的假设条件

（1）一般假设

1) 交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2) 公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3) 资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（2）特殊假设

1) 预测期内中美两国国内政局及国际关系稳定，大陆与台湾两岸关系稳定，各自现行的宏观经济以及产业政策、贸易政策、税收政策等不发生重大变化；

2) 预测期内人民币及其他相关货币之间的汇率与基准日相比不发生较大变化；

3) 北京矽成及其子公司主营业务所涉及的市场环境及竞争关系与基准日相比不发生较大变化；

4) 北京矽成及其子公司在未来经营期内的管理层尽职，并按照于基准日制定的经营管理计划持续经营；

5) 北京矽成及其子公司在未来经营期内，会按照 U.S. Transfer Pricing Cost Sharing Plan 和 Platform Contribution License Agreement 约定的 Cost Sharing Method 持续经营，而不发生重大变化；

6) 北京矽成及其子公司在未来经营期内的主营业务结构、收入与成本的构成及各子公司的管理人员、销售人员及研发人员结构按企业的经营计划和经营策略进行相应调整；

7) 在未来的经营期内，北京矽成及其子公司的各项期间费用所涉及项目类型不会在基准日现有基础上发生大幅的变化，并按照其基准日已确定的经营管理计划控制其相应费用支出；

8) 鉴于企业的货币资金或其银行存款等在生产经营过程中频繁变化且闲置资金均已作为溢余资产考虑，评估报告的财务费用评估时不考虑其存款产生的利息收入，也不考虑汇兑损益等不确定性损益；

9) 北京矽成及其子公司能够按照其于基准日已制定的经营管理计划调整各公司的业务及税前利润结构，该等调整不涉及重大法律法规及税务障碍；

10) 北京矽成及其子公司主营业务相关现金收支在预测期间内均匀发生而无月度或季节差异。

（二）重要评估依据及相关参数

1、具体模型

（1）基本模型

本次评估的基本模型为：

$$E = B - D - M \quad \text{式 1}$$

式中：

E：评估对象的所有者权益（净资产）价值；

B：评估对象的企业价值；

D：评估对象的付息债务价值；

M：纳入合并报表范围的非全资子公司所对应的少数股权价值；

$$B = P + C + I \quad \text{式 2}$$

P：评估对象的经营性资产价值；

C：评估对象基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值；

I：评估对象的长期股权投资价值；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n} \quad \text{式 3}$$

式中：

R_i ：评估对象未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；

r ：折现率；

n ：评估对象的未来经营期；

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{式 4}$$

C_1 ：基准日流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；

C_2 ：基准日非流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；

（2）收益指标

本次评估，使用企业的自由现金流量作为评估对象经营性资产的收益指标，其基本定义为：

$$R = \text{净利润} + \text{折旧摊销} + \text{扣税后付息债务利息} - \text{追加资本} \quad \text{式 5}$$

根据评估对象的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来经营期内的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和，测算得到企业的经营性资产价值。

（3）折现率

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率 r

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \quad \text{式 6}$$

式中： W_d ：评估对象的债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E + D)} \quad \text{式 7}$$

W_e ：评估对象的权益比率；

$$w_e = \frac{E}{(E + D)} \quad \text{式 8}$$

r_d : 所得税后的付息债务利率;

r_e : 权益资本成本。本次评估按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 r_e ;

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon \quad \text{式 9}$$

式中:

r_f : 无风险报酬率;

r_m : 市场期望报酬率;

ε : 评估对象的特性风险调整系数;

β_e : 评估对象权益资本的预期市场风险系数;

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E}) \quad \text{式 10}$$

β_u : 可比公司的预期无杠杆市场风险系数;

$$\beta_u = \frac{\beta_t}{1 + (1 - t) \frac{D_i}{E_i}} \quad \text{式 11}$$

β_t : 可比公司股票（资产）的预期市场平均风险系数;

$$\beta_t = 34\%K + 66\%\beta_x \quad \text{式 12}$$

式中:

K : 一定时期股票市场的平均风险值, 通常假设 $K=1$;

β_x : 可比公司股票（资产）的历史市场平均风险系数;

D_i 、 E_i : 分别为可比公司的付息债务与权益资本。

为了剔除汇率变动对企业财务数据的影响, 本次评估在评估过程中均采用美元报表及相关数据作为测算依据, 在最终确定评估结果后, 再将评估结论以基准日汇率折算回人民币价值。

2、营业收支预测

北京矽成为控股型公司, 自身暂未开展业务, 其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司, 于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子

公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。标的公司主要经营产品包括了动态随机存储器芯片（DRAM）、静态随机存储器芯片（SRAM）和 FLASH 闪存及集成电路模拟芯片（ANALOG）等高性能集成电路芯片的设计、技术支持和销售，产品广泛应用于汽车电子、工业制造、通信设备及数码消费品等行业领域，并且在 DRAM/SRAM 产品上拥有相对完整自主知识产权及技术专利。

历史两年一期经审计的营业收支情况如下所示：

单位：万美元

项目/年度			2014	2015	2016 年 1-9 月
营业收支	主营业务收支	主营业务收入	33,076.38	31,013.30	23,911.79
		主营业务成本	23,662.94	20,313.91	15,209.99
		主营业务毛利率	28.46%	34.50%	36.39%
	其他业务收支	其他业务收入	94.15	66.19	18.78
		其他业务成本	8.53	6.31	1.64
		其他业务毛利率	90.94%	90.47%	91.29%
合计		收入	33,170.52	31,079.49	23,930.56
		成本	23,671.47	20,320.21	15,211.63
		毛利率	28.64%	34.62%	36.43%

北京矽成两年一期主营业务收入分别为 33,076.38、31,013.30、23,911.79 万美元，毛利率分别为 28.46%、34.50%、36.39%。从产品类型来看，根据 ISSI 历史两年一期的主营业务销售收入，北京矽成及其子公司主营业务包括 SRAM、DRAM、FLASH 和 ANALOG 销售等。

（1）四类主营产品的预测

1) SRAM 产品销量、单价、成本预测

被评估企业目前主营产品中以 DRAM 和 SRAM 为主，两年一期 SRAM 收入占比约为 25.05%、23.28%和 22.59%，毛利率水平分布为 34.28%、42.67%和 41.97%。预测期，根据被评估企业已签订合同、客户下单情况、Backlog 情况、SRAM 产品毛利率水平，对被评估企业的 SRAM 产品的收入、成本进行预测。

2) DRAM 产品销量、单价、成本预测

被评估企业目前主营产品中以 DRAM 和 SRAM 为主，两年一期 DRAM 收入占比约为 64.94%、68.70%和 69.71%，毛利率分布水平约为 25.31%、31.31%和 34.51%。预测期，根据被评估企业已签订合同、客户下单情况、Backlog 情况、

DRAM 产品毛利率水平，对被评估企业的 DRAM 产品的收入、成本进行预测。

3) FLASH 产品销量、单价、成本预测

被评估企业两年一期 FLASH 收入占比分别为 7.69%、5.11%、4.64%，毛利率分别为 36.85%、35.81%、35.62%。预测期，根据被评估企业已签订合同、客户下单情况、Backlog 情况、FLASH 产品毛利率水平，对被评估企业的 FLASH 产品的收入、成本进行预测。

4) ANALOG 产品销量、单价、成本预测

被评估企业两年一期 ANALOG 收入占比分别为 2.32%、2.90%、3.06%，毛利率分别为 26.00%、42.05%、39.19%。预测期，根据被评估企业已签订合同、客户下单情况、Backlog 情况、ANALOG 产品毛利率水平，对被评估企业的 ANALOG 产品的收入、成本进行预测。

(2) 营业收支预测

结合上述产品销量、单价、毛利率预测数据，得到北京矽成未来经营期各年营业收支，详见下表：

营业收支预测表

单位：万美元

项目名称	2016 年 10-12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年及 以后
营业收入合计	8,181.63	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96	49,007.96
营业成本合计	5,114.39	21,822.96	23,964.10	26,316.46	28,271.54	30,336.65	30,336.65
合计毛利率	37.49%	38.50%	38.48%	38.37%	38.25%	38.10%	38.10%
主营业务收入	8,181.53	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96	49,007.96
主营业务成本	5,114.39	21,822.96	23,964.10	26,316.46	28,271.54	30,336.65	30,336.65
毛利率	37.49%	38.50%	38.48%	38.37%	38.25%	38.10%	38.10%

注：为与标的公司 2016 年备考审计报告保持一致，2016 年 10-12 月营业成本中包含了 PPA 摊销，但未包含存货跌价损失；预测期营业成本中包含了存货跌价损失减值，但未包含 PPA 摊销。

3、期间费用预测

(1) 销售费用估算

根据报表披露，北京矽成 2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月营业费用分别为 2,591.91 万美元、2,541.84 万美元、2,336.62 万美元，主要包括职工薪酬、佣金费用、办公费等。

预测思路：

职工薪酬的预测：本次盈利预测结合企业人员招聘计划和岗位编制，并参考历史年度人员成本水平、企业计划的增长目标进行估算。

佣金费、差旅费、办公费等其他营业费用参考历史年度相关成本水平以及北京矽成未来可能的规划进行估算，预测结果见净现金流量的预测结果表。

（2）管理费用估算

根据报表披露，北京矽成 2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月管理费用分别为 6,133.39 万美元、6,477.08 万美元、3,995.07 万美元，主要包括研发费用、职工薪酬、专业服务费、折旧费、差旅费、办公费等。

预测思路：

职工薪酬的预测：本次评估结合北京矽成人员招聘计划和岗位编制，并参考历史年度人员成本水平、北京矽成计划的增长目标进行估算。

研发费用的预测：本次评估结合北京矽成预测期产品研发规划、历史研发支出资本化比例及行业内国内外可比公司研发支出与收入比例，对预测期研发费用进行估算。

折旧的预测：本次评估按照北京矽成执行的固定资产折旧政策，以基准日固定资产账面原值、预计使用期、加权折旧率等估算未来经营期的折旧额。

对于专业服务费、差旅费、办公费等其他管理费用，本次评估结合历史年度该等费用情况与北京矽成的计划增长情况估算未来各年度的管理费用。预测结果见净现金流量的预测结果表。

（3）财务费用估算

截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，评估对象基准日付息债务余额 754.40 万美元，主要用于补充企业日常经营业务现金流之需。本次评估以此借款规模为基础结合北京矽成未来业务发展的资金需求及利率水平估算未来各年度的财务费用。鉴于企业的货币资金或银行存款等在生产经营过程中频繁变化且变化较大，评估时不考虑存款产生的利息收入，也不考虑汇兑损益等其他不确定性损益。预测结果见净现金流量的预测结果表。

4、营业税金及附加预测

北京矽成历史期没有营业税金及附加，未来假设主营实体和经营方式不发生变化，因此不对该项进行预测。

5、企业所得税预测

北京矽成拥有多家子公司，主要分布在美国、中国、韩国、日本、中国台湾、中国香港等国家和地区，但其中产生收入的公司主要为 ISSI、ICSI TW、ISSI Cayman、Si EN Cayman 等公司，涉及纳税的国家或地区为美国、中国、英属开曼群岛、中国台湾和中国香港等国家和地区。

北京矽成预测期内，各纳税主体所在国家或地区的税率分布情况如下表。

（1）美国

税种	具体情况税率
联邦税（Statutory federal income tax）	按应纳税所得额的35%计缴
州税（State income tax）	按应纳税所得额的10%计缴

（2）中国

税种	具体情况税率
增值税	应税商品和服务收入按17%、13%或6%的税率计算销项税；并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%或1%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%或15%计缴

（3）中国台湾

税种	具体情况税率
企业所得税	按应纳税所得额的17%计缴
增值税	按应税收入的5%计缴

（4）开曼群岛

税种	具体情况税率
企业所得税（Income Tax）	按应纳税所得额的0%计缴

预测期内，各经营主体按照所在国家或地区的法定所得税率缴纳所得税，最后计算得出的各实体所得税总数与各实体税前利润总额的比值，即为预测期北京矽成所得税综合税率，各实体所得税加总数即为预测期北京矽成综合所得税，预测结果见净现金流量的预测结果表。

6、折旧与摊销预测

（1）折旧预测

北京矽成原有固定资产主要是历史年度购买所得的房屋建筑物、机器设备、家具设备以及 2015 年 12 月 7 日并购形成的可辨认固定资产的公允价值增值部

分，预计新增的固定资产主要为电子设备、车辆及测试设备等。固定资产按取得时的实际成本计价。本次评估中，对于北京矽成原有固定资产，按照企业执行的固定资产折旧政策，以基准日经审计的固定资产账面原值、预计使用期、加权折旧率等估算未来经营期的折旧额；对于 2015 年 12 月 7 日并购形成的可辨认固定资产的公允价值增值部分，以基准日经审计的账面值、预计折旧年限等估算未来经营期的折旧金额。预测结果见净现金流量的预测结果表。

（2）摊销预测

截止评估基准日，北京矽成无形资产账面值为 9,977.25 万美元，主要为 2015 年 12 月 7 日并购形成的可辨认无形资产的公允价值增值部分，此外还有少量历史年度形成的专利技术、商标等。本次评估，针对账面记录的无形资产，以基准日经审计的无形资产账面值、预计摊销年限等估算未来经营期的摊销金额。未来每年的无形资产年摊销额预测结果见净现金流量的预测结果表。本次评估，针对 2015 年 12 月 7 日并购形成的可辨认无形资产的公允价值增值部分，以基准日经审计的可辨认无形资产的公允价值增值账面值、预计摊销年限等估算未来经营期的摊销金额，预测结果见净现金流量的预测结果表。被评估企业因存在研发费用资本化，因此预测期形成了新增无形资产，这部分新增无形资产执行与被评估企业原有无形资产一致的摊销政策，因此得出预测期每年摊销金额，预测结果见净现金流量的预测结果表。

7、追加资本预测

追加资本系指企业在不改变当前经营业务条件下，为保持持续经营所需增加的营运资金和超过一年的长期资本性投入，如经营规模扩大所需的资本性投资（购置固定资产或其他非流动资产）和新增营运资金及持续经营所必须的资产更新等。

评估报告所定义的追加资本为：

追加资本=资产更新+营运资金增加额+资本性支出

（1）资产更新投资估算

按照收益预测的前提和基础，结合企业历史年度资产更新和折旧摊销情况，北京矽成预计未来无资产更新改造支出。

（2）营运资金增加额估算

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、存货、应收账款等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。因此估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收款项、存货和应付款项等主要因素。评估报告所定义的营运资金增加额为：

营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

其中，营运资金=现金+应收款项+存货-应付款项

其中：

应收款项=营业收入总额/应收款项周转率

存货=营业成本总额/存货周转率

应付款项=营业成本总额/应付账款周转率

根据对未来经营期内各年度收入与成本、产品生产周期、货款回款周期等估算及资金运转情况，预测期应收账款周转率、应付账款周转率、存货周转率与历史经营情况保持一致，得到的未来经营期各年度的营运资金增加额见净现金流量的预测结果表。

（3）资本性支出

资本性支出是企业为实现市场开拓、规模扩张、业绩增长等战略目标而需要对其现有资产规模进行补充、扩增的支出项目。依据北京矽成管理层制定的经营管理计划，北京矽成预测期将根据中国会计准则中研发费用资本化的条件和规定，对可资本化研发费用进行相应资本化，该部分支出不包含在当期研发费用核算中，在现金流调整中作为资本性支出单独列示，预测结果见净现金流量的预测结果表。

8、净现金流量的预测结果

本次评估中对未来收益及现金流的估算，主要是在北京矽成合并备考报表揭示的历史营业收入、成本和财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础

上，根据其经营历史、市场未来的发展等综合情况做出的一种专业判断。估算时不考虑未来经营期内营业外收支、补贴收入以及其它非经常性经营等所产生的损益。

北京矽成未来经营期内的营业收入以及净现金流量的预测结果如下：

净现金流量的预测结果表

单位：万美元

项目/年度	2016年 10-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及 以后
收入	8,181.63	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96	49,007.96
成本	5,114.39	22,984.39	24,971.98	27,267.89	29,219.56	31,279.51	31,218.68	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65	30,336.65
销售费用	694.15	3,025.88	3,073.64	3,124.49	3,168.70	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25	3,202.25
管理费用	1,368.58	5,189.38	5,196.54	4,922.25	5,196.11	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39	5,489.39
PPA 摊销	-	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42
财务费用	-137.46	25.10	24.32	23.55	22.77	22.00	21.22	20.45	19.67	18.90	18.13	17.35	16.58	15.80	15.03	14.25	13.52	13.52
资产减值损失	289.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资收益	37.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业利润	890.37	4,252.42	5,680.27	7,353.84	8,169.09	9,005.40	9,067.00	9,949.81	9,950.58	9,951.36	9,952.13	9,952.90	9,953.68	9,954.45	9,955.23	9,956.00	9,956.73	9,956.73
加：营业外收入	28.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	918.98	4,252.42	5,680.27	7,353.84	8,169.09	9,005.40	9,067.00	9,949.81	9,950.58	9,951.36	9,952.13	9,952.90	9,953.68	9,954.45	9,955.23	9,956.00	9,956.73	9,956.73
减：所得税	188.95	874.31	1,051.09	1,224.70	1,360.47	1,499.74	1,510.00	1,657.02	1,657.15	1,657.28	1,657.41	1,657.54	1,657.67	1,657.80	1,657.92	1,658.05	1,658.18	1,658.18
净利润	730.04	3,378.11	4,629.18	6,129.15	6,808.63	7,505.66	7,557.00	8,292.78	8,293.43	8,294.08	8,294.72	8,295.37	8,296.01	8,296.66	8,297.30	8,297.95	8,298.56	8,298.56
固定资产折旧及无形资产摊销	160.56	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26
新增无形资产摊销/ 研发费用资本化	-	151.43	255.71	338.57	401.43	444.29	487.14	530.00	421.43	360.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
PPA 折旧和摊销	251.34	1,017.35	903.72	859.39	856.56	852.27	797.70	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42

扣税后利息	-	19.94	19.82	19.63	18.98	18.33	17.69	17.04	16.40	15.75	15.11	14.46	13.82	13.17	12.52	11.88	11.27	11.27
资产更新	160.56	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26	1,296.26
营运资本增加额	49.56	404.06	1,275.60	1,368.82	2,175.14	1,236.29	-3.64	-3.64	8.98	5.05	3.27	1.60	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-
资本性支出	-	860.00	730.00	580.00	440.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
净现金流量	931.82	2,802.77	3,802.84	5,397.91	5,470.45	7,284.26	8,563.17	8,549.88	8,428.69	8,371.19	8,332.98	8,314.65	8,316.31	8,316.31	8,316.31	8,316.31	8,316.31	8,316.25

9、折现率的确定

（1）无风险收益率 r_f

根据 Bloomberg 资讯金融终端数据，选取最近五年美国及台湾的市场无风险收益率的平均水平，作为本次评估的无风险收益率。

（2）市场预期报酬率 r_m

根据 Bloomberg 资讯金融终端数据，选取最近五年美国及台湾的市场预期回报率的平均水平，作为本次评估的市场预期报酬率 r_m 。

（3） β_e 值

取美国、台湾同类可比上市公司股票，以 2011 年 12 月至 2016 年 9 月的市场价格测算估计，得到可比公司股票的历史市场平均风险系数 β_x ，按式公 12 计算得到北京矽成预期市场平均风险系数 β_t ，并由公式 11 得到北京矽成预期无财务杠杆风险系数的估计值 β_u ，最后由公式 10 得到北京矽成权益资本预期风险系数的估计值 β_e 。

（4）权益资本成本 r_e

本次评估考虑到北京矽成在公司的融资条件、治理结构等方面与可比上市公司的差异性所可能产生的特性个体风险，设公司特性风险调整系数 $\epsilon=0.01$ ，本次评估根据公式 9 得到北京矽成的权益资本成本 r_e 。

（5）适用所得税率

本次评估按照预测年度北京矽成主体资产及主营业务所在地相应的企业所得税名义税率确定其各年度企业所得税税率。

（6）扣税后付息债务利率 r_d

根据北京矽成付息债务本金及利率结构，结合其所得税率情况，计算扣税后付息债务利率 r_d 。

（7）债务比率 W_d 和权益比率 W_e

由公式 7 和公式 8 得到债务比率 W_d 和权益比率 W_e 。

（8）折现率 r （WACC）

将上述各值分别代入公式 6 即得到折现率 r 。

北京矽成预测期折现率计算过程见下表。

北京矽成预测期折现率计算表

项目/年度	2016年 10-12月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
权益比	0.9914	0.9915	0.9919	0.9922	0.9925	0.9929	0.9932	0.9936	0.9939
债务比	0.0086	0.0085	0.0081	0.0078	0.0075	0.0071	0.0068	0.0064	0.0061
贷款加权利率	0.0874	0.0337	0.0340	0.0344	0.0348	0.0352	0.0357	0.0362	0.0368
国债利率	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172
可比公司收益率	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964
适用税率	0.2056	0.2056	0.1850	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665
历史 β	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313
调整 β	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207
无杠杆 β	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122
权益 β	0.9185	0.9184	0.9183	0.9182	0.9179	0.9176	0.9174	0.9171	0.9168
特性风险系数	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
权益成本	0.0999	0.0999	0.0999	0.0999	0.0999	0.0998	0.0998	0.0998	0.0998
债务成本（税后）	0.0694	0.0268	0.0277	0.0287	0.0290	0.0294	0.0298	0.0302	0.0307
折现率（WACC）	0.0996	0.0993	0.0993	0.0993	0.0993	0.0993	0.0994	0.0994	0.0994

北京矽成预测期折现率计算表（续）

项目/年度	2025年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033年 及以后
权益比	0.9942	0.9946	0.9949	0.9953	0.9956	0.9959	0.9963	0.9966	0.9966
债务比	0.0058	0.0054	0.0051	0.0047	0.0044	0.0041	0.0037	0.0034	0.0034
贷款加权利率	0.0375	0.0382	0.0390	0.0400	0.0411	0.0424	0.0439	0.0457	0.0457
国债利率	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172
可比公司收益率	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964	0.0964
适用税率	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665
历史 β	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313
调整 β	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207
无杠杆 β	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122	0.9122
权益 β	0.9166	0.9163	0.9161	0.9158	0.9155	0.9153	0.9150	0.9148	0.9148
特性风险系数	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
权益成本	0.0998	0.0997	0.0997	0.0997	0.0997	0.0997	0.0996	0.0996	0.0996
债务成本（税后）	0.0312	0.0318	0.0325	0.0333	0.0343	0.0353	0.0366	0.0381	0.0381

折现率 (WACC)	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994	0.0994

（9）折现率的合理性分析

考虑到本次交易标的北京矽成主要经营实体位于境外，故选取近期 A 股上市公司收购海外资产的案例作为可比交易案例。其主要参数情况如下：

序号	上市公司	交易标的主要经营主体	折现率
1	西王食品	Kerr	9.24%
2	耐威科技	赛莱克斯	8.04%
3	华灿光电	美新半导体 MEMSIC	11.22%
4	苏交科	TestAmerica	9.08%
平均值			9.39%
本次交易			9.93%

注：上述可比交易选取距本次交易评估基准日（2016 年 9 月 30 日）近一年内的交易案例；预测期第一年指预测期第一个完整会计年度。

本次交易中，北京矽成本次评估的折现率为 9.93%，高于国内上市公司收购海外资产案例中所采用的折现率平均值 9.39%，北京矽成的折现率处于合理的范围。

10、经营性资产价值

将得到的预期净现金流量代入公式 3，得到北京矽成的经营性资产价值为 69,756.21 万美元。

11、长期股权投资价值

被评估企业在评估基准日的长期股权投资系被评估企业集团子公司 Enchida International Limited 持有的 Saint Tai Group Limited 的股票 3,047,619 股，其占股比例 31.22%，投资日期为 2012 年 12 月，持股公司主营业务为 LED 应用灯具研发与制造，自被评估企业投资日期，持续经营，因此采用权益法对其进行价值核算，Saint Tai Group Limited 经权益法核算后的净资产价值为 179.73 万美元，因此得出被评估企业长期股权投资评估价值为 179.73 万美元。即：

$$I=179.73 \text{ 万美元}$$

12、溢余或非经营性资产价值估算

经核实，北京矽成基准日账面存在部分资产（负债）的价值在本次估算的净现金流量中未予考虑，属本次评估所估算现金流之外的溢余或非经营性资产（负

债），具体情况见下表。

本次评估依据资产基础法评估结果对该等资产（负债）价值进行单独估算，得到北京矽成基准日的溢余或非经营性资产（负债）（C）评估价值为：

$$C=C_1+C_2= 18,044.59 \text{（万美元）}$$

北京矽成溢余或非经营性资产（负债）评估价值具体情况如下：

北京矽成溢余或非经营性资产（负债）评估价值明细表

单位：万美元

项目名称	基准日账面值	基准日评估值
货币资金	9,021.51	9,021.51
其他应收款	37.01	37.01
流动类溢余/非经营性资产小计	9,058.52	9,058.52
C₁：流动类溢余/非经营性资产（负债）净值	9,058.52	9,058.52
可供出售的金融资产	259.51	264.04
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,274.12	7,274.12
递延所得税资产	1,447.91	1,447.91
非流动类溢余/非经营性资产小计	8,981.54	8,986.07
非流动类溢余/非经营性负债小计	-	-
C₂：非流动类溢余/非经营性资产（负债）净值	8,981.54	8,986.07
C：溢余/非经营性资产、负债净值	18,040.06	18,044.59

13、权益资本价值的确定

（1）将得到的经营性资产的价值 $P=69,756.21$ 万美元，基准日的溢余或非经营性资产的价值 $C=18,044.59$ 万美元，股权投资价值 $I=179.73$ 万美元，代入式 2，即得到被评估企业的企业价值为：

$$\begin{aligned} B &= P+C+I \\ &= 87,980.54 \text{（万美元）} \end{aligned}$$

（2）将被评估企业的企业价值 $B=87,980.54$ 万美元，付息债务的价值 $D=754.40$ 万美元，少数股东权益价值 $M=242.62$ 万美元，代入式 1，得到被评估企业的股东全部权益价值为：

$$\begin{aligned} E &= B-D-M \\ &= 86,983.51 \text{（万美元）} \end{aligned}$$

根据中国人民银行发布的评估基准日 2016 年 09 月 30 日外汇汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日被评估企业股东权益价值为 580,858.47 万人民币。

（三）评估结论

经过上述分析和估算，使用收益法估测出的北京矽成归属于母公司的所有者权益于 2016 年 9 月 30 日的持续经营价值为：86,983.51 万美元。根据中国人民银行发布的评估基准日 2016 年 09 月 30 日外汇汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日北京矽成归属于母公司所有者权益的评估值为 580,858.47 万人民币。

三、市场法评估具体情况

（一）可比企业的选择

所选择的可比企业需与被评估企业具有可比性。可比企业应当与被评估企业属于同一行业，或者受相同经济因素的影响。

北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。标的公司主要经营产品包括了动态随机存储器芯片（DRAM）、静态随机存储器芯片（SRAM）和 FLASH 闪存及集成电路模拟芯片（ANALOG）等高性能集成电路芯片的设计、技术支持和销售，产品广泛应用于汽车电子、工业制造、通信设备及数码消费品等行业领域，经营主体位于美国、台湾和中国。因此本次评估选取全球范围的上市公司作为可比公司，如下表所示：

序号	证券代码	公司名称
1	3532 TT Equity	FORMOSA SUMCO（台塑胜高科技股份有限公司）
2	2408 TT Equity	NANYA TECH（南亚科技股份有限公司）
3	5245 TT Equity	STATSChipPAC（星科金朋）
4	RMBS US Equity	RAMBUS INC
5	3006 TT Equity	ESMT（晶豪科技股份有限公司）

6	5351 TT Equity	ETRON TECH（钰创科技股份有限公司）

（二）评估对象与可比公司间的对比分析

本次评估主要从企业的盈利能力状况、偿债能力状况、营运能力、经营能力等方面对评估对象与可比公司间的差异进行量化，具体量化对比思路如下：

1、选取盈利能力指标：销售利润率、净资产收益率；成长能力指标：总资产增长率、营业利润增长率；偿债能力指标：速动比率、流动比率；营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率，合计 8 个财务指标作为评价可比公司及被评估企业的因素。

（1）销售利润率

销售利润率=利润总额/营业收入×100%

（2）净资产收益率

净资产收益率=净利润/平均净资产×100%

（3）净资产增长率

净资产增长率=（本年净资产/上年净资产-1）×100%

（4）净利润增长率

净利润增长率=（本年净利润/上年净利润-1）×100%

（5）速动比率

速动比率=速动资产/流动负债×100%

（6）流动比率

流动比率=流动资产合计/流动负债合计×100%

（7）总资产周转率

总资产周转率=营业收入净额/平均资产总额

（8）应收账款周转率

应收帐款周转率=销售净收入÷平均应收帐款

经计算，可比公司财务指标如下表：

可比公司财务指标比较表

序号	股票代码	公司名称	2016年9月30日							
			偿债能力		盈利能力		成长能力		营运能力	
			速动比率%	流动比率%	销售利润率%	净资产收益率%	净利润增长率%	净资产增长率%	总资产周转率(次)	应收账款周转率(次)
1	3532 TT Equity	FORMOSA SUMCO	2.13	3.22	3.26	1.01	-0.86	-0.03	1.00	8.86
2	2408 TT Equity	NANYA TECH	1.10	1.38	5.53	4.65	0.56	0.05	0.90	6.80
3	5245 TT Equity	WISECHIP SEMI	6.44	6.58	18.98	1.72	-0.28	0.05	0.31	5.12
4	RMBS US Equity	RAMBUS INC	4.08	5.05	13.65	3.13	-0.52	0.04	0.74	29.03
5	3006 TT Equity	ESMT	1.80	3.45	3.33	1.22	-0.78	0.02	1.02	9.39
6	5351 TT Equity	ETRON TECH	1.52	2.64	-9.92	-3.53	0.48	-0.05	0.81	3.94

数据来源：Bloomberg

2、将各可比公司及被评估企业各项财务指标进行比较修正。本次评估修正思路如下：

（1）本次选取的指标为：盈利能力指标：销售利润率、净资产收益率；成长能力指标：净利润增长率、净资产增长率；偿债能力指标：速动比率、流动比率；营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率，其数值越大表明其相应的财务能力越好，即财务指标与能力为正相关。对于上述指标，调整系数=被评估企业财务指标/可比公司财务指标；考虑部分指标为负数，对于该部分指标，调整系数=（1+被评估企业财务指标）/（1+可比公司财务指标）。

（2）根据行业近几年发展状况及访谈结果，对各指标进行权重分配，结果如下：

序号	指标分类	指标名称	比例
1	盈利能力指标	销售利润率%	10%
		净资产收益率%	15%
2	成长能力指标	净利润增长率%	10%
		净资产增长率%	15%
3	偿债能力指标	速动比率	15%
		流动比率	10%
4	营运能力指标	总资产周转率	10%

		应收账款周转率	15%
合计			100%

经过上述修正过程后，修正系数结果如下：

修正系数表

序号	公司名称	2016 年 9 月 30 日								修正系数
		偿债能力		盈利能力		成长能力		营运能力		
		速动比率 %	流动比率 %	销售利润率 %	净资产收益率 %	净利润增长率 %	净资产增长率 %	总资产周转率 (次)	应收账款周转率 (次)	
1	FORMOSA SUMCO	1.35	1.23	2.22	5.26	13.27	1.08	2.86	0.75	3.22
2	NANYA TECH	2.61	2.85	1.31	1.15	1.23	1.00	0.41	0.98	1.44
3	WISECHIP SEMI	0.44	0.60	0.38	3.11	2.68	1.00	9.40	1.30	2.18
4	RAMBUS INC	0.70	0.78	0.53	1.71	4.00	1.01	0.50	0.23	1.13
5	ESMT	1.60	1.14	2.17	4.37	8.67	1.03	2.82	0.71	2.64
6	ETRON TECH	1.89	1.49	-0.73	-1.51	1.30	1.10	3.55	1.69	1.04

3、将修正系数乘以可比上市公司基准日时点的 PB 后得到修正后的 PB：

可比上市公司 2016 年 9 月 30 日修正 PB

序号	公司名称	基准 PB	修正系数	修正 PB
1	FORMOSA SUMCO	1.65	3.22	5.31
2	NANYA TECH	1.75	1.44	2.52
3	WISECHIP SEMI	3.64	2.18	7.94
4	RAMBUS INC	3.92	1.13	4.42
5	ESMT	1.40	2.64	3.68
6	ETRON TECH	1.38	1.04	1.43
平均		2.29	1.94	4.22

数据来源：Bloomberg

分析以上修正 PB 采用 5 家修正后 PB 的平均值最为被评估企业的 PB，PB=4.22。

（三）流动性折扣

本次市场法评估选取的可比公司均为上市公司，而被评估企业并未上市，缺

乏市场流通性，因此在上述测算市销率的基础上需要扣除流动性折扣。

根据《Measuring the Discount for Lack of Marketability for Noncontrolling, Nonmarketable Ownership Interests》中的 Valuation Advisors Pre-IPO Study 研究，研究了包括 1.3 万家 IPO 案例，其中包括了 1350 家非美国上市案例，同时覆盖了 28 个国家，研究跨度从 1995 年至 2012 年。

根据 Valuation Advisors Pre-IPO Study 的研究，并考虑被评估企业的特点及基准日证券市场状况，本次评估的流动性折扣选取 37.37% 作为参考。

（四）上市公司比较法计算结果

根据上述各过程所得到的评估参数，可以得出被评估企业股东全部权益评估结果：

项目	金额/比率
流动性折扣	37.37%
PB	4.22
所有者权益账面值（万美元）	79,191.14
商誉（万美元）	34,589.88
溢余（万美元）	18,044.59
股东权益价值（万美元）	88,170.79
少数股东权益价值（万美元）	242.62
评估值（万美元）	87,928.17

少数股东权益价值=收益法评估结果中的少数股东权益价值；

评估值（P）=（市净率（PB）×（所有者权益-溢余或非经营性资产价值-商誉）×（1-流动性折扣率）+溢余或非经营性资产价值）-少数股东权益价值

$$= 4.22 * (79,191.14 - 34,589.88 - 18,044.59) * (1 - 37.37\%) + 18,044.59 - 242.62$$

$$= 87,928.17 \text{ 万美元。}$$

根据中国人民银行发布的评估基准日 2016 年 09 月 30 日外汇汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日被评估企业股东权益价值为 587,166.74 万人民币。

（五）评估结论

经市场法评估，北京矽成归属于母公司的所有者权益价值为 587,166.74 万元。

四、董事会对本次交易标的资产评估的合理性及定价的公允性分析

公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：

（一）评估机构的独立性

公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

（二）评估假设前提的合理性

本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

（四）评估定价的公允性

本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。

独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。

综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

（五）评估依据的合理性分析

在收益法评估中，评估机构基于目标公司北京矽成报告期内经营情况，结合行业发展趋势，综合考虑目标公司所处行业发展趋势、在行业中的地位、以及所拥有的行业经验、专业技术积累、客户渠道等各方面因素，对目标公司未来财务作出谨慎、合理预测。

1、结合报告期及未来财务预测的相关情况说明评估的合理性

根据中兴华会计师出具的中兴华专字（2017）第 010161 号《审计报告》，北京矽成 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月的收入、成本、净利润、毛利率、净利率情况如下表所示：

单位：万元

财务指标	2016 年 1-9 月	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
收入	157,534.90	193,575.52	203,759.90
成本	100,138.15	126,562.41	145,409.09
净利润	9,331.31	6,142.05	1,725.56
归属于母公司股东的净利润	9,145.50	5,905.54	1,564.04
毛利率	36.43%	34.62%	28.64%
净利率	5.92%	3.17%	0.85%
归属于母公司股东的净利率	5.81%	3.05%	0.77%

根据中联评估出具的“中联评报字[2017]第 483 号”《资产评估报告》及《资

产评估说明》，本次中联评估最终采用收益法评估结果对北京矽成 100%股权的价值进行了评估。在评估过程中，对北京矽成未来的营业收入、营业成本、净利润等数据的预测情况如下所示：

单位：万美元

项目/年度	2016 年 10-12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年及 以后
收入	8,181.63	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96
成本	5,114.39	22,984.39	24,971.98	27,267.89	29,219.56	31,279.51
毛利率	37.46%	35.23%	35.90%	36.14%	36.18%	36.17%
净利润	730.04	3,378.11	4,629.18	6,129.15	6,808.63	7,505.66
净利率	8.92%	9.52%	11.88%	14.35%	14.87%	15.32%

（1）营业收入的预测合理性分析

单位：万美元

项目/年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 及以后
收入	32,112.19	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96
收入增长率	3.32%	10.51%	9.78%	9.61%	7.22%	7.04%

本次评估预测中，2017 年北京矽成的收入预测增长提升至 10.51%，后续年份的收入预测增长率均未超过 10%，且增长率呈下降趋势直至降为零。2017 年北京矽成预测收入增长率有较大提升的原因主要是公司 2017 年开始大力进入中国市场，现有的客户结构在面对中国的专用领域市场时将得到优化，获得更多的市场份额。同时随着中国专用领域市场中加快的技术进步，例如汽车市场中越来越高的电子化趋势，北京矽成现有产品线在新的应用领域，例如高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车仪表、Cluster、T-box、显示屏驱动和控制（TDDI）、高可靠性（Hi reliability, Hi-rel）产品领域，拥有良好的市场前景。因此 2017 年收入增长率得到较大提升的预测具备合理性。

（2）毛利率的预测合理性分析

报告期内，北京矽成的毛利率分别为 28.66%、34.64%和 36.44%，呈逐年增长态势。主要系因为标的公司前次收购导致的存货 PPA 导致备考报表中主营业务成本发生调整。根据标的公司备考合并利润表的编制基础，标的公司 2014 年的主营业务成本中包含了前次收购导致的存货 PPA 部分，这导致备考合并财务报表中 2014 年度的营业成本大幅提升而经营利润大幅下降。2015 年备考报表中

的主营业务毛利不受存货增值部分摊销的影响，毛利率恢复至正常经营的水平。在扣除由前次收购产生的无形资产及固定资产增值部分摊销金额的影响因素，以及存货跌价准备的影响因素之后，报告期内北京矽成的毛利率为 37.17%、38.38%、40.08%。

单位：万美元

项目/年度	2016 年 10-12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年及 以后
收入	8,181.63	35,486.58	38,956.17	42,701.43	45,785.65	49,007.96	49,007.96	49,007.96
成本	5,114.39	22,984.39	24,971.98	27,267.89	29,219.56	31,279.51	31,218.68	30,336.65
不含 PPA 成本	4,824.03	21,822.96	23,964.10	26,316.46	28,271.54	30,336.65	30,336.65	30,336.65
毛利率	37.49%	35.23%	35.90%	36.14%	36.18%	36.17%	36.30%	38.10%
不含 PPA 毛利率	41.04%	38.50%	38.48%	38.37%	38.25%	38.10%	38.10%	38.10%

根据上表，在盈利预测期，2017 年-2022 年，标的公司毛利率基本保持在 38%左右，由于营业成本中所包含的由前次收购产生的无形资产增值摊销金额在 2022 年摊销完毕，预测期毛利率在 2023 年及之后增加到 38.10%若扣除由前次收购产生的无形资产及固定资产增值部分摊销金额的影响因素后，预测期北京矽成的实际毛利率水平在 2016 年 10-12 月达到 41.04%，较往后预测期毛利率高，主要原因来自于 2016 为了和历史期审计报告口径保持一致，10-12 月份的预测毛利率中扣除了存货跌价准备的影响。在预测期 2017 年及往后预测毛利率则包含了存货跌价准备影响，2017 至 2020 年，预测毛利率分别为 38.50%、38.48%、38.37%和 38.25%，2021 年及以后年度保持 38.10%的毛利率水平，实际毛利率水平逐步下降，符合行业发展规律，该预测具有合理性。

2、行业发展趋势

对标的公司所处行业发展趋势分析详见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点与盈利能力的讨论与分析”之“（一）行业整体发展情况”。

3、行业所处地位及行业竞争力

对标的公司行业所处地位及行业竞争力分析详见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点与盈利能力的讨论与分析”之“（八）标的公司

核心竞争力及行业地位”。

（六）后续经营的变化趋势及董事会应对措施对评估的影响

1、行业宏观环境及政策变化趋势及影响分析

对标的公司所处行业宏观环境及政策变化趋势及影响分析详见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点与盈利能力的讨论与分析”之“（一）行业整体发展情况”。

2、税收优惠政策变化趋势及影响分析

报告期内，标的公司的全资子公司芯成半导体（上海）有限公司获得了证书编号为 JF2014310150155 的技术先进型服务企业证书，自 2015 年 1 月 14 日起至 2018 年 12 月 31 日止，享受高新技术产业的减免政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。矽恩微电子（厦门）有限公司获得了证书编号为 GR201535100052 的高新技术企业证书，有效期自 2015 年 10 月 12 日起三年，享受高新技术产业的减免政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。预计未来税收优惠政策不会发生重大不利变化。

（七）标的公司经营模式对评估的影响及相关敏感性分析

1、估值结果对营业收入增长率的敏感性分析

项目	估值（万元）	变动额（万元）	估值变化率
营业收入增长 10%	671,691.27	90,832.80	15.64%
营业收入增长 5%	626,274.66	45,416.19	7.82%
营业收入增长 1%	589,941.66	9,083.19	1.56%
管理费用保持不变	580,858.47	0.00	0.00%
营业收入减少 1%	571,775.31	-9,083.16	-1.56%
营业收入减少 5%	535,443.11	-45,415.36	-7.82%
营业收入减少 10%	490,029.43	-90,829.04	-15.64%

2、估值结果对费用的敏感性分析

（1）对管理费用的敏感性分析

项目	估值（万元）	变动额（万元）	估值变化率

管理费用增长 10%	550,477.88	-30,380.59	-5.23%
管理费用增长 5%	565,668.01	-15,190.46	-2.62%
管理费用增长 1%	577,820.35	-3,038.12	-0.52%
管理费用保持不变	580,858.47	0.00	0.00%
管理费用减少 1%	583,896.60	3,038.13	0.52%
管理费用减少 5%	596,049.20	15,190.73	2.62%
管理费用减少 10%	611,240.15	30,381.68	5.23%

(2) 对营业费用的敏感性分析

项目	估值（万元）	变动额（万元）	估值变化率
营业费用增长 10%	563,029.59	-17,828.88	-3.07%
营业费用增长 5%	571,944.00	-8,914.47	-1.53%
营业费用增长 1%	579,075.57	-1,782.90	-0.31%
营业费用保持不变	580,858.47	0.00	0.00%
营业费用减少 1%	582,641.37	1,782.90	0.31%
营业费用减少 5%	589,773.01	8,914.54	1.53%
营业费用减少 10%	598,687.61	17,829.14	3.07%

3、估值结果对税收的敏感性分析

项目	估值（万元）	变动额	估值变化率
预测期当年所得税率+3%	563,872.74	-16,985.73	-2.92%
预测期当年所得税率+2%	569,534.83	-11,323.64	-1.95%
预测期当年所得税率+1%	575,196.74	-5,661.73	-0.97%
预测期当年所得税率+0%	580,858.47	0.00	0.00%
预测期当年所得税率-1%	586,520.04	5,661.57	0.97%
预测期当年所得税率-2%	592,181.44	11,322.97	1.95%
预测期当年所得税率-3%	597,842.68	16,984.21	2.92%

(八) 交易标的与上市公司的协同效应

北京矽成和上市公司同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售渠道、客户结构等方面都有较强的协同效应。在产品种类方面，北京矽成在本次交易后将有助于上市公司丰富存储芯片产品线，从原本以 NOR FLASH 和 NAND FLASH 闪存为主的非易失性存储芯片产品结构扩充至涵盖了 DRAM、SRAM、NOR FLASH 和 NAND FLASH 等各类型易失性及非易失性存储芯片的全品类产品结构。在产

品销售方面，本次重组将优化上市公司的销售渠道及客户结构。

（1）凭借上市公司和标的公司在不同行业领域的市场优势，上市公司的 FLASH 类非易失性存储芯片产品将获得在专用领域的市场开拓机会和收入增长，为产品的市场占有率提供更大的提升空间。

（2）上市公司和标的公司在境内、境外拓展的经验和客户，北京矽成现有的海外销售渠道能为上市公司提供高速、有效的和海外客户对接的机会，并在销售渠道整合共享后，降低一定的销售成本。

综合而言，本次重组中由上市公司和标的公司之间产生的协同效应将助力上市公司从国内领先、国际知名的闪存芯片供应商，快速迈入国际领先的全品类存储芯片供应商的行列，北京矽成将强化上市公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等各方面实力。

（九）结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率、市净率等指标，分析交易定价的公允性

1、与可比行业上市公司的对比分析

北京矽成的业务通过全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 Si En Cayman 等经营，其主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及模拟电路模拟芯片的研发和销售。截至 2016 年 9 月 30 日，北京矽成归属于母公司所有者的净利润为 9,145.50 万元，2016 年全年预测归属于母公司所有者的净利润为 2,112.67 万美元，采用截至 2016 年 12 月 31 日人民币对美元的年均汇率中间价 1 美元兑人民币 6.6529 元折算，2016 年全年预测归属于母公司所有者的净利润为 14,055.40 万元。拟购买资产的交易价格为 650,000.00 万元，对应的评估基准日市盈率倍数为 46.25 倍。截至 2016 年 9 月 30 日，北京矽成归属于母公司所有者权益为 527,046.21 万元，对应的评估基准日市净率为 1.23 倍。

（1）A 股市场可比上市公司

根据万得行业分类统计及标的公司主营业务情况，北京矽成属于半导体行业中集成电路设计企业。本报告书从万得数据库国内 A 股市场从事半导体行业的

上市公司中，选取 7 家与北京矽成业务相同或相近的半导体行业上市公司作为可比公司。2016 年 9 月 30 日同行业可比公司市盈率、市净率情况如下表所示：

序号	证券代码	证券简称	市盈率	市净率
1	300223.SZ	北京君正	674.16	6.70
2	300077.SZ	国民技术	159.58	3.46
3	300053.SZ	欧比特	174.32	6.62
4	300327.SZ	中颖电子	74.56	10.27
5	300139.SZ	晓程科技	196.71	2.97
6	300458.SZ	全志科技	70.25	6.18
7	002049.SZ	紫光国芯	58.69	6.90
平均值			201.18	6.16
中位值			159.58	6.62
标的公司			46.25	1.23

注：市盈率根据 2016 年 9 月 30 日总市值除以 2016 年度归属母公司股东的预测净利润计算得出；市净率根据 2016 年 9 月 30 日总市值除以 2016 年 9 月 30 日归属于母公司所有者的权益计算得出。

上述半导体行业上市公司截至 2016 年 9 月 30 日平均市盈率为 201.18 倍，中位数为 159.58 倍。本次交易对应的市盈率 46.25 倍，显著低于同行业上市公司的市盈率水平。

上述半导体行业上市公司截至 2016 年 9 月 30 日平均市净率为 6.16 倍，中位数为 6.62 倍。本次交易对应的市净率 1.23 倍，低于同行业上市公司水平，从同行业上市公司角度而言本次交易的定价具备公允性。

（2）境外市场可比公司

根据彭博数据库资料，选取半导体行业中，同北京矽成具有相似业务类型或经营模式的 8 家境外上市公司作为境外可比同行业公司，8 家可比同行业公司均在相对更为成熟的美国或台湾市场上市交易。截至 2016 年 9 月 30 日境外同行业可比公司市盈率、市净率情况如下表所示：

序号	证券代码	证券简称	公司简称	市盈率（倍）	市净率（倍）
1	CY US Equity	CYPRESS SEMICON	赛普拉斯	310.01	1.98
2	8261 TT Equity	ADVANCED POWER	富鼎先进	208.62	1.61
3	MCHP US Equity	MICROCHIP TECH	微芯科技	116.90	4.45

4	SMTC US Equity	SEMTECH CORP	先科电子	81.95	2.22
5	ADI US Equity	ANALOG DEVICES	亚德诺	64.14	3.94
6	TXN US Equity	TEXAS INSTRUMENT	德州仪器	54.11	6.83
7	8150 TT Equity	CHIPMOS TECH	南茂科技	78.03	1.52
8	MU US Equity	MICRON TECH	美光科技	-50.41	1.10
9	6531 TT Equity	爱普科技	爱普科技	24.37	2.71
10	3006 TT Equity	晶豪科	晶豪科	19.65	1.47
11	5351 TT Equity	钰创	钰创	14.72	1.38
平均值				97.25	2.66
中位数				71.09	1.98
标的公司				46.25	1.23

注：市盈率根据 2016 年 9 月 30 日总市值除以 2016 年全年预测净利润（1-9 月归属母公司股东的净利润*4/3 简单折算）计算得出；市净率根据 2016 年 9 月 30 日总市值除以 2016 年 9 月 30 日归属于母公司所有者的权益计算得出；上述平均值剔除负数等异常值。

上述境外半导体行业上市公司中，截至 2016 年 9 月 30 日，除美光科技的净利润为负值外，其他上市公司净利润均为正值。在排除美光科技市盈率后，境外半导体行业上市公司的平均市盈率为 97.25 倍，中位数为 71.09 倍。本次交易对应的市盈率 46.25 倍，交易市盈率低于境外同行业上市公司的市盈率水平。

上述境外半导体行业上市公司截至 2016 年 9 月 30 日平均市净率为 2.66 倍，中位数为 1.98 倍。本次交易对应的市净率为 1.23 倍，交易市净率较海外同行业上市公司的平均市净率水平更低，从境外同行业上市公司对比角度而言，本次交易的定价具有合理性。

2、与可比交易案例的对比分析

截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成的交易价格为 650,000.00 万元，预测期第一年净利润为 3,378.11 万美元，根据中国人民银行发布的评估基准日 2016 年 09 月 30 日外汇汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出预测期第一年净利润为 22,558.35 万元，对应预测期市盈率为 28.81 倍。

选取近期集成电路芯片行业 A 股上市公司收购案例作为可比交易案例，其具体估值情况如下：

序号	上市公司	标的公司	交易价格 (万元)	预测期第一年净 利润 (万元)	预测期第一年 净利润对应市

					盈率（倍）
1	通富微电	富润达、通润达	389,700.00	10,504.08	37.10
2	华灿光电	和谐光电	165,000.00	9,137.79	18.06
3	耐威科技	瑞通芯源	75,315.87	1,980.15	38.04
4	四维图新	杰发科技	386,650.00	15,798.52	24.47
平均值			-	-	29.42
本次交易			650,000.00	22,558.35	28.81

注：上述可比交易选取距本次交易评估基准日（2016年9月30日）近一年内的交易案例；预测期第一年指预测期第一个完整会计年度。

本次交易中，根据北京矽成预测期第一年净利润对应市盈率为 28.81 倍，对比上市公司收购同类型资产案例，低于同行业可比交易案例对应平均市盈率 29.42 倍，整体而言，本次定价可实现性属于合理范围内。

（十）评估或者估值基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化及其影响分析

评估基准日至本报告书签署日，本次交易标的不存在发生重要变化的事项。

（十一）交易定价与评估或者估值结果差异分析

1、本次交易作价与评估值的差异情况说明

本次交易中北京矽成 100%股权的交易作价以北京矽成截至 2016 年 9 月 30 日的全部股权价值的评估值作为作价依据。本次评估工作中，中联评估采用收益法及市场法对北京矽成全部股东权益进行了评估，并最终采用收益法评估结果作为北京矽成 100%股权价值的最终评估结果。截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，北京矽成 100%股权按收益法评估价值为 580,858.47 万元，较其合并报表净资产账面值增 53,812.26 万元，增值率 10.21%。经交易双方协商，基于上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，各方协商一致确定本次交易标的资产的交易价格为 650,000.00 万元，相比收益法评估后的 100%股权价值 580,858.47 万元，增值 69,141.53 万元，增值率 11.90%。

2、本次交易作价与评估值差异合理性分析

本次交易作价相较于评估值存在溢价，交易双方综合考虑了本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，具体如下：

（1）汇率变动

北京矽成 100%股权按照收益法评估的归属于母公司股东权益价值为 86,983.51 万美元，按照本次评估基准日 2016 年 9 月 30 日人民币的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日被评估企业股东权益价值为 580,858.47 万人民币。

自评估基准日至本报告书出具日，人民币对美元的汇率波动较大。经交易双方协商确定，本次交易作价考虑相关汇率变动的影响。并以 2016 年 12 月 30 日的人民币对美元的汇率中间价为参考基准，按照 1 美元兑 6.9370 元人民币折算，被评估企业股东权益价值为 603,404.61 万元人民币，汇率变动对标的公司股权评估价值的影响为 22,546.14 万元人民币。

（2）协同效应

北京矽成和上市公司同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售渠道、客户结构等方面都有较强的协同效应。在产品种类方面，北京矽成在本次交易后将有助于上市公司丰富存储芯片产品线，从原本以 NOR FLASH 和 NAND FLASH 闪存为主的非易失性存储芯片产品结构扩充至涵盖了 DRAM、SRAM、NOR FLASH 和 NAND FLASH 等各类型易失性及非易失性存储芯片的全品类产品结构。在产品销售方面，本次重组将优化上市公司的销售渠道及客户结构。

根据中联评估出具的中联评咨字[2017]第 494 号估值报告，本次交易对上市公司业务的协同效应以及因本次交易对标的公司形成的负协同情况如下：

1) 产品销售协同效应

2014 年，上市公司 NOR Flash 产品成功进入可穿戴设备、智能家居市场，公司存储类产品销售约 11 亿颗。截至 2015 年底，上市公司存储类产品累计出货接近 30 亿颗。整合后，凭借上市公司和标的公司在不同行业领域的市场优势，上市公司的 FLASH 类非易失性存储芯片产品中包括了 Serial NOR Flash、Serial NAND Flash、SLC (ONFi) NAND、eMMC5.1 等优势产品，将通过北京矽成已建立的客户群体获得在专用领域的市场开拓机会和收入增长，为产品的市场占有率提供更大的提升空间。在进取和稳健两种情形下，预测期产品销售协同效应对应的收入及净利润预测如下：

产品销售协同效应收益预测（进取情形）

单位：万元

项目/年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
收入合计	450.00	5,150.00	15,550.00	30,700.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00
净利润	180.00	2,060.00	6,220.00	12,280.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00

产品销售协调效应收益预测（稳健情形）

单位：万元

项目/年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
收入合计	450.00	5,150.00	15,550.00	16,885.00	20,262.00	20,262.00	20,262.00	20,262.00	20,262.00
净利润	180.00	2,060.00	6,220.00	6,754.00	8,104.80	8,104.80	8,104.80	8,104.80	8,104.80

2) 销售费用协同效应

上市公司原有产品销售业务覆盖范围主要以国内消费电子市场为主，重组后，上市公司可以共享北京矽成凭借多年来在全球存储芯片市场不断的开拓下积累的全球销售网络，在海外销售网络获得高速、有效的和海外客户对接的机会。同时销售渠道整合共享后，上市公司在海外聘请销售人员、开拓销售渠道的费用将会得到一定程度的降低。在进取和稳健两种情形下，预测期销售协同效应对应的利润及净利润预测如下：

销售协调效应收益预测（进取情形）

单位：万元

项目/年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
利润增加额	-	399.35	938.46	1,660.28	2,620.65	2,620.65	2,620.65	2,620.65	2,620.65
净利润增加额	-	340.06	799.14	1,413.80	2,231.60	2,231.60	2,231.60	2,231.60	2,231.60

销售协调效应收益预测（稳健情形）

单位：万元

项目/年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后
利润增加额	-	399.35	938.46	1,162.19	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46
净利润增加额	-	340.06	799.14	989.66	1,562.12	1,562.12	1,562.12	1,562.12	1,562.12

3) 整合后的负协同效应

本次并购重组成功后，北京矽成需支付给管理层 3,000 万美元作为重组补偿，该项作为负向协同，在协同模型中的 2017 年费用支出中予以考虑。

本次并购重组成功后，北京矽成下属子公司 ISSI 与 Spansion 公司已签订的授权合作协议将会失效，如不再续签，管理层预计，给北京矽成带来的每年损失金额为盈利预测中 FLash 收入的 2%~4%，该项作为负向协同，在协同模型每年预测的费用支出中予以考虑。

4) 协同效应估值结果

在上市公司成功收购并顺利整合标的公司后，基于两者之间存在的较强协同效应，在实现产品销售协同和销售费用协同存在对未来营业净利润的较强支撑。在考虑了两者整合后经营管理上在预测期存在的对协同效应存在负面影响，基于上市公司和标的公司于 2016 年 9 月 30 日估值基准日时可辨认并计量的协同效应投资价值的估值区间为 24,037.35 至 54,425.49 万元。

五、独立董事对本次交易评估相关事项的独立意见

为本次交易之目的，公司聘请具有证券业务相关资格的中联资产评估集团有限公司以 2016 年 9 月 30 日为基准日，对本次交易涉及的标的资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《重组管理办法》，作为公司的独立董事，现对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性发表如下独立意见：

（一）评估机构的独立性

公司聘请的专项评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资质，公司的选聘程序合法合规；评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

（二）评估假设前提的合理性

本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次交易项下资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

（四）评估定价的公允性

本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。

作为公司独立董事，我们认为公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果与标的资产定价公允。

第六章 发行股份情况

一、发行股份购买资产并募集配套资金具体情况

（一）发行股份购买资产方案

1、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。”

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日，即 2017 年 2 月 14 日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 158.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。其中，董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

2、发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格将进行相应调整。此外，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不再调整。

3、发行股票的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

4、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

按照本次标的的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，本次交易上市公司向交易对方支付的股份对价金额共计 495,238.66 万元，发行数量共计 31,284,816 股，占发行完成后上市公司总股本的比例为 23.83%。具体

如下：

序号	股东姓名	股票支付数量（股）	占发行股份购买资产后总股本比例（不考虑配套融资的影响）
1	上海承裕	14,181,763	10.80%
2	屹唐投资	11,106,964	8.46%
3	华创芯原	2,830,931	2.16%
4	民和志威	1,610,989	1.23%
5	闪胜创芯	1,554,169	1.18%
总计		31,284,816	23.83%

本次发行股份及支付现金购买资产的股份最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。

5、锁定期安排

根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和发行股份及支付现金购买资产的交易对方出具的《股份锁定承诺函》，本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方的股份锁定期具体安排如下：

（1）业绩承诺方

如业绩承诺方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，业绩承诺方按照下列公式计算的股份可以转让或交易（即解锁，下同）：业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50%-业绩承诺方获得的现金对价）/发行价格。同时，业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可再解锁的

股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可再解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年的累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例 / 发行价格 - 第一期解锁股份数

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格 - 第一期解锁股份数

第三期，在 2019 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在 2017 年至 2019 年累计实现净利润达到累计承诺净利润的 90%或以上，则业绩承诺方剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。

为确定各期可解锁股份数量，《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经交易双方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司年度报告披露届满 30 日后解锁相应数量的股份。

如业绩承诺方取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其相应部分的新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日或其在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。

（2）民和志威

如民和志威取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

华创芯原及民和志威在本次交易项下获得的交易对价（含股份对价及现金对价）将因华创芯原股权转让发生调整。各方确认，在按《发行股份及支付现金购买资产协议》第二条第 3 款第（7）项“锁定期安排”计算各方可解锁股份时，相关公式中的“业绩承诺方获得的交易对价”、“业绩承诺方获得的现金对价”均应按华创芯原股权转让前（即截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日）各交易对方所持标的公司出资额对应的交易对价计算。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

非经上市公司同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如果非经上市公司同意业绩承诺方转让该等股份，业绩承诺方应按《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定承担相应的违约责任。

（二）发行股份募集配套资金

1、募集配套资金的金额及占交易总金额的比例

本次拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。名建致真不参与发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产

交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%。

2、募集配套资金的发行价格及定价原则

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。其中，名建致真不参与本次发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

3、募集配套资金的董事会决议明确的发行价格调整方案

本次发行股份募集配套资金采取向特定投资者非公开发行股份的方式。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

4、发行股份的种类、每股面值

本次募集配套资金所发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

5、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元，其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。本次募集配套资金最终发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准

的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。

6、锁定期安排

本次交易上市公司拟向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金，其中名建致真所认购的股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得转让。

本次发行完成后至锁定期满之日止，由于上市公司分配股票股利、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

本次所认购的上市公司股份锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、上交所届时有效的相关规定。

二、本次发行股份募集配套资金情况说明

（一）募集配套资金的用途

本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易中的现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。募集配套资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	拟投入募集配套资金金额
1	支付本次交易现金对价	154,761.00
2	eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目	20,000.00
3	支付交易相关的中介费用	8,239.00
合计		183,000.00

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足或未能实施完成，上市公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

（二）募集配套资金投资项目介绍

本次交易中，上市公司拟投资配套募集资金 20,000.00 万元用于 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目的建设，具体如下：

1、项目概况

为完善北京矽成存储芯片产品线，扩展标的公司在移动通信、消费电子领域的市场，本项目的主要建设内容为基于 28nm Nand Flash 闪存的 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案。标的公司在原有 DRAM、SRAM、FLASH 等存储芯片技术的基础上，通过本次新项目建设，切入 eMMC/eMCP 嵌入式闪存解决方案领域，主要面向下游以智能手机、平板电脑等移动智能终端为代表的通信和消费类市场。

本项目计划总投资 20,857.74 万元。其中，拟投资 2,842.14 万元场地购置、设备购置和软件购置等工程费用；拟投资 15,265.60 万元用于工程建设其他费用；拟分别投资 750.00 万元和 2,000.00 万元用于项目预备费和铺底流动资金。

2、项目实施的可行性分析

通过对于中国 eMMC/eMCP 嵌入式闪存解决方案市场的深入研究，以及对北京矽成拓展该领域业务在技术和经济方面所做的谨慎分析，北京矽成拓展该方向业务，并为此实施的相关开发项目具有可行性，这是基于：

（1）从宏观政策层面分析，该项目具备有利的政策环境

从宏观政策层面分析，该项目属于国家重点扶持的集成电路行业，符合国家政策导向。2000 年国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从战略布局上明确了集成电路产业的发展路径；2008 年 1 月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，给予集成电路设计、生产、制造企业税收政策优惠；2011 年 2 月 9 日，国务院办公厅发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，对集成电路产业的所得税优惠范围加大；2014 年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布，明确指出大力“推动集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑”；2016 年 11 月，《中国半导体产业“十三五”发展规划》发布，重点指出国内集成电路产业要在“通

用处理器、存储芯片等核心产品要形成自主设计与生产能力”，形成自主可控的产业生态体系。

（2）从中观行业层面分析，该项目具备广阔的市场空间

从中观行业层面分析，随着智能手机、平板电脑等消费电子类产品市场的增长，NAND Flash 存储芯片市场规模也在逐年迅速扩大，eMMC 标准作为目前主流嵌入式闪存方案占据了 7 成以上的市场份额，MCP 则代表了 eMMC 的发展方向之一。从国际市场来看，除苹果外，市场主要的智能手机产品均采用 eMMC 方案，平板领域除了刚兴起的 NVMe 方案以外，主要的产品也以 eMMC 方案为主；从国内市场来看，我国作为世界第一智能手机生产大国、第一平板电脑生产大国，对成熟的嵌入式闪存解决方案有巨大的市场需求。因此，本项目预计研发的 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案具有广阔的市场空间。

（3）从微观公司层面分析，标的公司具有坚实的技术基础与管理经验

从微观公司层面分析，北京矽成的主要产品线包括 DRAM，异步 SRAM/同步 SRAM（包括 Pipeline、Flow-Through、DDR-II、QUAD）、RLDRAM 2/3、Flash 以及模拟混合信号产品，技术实力雄厚、核心团队稳定，在自主创新、产品化、本地化服务、知识管理等方面有突出表现，能针对市场变化快速推出符合客户要求的芯片与整体解决方案，并为客户提供本地化的技术支持与定制化设计，具备完成项目的技术基础与服务经验。

标的公司构建了较为完善的知识体系，将技术管理模块化、平台化。高集成度、低功耗、稳定性强的芯片研发难度较高，一般要较长时间的自主知识产权的开发和积累才能完成。标的公司把核心技术的自主创新作为长期发展战略，在芯片设计中将积累的丰富经验规模化、体系化、平台化，建立了良好的知识管理、知识分享体系，便于技术经验在研发过程中的延续。

（4）从项目可行角度分析，标的公司实施该项目在经济效益和社会效益上具备可行性

通过对标的公司实施该项目相关财务数据进行谨慎测算，其内部收益率高于社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强；该项目是国家鼓励发展的项目之一，项目建成后，社会效益明显。

本项目实施以后，对我国的存储芯片产业的整体发展水平有很大帮助。首先是有助于打通国内存储芯片设计、制造、终端应用的产业链，实现整体联合优势，为刺激本地经济做出贡献。其次，本项目以存储芯片产业链核心存储芯片设计为研发目标，项目建成后将促进国内集成电路产业的发展，加快核心技术的国产化，为产业培养一批高科技的技术市场人才。

综合衡量，该项目具有较高的经济效益和社会效益。

3、项目投资概算

本项目计划总投资 20,857.74 万元。其中，拟投资 2,842.14 万元场地购置、设备购置和软件购置等工程费用；拟投资 15,265.60 万元用于工程建设其他费用；拟分别投资 750.00 万元和 2,000.00 万元用于项目预备费和铺底流动资金。项目总投资构成见下表：

单位：万元

项目投资估算表		
项目类别	项目名称	费用测算
1、工程费用	1.1 场地购置费	1,750.00
	1.2 设备购置费	571.94
	1.3 软件购置费	520.20
	小 计	2,842.14
2、工程建设及其他费用	2.1 办公场地装修费	175.00
	2.2 办公家具购置费	20.00
	2.3 知识产权授权使用费	600.00
	2.4 试制费用	10,464.60
	2.5 人员费用	3,796.00
	2.6 培训费	60.00
	2.7 可行性研究费	30.00
	2.8 研讨及咨询费	30.00
	2.9 知识产权等级费用	90.00
	小 计	15,265.60
3、预备费	3.1 基本预备费	300.00
	3.2 涨价预备费	450.00
	小 计	750.00
4、铺底流动资金	铺底流动资金	2,000.00

	小 计	2,000.00
总计		20,857.74

4、项目实施进展计划

结合 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目的建设目标，本项目建设期为三年。具体进展计划如下：

第一年在原有芯片、软件、系统设备的基础上，引入研发设备；同时通过内部调拨和外部招聘两种方式配置研发人员，完成人员的培训；开始 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案研发。本项目需在第一年购置一处 500 平米左右的研发基地，主要是芯片研发实验室。芯片研发实验室主要用于芯片开发及测试。设备包括开发 PC 机、工作站和 EDA 开发工具、版本管理软件、高速示波器、频谱分析仪、信号源等软硬件设备。

第二年继续引入研发设备和研发人员，继续对产品进行升级和研发；加大市场推广力度，尽可能的利用现有产品渠道，扩大市场销售收入。

第三年在继续对产品进行升级和研发的基础上，加快产业化进程，加大市场推广力度，尽可能的利用现有产品渠道，同时开拓新市场，扩大市场销售收入。

5、项目投资的相关收益

结合中国 eMMC 及 eMCP 芯片市场规模预测以及行业特点，同时根据标的公司 eMMC 及 eMCP 芯片的业务结构，项目启动第一年将处于产品研发阶段，预计无法产生销售收入。第二年 eMMC 实现小批量供货。第三年，eMCP 实现小批量产品。从第四年开始，产品销量开始进入快速增长期。

根据测算，在综合考虑了固定资产折旧、无形资产摊销、销售费用和其他管理费用后，该项目的投资回收期约为 4.81 年，税后内部收益率约为 15.28%。

6、项目涉及立项、环保审批情况

截至本募集说明书出具日，本项目的立项、环保部门环评文件工作正在办理过程中。本项目产品的研发、产业化和市场推广，产业形态不同于传统制造业，主要通过知识创新和智力劳动，获得价值和利润。开发、测试过程不产生废气、废水和固体废弃物，对环境不产生任何污染，属于环保、绿色、无害化产业。

（三）上市公司前次募集资金情况

1、首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会于 2016 年 7 月 20 日签发的证监许可[2016]1643 号文《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上交所（自律监管决定书 [2016]215 号）同意，兆易创新首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 23.26 元，募集资金总额为人民币 58,150.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,497.07 万元后，募集资金净额为人民币 51,652.93 万元。

上述募集资金到位情况业经瑞华会计师验证，并出具瑞华验字 [2016]01500020 号《验资报告》。

2、上市公司首次公开发行股票募集资金使用情况

根据公司于 2016 年 7 月 22 日签署的《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，兆易创新计划将募集资金主要用于 NOR 闪存技术及产品改造项目、NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目、基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化项目以及研发中心建设项目等。募集资金到位前，公司可以用自筹资金对上述拟投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换出上述自筹资金。

（1）本年度使用金额及当前余额

根据瑞华会计师出具的《关于北京兆易创新科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01500010 号），2016 年度，兆易创新的募集资金使用情况如下表所示：

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				53,446.93		本年度投入募集资金总额					14,559.05	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,559.05	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
NAND 闪存技术 开发、应用及 产业化项目	无	20,358.52	20,358.52	9,956.75	3,098.12	3,098.12	-6,858.63	31.12	2018年12 月		不适用	否
NOR 闪存技术 及产品改造项 目	无	16,018.17	16,018.17	7,211.40	6,517.70	6,517.70	-693.7	90.38	2018年12 月		不适用	否
基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发 及产业化项目	无	11,995.47	11,995.47	5,769.00	3,877.70	3,877.70	-1,891.3	67.22	2018年12 月		不适用	否
研发中心建设 项目	无	3,280.77	3,280.77	2,417.23	331.53	331.53	-2,085.7	13.72	2017年12 月		不适用	否
合计	-	51,652.93	51,652.93	25,354.38	13,825.05	13,825.05	-11,529.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					截止 2016 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,266.62 万元。瑞华会计师出具《北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2106]01500110 号）予以鉴证
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 3.3 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品 and 结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 39,107.59 万元，其中尚未使用的募集资金 38,877.88 万元，利息收入扣除手续费导致募集资金净额增加 219.71 万元。
募集资金其他使用情况	无

（2）变更募投项目的资金使用情况

根据公司实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施主体，由兆易创新变更为公司全资子公司合肥格易集成电路有限公司（下称“合肥格易”），实施地点由北京市海淀区相应变更为合肥市经济技术开发区。除此之外，与“研发中心建设项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。公司拟以增资时研发中心建设项目募集资金专项账户全部余额（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对合肥格易进行增资。本次增资完成后，合肥格易仍为公司的全资子公司。

本次变更研发中心建设项目实施主体系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的审慎决定。本次项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司整体经营管理水平。

2016年11月29日，上市公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，2016年12月16日，兆易创新召开2016年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构亦就该事项出具了专项核查意见。

截至本报告出具日，上市公司前次募集资金使用进度正常，后期兆易创新将根据项目建设进度继续将剩余募集资金投入于 NOR 闪存技术及产品改造项目、NAND 闪存技术开发、应用及产业化项目、基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化项目以及研发中心建设项目等项目建设。

（四）募集配套资金的必要性

1、上市公司、标的资产报告期末货币资金余额及用途

（1）上市公司期末货币资金余额及用途

截至2016年12月31日，上市公司货币资金账面余额合计87,155.92万元，其中2016年上市公司首次公开发行股票募集资金尚余39,107.59万元（包括尚未

支付完毕的中介费用和募集资金专户的利息收入），扣除属于上市公司首次公开发行股票募集资金部分，上市公司剩余货币资金账面余额为 48,048.33 万元，期末货币资金主要将用于维持公司日常生产经营所需资金。

（2）标的公司期末货币资金余额及用途

截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成备考合并财务报表中的货币资金余额为 89,450.90 万元，未来货币资金将主要用于 DRAM、SRAM 等存储芯片及衍生产品的研发、设计、委外加工和销售等日常营运。报告期内，北京矽成业务规模稳健增长，对营运资金的需求相对较大。

本次交易完成后，上市公司将拥有北京矽成 100%股权，为了提高本次交易的整合绩效，充分发挥交易完成后带来的协同效应，本次交易拟募集配套资金除用于支付本次交易的标的资产的现金对价及中介机构费用外，还将在 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存(4G-16G)解决方案领域加大投入，通过在存储芯片行业的横向延伸，实现整个存储芯片领域产品全覆盖，打造行业内领先的半导体芯片研发、设计支持企业。鉴于此，上市公司的营运资金需求将进一步增加。

根据本次重大资产重组交易方案，上市公司需以现金方式向交易对方支付 154,761.34 万元，仅依靠上市公司和标的公司的货币资金无法满足支付本次交易现金对价、本次交易相关的中介费用、拟筹建项目的实施以及上市公司交易完成后日常运营的全部资金需求，需借助外部融资的有效支撑。

2、上市公司属于轻资产企业，较难通过债务融资方式支付所需现金对价

兆易创新采用 Fabless 生产模式，公司仅从事芯片的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。由于无需花费巨额资金建立晶圆生产线，Fabless 模式使得公司具有“资产轻、专业强”的特点。

该种生产模式下，公司能在资金和规模有限的情况下，充分发挥公司的研发能力，集中资源进行芯片的设计和研发，对公司的快速发展起到了至关重要的作用。但是，与此同时上市公司拥有的可用作抵押物进行债务融资的资产相对较少，公司较难通过债务融资筹集所需的现金对价。

截至 2016 年 12 月 31 日，兆易创新与 A 股同行业可比上市公司的资产负债

率对比情况如下：

序号	证券简称	证券代码	资产负债率（%）
1	北京君正	300223	3.28
2	国民技术	300077	10.03
3	欧比特	300053	-
4	中颖电子	300327	13.56
5	晓程科技	300139	-
6	全志科技	300458	14.48
7	紫光国芯	002049	26.66
平均值			13.60
兆易创新			23.39
兆易创新（不考虑 IPO 募集资金余额）			30.54

数据来源：Wind 资讯

注：截至本报告书出具日，欧比特和晓程科技的 2016 年年报尚未披露，计算同行业平均值时剔除两家公司的影响

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率绝对水平较低，为 23.39%，鉴于兆易创新的资产中包括 2016 年上市公司首次公开发行股票剩余的资金，上述资金已有明确募集资金用途，剔除该募集资金的影响，上市公司的资产负债率为 30.54%。同期 A 股同行业可比上市公司的资产负债率平均水平为 13.60%。相比之下，上市公司的资产负债率已经位于同行业较高水平。因此，在可用于抵押借款的资产较少的情况，公司较难通过债务融资筹集所需的现金对价。

3、本次募集配套资金金额与上市公司及标的资产现有生产经营规模、财务状况相匹配

本次交易中，公司拟募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元。其中，用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价部分为 154,761.00 万元，用于 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存(4G-16G)解决方案开发、应用及产业化项目的建设为 20,000.00 万元，剩余部分用于支付本次重组相关的中介费用。上述金额无法通过上市公司的自有资金进行全额支付。基于本次交易方案和公司财务状况的综合考虑，拟通过募集配套资金解决。

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司及标的公司的总资产，以及与本次募集

配套资金上限的比较情况如下表所示：

项目	金额/比例
兆易创新总资产（万元）	166,965.03
北京矽成总资产（万元）	602,784.78
资产合计数（万元）	769,749.81
募集配套资金上限占合计数的比例	23.77%

由上表可知，以上市公司及标的公司的总资产合计数进行测算，并与本次募集配套资金上限进行比较分析，后者占前者的比例为 23.77%，占比相对较小。

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率为 23.39%，剔除公司 2016 年上市公司首次公开发行股票募集资金剩余部分的影响，上市公司的资产负债率为 30.54%。同期 A 股同行业可比上市公司的资产负债率平均水平为 13.60%，可见上市公司资产负债率处于同行业较高水平，本次募集配套资金有利于改善重组完成后上市公司的整体财务状况，降低财务风险。

此外，本次募集配套资金拟投资建设的 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存 (4G-16G) 解决方案开发、应用及产业化项目，紧紧围绕北京矽成主营业务的发展，紧密结合北京矽成的核心竞争力和行业的未来发展趋势。北京矽成将在原有 DRAM、SRAM、FLASH 等存储芯片技术的基础上，通过本次新项目建设，切入 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存解决方案领域，主要面向下游以智能手机、平板电脑等移动智能终端为代表的通信和消费类市场，对标的公司的未来发展具有重要意义。上市公司可将募集资金和技术力量集中于新产品、新技术的研发，并通过与原有业务的整合，共享产业链资源，进一步增强公司与全球一流厂商同台竞技时的实力。

综上所述，本次募集配套资金金额与上市公司及标的资产现有生产经营规模和财务状况相匹配，拟投资建设项目为标的公司发展所需，有利于进一步提高本次交易后上市公司的整体盈利水平。

（五）募集配套资金管理和使用的内部控制制度

为规范公司募集资金管理，保护投资者尤其是中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，依照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司修订了《北京兆易创新科技股

份有限公司募集资金使用管理制度》。

根据新修订的《北京兆易创新科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金的存储、使用、投向变更的有关分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了规定，其核心内容如下：

1、对募集资金存放的规定

（1）公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

（2）公司应在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、对募集资金使用的规定

（1）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定，并应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

（2）募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：①募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；②募投项目搁置时间超过一年的；③超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；④募投项目出现其他异常情形的。

（3）公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：①募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；②通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；③将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

（4）公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事

务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

（5）公司可以将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品须符合以下条件：①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（6）公司使用闲置募集资金投资产品，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。

（7）公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见，公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。且应当符合下列条件：①不得变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；②仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；③单次补充流动资金时间不得超过十二个月；④已归还已到的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。

（8）公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

（9）单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。节余募投资金（包括利息收入）低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相关程序及披露义务。

（10）募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

3、对募集资金投资项目变更的规定

（1）公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可变更。公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保荐人的意见。

（2）变更后的募集项目应投资于主营业务。公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

（3）公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：①原募投项目基本情况及变更的具体原因；②新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；③新募投项目的投资计划；④新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；⑤独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见；⑥变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；⑦上海证券交易所要求的其他内容。新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。

（4）公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

（5）公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内

报告上海证券交易所并公告以下内容：①对外转让或置换募投项目的具体原因；②已使用募集资金投资该项目的金额；③该项目完工程度和实现效益；④换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；⑤转让或置换的定价依据及相关收益；⑥独立董事、监事会、保荐人对转让或置换募投项目的意见；⑦转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；⑧上海证券交易所要求的其他内容。公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

4、募集资金使用管理与监督

（1）公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。

如募投项目实际投资进度与投资计划存在差异，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。如当期存在使用闲置募集资金投资产品情况，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。

（2）独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2 个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。

（3）保荐人至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场

调查。每个会计年度结束后，保荐人应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于上市公司披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。

每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

（六）本次募集配套资金失败的补救措施

1、本次募集配套资金失败的补救措施

如果本次募集配套资金不足或未能实施完成，本公司计划采取自有资金积累、债务融资等补救措施，具体如下：（1）在满足公司现金分红的条件下，增加自身利润积累，从而留存更多的利润增加自身资金；（2）以银行贷款等债务性融资方式解决部分资金需求；（3）重组完成后利用资本市场的多渠道融资方式募集资金，积极推进公司在本次交易完成后的后续发展。

2、补救措施对上市公司的影响

根据经审计的上市公司 2014 年、2015 年和 2016 年的财务报告，兆易创新 2014 年末、2015 年末和 2016 年末的资产负债率分别为 34.01%、36.58%和 23.39%，2014 年度、2015 年度和 2016 年度的财务费用分别为-214.77 万元、-1,991.00 万元、-2,463.84 万元。若本次交易配套募集资金未能实施，上市公司采用银行借款筹措项目所需资金，将导致上市公司资产负债率升高、财务费用增加，从而对上市公司财务安全及盈利能力造成不利影响。

使用股权融资手段，可降低上市公司的财务负担，但会增加上市公司总股本，造成每股收益的摊薄。

（七）对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中包含募集配套资金投入带来的收益的情况

中联评估对标的资产采取收益法评估时，预测现金流中未包含募集配套资金投入带来的增量收益。

三、上市公司发行股份前后主要财务数据

本次交易前后，上市公司主要财务指标情况如下：

项目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度		2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考)	本次交易前	本次交易后 (备考)
资产总额（万元）	166,965.03	871,603.24	89,979.92	746,385.95
归属上市公司股东所有者权益（万元）	127,853.57	623,092.23	57,127.89	483,628.07
营业收入（万元）	148,894.82	362,534.03	118,878.02	312,453.54
利润总额（万元）	18,576.65	36,200.29	18,124.48	31,921.44
归属母公司所有者的净利润（万元）	17,642.76	31,698.15	15,778.26	21,683.81
资产负债率	23.39%	28.29%	36.58%	35.00%
毛利率	26.72%	32.60%	28.67%	32.35%
每股收益	1.81	2.40	1.89	1.89

注：每股收益计算中不考虑配套募集资金发行股份的影响。分子为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分母为加权平均股本数。

如上表所示，本次交易后，上市公司资产总额、归属上市公司股东所有者权益、营业收入、利润总额和归属母公司所有者的净利润等指标均大幅增长，公司资产规模的扩大有助于增强公司抗风险能力；

其次，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司的备考报表将本次交易应支付的现金对价部分计入负债中，因此本次交易后上市公司的资产负债率水平出现一定程度上升，财务杠杆利用效率有所提高；

最后，基于标的公司较高的毛利率水平，本次交易导致上市公司毛利率水平进一步增加。2015 年，本次交易完成前后的每股收益指标基本保持不变。2016 年，随着标的公司主营业务收入的 growth 以及期间费用率的同比下降，在人民币汇率贬值的放大效应下，本次交易完成后上市公司的每股收益指标较本次交易前以及 2015 年同比均得到较大提升。

综上，鉴于标的公司报告期内稳健的经营状况和良好的盈利能力，本次交易有利于进一步提高上市公司的抗风险能力、杠杆利用率和盈利能力。

四、本次发行股份前后上市公司的股权结构

本次交易前，上市公司的总股本为 10,000.00 万元，朱一明为公司控股股东和实际控制人。本次交易上市公司拟向北京矽成全体股东发行 3,128.48 万股股份，本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 13,128.48 万元（不考虑发行股份募集配套资金部分）。本次交易完成前后公司的股权结构如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
朱一明	12,219,000	12.22%	12,219,000	9.31%
香港赢富得	10,459,500	10.46%	10,459,500	7.97%
友容恒通	2,724,825	2.72%	2,724,825	2.08%
万顺通合	924,000	0.92%	924,000	0.70%
上海承裕	-	-	14,181,763	10.80%
屹唐投资	-	-	11,106,964	8.46%
华创芯原	-	-	2,830,931	2.16%
民和志威	-	-	1,610,989	1.23%
闪胜创芯	-	-	1,554,169	1.18%
重组前的其他股东	73,672,675	73.67%	73,672,675	56.12%
合计	100,000,000	100.00%	131,284,816	100.00%

本次交易前，朱一明直接持有兆易创新 12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.72%及 0.92%股份；香港赢富得持有兆易创新 10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

在不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，本次交易完成后，朱一明直接持有兆易创新 9.31%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.08%及 0.70%股份；香港赢富得持有兆易创新 7.97%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 20.06%，仍为公司控股股东和实际控制人，因此本次交易将不会导致公司控制权发生变化。

第七章 本次交易主要合同

一、发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议

（一）合同主体、签订时间

2017年2月13日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威以及北京矽成签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2017年2月24日和4月17日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。

（二）本次交易整体方案

1、上市公司分别以发行股份及支付现金方式购买上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%的股权；上市公司同时向特定投资者定向发行股份募集配套资金，其中部分募集资金作为现金购买资产的资金来源。前述发行股份及支付现金方式收购北京矽成100%股权的具体情况如下：

交易对方	发行股份购买资产		现金购买资产	
	出资额(元)	持股比例(%)	出资额(元)	持股比例(%)
上海承裕	179,483,696	34.538	44,870,924	8.635
屹唐投资	140,569,194	27.050	52,552,409	10.113
华创芯原	35,828,125	6.894	26,307,045	5.062
民和志威	20,388,607	3.923	-	-
闪胜创芯	19,669,490	3.785	-	-
合计	395,939,112	76.191	123,730,378	23.809

各方同意，为免歧义，上表“现金购买资产”中上海承裕和屹唐投资部分包括两方于2016年12月分别受让的标的公司4.09%股权（对应出资额21,229,620.00元）和10.10%股权（对应出资额52,496,603.00元）。

2、各方同意，本次发行股份及支付现金购买资产的实施不以本次发行股份募集配套资金为前提，本次发行股份募集配套资金最终成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若募集资金不足，资金缺口由上市公司自

筹解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。

（三）标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日（即 2016 年 9 月 30 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商一致，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，标的资产的交易价格确定为 650,000 万元。

（四）发行股份购买资产

作为本次购买资产的一部分，上市公司以发行股份的方式向交易对方购买标的公司 76.19%的股权，其主要内容如下：

1、发行方式

本次发行的方式为向特定投资者（即交易对方）非公开发行股份。

2、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行对象及认购方式

发行股份购买资产项下的发行对象即为交易对方，即上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威。前述各方以其所持标的公司相应股权为对价认购上市公司新增股份。

4、定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为上市公司审议本次交易的董事会决议公告日，即

2017年2月14日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

鉴于兆易创新股票于2016年8月18日在上交所上市交易，就本次交易相关事项于2016年9月19日起停牌，各方拟定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即158.30元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量，下同。

经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为158.30元/股。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不再调整。

5、发行数量

发行股份购买资产项下上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=以股份支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。根据上述公式，发行股份购买资产项下向交易对方发行股份的具体情况如下：

交易对方	以股份支付的交易对价（元）	发行股份（股）
上海承裕	2,244,973,096.27	14,181,763
屹唐投资	1,758,232,451.95	11,106,964
华创芯原	448,136,396.27	2,830,931
民和志威	255,019,682.78	1,610,989
闪胜创芯	246,024,997.54	1,554,169
合计	4,952,386,624.81	31,284,816

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本

或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

6、滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

7、锁定期安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认，上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威对本次购买资产项下取得上市公司新增股份作出如下承诺：

（1）业绩承诺方

如业绩承诺方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，业绩承诺方按照下列公式计算的股份可以转让或交易（即解锁，下同）：业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价）/发行价格。同时，业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以再分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2017 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可再解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可再解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

华创芯原可解锁的股份数=（业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例）/ 发行价格

第二期，在 2018 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方未完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%，则业绩承诺方可解锁的股份数为零。如业绩承诺方完成 2017 年和 2018 年的累计承诺净利润的 90%或以上，业绩承诺方可解锁的股份数分别按如下公式计算：

除华创芯原外的其他业绩承诺方可解锁的股份数=业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年的累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例 / 发行价格 - 第一期解锁股份数

华创芯原可解锁的股份数=(业绩承诺方获得的交易对价*50% - 业绩承诺方获得的现金对价+业绩承诺方获得的交易对价*50%*2017 年和 2018 年累计承诺净利润占业绩承诺期累计承诺净利润的比例) / 发行价格 - 第一期解锁股份数

第三期，在 2019 年《专项审核报告》出具后，如业绩承诺方在 2017 年至 2019 年累计实现净利润达到累计承诺净利润的 90%或以上，则业绩承诺方剩余股份可全部解锁，如需进行业绩补偿，则剩余股份在完成业绩补偿后解锁。

为确定各期可解锁股份数量，《专项审核报告》应于上市公司年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经交易双方同意并确认延期的，则视为业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司年度报告披露届满 30 日后解锁相应数量的股份。

如业绩承诺方取得新增股份时，对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其相应部分的新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日或其在《盈利补偿协议》中业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。

（2）民和志威

如民和志威取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

华创芯原及民和志威在本次交易项下获得的交易对价（含股份对价及现金对价）将因华创芯原股权转让发生调整。各方确认，在按《发行股份及支付现金购买资产协议》第二条第3款第（7）项“锁定期安排”计算各方可解锁股份时，相关公式中的“业绩承诺方获得的交易对价”、“业绩承诺方获得的现金对价”均应按华创芯原股权转让前（即截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日）各交易对方所持标的公司出资额对应的交易对价计算。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

非经上市公司同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如果非经上市公司同意业绩承诺方转让该等股份，业绩承诺方应按《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定承担相应的违约责任。

8、上市地点

上市公司发行股份购买资产项下的新增股份将在上交所上市交易。

（五）现金购买资产

1、作为本次购买资产的一部分，上市公司以现金方式向交易对方购买标的公司 23.81%的股权，具体情况如下：

交易对方	以现金支付的交易对价（元）
上海承裕	561,243,274.06
屹唐投资	657,322,903.24
华创芯原	329,047,197.88
民和志威	-
闪胜创芯	-
合计	1,547,613,375.18

2、各方同意，本次购买资产项下的标的资产交割完成之日（以标的公司完

成工商变更登记之日为准）起 45 个工作日内，上市公司应向交易对方一次性支付现金购买资产部分的全部交易对价（简称“现金对价”）。

（六）本次配套融资方案

各方同意，上市公司将向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股份募集不超过 183,000.00 万元的资金，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的 20%。

（七）资产交割条件、资产交付或过户的时间安排

1、交割条件

各方同意，《发行股份及支付现金购买资产协议》所述之交易在以下条件均已成就或上市公司书面豁免全部或部分条件后方可交割：

（1）于本次交易交割前，各方保证其在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下作出的相关陈述与保证及此前提供的全部文件仍然真实、准确及完整，没有发生重大不利变更，不存在任何限制、禁止或致使本次交易被取消的重大不利事件，或者任何已对或将对标的公司及本次交易产生重大不利影响的事件、或者任何对标的公司的经营、财务状况或资产有或基于其合理的预测将产生重大不利影响的事件；

（2）各方均未实质违反各自于《发行股份及支付现金购买资产协议》项下应在本次交易交割日前履行的义务和责任；

（3）通过美国外国投资委员会对本次交易相关事项的国家安全审查；

（4）通过台湾经济部投资审议委员会对本次交易涉及的陆资企业投资相关事项的审查；

（5）除标的公司本次交易所涉的工商变更登记手续外，为完成本次交易所必需的由第三方或政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案均已适当取得且有效。

2、资产交付或过户的时间安排

各方同意，《发行股份及支付现金购买资产协议》第四条第 1 款所述交割先

决条件全部成就（或被豁免）之日起 20 个工作日内，交易对方及标的公司应尽快负责到有关工商行政管理部门办理标的资产过户至上市公司的工商变更登记手续，具体工作包括但不限于：

（1）促使标的公司召开股东会，变更公司股东为上市公司，同时修改公司章程；

（2）促使标的公司办理股东、公司章程及董事、监事、高级管理人员（如涉及）的工商变更登记手续。

办理上述程序或手续期间，涉及需要上市公司配合的，上市公司应予以及时响应和协助。各方进一步确认，标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记完成之日，即为本次交易交割日。

各方同意，交割日起 20 个工作日内，上市公司应尽快负责将向交易对方发行的股份相应办理至交易对方名下，具体工作包括但不限于：

（1）聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告（如需）；

（2）于上交所及中国证券登记结算有限公司上海分公司办理本次交易项下新增股份的发行、登记、上市等手续；

（3）向中国证监会及其派出机构履行报告等有关手续。

办理上述手续期间，涉及需要交易对方配合的，交易对方应予以及时响应和协助。

（八）过渡期

1、交易对方保证在过渡期内，将对标的公司尽善良管理义务，保证持续拥有标的公司股权的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保其持有的标的公司股权不存在司法查封、冻结、为任何其他第三方设定质押或设置任何形式的权利负担或第三方权利的情形。

2、交易对方保证在过渡期内，将合理、谨慎地运营及管理标的公司；确保标的公司管理层、客户的稳定和业务的正常经营；确保标的公司在正常经营之外不进行非正常的导致标的公司股权价值减损的行为，亦不从事任何导致标的公司无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为；保证标的公司的

经营状况将不会发生重大不利变化。

3、交易对方同意，过渡期间内，标的公司如作出日常生产经营外可能引发标的资产发生重大变化（包括但不限于主营业务变更、股本结构变化、重大资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等涉及金额在 1,000 万人民币以上的事项/行为）的决策，应征得上市公司的书面同意。

4、交易对方同意，在标的资产交割前，标的公司不进行利润分配；标的公司滚存未分配利润自交割后归上市公司所有。

5、各方同意自交割日起 5 个工作日内，各方将共同聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司在过渡期内的损益进行审计，该审计的基准日为交割日所在月的最后一日。若标的公司在过渡期内净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加等情形）的，则增加部分由上市公司享有；若标的公司在过渡期内净资产减少（不限于因正常经营造成亏损导致净资产减少，但经双方认可的事项/情形除外）的，则在净资产减少数额经审计确定后的 30 个工作日内，由交易对方按照本次交易前其在标的公司的持股比例以现金方式向上市公司全额补足。

（九）本次交易涉及的人员安排及债务处理

1、本次交易涉及标的公司股东变动，不涉及标的公司及其下属企业聘用人员劳动关系的调整变更。

2、本次交易不涉及标的公司债权债务转移，标的公司及其下属企业对其现有的债权债务在本次交易完成后依然以其自身的名义享有或承担。

（十）盈利补偿

因本次交易对标的资产采用收益法进行评估作价，参考中国证监会的相关规定，上市公司将与业绩承诺方另行签署《盈利补偿协议》，就本次交易涉及的业绩承诺及补偿相关事宜进行约定。

（十一）协议的生效、变更和终止

1、本协议及本协议所述之交易行为在以下条件均获得满足之日起生效：（1）交易对方均按各自章程或内部管理制度规定，经内部有权机构审议批准或同意本

次交易相关事宜；（2）标的公司股东会审议批准或同意本次交易相关事项；（3）上市公司董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；（4）中国证监会核准本次交易。

2、《发行股份及支付现金购买资产协议》经各方签署（法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章）后成立，其中第九条至第十九条自本协议签署之日起生效，其他条款自《发行股份及支付现金购买资产协议》第三条第1款所述之先决条件全部满足之日起生效。

3、《发行股份及支付现金购买资产协议》签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经各方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、下列情况发生，《发行股份及支付现金购买资产协议》终止：

（1）协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；

（2）经《发行股份及支付现金购买资产协议》各方协商一致同意终止本协议；

（3）各方承诺将尽全力在本次交易预案披露之日起2个月内完备相关手续并披露报告书，如届时未能披露，则本次发行股份及支付现金购买资产交易双方均有权于前述期限届满之日起5个工作日内以书面方式提出终止本协议，其他方应配合完成相关终止程序；交易双方经协商同意延期的，最迟需在前述期限届满之日起5个工作日内以书面方式确认后并继续履行本协议。根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，各方确认，同意延长上述期限以继续推进本次交易；

（4）《发行股份及支付现金购买资产协议》有效期限自签署之日起10个月届满，除非各方协商一致同意延长前述期限；

（5）受不可抗力影响，一方可依据《发行股份及支付现金购买资产协议》第十四条第3款规定终止本协议。

5、《发行股份及支付现金购买资产协议》终止后将不再对各方均有法律效力，

但其中第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条除外。

（十二）违约责任条款

1、《发行股份及支付现金购买资产协议》签署后，各方均应严格遵照执行，并积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，非因《发行股份及支付现金购买资产协议》各方的原因致使协议不能生效的，各方均不需要承担责任。

2、各方明确，交易对方各成员相互独立，均独立履行义务并承担责任。就《发行股份及支付现金购买资产协议》第十六条约定的违约责任，除非另有明定，彼此间无任何连带、担保、保证、代理、代表法律关系。交易对方任一名或数名成员违约，不代表、亦不视为交易对方其他成员违约，相关违约方应独立承担违约责任，与未违约的交易对方成员无关，未违约的交易对方成员就违约行为不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其合法权益不因此受到损害。

3、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第二条第3款第（7）项，非经上市公司同意，业绩承诺方转让相关股份的，该业绩承诺方需向上市公司支付违约金，违约金标准为已转让股份在股份过户日市值的10%。非经上市公司同意，业绩承诺方质押相关股份的，该业绩承诺方应根据上市公司要求与通知及时解除质押，并自质押日（以证券登记结算公司办理质押登记手续之日为准）起向上市公司支付违约金，违约金标准为已质押股份在质押日市值的0.03%/天，直至该业绩承诺方解除股份质押，但由于上市公司的原因导致逾期办理解除股份质押手续的除外。

业绩承诺方不可撤销地确认及同意，业绩承诺方承担上述违约责任后，并不当然免除其对上市公司的业绩补偿责任。

4、各方同意，本次交易交割条件满足后，上市公司未能按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的付款期限、付款金额向交易对方支付现金对价或股份对价的，每逾期一日，应以应付未付金额为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮5%计算违约金，但由于交易对方的原因导致逾期支付的除外。

5、各方同意，本次交易交割条件满足后，交易对方中任何一方违反本协议

的约定，未能按照本协议约定的期限办理完毕标的资产交割，每逾期一日，该违约方应以其所对应的标的资产相应对价为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 5% 计算违约金支付给上市公司，但由于上市公司的原因导致逾期交割的除外。

6、《发行股份及支付现金购买资产协议》签署后，任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，或除不可抗力外，任何一方不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金（包括守约方为避免损失而支出的合理费用）。其中，交易对方（包括其中任一方）及/或标的公司违反《发行股份及支付现金购买资产协议》附件二所述的陈述与保证而导致上市公司遭受损失的，该违约方承担的赔偿金额应不超过标的资产交易价格的 50%；上市公司应于本次交易交割日起两年内向违约方提出赔偿请求。

7、前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违约方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

二、盈利补偿协议及其补充协议

（一）合同主体、签订时间

2017 年 2 月 13 日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署了《盈利补偿协议》。

2017 年 4 月 17 日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署了《盈利补偿协议之补充协议》。

（二）利润承诺

1、业绩承诺期限

双方确认，《盈利补偿协议》项下业绩承诺方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即 2017 年、2018 年和 2019 年。如本次交易未能在 2017 年度实施完毕或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，双方协商后签署补充协议予以确认。

2、业绩承诺净利润数及实际利润数

（1）根据评估报告，经双方协商及确认，上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯作为业绩承诺方，其承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。

若本次交易未能在 2017 年度交割及实施完毕，则业绩承诺方的业绩承诺期及承诺净利润数将作相应调整，届时依据中国证监会的相关规定，由双方另行协商并签署补充协议。

（2）双方同意，标的公司业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，为实际净利润数。在计算实际净利润数时，不考虑：①标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；②标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

（3）上市公司在业绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实现的实际净利润数，以及该等净利润与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。双方理解并确认，《盈利补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

就标的公司业绩承诺期内各年度实际净利润数的累计数与承诺净利润数的累计数相关差额部分，由业绩承诺方根据《盈利补偿协议》及补充协议的有关约定进行补偿。

（三）补偿原则

业绩承诺期届满后，若标的公司实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 90%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿；否则，业绩承诺方应就实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分进行补偿。业绩承诺方有权选择以现金或股份或现金与股份相结合的方式补偿。

（四）利润补偿方式的计算

1、现金补偿金额及股份补偿数量：

应补偿金额=（承诺净利润累计数－实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数
×标的资产交易作价

应补偿股份数量=（补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

“发行价格”为上市公司本次交易项下发行股份购买标的资产的发行价格；
“标的资产交易作价”为上市公司为购买标的资产而向业绩承诺方支付的对价

业绩承诺方业绩补偿总额以标的资产交易作价的 50%为限，如有超出部分，业绩承诺方无需进一步补偿。业绩承诺方中各方应补偿金额及/或应补偿股份数量按其截至《盈利补偿协议》签署日各自持有标的公司的出资额占业绩承诺方合计持有标的公司的出资额的比例分别计算。

2、若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量；若上市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按《盈利补偿协议》第四条第 2 款公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

（五）盈利补偿的实施

1、业绩承诺期限内，若根据《盈利补偿协议》第四条第 1 款约定发生应进行盈利补偿的情形，业绩承诺方应在审计机构专项审计报告正式出具日起 10 个工作日内，将其选择以现金或股份或现金与股份相结合的方式进行补偿的决定以及具体补偿方案（包括现金和股份补偿分别占应补偿总量的比例以及预计金额/数量等）以书面方式通知上市公司，上市公司应在收到业绩承诺方通知后 20 个工作日内召开董事会，审议确定业绩承诺方具体盈利补偿方案。

2、双方同意，就采用股份方式补偿的部分，业绩承诺方应在上市公司董事会决议日后 10 个工作日内将其持有的相应数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分应补偿的股份自上市公司董事会审议通过盈利补偿方案之日起即不再拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归上市公司所有。

上市公司应在前述董事会后就盈利补偿方案及股份回购等事宜召开股东大会，并在股东大会审议通过之日起 30 个工作日内将应补偿股份以人民币 1.00 元

的总价格进行回购并予以注销。

若上市公司股东大会未审议通过盈利补偿方案及相关股份回购议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通知业绩承诺方，业绩承诺方应在接到通知后的 30 个工作日内将相应数量的股份赠与上市公司董事会确定的股权登记日在册的除业绩承诺方以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的股份数后上市公司的股份数量之比例享有相应的获赠股份。

3、双方同意，就采用现金方式补偿的部分，业绩承诺方应在上市公司董事会审议通过盈利补偿方案之日起 30 个工作日内，将用于补偿的现金金额（按《盈利补偿协议》第四条第 2 款计算）支付至上市公司指定账户。

（六）违约责任

1、一方未履行或部分履行本协议项下的义务给对方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。

2、各方明确，业绩承诺方各成员相互独立，均独立履行义务并承担责任。就《盈利补偿协议》第六条约定的违约责任，除非另有明定，彼此间无任何连带、担保、保证、代理、代表法律关系。业绩承诺方任一名或数名成员违约，不代表、亦不视为业绩承诺方其他成员违约，相关违约方应独立承担违约责任，与未违约的业绩承诺方成员无关，未违约的业绩承诺方成员就违约行为不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其合法权益不因此受到损害。

3、如果业绩承诺方持有的在本次交易中认购的上市公司股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于业绩承诺方对其持有的在本次交易中认购的上市公司股份进行处分而导致其所持有的股份不足以完全履行本补偿协议项下补偿义务的，业绩承诺方应就股份不足补偿的部分以现金或其他方式进行足额补偿。

（七）协议的成立、生效、解除或终止

《盈利补偿协议》自双方签署（企业由法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章，自然人由本人签字）之日起成立，并随《发行股份及支付

现金购买资产协议》同时生效；若《发行股份及支付现金购买资产协议》解除或终止的，则《盈利补偿协议》同时解除或终止。

三、股份认购协议及其补充协议

（一）合同主体、签订时间

2017年2月24日和4月17日，上市公司与名建致真分别签署了《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》。

（二）发行股份募集配套资金方案

1、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定投资者非公开发行股份的方式。

2、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

3、发行对象和认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为名建致真等不超过10名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

4、定价基准日及发行价格

本次配套融资项下发行股份的定价基准日为上市公司本次发行的发行期首日，发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。具体发行价格在取得发行核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价等市场询价情况，最终由公司股东大会授权董事会与独立财务顾问按照价格优先的原则合理确定。

名建致真不参与本次发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同

价格认购新增股份。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

5、本次配套融资总金额与名建致真认购的配套融资金额

本次配套融资总金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。根据标的资产的交易价格，确定本次配套融资总金额不超过 183,000 万元，其中，名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000 万元。最终认购金额将由上市公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

6、股票锁定期

名建致真认购股份自发行完成之日起三十六（36）个月内不得转让。本次配套融资完成后，上市公司实行分配股票股利、转增股本等情形的，则名建致真基于持有的上述认购股份而增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。名建致真同意按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。

名建致真认购股份在前款规定的锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

7、滚存利润

本次发行完成后，名建致真按其对上市公司的持股比例，与上市公司其他股东共同享有上市公司本次发行前滚存的未分配利润。

（三）股份认购价款支付及验资

1、支付方式

自本次交易生效后，在上市公司与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期（简称“缴款日”），名建致真在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。在主承销商及上市公司确认收到认购价款后，上市公司应在缴款日前至少 3 个工作日前书面通知名建致真有关上市公司非公开发行收款账户的详细信息。

2、验资

在收到名建致真支付的认购价款后，上市公司应当及时委托有从事证券业务资格的会计师事务所对本次发行所募集的全部资金进行验资并出具验资报告。

（四）股份交割和交割后续事项

1、股份交割

双方均理解并同意，在名建致真依协议约定向上市公司支付全部认购价款并经验资后，上市公司应及时向名建致真发行新增股份，即上市公司应于前述验资完成之日起 3 个工作日内按照上交所、证券登记结算机构的相关业务规则及要求提交股份发行及登记的相关申请文件。名建致真将认购价款交付上市公司指定账户后 10 个工作日内，上市公司应为名建致真在中国证券登记结算有限责任公司办理本次现金认购股份的股票登记手续。

新增股份经证券登记结算机构登记在配套资金认购方合法开立的各自 A 股股票账户名下即视为交割的完成，完成该等登记当日即为新增股份交割日。

2、交割完成后，名建致真将成为新增股份的所有人，享有或承担作为上市公司股东的权利或义务。

3、双方同意，为履行新增股份的相关交割及落实后续各项手续，双方将密切合作并采取一切必要的行动和措施（包括按照《股份认购协议》规定的原则根据需要签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件），以尽快完成各项工作。

（五）违约责任

1、《股份认购协议》生效后，非因主体资格未被有权机关批准而不再参与本次配套融资的原因外，名建致真因其他任何原因未参与本次发行的，应向上市公司支付认购金额 2% 的违约金。因名建致真主体资格未被有权机关批准导致本协议不能适当履行的，双方均不负违约责任。

2、如因任何一方违反其在《股份认购协议》下的任何声明和保证或违反其在《股份认购协议》下的任何承诺或义务而直接或间接地导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费等），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。

（六）协议的成立、生效、解除或终止

1、协议的成立

《股份认购协议》经上市公司和名建致真各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

2、协议的生效

《股份认购协议》在下列生效条件全部成就之日起生效：

- （1）上市公司董事会和股东大会审议批准本次交易相关事宜；
- （2）中国证监会核准本次交易；
- （3）法律、法规所要求的其他有权机关的审批、许可或同意（如适用）。

3、《股份认购协议》签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与《股份认购协议》具有同等法律效力。

4、在下述情况下，《股份认购协议》终止：

- （1）协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；
- （2）经双方协商一致达成书面协议同意终止本协议；
- （3）受不可抗力影响，一方可依据《股份认购协议》第十一条第3款规定终止《股份认购协议》。

5、《股份认购协议》终止后将不再对双方均有法律效力，但《股份认购协议》的第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条除外。

第八章 交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、本次交易符合国家产业政策

上市公司主营业务为 FLASH 存储芯片的研发、技术支持及销售，本次交易属于横向同行业产业并购，本次交易完成后，上市公司的存储芯片产品线将由 FLASH 产品线拓展至 DRAM、SRAM、FLASH 全存储芯片产品线，业务规模进一步扩大。

集成电路产业作为信息技术产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。根据国家《产业结构调整指导目录（2011）》，集成电路设计、先进集成电路制造、封装与测试、集成电路装备制造属于鼓励类产业。

国家高度重视集成电路产业的发展，自 2000 年以来，相继出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《集成电路产业“十二五”发展规划》、《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策文件，从政策、资金等方面大力扶持国内集成电路产业，推动国内集成电路产业的快速发展。

存储芯片是我国集成电路产业重点发展的领域，兆易创新是我国存储芯片设计领域的龙头企业，在存储芯片国产化、工业智能化等大背景下，兆易创新面临良好的发展机遇，有望实现快速发展。

因此，本次交易符合国家相关的产业政策。

2、本次交易符合有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易上市公司及标的公司所处行业不属于高能耗、高污染的行业，上市公司和标的公司严格按照国家、地方环保部门的各项规定，做好环境保护相关工作，不存在与环境保护相关的重大违法违规行为。

本次交易标的公司合法拥有土地使用权，涉及的土地情况符合土地管理相关法律法规的规定。

本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司后，上市公司并未在其所处的行业内形成垄断，不构成行业垄断行为，本次交易符合有关反垄断方面的法律和行政法规的规定。

综上所述，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

截至本报告书出具日，上市公司总股本为 100,000,000 股。本次交易完成后，不考虑募集配套资金的情况下，上市公司总股本将增至 131,284,816 股，其中社会公众股持股比例不低于 25%，不会导致上市公司股权分布不符合股票上市条件。

综上所述，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易涉及的资产定价以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值作为定价依据。兆易创新第二届董事会第九次、第十次和第十二次会议审议通过了本次交易的相关议案，关联董事均回避了相关议案的表决，独立董事发表的独立意见认为，本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，资产定价原则合理、公允。

综上所述，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的资产为北京矽成 100%的股权。根据北京矽成工商登记资料，除上海承裕、华创芯原以其持有的北京矽成的相关股权质押予亦庄国投外，不存在其他质押等权利限制，不存在司法冻结、查封、以及权属争议或潜在纠纷的情形。

就上海承裕、华创芯原持有的北京矽成相关股权质押事宜，截至本报告书出具日，上海承裕持有的 43.173%标的公司股权中 39.087%的股权质押予亦庄国投，华创芯原持有的标的公司 15.034%股权，全部质押予亦庄国投。上海承裕和华创芯原已分别作出承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除相应质押，确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。亦庄国投亦出具《关于解除标的资产质押的说明与承诺函》，承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。

根据上述承诺，上海承裕、华创芯原将尽快与亦庄国投就质押解除事宜协商一致。在上海承裕、华创芯原与亦庄国投相关方协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，标的资产过户及权属变更将不存在法律障碍。

此外，因亦庄国投为上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原私有化收购 ISSI 交易的并购贷款提供连带责任保证，北京矽成将上海闪胜 100%股权质押予亦庄国投以提供反担保。截至本报告书出具日，上述股权质押尚未解除。根据北京矽成的说明，其承诺于本次交易申报文件提交中国证监会前解除前述股权质押。

同时，本次重组不涉及债权债务的转移，本次重组完成后，北京矽成仍对自身所负债务承担责任。

综上所述，本次交易所涉及的资产权属清晰，就上海承裕、华创芯原以其所持标的公司股份向亦庄国投质押事宜，上海承裕、华创芯原已分别出具承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除标的公司股权相应质押，确保标

的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。亦庄国投亦出具《关于解除标的资产质押的说明与承诺函》，承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。在上海承裕、华创芯原及亦庄国投协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，上市公司主营业务仍为存储芯片的研发、技术支持和销售，上市公司将因本次交易拓展新的产品线，有利于其增强持续经营能力，不存在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，信息披露及时，运行规范。未因违反独立性原则而受到监管机构的处罚。

本次交易完成后，上市公司的实际控制人未发生变更，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，本次交易不会对上市公司的独立性造成不利影响，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。为了维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东及实际控制人已出具承诺，保证上市公司独立性。具体情况请详见本报告书“重大事项提示”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

综上所述，本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设立了股东大会、董事会等组织机构并制定相应的议事规则，并建立了比较完善的内部控制制度，从制度上保证股东大会、董事会和监事层面的规范运作和依法行使职权。

本次交易完成后，上市公司将根据重组后的业务及组织架构，进一步完善股东大会、董事会制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

综上所述，本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力

本次交易，兆易创新 2014 年至 2016 年度归属于母公司所有者净利润分别为 9,812.25 万元，15,778.26 万元和 17,642.76 万元。本次交易拟收购资产北京矽成最近三年备考合并财务报表归属于母公司股东的净利润分别为 1,564.04 万元、5,905.54 万元和 14,055.40 万元，扣除非经常性损益后的归母净利润分别为 -2,572.71 万元、5,919.32 万元和 12,379.03 万元。

根据《盈利补偿协议》及补充协议，本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。考虑标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响以及 PPA 摊销的影响后，盈利承诺期扣非后归母净利润分别为 20,365.80 万元、36,066.31 万元和 51,461.18 万元。本次交易完成后，上市公司盈利规模将大幅增加。

本次交易完成后，上市公司资产总额、净资产将大幅增加，资产负债率显著减小。上市公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，本次交易完成后，兆易创新将整合并购双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与标的公司相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。

基于上述分析，本次交易完成后，上市公司资产总额、净资产大幅增加，资产负债率显著减小，财务状况改善；且本次交易完成后，上市公司的收入水平和盈利能力将进一步提升，有利于增强上市公司的盈利能力和持续竞争力。

（二）本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

1、关于减少关联交易

本次交易前，上市公司与北京矽成及其股东之间不存在关联关系，亦不存在关联交易。本次交易完成后，标的公司北京矽成将作为上市公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，上市公司将新增关联方。

本次交易完成后，上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人、本次交易新增关联方和上市公司的关联交易，朱一明、上海承裕及屹唐投资分别就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

2、关于避免同业竞争

本次交易并未导致兆易创新控股股东和实际控制人发生变更，朱一明仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，北京矽成旗下的存储芯片业务将整体注入上市公司。目前，朱一明未直接或间接

经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及标的公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及标的公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争的问题。

本次交易完成后，为从根本上避免和消除控股股东及实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东及实际控制人朱一明作出承诺避免同业竞争。此外，本次交易完成后，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，也作出承诺避免同业竞争。

3、关于增强独立性

本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续与实际控制人及其控制的其他企业保持独立，公司各项经营活动（包括但不限于采购、销售、技术、商标等）对控股股东、实际控制人以及其他第三方不存在重大依赖。

为增强上市公司独立性，朱一明就本次交易出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

（三）上市公司最近两年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告

瑞华会计师为上市公司 2015 年和 2016 年财务报告分别出具了标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]01500512 号和瑞华审字[2017]01500195 号）。审计认为，上市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（四）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

公司确认，公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（五）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

1、上市公司发行股份所购买的资产权属清晰

详细情况请详见本章“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定”之“（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”。

2、上市公司发行股份所购买的资产为经营性资产

拟购买标的资产的主营业务为存储芯片及模拟芯片的研发设计、技术支持和销售，属于经营性资产。

3、上市公司发行股份所购买的资产能在约定期限内办理完毕权属转移手续

根据本章“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定”之“（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”得出的结论，“本次交易所涉及的资产权属清晰，就上海承裕、华创芯原以其所持标的公司股份向亦庄国投质押事宜，上海承裕、华创芯原已分别出具承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除标的公司股权相应质押，确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。亦庄国投亦出具《关于解除标的资产质押的说明与承诺函》，承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。在上海承裕、华创芯原及亦庄国投协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。”

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，交易双方已约定了办理北京矽成股权交割的条件及时限。

鉴于标的资产为股权且权属清晰，《发行股份及支付现金购买资产协议》已对标的资产过户作出明确约定，因此，在上海承裕、华创芯原及亦庄国投协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，标的资产能在约定期限内办理完毕权属

转移手续。

综上所述，上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在上海承裕、华创芯原及亦庄国投协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，资产过户或者转移不存在法律障碍，能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

三、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的情形：

- 1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 2、不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
- 3、不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
- 4、不存在上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；
- 5、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
- 6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；
- 7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定

《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100% 的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100% 的，一并由发行审核委员会予以审核。

本次交易上市公司募集配套资金不超过 183,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现

金增资入股标的资产部分对应的交易价格），将一并提交并购重组审核委员会审核。

第九章 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析

本次交易前，上市公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。上述产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

瑞华会计师对上市公司 2014 年、2015 年和 2016 年财务报表进行了审计，并出具了瑞华审字[2016]01500512 号和瑞华审字[2017]01500195 号标准无保留意见的《审计报告》。上市公司最近三年财务数据、经营指标如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	166,965.03	89,979.92	63,641.58
负债总额	39,052.64	32,916.56	21,641.56
归属上市公司股东所有者权益	127,853.57	57,127.89	41,986.71
资产负债率	23.39%	36.58%	34.01%
项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	148,894.82	118,878.02	94,672.32
营业利润	16,206.52	16,308.70	9,115.10
利润总额	18,576.65	18,124.48	11,294.98
归属母公司所有者的净利润	17,642.76	15,778.26	9,812.25
经营活动产生的现金流量净额	8,361.27	21,718.56	9,508.44
毛利率	26.72%	28.67%	25.22%
基本每股收益（元/股）	2.12	2.10	1.31

（一）本次交易前上市公司财务状况分析

1、资产结构分析

最近三年，上市公司合并报表口径的资产构成主要如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产：						
货币资金	87,155.92	52.20%	41,974.87	46.65%	26,181.68	41.14%
应收账款	10,314.48	6.18%	12,695.24	14.11%	10,480.68	16.47%
预付款项	254.36	0.15%	497.15	0.55%	430.87	0.68%
其他应收款	2,542.50	1.52%	894.97	0.99%	1,097.13	1.72%
存货	40,676.29	24.36%	21,976.43	24.42%	18,376.16	28.87%
一年内到期的非流动资产	424.08	0.25%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动资产	2,145.55	1.29%	1,794.09	1.99%	809.65	1.27%
流动资产合计	143,513.19	85.95%	79,832.75	88.72%	57,376.18	90.16%
非流动资产：						
可供出售金融资产	8,622.09	5.16%	2,408.24	2.68%	1,458.24	2.29%
长期股权投资	2,379.98	1.43%	-	-	-	-
固定资产	7,552.76	4.52%	4,698.08	5.22%	3,467.63	5.45%
在建工程	1,867.54	1.12%	32.37	0.04%	-	0.00%
无形资产	518.93	0.31%	-	0.00%	4.00	0.01%
商誉	383.00	0.23%	145.00	0.16%	-	0.00%
长期待摊费用	274.41	0.16%	987.97	1.10%	220.85	0.35%
递延所得税资产	1,553.12	0.93%	1,875.51	2.08%	1,114.69	1.75%
其他非流动资产	300.00	0.18%	-	-	-	-
非流动资产合计	23,451.84	14.05%	10,147.18	11.28%	6,265.40	9.84%
资产总计	166,965.03	100.00%	89,979.92	100.00%	63,641.58	100.00%

（1）资产结构总体分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司资产总额分别为 63,641.58 万元、89,979.92 万元和 166,965.03 万元，上市公司良好的盈利能力使得资产规模迅速扩张。上市公司资产主要由于货币资金、应收账款、存货和固定资产构成，2014 年末、2015 年末及 2016 年末，上述四项资产合计占资产总额的比重分别为 91.93%、90.40%和 87.26%。

从资产结构方面看，上市公司资产主要以流动资产为主，主要原因在于上市公司经营采用 Fabless 模式，无需大型生产设备及厂房的大额投入。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司流动资产金额分别为 57,376.18 万元、79,832.75 万元和 143,513.19 万元，占资产总额的比例分别为 90.16%、88.72%和 85.95%。

（2）流动资产结构分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司流动资产分别为 57,376.18 万元、79,832.75 万元和 143,513.19 万元。上市公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述三项资产账面价值合计占流动资产总额的比重分别为 95.93%、96.01%和 96.26%。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司货币资金的余额分别为 26,181.68 万元、41,974.87 万元和 87,155.92 万元。其中，2015 年末和 2016 年末，货币资金余额分别较上一期末增长 60.32%和 107.64%。2015 年末上市公司货币资金的增加主要来源于经营活动产生的净现金流入，2016 年末上市公司货币资金的增加主要来源于当期公司首次公开发行股票净融资 5.17 亿元。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司应收账款的余额分别为 10,480.68 万元、12,695.24 万元和 10,314.48 万元。2015 年末，发行人应收账款余额 12,695.24 万元，较 2014 年末增加 2,214.56 万元，主要原因为 2015 年末对 RDA TECHNOLOGIES LIMITED、MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD.、Samsung Electronics HK Co.Ltd 三家公司应收账款期末余额的增加所致。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司存货的余额分别为 18,376.16 万元、21,976.43 万元和 40,676.29 万元。2015 年末，公司存货较 2014 年末存货增加 3,600.27 万元，增幅为 19.59%，主要原因是公司销售规模较 2014 年有所增加，公司相应增加备货所致。2016 年末，公司存货较 2015 年末增加 18,699.86 万元，增幅为 85.09%，主要原因是公司新产品备货量增加所致。

（3）非流动资产结构分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司非流动资产分别为 6,265.40 万元、10,147.18 万元和 23,451.84 万元，逐年增长。上市公司非流动资产主要为固定资产、可供出售金融资产和递延所得税资产，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述三项资产账面价值合计占非流动资产总额的比重分别为 96.41%、88.52%和 75.59%。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司可供出售金融资产的余额分别为 1,458.24 万元、2,408.24 万元和 8,622.09 万元。2016 年末，上市公司可供出售

金融资产余额较 2015 年末增加 6,213.85 万元，增幅为 258.02%，主要原因是上市公司新增对 Everspin Technologies, Inc.、苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)等企业的投资所致。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司的固定资产金额分别为 3,467.63 万元、4,698.08 万元和 7,552.76 万元，在资产总额的占比较小，分别为 5.45%、5.22% 和 4.52%。主要是因为公司采用具有“轻资产”特点的 Fabless 运营模式，自身不直接从事产品的生产制造。公司的机器设备主要包括 MASK 和探针卡，主要放置在晶圆代工厂、晶圆测试厂。

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司的递延所得税资产分别为 1,114.69 万元、1,875.51 万元和 1,553.12 万元，占资产总额的比重分别为 1.75%、2.08% 和 0.93%。公司的递延所得税资产主要是因计提资产减值准备、固定资产折旧、抵销内部未实现利润、收到政府补助、可抵扣亏损等因素形成，在资产总额中占比较低，对公司财务状况影响较小。

2、负债结构分析

最近三年，上市公司合并报表口径的负债结构主要如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债						
应付账款	24,495.99	62.73%	17,767.21	53.98%	14,074.16	65.03%
预收款项	2,256.83	5.78%	1,286.60	3.91%	905.83	4.19%
应付职工薪酬	3,534.60	9.05%	3,459.45	10.51%	1,949.22	9.01%
应交税费	576.51	1.48%	1,609.20	4.89%	589.11	2.72%
其他应付款	749.79	1.92%	466.18	1.42%	522.90	2.42%
流动负债合计	31,613.72	80.95%	24,588.64	74.70%	18,041.22	83.36%
非流动负债						
递延所得税负债	27.49	0.07%	-	-	37.10	0.17%
递延收益	7,411.42	18.98%	8,327.92	25.30%	3,563.24	16.46%
非流动负债合计	7,438.92	19.05%	8,327.92	25.30%	3,600.34	16.64%
负债合计	39,052.64	100.00%	32,916.56	100.00%	21,641.56	100.00%

（1）负债总体结构分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司负债总额分别为 21,641.56 万元、32,916.56 万元和 39,052.64 万元，2015 年末较 2014 年末增加 11,275.00 万元，

增长 52.10%，主要原因系随着上市公司业务规模的扩大，公司原材料采购增加及委托加工增加导致期末应付账款余额增加，以及政府补助结转导致的递延收益增加所致。2016 年末较 2015 年末增加 6,136.08 万元，增长 18.64%，主要原因系上市公司业务规模扩大，销售增加导致原材料采购增加，从而引起的应付账款增加。同时，由于上市公司大部分客户采用预收货款的销售方式，销售增加也导致预收账款的增加。

从负债总体结构来看，上市公司负债结构稳定，主要为流动负债。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司流动负债分别为 18,041.22 万元、24,588.64 万元和 31,613.72 万元，占负债总额的比重分别为 83.36%、74.70%和 80.95%，报告期内保持相对稳定。

（2）流动负债结构分析

流动负债主要为应付账款、预收款项等，主要是公司采购原材料、委托加工形成的应付账款、销售产品形成的预收账款，与公司流动资产占比较高的资产结构相匹配。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述两项负债占流动负债的比重分别为 83.03%、77.49%和 84.62%。

2015 年末、2016 年末，上市公司应付账款余额分别比上年末增加 3,693.05 万元和 6,728.78 万元，主要是因为随着业务规模的扩大，公司原材料采购增加及委托加工增加导致应付账款期末余额增加。

2015 年末，上市公司应付职工薪酬余额较上年末增长较大，主要是期末计提的奖金尚未发放完毕所致。

2015 年末，上市公司应交税费较 2014 年末增长 1,020.09 万元，增幅为 173.16%，主要系随着公司利润的持续稳定增长，报告期内上市公司应交企业所得税亦大幅增加。2016 年末，上市公司应交税费较 2015 年末下降 1,032.69 万元，降幅为 64.17%，主要系 2016 年，上市公司申请为国家规划布局内的集成电路设计企业，计提企业所得税的税率由高新技术企业的 15%变为重点企业的 10%。

（3）非流动负债结构分析

上市公司非流动负债主要由递延收益组成，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，递延收益占非流动负债的比重分别为 98.97%、100.00%和 99.63%。递延收

益主要系上市公司所取得的与资产相关的政府补助，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

2015 年末，上市公司递延收益较 2014 年末增加 4,764.68 万元，增长 133.72%，主要系由于上市公司 2015 年新增“集成电路设计企业研发能力补助资金”政府补助 4,764.68 万元所致。

3、现金流量分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，上市公司经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,361.27	21,718.56	9,508.44
投资活动产生的现金流量净额	-16,121.44	-4,735.84	-2,336.31
筹资活动产生的现金流量净额	52,059.85	-1,450.08	-998.07
现金及现金等价物净增加额	45,181.06	15,793.19	6,276.91

上市公司经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金所收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。

2014 年度、2015 年度以及 2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,508.44 万元、21,718.56 万元和 8,361.27 万元。2016 年度，上市公司经营活动产生的现金流较上年减少 13,357.29 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金三项现金流出相比上年同期显著增加导致。

2014 年度、2015 年度以及 2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,336.31 万元、-4,735.84 万元和-16,121.44 万元。2015 年度，上市公司投资活动产生现金流出主要为随着公司业务扩张，对生产设备投资增加所致。2016 年度，上市公司投资活动产生现金流出显著增加，主要是理财投资增加导致现金流出较多。

2014 年度、2015 年度以及 2016 年度，上市公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-998.07 万元、-1,450.08 万元和 52,059.85 万元，2014 年度及 2015 年度

公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是报告期内公司分配股利产生的现金支出。2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长，系由当期公司首次公开发行股票净融资 5.17 亿元导致。

4、偿债能力分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司合并报表口径的公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率	4.54	3.25	3.18
速动比率	3.25	2.35	2.16
资产负债率（合并报表）	23.39%	36.58%	34.01%

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上市公司流动比率分别为 3.18、3.25 和 4.54，速动比率分别为 2.16、2.35 和 3.25，流动比率和速动比率稳定增加，上市公司的短期偿债能力较强；2014 年末、2015 年末和 2016 年末资产负债率（合并报表）分别为 34.01%、36.58%和 23.39%，上市公司负债水平较低，资产流动性较高，上市公司总体偿债能力较好。

（二）本次交易前经营成果分析

1、利润构成分析

2014 年、2015 年和 2016 年度，上市公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业总收入	148,894.82	118,878.02	94,672.32
营业收入	148,894.82	118,878.02	94,672.32
营业总成本	132,755.60	102,605.71	86,099.30
营业成本	109,109.04	84,800.27	70,800.04
营业税金及附加	554.34	404.62	218.01
销售费用	5,275.25	3,824.52	2,797.48
管理费用	18,826.42	14,163.05	11,805.15
财务费用	-2,463.84	-1,991.00	-214.77
资产减值损失	1,454.39	1,404.25	693.39
投资收益	67.30	36.38	542.08

营业利润	16,206.52	16,308.70	9,115.10
加：营业外收入	2,628.49	1,896.13	2,485.55
减：营业外支出	258.36	80.34	305.66
利润总额	18,576.65	18,124.48	11,294.98
减：所得税	1,106.82	2,527.40	1,469.74
净利润	17,469.83	15,597.09	9,825.25
减：少数股东损益	-172.93	-181.17	12.99
归属于母公司所有者的净利润	17,642.76	15,778.26	9,812.25

报告期内，上市公司的收入主要来源于主营业务收入。上市公司主营业务为闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，报告期内主要收入来源于存储芯片销售收入。

2014 年、2015 年和 2016 年度，上市公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 100.00%、99.97%和 99.99%；按产品大类分类，上市公司主营业务收入主要为存储芯片销售收入，占营业收入比重为 98.39%、89.29%和 86.77%。

上市公司最近三年营业收入按产品分类列示如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	148,882.97	99.99%	118,837.43	99.97%	94,672.32	100.00%
其中：存储芯片	129,188.64	86.77%	106,151.60	89.30%	93,148.68	98.39%
MCU	19,660.62	13.20%	12,667.79	10.66%	1,494.25	1.58%
技术服务及其他	33.70	0.02%	18.04	0.02%	29.39	0.03%
其他业务收入	11.85	0.01%	40.60	0.03%	-	-
营业收入	148,894.82	100.00%	118,878.02	100.00%	94,672.32	100.00%

2014 年度、2015 年度、2016 年度，上市公司实现营业收入分别为 94,672.32 万元、118,878.02 万元和 148,894.82 万元，分别实现营业利润 9,115.10 万元、16,308.70 万元和 16,206.52 万元，分别实现净利润 9,825.25 万元、15,597.09 万元和 17,469.83 万元。2016 年度，受益于公司存储芯片和 MCU 产品收入持续的高速增长，上市公司营业收入较 2015 年度增长 25.25%。同时，由于晶圆产品市场整体价格下降导致毛利率降低，上市公司营业利润较 2015 年度降低 0.63%，基

本保持稳定。

2、盈利指标分析

上市公司最近三年的盈利指标如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售毛利率	26.72%	28.67%	25.22%
销售净利率	11.73%	13.12%	10.38%
期间费用率	14.53%	13.46%	15.20%
加权平均净资产收益率	21.18%	31.92%	25.78%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	18.13%	28.68%	19.69%
基本每股收益（元/股）	2.12	2.10	1.31
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	1.81	1.89	1.00

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，上市公司各项盈利指标保持稳定，盈利能力较好，盈利主要来源于公司主营业务，非经常性损益以计入当期损益的政府补助为主，并不构成公司盈利的主要来源。

二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）行业整体发展情况

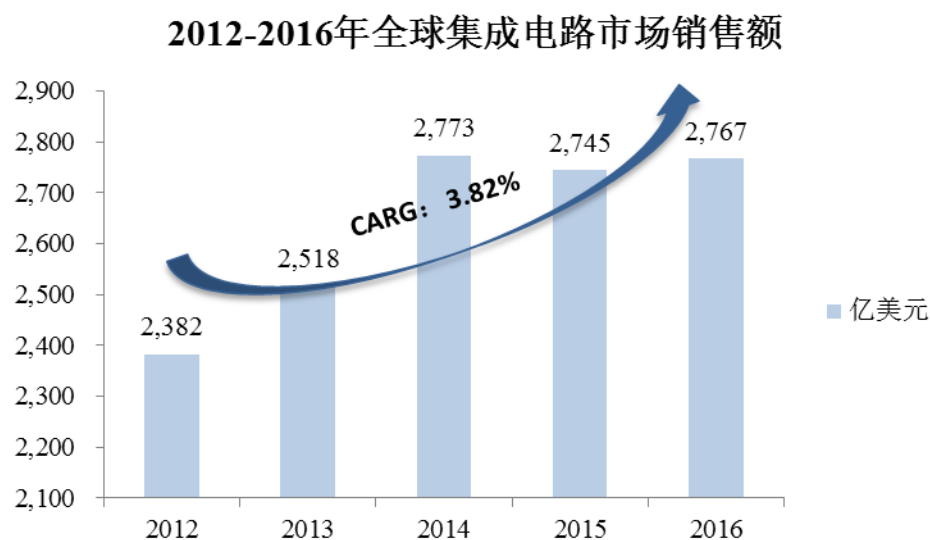
1、集成电路产业现状及趋势

集成电路是一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的电路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路具有高度集成化、低功耗和高可靠性等优点，同时其成本较低，便于大规模生产，在电子设备领域得到广泛应用。集成电路产业是促进经济发展的关键基础产业，是世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的产业之一。

（1）全球集成电路行业发展现状及趋势

全球集成电路行业在过去三十年的时间内，在以美国和欧洲为首的西方发达国家带领下经历了从无到有的进步。其后以日本、韩国、中国台湾为代表的新势力的崛起，为全球集成电路经营模式带来的革新，晶圆代工厂以及纯 Fabless 的

设计厂商的出现在全球集成电路的生产产能、生产工艺以及技术路径上都带来了前所未有的快速提升。之后在面对全球消费电子，包括计算机、便携式电脑、智能手机、智能手表等应用产品的发展和普及浪潮下，集成电路产业逐渐成为全球经济发展的支柱型产业之一。根据 Wind 资讯的历史数据显示，全球集成电路市场规模从 2012 年至 2016 年的年化复合增长率为 3.82%，其中 2016 年销售额为 2,767 亿美元，同比上涨 0.80%，出现上升趋势的主要原因是模拟电路 2016 年销售量同比上升了 5.80% 和逻辑电路 2016 年销售量实现回暖，扭转了 2015 年的下降趋势，同比上升了 0.80%。其中区域市场两极分化，欧美地区呈下滑态势，而亚洲地区呈增长态势。



数据来源：Wind 资讯

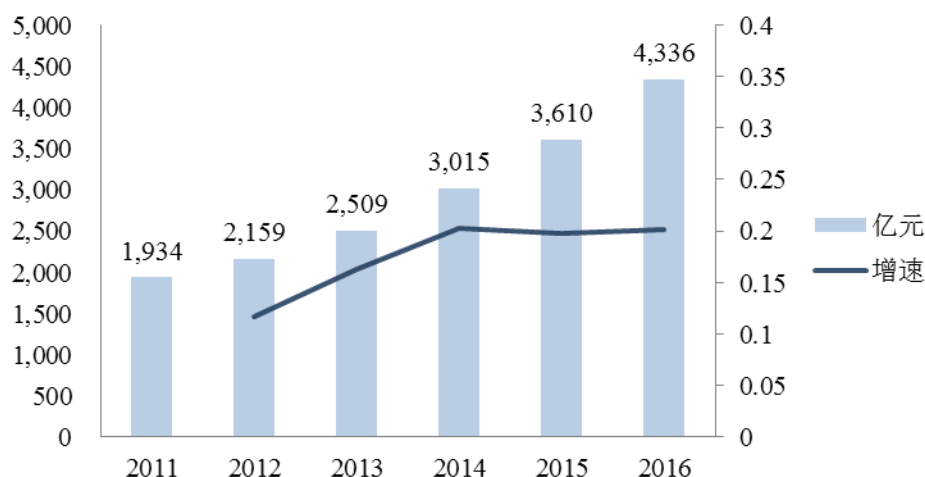
集成电路市场作为半导体市场的主要构成，占到了 2016 年世界半导体产业 3,389 亿美元销售额中的 81.64% 的比重。可见，集成电路产业作为新兴产业具有极强渗透力和旺盛生命力，在现代基础行业中例如通信、消费类电子、工业仪器和国防等领域具有较为广泛的应用，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

（2）我国集成电路产业发展现状及趋势

集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当

前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

2011-2016年我国集成电路销售规模



数据来源：中国半导体行业协会

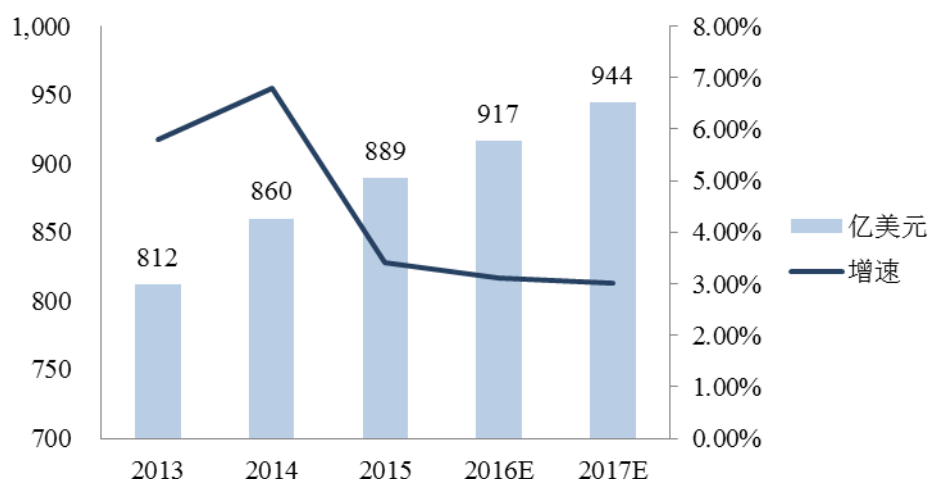
近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2016 年规模达到 4,335.50 亿元人民币，受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及外资企业加大在华投资影响，过去三年行业销售规模增速为 20.10%、19.72%、20.20%，行业市场增速明显高于全球水平。

2、集成电路设计行业现状及趋势

（1）全球集成电路设计行业发展现状及趋势

集成电路行业包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装业、集成电路测试业、集成电路加工设备制造业等子行业。集成电路设计行业作为集成电路行业的子行业，处于产业链的上游，主要根据终端市场的客户需求，设计开发各类芯片产品，对于下游应用市场有着密切的依赖关系，近年来来自于汽车电子、工业控制、医疗电子、移动通讯、消费电子、移动互联网、显示照明等市场发展有力促进了集成电路设计行业的快速发展。

2013-2017E全球集成电路设计行业销售规模



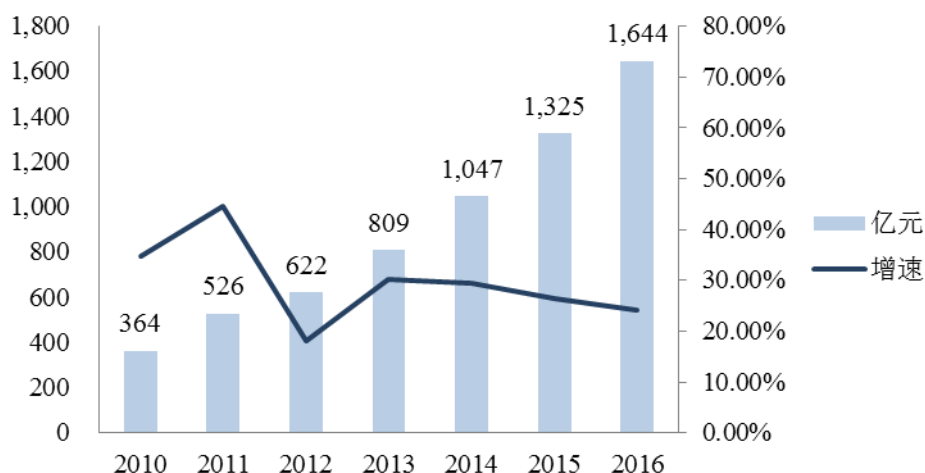
数据来源：中国产业信息网

集成电路设计行业兼具资金密集型和技术密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求，因此也带来了作为集成电路子行业中毛利率水平相对较高的特征，也保障了行业持续不断的增长。根据中国产业信息网的整理数据，2016 年全球集成电路设计行业市场预测规模将达到 916.80 亿美元，同比增长达 3.10%，2013 至 2016 年的行业复合年增长率预计将为 4.13%。

（2）我国集成电路设计行业发展现状及趋势

经过十年“创芯”发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为主体，制造业为重点的产业格局。虽然我国集成电路设计行业的起步较晚，但发展速度较快，根据中国半导体行业协会的数据，我国集成电路设计企业销售规模在 2014 至 2016 年分别为 1,047、1,325、1,644 亿元人民币，同比增速达到 29.50%、26.50%、24.10%，远高于全球行业平均水平。

2010-2016我国集成电路设计企业销售额



数据来源：中国半导体行业协会

在全球经济持续低迷，国际市场需求增速逐渐放缓的背景下，我国集成电路设计行业实现高速增长主要来自于以下三大因素：

1) 中国市场作为近年来提供全球集成电路行业需求的主要市场之一，在个人电脑、智能手机、平板电脑等市场为行业提供了爆发式的需求增长。未来在可穿戴设备、智能家居等消费电子领域，将更加显现我国集成电路市场的内生增长动力。

2) 我国作为劳动力市场的输出国，在基本劳动力上具有相对其他地区的天然优势。集成电路设计行业作为人力和技术的密集型行业，伴随着我国设计行业市场规模的逐渐扩大，对研发人员的需求也逐年提升，而我国拥有大量且具备专业素质的基层设计人员，为企业带来劳动力成本的优势，提供了强而有力的行业竞争力。

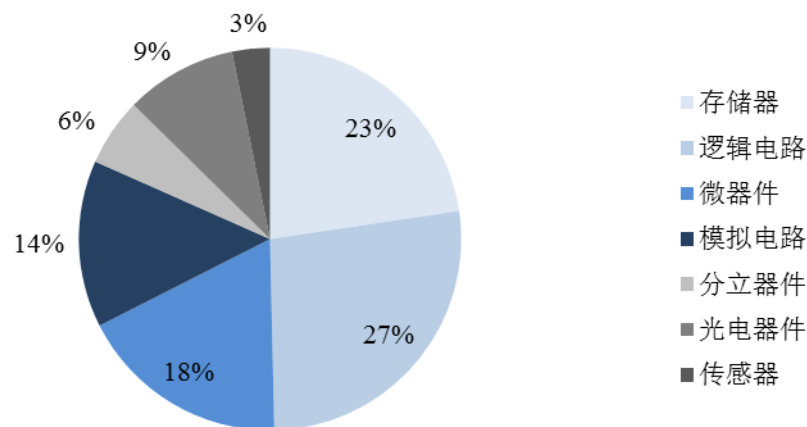
3) 基于潜力巨大的我国集成电路消费市场空间，以及诱人的制造及劳动力成本优势，越来越多的全球集成电路厂商开始在国内投资设厂。同时来自于我国政府对于集成电路产业的大力支持，优质的本土半导体企业也逐步形成规模，参与全球市场竞争，进一步促成全球集成电路产业中心开始逐渐向我国转移的趋势。

3、集成电路存储芯片行业现状及趋势

(1) 集成电路存储芯片的产业地位

通俗而言，在计算设备的运算过程中，原始数据的输入、计算设备运算过程中的中间结果以及最终运行结果都会经过计算设备中的存储器并在一定期限内保留其中，所以集成电路存储芯片作为保存信息的记忆设备是现代信息技术发展的核心部件之一。

2016年半导体产业产品结构图



数据来源：WSTS

根据 WSTS 的统计显示，2016 年全球半导体市场规模近 3,389 亿美元中，其中 767.67 亿美元来自于集成电路存储芯片的销售，占全年市场 22.65% 的份额。可见集成电路存储芯片作为逻辑电路、模拟电路、存储芯片、微器件全球四大集成电路产品之一，有着重要的产业地位，同时伴随着未来移动互联网、大数据等新兴产业的进一步发展，集成电路存储器芯片对于现代化信息通讯以及信息安全等领域有着至关重要的作用。

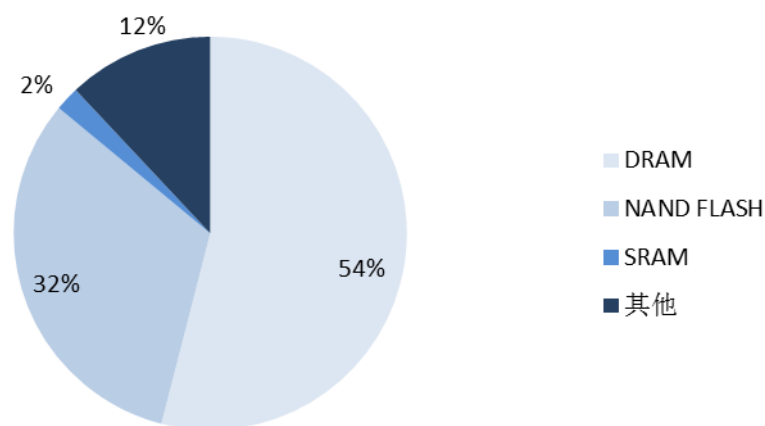
（2）集成电路存储行业的产品情况

集成电路存储芯片的种类繁多，不同技术原理下催生出不同的产品，具有各自的优缺点和适用领域。若按照信息保存的角度来分类，可以分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片，易失性存储芯片在所在电路断电后，将无法保存数据，代表性产品有 DRAM 和 SRAM，非易失性存储芯片在所在电路断电后，仍保有数据，代表性产品为 NAND FLASH 和 NOR FLASH。

DRAM 作为具有高容量、大带宽、低功耗、短延时、低成本等特征，是主要用于个人电脑、服务器、手机等设备的最为常见的系统内存。而 FLASH 具有

寿命长、体积小、功耗低、非易失性等特点和优势，广泛应用于消费电子、移动通信、网络通信、个人电脑、服务器等领域，主要用于代码存储和数据存储等，是近年来发展较快的存储器芯片产品。由于 SRAM 芯片采用不同的设计结构，带来了 DRAM 产品所不具备的更快的读写速度和更低的功耗水平的优点，但电路结构的差异也造成了相同容量的 SRAM 的成本高于 DRAM，通常情况下只会使用在 CPU 的一、二级缓存等对存储速度要求严格的地方。

全球集成电路存储芯片产业构成

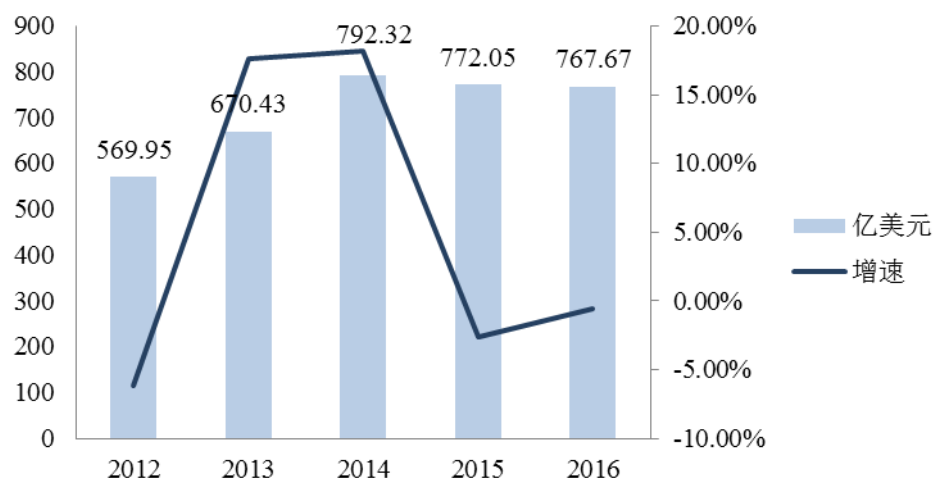


数据来源：Gartner

从各类存储芯片的性能、特征、成本和适用性考虑，其中能够被广泛运用的产品所具有的市场规模相对较大，目前市场上主流的存储芯片主要为 DRAM 和 NAND FLASH 类产品，参考 Gartner 的行业历史数据，DRAM 和 NAND FLASH 两种类型产品占到了集成电路存储芯片产业的八成以上，并且该市场情况一直延续至今。

全球存储芯片市场在经历了 2013 年和 2014 年连续两年 15% 以上的增长之后，2015 年陷入困境，主要原因来自于个人电脑细分市场的低迷导致存储芯片产品库存过多，2015 年下半年存储芯片市场出现较大降幅，市场颓势延续至 2016 年上半年。2016 年下半年，在中国智能手机出货顺畅以及全球个人电脑出货回暖的带动下，存储芯片价格开始回升，该趋势一直持续至 2017 年第一季度。根据 WSTS 的数据，2016 年全球集成电路存储芯片市场销售额为 767.67 亿美元，同比微降 0.60%，整体市场开始呈现复苏趋势。

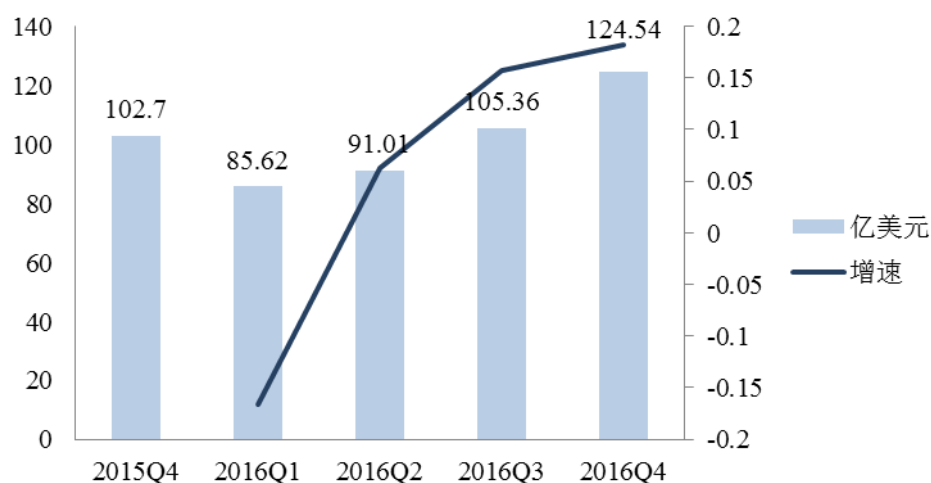
2012-2016年全球集成电路存储芯片销售情况



数据来源：WSTS

以 DRAM 芯片市场为例，根据 IC Insights 数据显示，2016 上半年全球 DRAM 芯片市场持续供过于求态势，且平均单价继续保持低位，虽然二季度来自于美光 20 纳米及 SK 海力士 21 纳米的顺利量产带动了单位供给增长，但前两季度 DRAM 市场销售额仍处于历史低位，分别为 85.62 和 91.01 亿美元，同比下跌 16.63% 和增长 6.30%。2016 年下半年全球 DRAM 芯片市场呈现强力反弹，主要受惠于传统旺季下全球智能手机的强劲需求及个人电脑产品出货量回暖，其中国产手机的旺盛需求带来显著正面影响，此外来自于供给端的产能减少带动了 DRAM 芯片产品单价的快速回升，DRAM 芯片价格出现全面上涨，三、四季度 DRAM 市场销售额分别为 105.36 和 124.54 亿美元，同比增长 15.77% 和 18.20%。

2015Q4-2016Q4全球DRAM芯片销售情况



数据来源：IC Insights

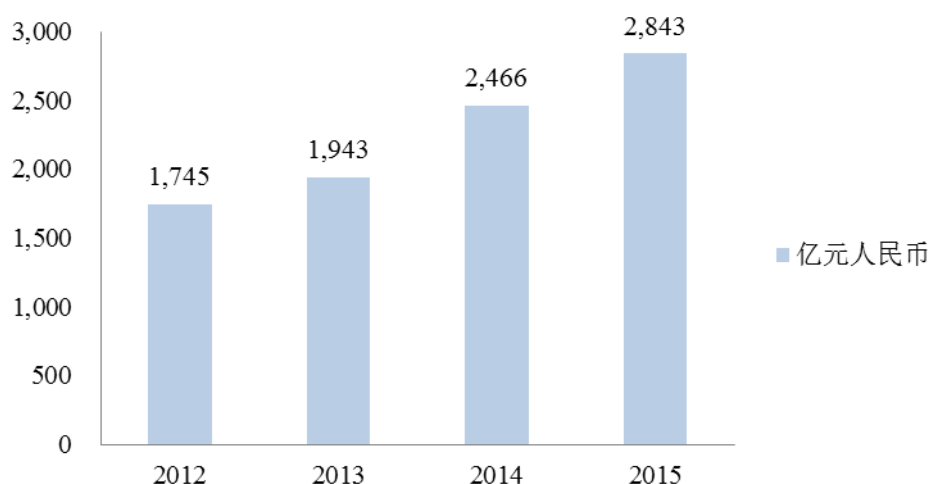
目前来看，全球主要 DRAM 生产商均无增产计划，仅凭借制程微缩来增加微弱产能，同时由于存在部分厂商将产能逐步转移至生产 3D NAND FLASH 的现象，造成 DRAM 市场供给维持短缺态势，预计 2017 年集成电路存储芯片市场将延续供不应求和单价上涨的趋势。

（3）我国集成电路存储芯片产业情况

1) 我国集成电路高端芯片基本依赖进口，存储芯片存量需求巨大

我国作为全球最大的集成电路市场和消费国，在高端微芯片、大容量存储芯片、通信芯片、模拟电路等方面基本依靠进口，根据海关总署数据显示，我国进口集成电路金额在 2014-2016 年分比为近 2,176.16、2,299.28、2,270.26 亿美元，常年保持较高的进口金额水平。

2012-2015年中国集成电路存储芯片市场规模



数据来源：中国产业信息网

同时，我国作为全球消费电子产品的加工制造基地，对于集成电路存储芯片的需求量巨大，根据中国产业信息网数据显示，2015 年我国集成电路存储芯片市场规模为 2,842.70 亿元人民币，同比增长 15.30%，其中对 DRAM 的采购规模约为 120 亿美元，对 NAND FLASH 的采购规模约为 66.70 亿美元，占到全球当期 DRAM 和 NAND FLASH 供货量近 21.60%和 29.10%。我国集成电路存储芯片市场需求的快速增长主要受到了来自于个人电脑、智能手机等消费电子市场的带动，同时由于高端存储芯片产能目前我国仍为空白，基本需要依赖进口产能，

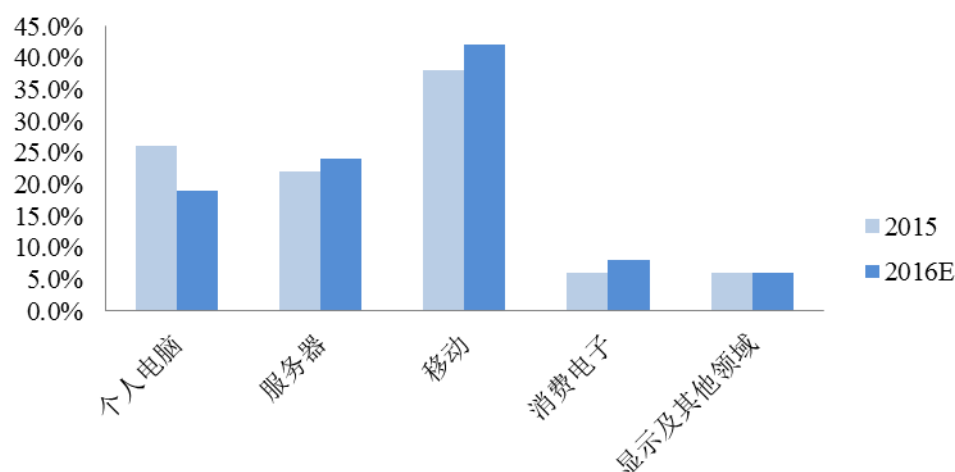
以此带来未来国产芯片代替进口芯片的巨大存量市场。

2) 通用领域市场竞争激烈，专用领域具备切入契机

集成电路存储芯片按照应用领域分类可以大致分为通用领域和专用领域。其中通用领域具有普及度高、差异化小的特征，例如个人电脑、智能手机、服务器等终端应用领域，所对应的存储芯片产品具有适合规模生产，毛利水平适中的特点，通常也被称为标准型产品。专用领域指产品具有较强差异化，不适用于大批量标准化生产制造，例如汽车电子（如汽车发动机控制、汽车传动系统等）、工业控制（如数控机床等）、网络通信（如通讯基站等）终端应用领域，所对应存储芯片产品大多需要经过客户和芯片设计厂商做定制化设计，往往拥有较标准型产品而言更高的毛利率水平，此类产品也被称为利基型产品。

目前市场中大部分集成电路半导体芯片属于标准型产品。以市场上主流存储芯片 DRAM 为例，根据 Gartner 数据统计，伴随全球个人电脑出货量的持续萎缩，DRAM 芯片对应市场近年来已逐步向智能手机、服务器及其他类别市场转移，2015 年全球 DRAM 市场近九成用于通用领域。而其他领域市场例如专用领域市场占 DRAM 整体应用市场比例仍旧较低，属于存储芯片市场中的小众市场。

2015-2016E年全球内存供给端市场



数据来源：Gartner

集中性强、垄断度高是全球集成电路存储芯片市场的主要特征。从产业的兴起至今二十多年中，激烈的竞争导致行业内厂商的数量逐年减少，从最初的三、四十家企业到如今行业中不超过十家的主要企业，市场份额逐步被行业少数企业

占据。以具有代表性的 DRAM 和 FLASH 产品为例，两者全球市场基本被行业前三大公司占据，截止至 2016 年全年，DRAM 全球市场的 92.55% 份额由三星、海力士和美光三家龙头公司占据；而 92.16% 的 NAND FLASH 市场由三星、东芝、闪迪、美光和海力士包揽。由于三星、海力士、美光等龙头均采用 IDM 经营模式的半导体企业，需要对资本密集型的存储芯片设计团队和生产制造产线进行每年巨量的资金投入，所以对存储芯片产品标准化之后带来的成规模利润有着较高的要求，也导致了巨头们容易忽视份额相对较小、定制化设计成本相对较高的专用领域市场。而这对于采用 Fabless 经营模式的存储芯片设计厂商是最为合适的市场机遇，且对于目前处于空白期的我国高端存储芯片产业，也提供了顺势切入行业的契机，借此引进重要人才，积累核心行业技术，加快我国在集成电路存储芯片领域的布局。

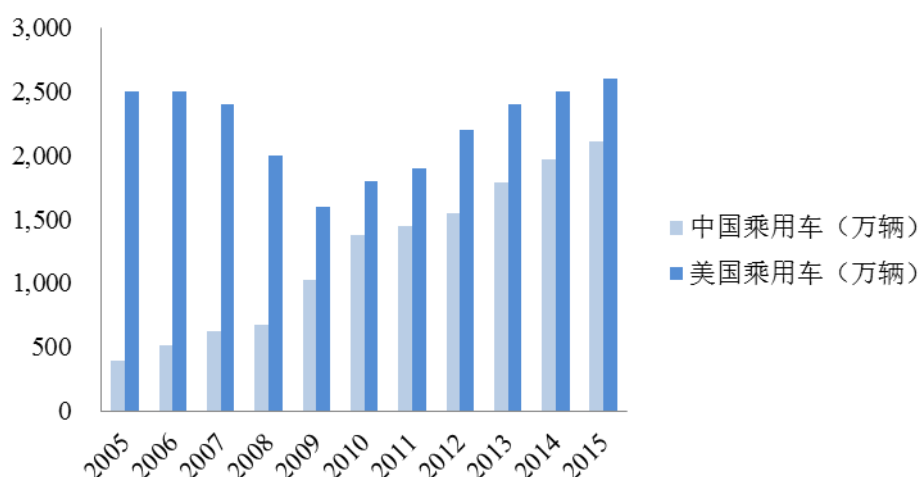
4、汽车电子行业现状及趋势

作为近年来行业增速逐年增长的半导体专用领域行业之一，全球汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。目前美国、欧洲和日本是全球汽车电子的主要市场。汽车电子的发展及大规模应用始于 1970 年，自那以后每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子的发展与应用，40 多年来随着人们对安全性、舒适性、经济性、稳定性、娱乐性等要求的提高，汽车在不断的朝着互联网化、智能化和新能源化发展，因此汽车电子在汽车整车成本中占比越来越高。

（1）全球汽车市场增长重心向亚洲地区转移

作为全球最大的汽车市场，美国的乘用车市场近十年来一直保持较为稳定的规模上限，而此时的中国乘用车市场，受到国内产业升级，消费升级双轮驱动刺激，表现出快速增长的趋势。根据 Wind 资讯数据显示，从 2005 年至 2015 年，美国乘用车市场年均销售量为 2,218 万辆，中国乘用车市场从每年的 397 万辆飞速增长至每年 2,111 万辆，年复合增长率高达 18.19%。随着我国人均消费水品的提升，以及国有乘用车品牌中越来越多中档消费定位的自主研发车型陆续发布，国内乘用车市场规模将得到进一步扩大。对于中美乘用车出货量的趋势对比一定程度上表明全球汽车制造业的重心已经向亚洲地区转移。

2005-2015年中国和美国乘用车出货量情况

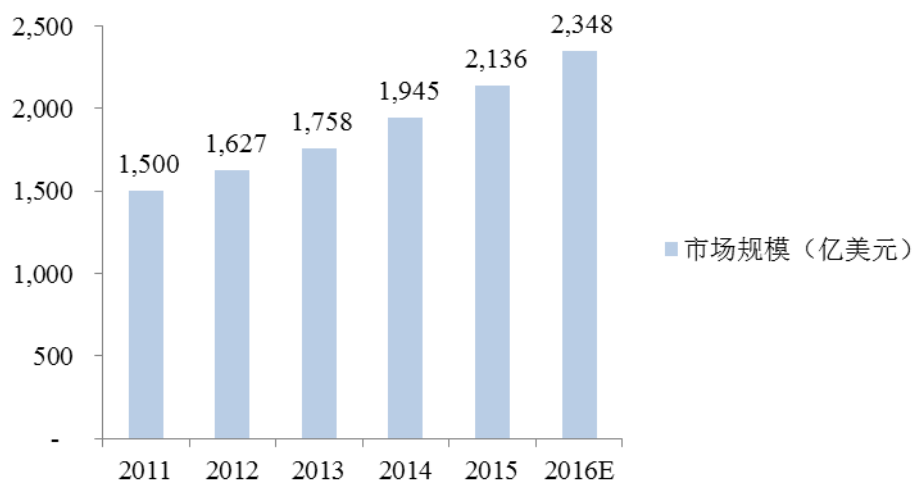


数据来源：Wind 资讯

（2）全球汽车电子市场保持快速增长

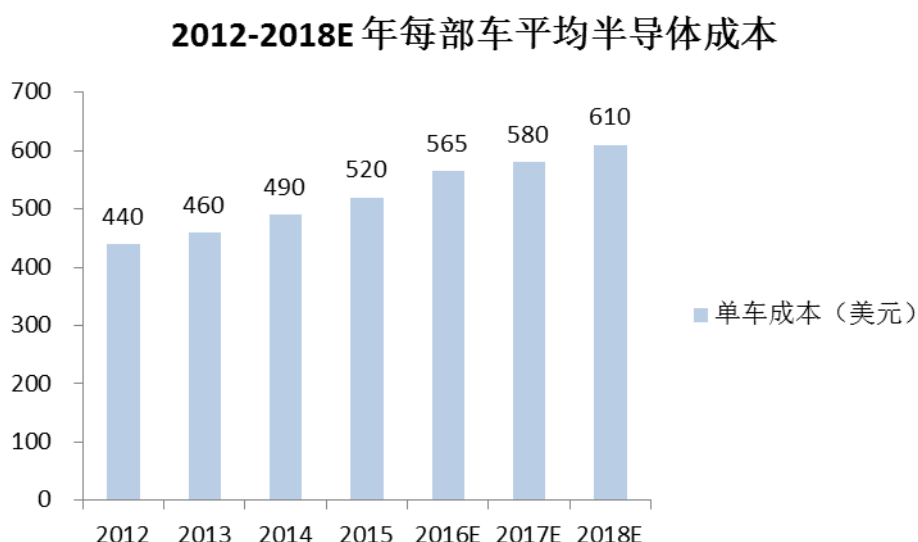
根据《中国汽车电子行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告》，2015年全球汽车电子市场规模约为 2,136 亿美元，预计 2016 年全球汽车电子市场规模将达到近 2,348 亿美元，2011 年至 2016 年的年化复合增长率可达 9.76%，汽车电子市场快速的增长趋势不仅受益于中国汽车行业近十年来的快速发展，同时也受到了现代消费者对汽车智能化和电子化更大的需求影响。观察近年来各大车厂陆续推出的新款车型，从更高分辨率的车载显示、触控化的汽车中控操作系统、更完善的汽车联网通讯系统和更智能的汽车驾驶辅助系统等，无一不呈现出传统汽车正快速向智能化和电子化的新时代产品定位方向转变的趋势。

全球汽车电子行业规模预测



数据来源：中国产业信息网

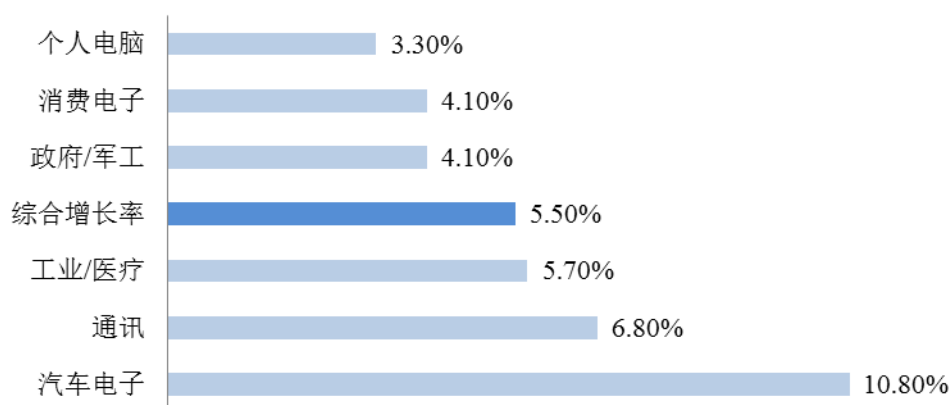
汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施，汽车电子已经成为汽车控制系统中最为重要的支撑基础。根据 IC Insights 研究数据显示，在安全、节能、联网和娱乐四大发展趋势的驱动下，汽车电子化程度将愈来愈高，平均每部汽车的半导体成本预估将由 2012 年的 440 美元左右，攀升至 2018 年的 610 美元左右，单车半导体价值增长迅速。在汽车销量的持续增长，以及单车半导体占汽车总成本比重逐年提升的两大趋势叠加下，汽车电子市场规模的持续扩大。将成为消费电子市场之后，下一轮集成电路市场的新机遇。



数据来源：IC Insights

同样根据 IC insights 研究数据的预测，全球集成电路市场规模在 2013 年至 2018 年年化复合增长率预计为 5.50%，细分终端市场中汽车电子市场复合增长率预计为 10.80%，远高于整体集成电路市场的平均增速。同时汽车电子也将是未来集成电路终端市场六大板块中增速最高的市场，成为全球集成电路市场发展的创新点和重要增长点。综合而言，汽车电子作为主导未来汽车技术发展方向和行业前进步伐的关键因素，是汽车产业创新的核心竞争力之一。

2013-2018年全球集成电路终端市场年化复合增速情况

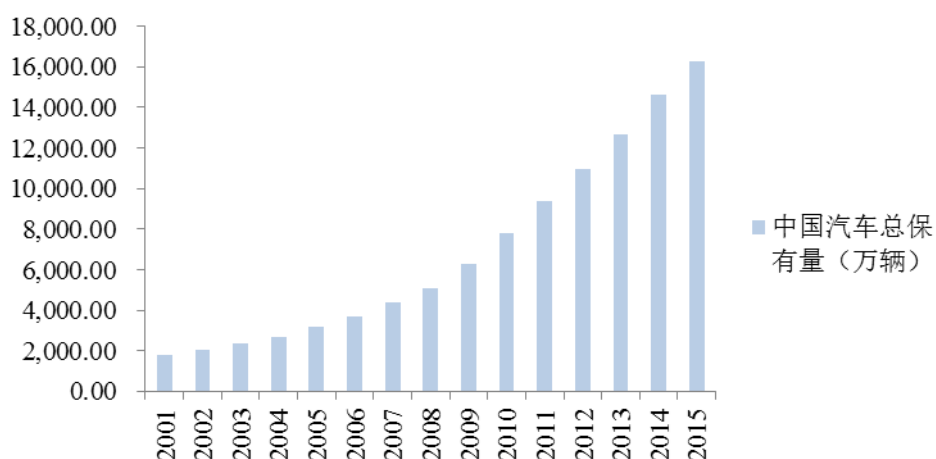


数据来源：IC insights

（3）我国汽车行业发展及汽车电子行业渗透率

自加入世贸组织以来，我国经济的增长得到迅速的提升，受益于此，国内汽车产业的成长也迎来了大好机遇，汽车整体销量持续上升。根据 Wind 资讯数据显示，我国汽车总保有量在过去十五年间爆发式增长，从 2001 年的 1,802.04 万辆汽车保有量迅速提升至 2015 年的 16,284.45 万辆，15 年间年化复合增长率达到 17.03%。虽然以我国现有的汽车保有量基数看，消费者购置新车需求的增速在未来有面临变缓的可能，但除了购置新车需求外，对于目前巨量汽车保有量下新、老汽车的替换需求也是不小的数量，因此未来中国市场的汽车出货量仍将保持较高水平。

2001-2015年中国汽车总保有量情况

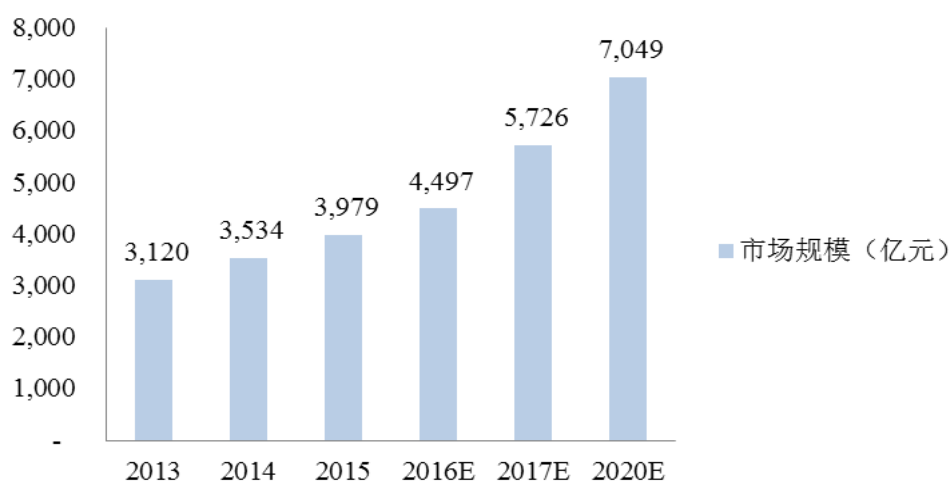


数据来源：Wind 资讯

目前汽车产业正经历一轮深刻的变革，伴随着人们对汽车的安全性、舒适性、便利性以及智能化的要求日益提高，对于汽车的使用定义正逐渐向安全、节能、联网及娱乐等各细分方向延伸，汽车技术的发展和产品性能的提升也被提到了重要的位置。近年来逐步被提出的汽车智能化概念深得消费者及各大车厂支持，具备高级汽车驾驶辅助系统（ADAS）、无人驾驶（UA）、车联网（V2X）、新能源动力等功能和技术的新款车型将正逐步迈入成熟的民用商业化阶段。汽车智能化的趋势使汽车电子市场的增长不再仅仅依赖于汽车销量的增涨，同样也受到单车中车规型集成电路产品搭载数量提升的影响。根据中投顾问产业研究中心的数据，2020 年汽车电子在整车中的成本将达到约 50%，而目前汽车电子的渗透率仅约为 30%，具有较大的增长空间。

根据《2016-2022 年中国智能驾驶市场运行态势及投资战略研究报告》的数据显示，2015 年我国汽车电子市场规模为 3,979 亿元，2016 年市场规模预计 4,497 亿元，2013 年至 2016 年复合增长率达到 12.96%，我国汽车电子市场近年来呈高速发展。未来随着契合电子技术的发展及推广，汽车电子技术将更易于与行驶系统、控制系统等汽车子系统之间的向下兼容，这也为汽车电子部件在整车中的占比提升带来了有力的基础条件。在汽车制造厂商为迎合消费者对汽车安全性、舒适性、便利性以及智能化需求的同时，行业对汽车的重新定义，一同推动着新款汽车中电子产品的渗透率，预计到 2020 年，我国汽车电子市场规模将攀至 7,049 亿元人民币，较 2016 年的预计市场规模增长 56.75%。

中国汽车电子市场规模预测



数据来源：《2016-2022 年中国智能驾驶市场运行态势及投资战略研究报告》

目前我国的汽车电子行业发展时间较欧美日韩成熟市场相对较短，大部分国产品牌尚处于技术和客户的积累阶段，在未来的汽车市场占有率上具有较大的增长潜力，同时伴随未来国有自主品牌整车厂的蓬勃发展以及新能源汽车的大规模普及，我国的汽车电子市场将得到进一步提升的空间。

（二）行业进入壁垒

1、技术壁垒

集成电路行业属于技术密集型行业，集成电路的制程进步遵循摩尔定律，即每一至两年伴随集成电路的工艺进步，集成电路产品在计算能力上将得到一倍的提升，在制造生产上将获得减半的成本。对于集成电路设计企业而言，需要紧跟工艺的进步以及生产技术的发展，以保持自身在行业进步中在市场上的竞争优势。随着集成电技术的迭代发展，电路结构越来越复杂，加工步骤也越来越繁多，集成电路设计中部分企业逐渐创新出自身的差异化产品，形成自主核心技术，构筑起同行难以仿效的技术壁垒。

2、资金和规模壁垒

集成电路存储行业一直以来都是资金密集型行业，无论是在产品的设计研发或是制造生产环节，大量的研发投入或是制造生产线的投入对于资金的规模都有很高的要求。在集成电路存储芯片设计行业，来自于存储芯片产品的更新换代，要求在制程的研发、规格的升级上也必须快速跟上市场要求，以此带来设计厂商持续的研发投入，一旦研发费用不足而使研发进展放缓，很可能使设计厂商失去技术和成本上的优势。集成电路制造厂商亦是如此，对于持续采购大额的先进设备以及对于生产先的技术升级所需要的巨额资金往往比设计厂商的研发投入规模要求更高，以此才能保持制造厂商在生产规模及成本上的优势。通过过去二、三十年来存储领域的发展和积累，巨额资金的投入构成的技术及规模壁垒对于足以将行业新进入者拒之门外。

3、人才壁垒

集成电路行业属于知识密集型行业，领先的技术创新人才和经验丰富的管理人才对于企业未来的发展和市场竞争力的提高具有重要的推动作用。集成电路设

计行业在所有集成电路子行业中，对于人才的要求和依赖程度最高，作为以 Fabless 模式经营的轻资产行业，人员稳定、高效而富有经验的团队是企业的核心竞争力之一。我国集成电路存储领域的高端技术人才相较于美国、韩国和台外地区而言相对稀缺，优秀的管理人才和技术人才多集中于行业龙头企业。因此，对于市场的新进入者，人才的引进和激励管理是非常重要的战略工作。

4、资质壁垒

对于专用领域的集成电路产品设计通常具有较高的资质壁垒，其产品和解决方案在进入市场前需要获得客户所在国家或地区的相关行业资质认定。例如，作为汽车电子行业的资质认证，常规的 ISO900x 认证不可或缺，同时还需满足 TS1696 等符合车用规格的产品标准。资质的认证对于集成电路企业打入国际专用领域市场形成了较为关键的壁垒。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）集成电路设计产业中心逐步向亚洲尤其是中国转移

近年来全球集成电路市场随着个人电脑、智能手机、平板电脑等消费电子的广泛普及迎来了不错的增长，其中来自中国市场的大量需求提供了不少贡献。同时亚洲作为劳动力市场的输出地区，在基本劳动力上具有相对其他地区的成本上的优势，这是拥有人力和技术的密集型行业特征的集成电路设计产业所追逐的核心利益之一。根据中国半导体行业协会数据显示，2010-2016 年，中国地区集成电路设计产业规模年化复合增长率为 28.58%，大幅超过全球集成电路设计产业规模 7.10% 的年化复合增长率。随着集成电路设计产业中心逐步向亚洲转移的趋势下，中国作为市场需求和大量劳动力的供应地区，无疑将会收获最大的收益。

（2）存储芯片进口替代空间巨大

2016 年我国集成电路芯片产业进口规模为 2,270 亿美元，超过了商品原油的 1,165 亿美元，其中集成电路存储芯片的进口规模达到约 680 亿美元。目前我国集成电路芯片产业 90% 以上仍依赖进口，其中存储芯片的比重排名第一，超过了 CPU、模拟芯片等。在易失性存储领域，DRAM、SRAM 芯片的进口依赖度几乎为 100%，我国集成电路产业在该领域的研究积累几乎为空白，存在巨大的

进口替代空间。不同于其他发达国家，受益于全球集成电路产业链逐渐向亚洲转移的趋势，我国巨大的电子终端生产和消费市场，将为国内存储芯片市场创造快速发展的机遇。根据中国产业信息网的统计，我国集成电路存储芯片市场在 2012-2015 年中的年化复合增长率已达到 17.66%，属于行业较高增长地区。随着未来物联网应用的普及，数据流量将迎来几何级数成长，这对于存储芯片在技术、容量、性能、稳定性、价格方面有更高要求，同时作为保持高增速的重要集成电路子市场，国产存储芯片的进口代替战略势在必行，且空间巨大。

（3）集成电路存储芯片专用领域具备切入契机

作为集成电路存储芯片领域的三大龙头企业，三星、海力士、美光等均采用 IDM 的经营模式。为应对摩尔定律下技术的迭代更新，在 IDM 模式中从生产制造到产品研发全链条都需要付出相应投入，往往资本开支总和非常高，导致企业需要依靠较高的出货量才能覆盖生产成本和各类费用，外加伴随行业周期中低迷期带来的亏损风险，大型 IDM 厂商的持续生存能力一直受到挑战。为了保障持续的经营能力和可观的利润规模，行业龙头们一致瞄准具有大规模出货潜力、生产及设计流程较为标准化的标准型存储芯片产品，在通用领域市场争抢份额。这也导致了龙头厂商们容易忽视份额相对较小、定制化设计成本相对较高的专用领域市场。而这对于采用 Fabless 经营模式的存储芯片设计厂商带来良好的契机，顺势切入竞争环境并没有那么激烈的专用领域市场，以此获得研发技术的积累和追赶行业龙头们的窗口期。

（4）国家产业政策大力扶持

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一，我国政府也已通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，已陆续颁布了一系列法律法规及政策，拟从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业企业的发展。2015 年颁布的《中国制造 2025》中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点照顾的领域，而存储芯片产品作为目前进口消费比重最高的领域无疑将过得更大的产业政策支持。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业竞争激烈，国内集成电路存储设计领域基础薄弱

集成电路行业在我国竞争非常激烈，其市场主要由国际技术领先、资本雄厚、经营灵活的国际企业占据。尽管国内企业在集成电路设计领域取得了一定进步，但技术水平与产业规模都与国际企业有较大差距，基础仍较为薄弱。

（2）设计人才匮乏，研发投入巨大

集成电路的发展遵循摩尔定律，因此持续的研发投入是保证企业竞争性的前提和基础。同时，高性能、高可靠性的集成电路产品设计也需要大量高端人才，目前从事集成电路设计的人才无论是从数量或者经验的角度与国际高端技术人才对比，都还有一定的差距。

（四）区域性、周期性和季节性特征

1、区域性

集成电路存储产业具有明显的区域性特征，行业主要的三大龙头企业分别为三星、海力士、美光，均采用从设计到制造生产的完整产业链 IDM 经营模式。从全球角度来看，美国和韩国是集成电路存储产业主要产能的贡献地区，日本地区拥有部分 FALSH 的先进产能，台湾地区厂商，例如南茂、力晶、华邦电子等 DRAM 纯晶圆代工厂，对于全球存储产业影响力稍弱。从我国角度来看，我国集成电路企业主要集中于长三角、珠三角等地区，具有明显的辐射和带动效应。这些地区具有发达的物流网、宽松的政府政策和充足的人才储备等优势。在集成电路存储领域的的积累较为空缺，同美国、韩国和日本存在技术上的较大差距，是未来我国集成电路产业战略中重点发展领域。

2、周期性

集成电路存储产业具有明显的周期性特征。存储市场的发展趋势和宏观经济运行周期存在一定相似性，即宏观经济发展较好时，终端客户对产品的需求增加。而宏观经济放缓时，终端客户需求的减弱也会减少对集成电路产品的需求。其中通用领域存储市场的周期性更为明显，其波动性远高于集成电路产业平均水平。纵观集成电路产业历史，行业拐点时大概率受到以下几种情况影响：一是行业迎

来制程技术的升级，致使集成电路企业的资本开支节节攀升；二是集成电路企业扩产之后，导致行业总产能增速高于终端产品市场需求的增速；三是行业出现史上最高金额的大型并购案例。相较于通用领域存储市场明显的周期性波动，专用领域存储市场的周期性特征较弱，受益于历来稳定的汽车、工业等行业客户需求，以及规模相对较小的产能变动，专用领域存储市场周期性波动较小。

3、季节性

集成电路存储产业的通用市场没有明显的季节特征，专用市场中例如汽车集成电路子行业，则会根据汽车行业销售的季节变动，呈现一定的季节性。

（五）行业经营模式

根据集成电路设计企业是否具有晶圆生产线，集成电路设计企业经营模式主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。IDM 模式即垂直整合制造模式，Fabless 即无晶圆生产线集成电路设计模式，目前全球范围内 Fabless 厂商数量远大于 IDM 厂商。

1、IDM

IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业业务范围涵盖集成电路的设计、制造、封装和测试等所有环节。这种模式对企业的研发力量、资金实力和市场影响力都有较高的要求，企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装和测试厂，部分企业甚至延伸至下游电子设备制造行业。面对晶圆生产、封装和测试的生产线建设，企业均需要投入巨额资金。IDM 模式的优点是企业具有对内部资源整合的优势、以及垂直生产线的技术优势。采用 IDM 模式的代表性企业包括英特尔、三星、东芝半导体、意法半导体等大型跨国企业。

2、Fabless

Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指集成电路企业只从事集成电路设计业务，晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。Fabless 模式源于集成电路产业的专业化分工，相比 IDM 模式，Fabless 模式的资金、规模门槛更低，企业能够将资源更好地集中于设计，在资金和规模有限的情况下，充分发挥企业的研发能力，集中资源进行集成电路的设计和研发，因此具有轻资产、强专业的特点，对企业的快速发展起

到了至关重要的作用。目前，全球大多数集成电路企业采用 Fabless 模式，采用 Fabless 模式的代表性企业包括高通、博通、英伟达、迈威科技、展讯、海思等。

（六）所处行业与上、下游行业之间的关系

标的公司作为集成电路设计企业，处于集成电路产业链中的核心环节。集成电路存储芯片设计企业的产品方案通过代工方式委托给晶圆制造企业、封装和测试企业进行产品的制造和生产，标的公司的上游企业包括了晶圆制造企业、封装企业以及测试企业。集成电路存储芯片设计企业通过上游企业的代加工生产，将产成品销售给各种电子产品制造企业或是集成电路产品经销商。标的公司的下游企业主要包括了专用领域集成电路产品经销商和品牌厂商等。

1、上游行业对本行业的影响

晶圆制造行业、封装行业和测试行业作为集成电路存储芯片设计行业的上游行业，对本行业的影响体现在四个方面：一是产品良率，受到代工企业的晶圆制造和芯片封装的工艺水平、存储芯片测试技术能力的影响，集成电路存储芯片设计企业的产品良率高低会直接影响到存储芯片的单位成本；二是产品成本，集成电路存储芯片主要原材料的晶圆价格的变化，以及封装和测试费用的高低，直接影响集成电路存储芯片设计企业产品的成本高低和结构；三是交货周期，代工企业的整体产能以及产能利用率将直接决定集成电路存储芯片设计企业产品的出货数量，进而导致代工企业在交货周期上产生差异。所以，建立和代工企业之间紧密而良好的合作关系对于集成电路存储芯片设计企业而言尤为重要，谨慎选择代工企业、对产品制造工艺和技术问题等保持和代工厂有效的沟通、完善企业采购管理制度等措施，能有效降低上游行业对集成电路存储芯片企业的负面影响，同时强化企业自身在行业的竞争实力。

2、下游行业对本行业的影响

作为涵盖了汽车、工业制造、通讯设备等细分行业的专用领域集成电路市场是集成电路存储芯片设计行业的下游行业。专业领域应用方向的各类产品包括了汽车、工控机床、数控机床、通讯微基站、信号发射器等，在下游行业企业面临的产品性能提升、成本优化、技术升级等需求通过市场传递到集成电路存储芯片设计企业。由于专用领域市场存在的高壁垒特征，使行业新进入设计公司很难在短

期内提高市场份额，而具有多年行业经验的设计厂商则能更快速的对接上下游企业的设计需求。以汽车电子市场为例，受到驾驶自动化和汽车电子化趋势的所带来的产品升级，近年来汽车存储芯片的技术升级之路将其逐步定义为具有更高集成度、更低功耗表现、更广范围的同其他集成电路产品的兼容程度的存储芯片产品，这也为具有多年芯片设计经验的企业提供了更好的前景。因此，集成电路设计企业不仅会直接和下游厂商开展合作，也会同优质集成电路产品经销商合作，以快速对接上市场需求，保持对于专用领域产品升级路径上芯片设计技术的与时俱进。集成电路设计企业依靠对市场变化的敏锐洞察能力以及下游企业持续对产品进行升级和设计要求提高的需求，保持行业竞争力，减小下游行业变化带来的负面影响。

3、汽车行业变革带来的发展机遇

随着人们对汽车的安全性、舒适性、便利性以及智能化的要求日益提高，汽车技术的发展和产品性能的提升也被提到了重要的位置。汽车产业正经历一轮深刻的变革，未来汽车将向安全、节能、联网及娱乐的方向发展，具备高级汽车驾驶辅助系统（ADAS）、无人驾驶（UA）、车联网（V2X）、新能源动力等功能和技术的新款车型将逐步迈入成熟的民用商业化阶段。在消费升级和需求多元化的大背景下，汽车智能化发展成为汽车行业发展的必然趋势，这也为汽车电子行业以及集成电路行业带来了较好的发展机遇。

1) 汽车智能化推动车规型集成电路产品搭载数量的提升

汽车智能化的趋势将致使汽车电子市场的增长不再仅仅依赖于汽车销量的增涨，也同样受到单车中车规型集成电路产品数量提升的影响。根据中投顾问产业研究中心的数据，2020 年汽车电子在整车中的成本将达到约 50%，而目前汽车电子的渗透率仅约为 30%，具有较大增长空间。同时汽车智能化将进一步细化车载集成电路的功能分工，汽车供应商面对汽车细分功能上搭载车规型集成电路产品数量的需求也将进一步增加。随着汽车智能化程度的提高，不仅将提升汽车中车规型集成电路产品的搭载数量，更会促进车规型集成电路产品性能的进一步优化和升级。

2) 汽车智能化带来海量信息存储处理需求

现阶段汽车作为交通运输工具的单一定位正逐渐被颠覆，未来汽车将成为以信息汇总、计算和传递为核心的综合交通工具，这对汽车的信息处理能力提出了更高的要求。目前汽车智能化主要的应用领域包括了高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车行驶电子化配套系统、高集成度车载显示及触控等领域。对于 ADAS 系统而言，该系统在汽车的行驶过程中，需要通过传感器感知环境、收集数据、进行处理、做出预警等动作，以此实现智能化的辅助驾驶功能。因此 ADAS 系统需要拥有大量存储空间和高速存储速度支撑系统的快速处理能力，对于信息存储及信息处理的要求较高。对于车载信息娱乐系统（IVI）而言，随着车载信息娱乐系统的显示器高清化大屏化的发展，对信息存储的容量和处理速度也提出了更高的要求，在不断提升的汽车内存容量下，高集成度的车载显示及触控系统对信息的存储处理需求也达到了较高的要求。由此可见，随着汽车各种功能的不断延伸和升级，面对海量的数据存储处理需求和更高速的数据传输需求，适用于汽车的各类集成电路存储芯片将面临巨大的需求。

（七）行业主要企业及竞争格局

1、行业主要企业

（1）赛普拉斯（Cypress）

赛普拉斯是全球领先的集成电路体芯片供应商，2016 年前三季度实现销售收入 13.93 亿美元，同比增加 20.32%，其中净利润为-6.14 亿美元，同比减少 100.26%。公司的产品主要包括 NAND FLASH、SRAM、F-RAMs 等，其产品主要对应的市场为消费电子、通讯、工业和汽车。2015 年，赛普拉斯完成与飞索半导体的兼并。飞索半导体作为全球领先的半导体芯片、微控制器等嵌入式半导体产品的设计和生产商，其卓越的研发能力和客户网络进一步提升了赛普拉斯在嵌入式集成电路的市场地位。公司计划推出基于 USB Type-C 的多种解决方案、超高速 USB 3.0 控制器等新产品。

（2）三星电子（Samsung Electronics）

三星电子是韩国最大的电子工业公司。1938 年 3 月于朝鲜大邱成立，创始人是李秉喆，现任社长兼 CEO 是崔志成。在世界上最有名的 100 个商标的列表中，三星电子是唯一的一个韩国商标，作为韩国规模最大的企业，三星电子是三

星集团子公司中规模最大且在国际市场处于领先地位的企业。三星电子在全世界共 65 个国家拥有生产和销售法人网络，员工数多达 157,000 人，主要业务涉及了移动电子业务、半导体业务、显像产品业务、家庭娱乐业务等。2016 年全年三星电子营收 201.87 万亿韩元，营业利润 29.24 万亿韩元，营业利润较上一年增长 10.7%，主要受益于移动电子业务和半导体业务的强劲表现。三星电子半导体业务 2016 年全球排名第二，仅次于英特尔。三星电子未来重心将聚焦于高利润率的产品组合，解决智能手机、高端 PC 以及数据中心服务等领域不断增长的市场需求。在 DRAM 业务方面，三星计划发力高密度、低功耗产品线，同时扩大 1Xnm 工艺的使用范围，从而实现盈利最大化的目标。

（3）SK 海力士（SK Hynix）

SK 海力士是全球第三大 DRAM 生产商，受全球宏观经济市场不景气的影响，公司 2016 年前三季度实现销售收入 4.244 万亿韩元，同比减少 13.8%，其中净利润 5980 亿韩元，同比减少 43%。公司专业从事 DRAM、NAND Flash 和 CIS 系统等产品的研发、生产和销售，其中 DRAM 和 NAND FLASH 产品是其销售收入的主要来源，其毛利率为 44%左右。主要产品对应的领域为消费电子、工业和汽车市场，2016 年前三季度 DRAM 和 NAND FLASH 销售同比增长分别为 8%和 12%，该增长源于市场对智能手机对需求的增加。公司目前在着力开发其 3D NAND FLASH 产品，预计 2017 年第二季度进入量产阶段。相比于 2D 产品，3D 产品具有容量高、单位成本低、可靠性好等特点，目前市场上只有三星、英特尔和美光科技提供 3D NAND FLASH 产品，市场前景巨大，未来公司有可能迎来快速发展的机遇。

（4）美光科技（Micron Technology, Inc.）

美光科技是全球大的半导体芯片领先供应商之一，公司 2016 财年（截至 2016 年 9 月 1 日）实现销售收入 123.99 亿美元，同比减少 23.43%，其中净利润 2.76 亿美元，同比减少 109.52%。公司通过全球化的运营，向市场推出 DRAM、NAND Flash、CMOS 图像传感器等其他半导体元件和内存模组。其产品主要用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品等。报告期内，整体毛利率保持在 25%左右。公司于 2016 年开始量产 3D XPoint 存储芯片产品，其创新的 3D 架构使其相比于 2D 产品有更快、更高校的读写速度，同时其容量也会进一步提升，成本也会进

一步降低 30%左右，公司计划 2017 年大量增加 3D XPoint 产品的产量，未来该产品的市场前景广阔，公司业务将深受重益，从而止住销售收入下跌的趋势。

2、标的公司易失性存储芯片产品的市场份额

（1）根据第三方机构 IHS 的统计，报告期内标的公司 SRAM 产品在全球易失性存储芯片 SRAM 市场中的份额占比情况，如下表所示：

时间	排名	公司简称	市场份额占比
2016 年度	1	赛普拉斯	37.44%
	2	标的公司	18.04%
	3	其他	44.52%
	合计		100.00%
2015 年度	1	赛普拉斯	42.14%
	2	标的公司	15.72%
	3	其他	42.14%
	合计		100.00%
2014 年度	1	赛普拉斯	34.63%
	2	标的公司	13.75%
	3	其他	51.62%
	合计		100.00%

全球 SRAM 产品市场中，标的公司拥有的市场份额仅次于赛普拉斯。2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司下属经营实体的 SRAM 产品在全球市场均排名第二，市场份额占比分别为 13.75%、15.72%和 18.04%，报告期内市场占有率保持逐年上升趋势。

（2）根据第三方机构 IHS 的统计，报告期内标的公司 DRAM 产品在全球易失性存储芯片 DRAM 市场中的份额占比情况，如下表所示：

时间	排名	公司名称	市场份额占比
2016 年度	1	三星电子	47.09%
	2	SK 海力士	25.81%
	3	美光科技	19.65%
	4	南亚科技	3.08%
	5	华邦电子	1.58%
	6	力晶科技	0.86%

	7	晶豪科技	0.60%
	8	标的公司	0.52%
	9	其他	0.81%
	合计		100.00%
2015 年度	1	三星电子	45.31%
	2	SK 海力士	27.69%
	3	美光科技	19.97%
	4	南亚科技	3.00%
	5	华邦电子	1.35%
	6	力晶科技	0.77%
	7	晶豪科技	0.57%
	8	标的公司	0.46%
	9	其他	0.87%
	合计		100.00%
2014 年度	1	三星电子	40.25%
	2	SK 海力士	27.44%
	3	美光科技	24.69%
	4	南亚科技	3.47%
	5	华邦电子	1.38%
	6	力晶科技	0.77%
	7	晶豪科技	0.62%
	8	标的公司	0.46%
	9	其他	0.91%
	合计		100.00%

全球 DRAM 市场中，三星电子、SK 海力士、美光科技等行业前三名占据了超过 90% 市场份额，其他行业排名靠前的企业所占市场份额差距不大。2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司下属经营实体的 DRAM 产品在全球市场均排名第八，市场份额占比分别为 0.46%、0.46%、0.52%，报告期内市场占有率保持总体稳步上升趋势。

3、易失性存储芯片市场竞争格局

（1）SRAM 市场竞争对手分析

由于 SRAM 在设计逻辑和工作原理方面与 DRAM 产品存在的本质不同，在

同等规格和容量下，SRAM产品在制程工艺、性能表现、产品成本等方面较DRAM产品有着更严格的标准、更高效的表现和更高的生产成本，这也导致SRAM产品在目前非易失性存储芯片领域的使用范围较DRAM产品小，通常被作为处理器的二级高速缓存使用。标的公司在全全球SRAM市场位居第二，具有明显的行业领先地位，主要竞争对手为美国的半导体芯片供应商赛普拉斯。

赛普拉斯作为行业老牌厂商，提供包括NAND FLASH、SRAM等存储芯片以及芯片解决方案服务，在SRAM领域具有多年丰富的经营历史和行业经验，在高端产品设计领域具有领先优势，产品覆盖了包括消费电子、通讯、工业和汽车等领域，业务规模相对较大。标的公司则凭借多年在专用领域的深耕，同客户之间形成了紧密的合作模式，从早期介入客户的初步方案设计直至后期根据客户要求对试生产产品性能进行循环测试，标的公司向专用领域客户提供的更专注的芯片设计服务近年来正逐步获得更多客户信任。凭借优质的芯片设计服务，近年来标的公司在全全球SRAM市场的占有率获得逐年提升，在行业内的竞争实力也随之得到有效增强。

（2）DRAM市场竞争对手分析

DRAM市场具有典型的集成电路存储芯片的行业特征，高垄断性和高集中度导致全球DRAM市场90%以上的份额常年由行业排名前三的三星电子、SK海力士、美光科技包揽。作为DRAM行业龙头公司的三家公司均采用IDM经营模式，涵盖了存储芯片设计、晶圆制造、测试等重要生产工艺环节。IDM经营模式尽可能降低了存储芯片产品的单位生产成本，而标准型DRAM存储芯片作为适用范围广阔、标准化程度高的产品，在IDM经营模式下能高效的向集成电路存储芯片企业提供可观的利润，同时也成为了IDM类型企业赖以生存的重要产品。

相比行业中的龙头企业，标的公司不具备晶圆制造、测试、封装的生产工序，相关环节需外包给其他厂商。但作为轻资产的纯芯片设计企业，标的公司更能发挥自身研发特长，优化芯片设计服务体验，并专注于深耕工业、汽车等专用领域，但无需对生产设备、制造流水线、先进制程生产工艺研发等进行巨额资本投入并承担相关风险。由于专用领域DRAM存储芯片产品不具生产标准化特点，且具有较低的生产成本敏感性，三大行业龙头企业对专用领域市场介入不多，这恰巧

为具备丰富行业经验的标的公司提供了合适的发展空间。标的公司结合自身在易失性存储芯片领域多年的设计积累，有效抓住专用领域客户对 DRAM 产品的不同需求，并提供优质的芯片设计服务，凭借和客户之间密切的合作关系，标的公司的 DRAM 市场份额逐年提升。

（八）标的公司核心竞争力及行业地位

1、标的公司的行业地位

标的公司是专注于面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，提供集成电路存储芯片及集成电路模拟芯片的研发和设计，目前主要客户来自于专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯、消费电子等行业。标的公司凭借行业领先的研发技术，其产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，收到专业领域客户的广泛认可。

标的公司凭借丰富的利基型芯片研发实力和国际客户中良好的合作关系，在全球纯半导体设计领域具有领先的行业地位。根据第三方机构 IHS 统计，2016 年上半年，标的公司的 SRAM、DRAM 产品收入在全球 SRAM、DRAM 产品分类中位居第二位和第八位，仅次于三星、美光、海力士、赛普拉斯等国际一流厂商，处于行业领先地位。

2、标的公司的核心竞争力

（1）研发优势

标的公司作为存储行业领先的设计公司，在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念，在产品的工艺上一直保持行业前沿。截止至 2016 年 9 月 30 日，标的公司共有研发人员 166 人，其中核心技术人员在易失性存储领域或非易失性存储领域均有多年丰富的工作经验，经历了数次行业研发技术的革新以及多轮产品的迭代，其平均从业年限超过 20 年。在经验丰富的核心技术团队带领下，目前基于 30nm 制程工艺 4Gb（x16）容量的车用型 DRR4 产品已经进入小规模生产阶段，经过长期的技术积累，代表行业领先技术水平的专用领域存储芯片的研发成果将逐渐在未来显现，同时基于先进制程的研发能力会进一步稳固公司在芯片设计领域的行业地位。

（2）产品优势

标的公司的集成电路芯片产品主要定位于汽车电子、工业及通讯等专用型产品领域，相较于大部分半导体存储芯片所在的通用型领域，具有较高的毛利率以及较为稳定的市场需求。标的公司拥有丰富的行业经验，紧跟市场的动向，目前基于 45nm 和 65nm 工艺制程，针对车用级客户及工业级客户的高传输速度、高容量存储芯片保持良好的出货量。其产品性能的稳定表现和在极端环境下的可靠性优势促使越来越多的整机客户及汽车客户采用进整体设计方案中。

同时，伴随近两年存储行业龙头三星、美光等逐渐在传统产品产能上的削减，北京矽成凭借多年研发的积累和客户的优势，迅速占有传统产品的市场分额，成功扩展 SDR、DDR、mDDR 等产品的市场份额，逐步提高利基型产品销量，进一步增强产品竞争力。

（3）供应链优势

标的公司专注于设计领域二十多年的经营历史构筑了其在行业内同供应商之间可靠而稳定地合作关系。目前其长期合作的供应商伙伴包括了力晶半导体、南亚科技、世界先进、中芯国际等，均为在集成电路存储领域具有高品质、高良率、产能充足的晶圆代工产。在封装和测试环节，标的公司和南茂科技、矽格等本土性厂商有着深厚的合作关系，在产能安排、测试品质、物流安排得到封装、测试厂的有力支持，保证了专用领域客户能在第一时间收到标的公司高品质的芯片产品。此外，北京矽成对大陆的供应链厂商正逐渐加强合作关系，进一步构建高效、稳定和低成本的区域供应链网络。

（4）客户优势

标的公司在专用领域市场拥有多元化的客户结构，直销模式和经销商模式下带来的终端客户和代理商客户使其规避了对单一大客户的依赖风险。同时受益于来自各专用领域的全球顶级客户均具有较好的现金流，使标的公司的坏账率处于较低水平。本次报告期内，标的公司具有合作关系的终端客户覆盖了博世、松下、大陆集团、思科、西门子、通用电气、索尼等全球知名企业，全球级客户的流失率为零，客户结构具有较高稳定性。

由于标的公司的终端客户均来自于汽车、工业、通讯等专用领域，在向其提

供芯片产品时，经常需要和客户直接或联合经销商一起根据客户要求对芯片产品做细节上的个性化设计。凭借该种合作模式，标的公司不仅和客户之间形成了极强的粘性和信任，同时来自于全球顶级的专用领域客户对芯片产品的要求，一定程度上也成为专用领域存储芯片未来发展趋势，为标的公司产品在行业内树立了标杆的形象。

（5）团队优势

经验丰富而稳定的管理团队是标的公司保持行业领先地位的重要因素。标的公司的核心管理层在集成电路存储领域均拥有二十多年的行业经验，对于存储技术的应用和技术发展的探索有着准确的判断，能谨慎而敏锐地把握市场未来的需求和行业发展的趋势。核心管理层常年保持稳定结构，以此带来决策和执行层面顺畅的沟通交流、高效的工作效率、强烈的团队精神以及务实的管理风格，这是标的公司多年来在变化莫测的集成电路存储领域保持行业领先核心竞争力，也是保障公司未来持续快速发展的重要基石。

三、交易标的最近三年的财务状况分析

中兴华会计师对北京矽成编制的 2014 年、2015 年和 2016 年的备考合并财务报表及附注进行了审计，并出具了中兴华专字（2017）第 010161 号和 010162 号标准无保留意见审计报告。

如无特别说明，本节有关财务数据均为合并备考口径，与北京矽成实际财务状况有一定的差异：合并备考财务报表的编制基础具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，提醒广大投资者注意。

北京矽成 2014 年末、2015 年末和 2016 年末的财务情况分析如下：

（一）标的公司财务状况分析

1、合并备考报表资产结构分析

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：						
货币资金	89,450.90	14.84%	56,449.30	10.18%	80,861.50	15.23%

应收账款	41,220.53	6.84%	25,301.95	4.56%	31,657.03	5.96%
预付款项	12,616.06	2.09%	8,002.16	1.44%	5,262.38	0.99%
其他应收款	301.84	0.05%	316.54	0.06%	389.66	0.07%
存货	51,428.57	8.53%	60,073.34	10.83%	53,911.36	10.15%
其他流动资产	4,893.47	0.81%	4,958.78	0.89%	3,842.55	0.72%
流动资产合计	199,911.37	33.16%	155,102.07	27.97%	175,924.48	33.13%
非流动资产：						
可供出售金融资产	-	-	15,148.71	2.73%	12,694.20	2.39%
长期应收款	49,896.06	8.28%	38,675.79	6.97%	-	-
长期股权投资	930.19	0.15%	876.71	0.16%	860.03	0.16%
固定资产	30,784.70	5.11%	40,004.12	7.21%	44,339.65	8.35%
无形资产	66,886.03	11.10%	69,929.53	12.61%	73,707.04	13.88%
开发支出	6,088.44	1.01%	318.04	0.06%	-	-
商誉	239,950.02	39.81%	224,612.86	40.50%	211,655.49	39.86%
递延所得税资产	7,272.44	1.21%	8,009.85	1.44%	11,126.27	2.10%
其他非流动资产	1,065.55	0.18%	1,874.93	0.34%	731.09	0.14%
非流动资产	402,873.41	66.84%	399,450.53	72.03%	355,113.78	66.87%
资产总计	602,784.78	100.00%	554,552.60	100.00%	531,038.26	100.00%

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的资产总额分别为 531,038.26 万元、554,552.60 万元和 602,784.78 万元。报告期内，北京矽成期末资产总额保持稳定增长，2015 年末和 2016 年末，北京矽成资产总额分别较上年末增长 23,514.34 万元和 48,232.18 万元，增幅分别为 4.43%和 8.70%。主要系报告期内人民币汇率贬值的影响，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，每单位美元对人民币的汇率中间价分别为 6.1190、6.4936 和 6.9370，分别较上年末增长 6.12%和 6.83%。因此，北京矽成下属主要经营实体的资产总额由美元转为以人民币计价后，资产规模增幅较大。若剔除汇率因素，北京矽成 2014 年末、2015 年末、2016 年末资产总额分别为 86,744.49 万美元、85,410.25 万美元和 86,853.51 万元，2015 年末和 2016 年末分别较上年末变动-1.54%和 1.69%，变动幅度较小，主要系因货币资金和应收账款变动所致。

从资产结构来看，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的非流动资产总额分别为 355,113.78 万元、399,450.53 万元和 402,873.41 万元，占总资产的

比重分别为 66.87%、72.03%和 66.84%，非流动资产占比较高的原因主要系北京矽成前次收购 ISSI 100%股权导致商誉大幅增加以及无形资产及固定资产公允价值增值所致。报告期各期末，商誉占总资产的比重分别为 39.86%、40.50%和 39.81%。

北京矽成作为高性能集成电路存储芯片的研发、设计和销售企业，采用 Fabless 模式运营，将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。因此，固定资产投入相对较低，而无形资产和开发支出等轻资产占总资产的比重较高。

北京矽成流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，非流动资产主要由长期应收款、固定资产、无形资产以及商誉构成。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述七种资产合计占资产总额的比重分别为：93.43%、92.88%和 94.50%。主要资产情况具体分析如下：

（1）货币资金

北京矽成的货币资金主要为银行存款，2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的货币资金分别为 80,861.50 万元、56,449.30 万元和 89,450.90 万元，占总资产的比例分别为 15.23%、10.18%和 14.85%。其中，银行存款余额分别为 79,983.73 万元、55,595.80 万元和 87,352.79 万元。此外，因为标的公司的主要经营实体大多分布在境外，因此标的公司的货币资金大部分为存放在境外的款项。报告期各期末，货币资金的具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	7.58	8.74	10.59
银行存款	89,443.32	56,440.56	80,850.90
其中：定期存款	2,090.53	844.76	867.17
合计	89,450.90	56,449.30	80,861.50
其中：存放在境外的款项	88,021.65	53,326.08	79,504.75

2015 年末，北京矽成的货币资金余额较 2014 年末减少 2.44 亿元，降幅为 30.19%，主要系 2015 年实际支付与前次收购相关的费用金额较高所致：一方面因前次收购导致部分员工期权提前行权，2015 年北京矽成支付给职工以及为职

工支付的现金较上年增加 1.38 亿元；另一方面，北京矽成支付与前次收购相关的咨询和中介服务费金额较高，导致 2015 年其他与经营活动有关的现金流出金额较 2014 年增长 2.27 亿元。2016 年末，货币资金较 2015 年末增加 3.30 亿元，增幅达 58.46%，主要原因是本年度支付的前次收购相关的成本金额大幅减少，导致北京矽成的期末经营活动现金流出金额同比减少 2.11 亿元。

（2）应收账款

北京矽成的应收账款主要为芯片销售业务形成的应收客户和委托经销商的销售款。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成应收账款账面价值分别为 31,657.03 万元、25,301.95 万元和 41,220.53 万元，明细情况如下表所示：

单位：万元

2016 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	15,050.80	36.49%	-	-	15,050.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	26,195.43	63.51%	25.71	0.10%	26,169.73
合计	41,246.23	100.00%	25.71	0.06%	41,220.53
2015 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	8,568.78	33.83	-	-	8,568.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	16,758.80	66.17	25.64	0.15%	16,733.16
合计	25,327.58	100.00%	25.64	0.10%	25,301.95
2014 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	12,396.84	39.13%	-	-	12,396.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,283.92	60.87%	23.73	0.12%	19,260.19
合计	31,680.76	100.00%	23.73	0.07%	31,657.03

2015 年末，北京矽成应收账款较 2014 年末减少 6,355.08 万元，降幅为

20.07%，降幅大于 2015 年度北京矽成主营业务收入的同比降幅。主要系标的公司 2015 年的应收账款回款情况较好所致。

2016 年末，应收账款账面价值较 2015 年末增加 15,918.58 万元，增幅达 62.91%。一方面系因为 2016 年，随着全球集成电路市场尤其是存储芯片市场的逐渐复苏，标的主营业务恢复至正常水平导致期间应收账款新增额同比增长；另一方面系因为 2016 年末部分应收账款尚未到回款期所致。

北京矽成在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

报告期内，因为应收账款对象的信用情况以及历史期间应收账款回收情况良好，报告期各期末标的公司的应收账款坏账准备金额很小。

（3）预付账款

预付账款主要系预付给晶圆厂和封装测试厂的账款。报告期内，北京矽成的预付账款占总资产的比例较小。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，预付账款分别为 5,262.38 万元、8,002.16 万元和 12,616.06 万元。

2015 年末，预付账款较 2014 年末增长 52.06%，主要系北京矽成为应对部分供应商未来将停止供应相关原材料而增加相关产品的采购所致。

2016 年 6 月 3 日，标的公司下属公司 ISSI Cayman 的台湾分公司与南亚科技签订预付款和批量供应协议。该协议项下规定，ISSI Cayman 的台湾分公司应该向南亚科技支付 3,000 万美元的预付账款作为批量供应的预付账款，可以抵扣以后期间的晶圆采购款。同时，ISSI Cayman 的台湾分公司还需保障合同期内保证预付给南亚科技的预付账款不低于 1,000 万美元。该协议的签订和履行导致北京矽成向南亚科技支付的预付款大幅增加。截至 2016 年 12 月 31 日，预付账款较 2015 年末增长 0.46 亿元，增幅达 57.66%。

（4）存货

报告期各期末，存货占总资产的比例较高，分别为 10.15%、10.83%和 8.53%。

报告期各期末，存货金额分别为 53,911.36 万元、60,073.34 万元和 51,428.57 万元。北京矽成的存货由原材料、在产品和库存商品等构成，具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	13,650.86	26.54%	17,759.85	29.56%	15,883.72	29.46%
在产品	12,754.65	24.80%	11,103.92	18.48%	15,445.00	28.65%
库存商品	25,023.06	48.66%	31,209.58	51.95%	22,582.64	41.89%
合 计	51,428.57	100.00%	60,073.34	100.00%	53,911.36	100.00%

2015 年末，北京矽成存货较 2014 年末增加 6,161.98 万元，增长 11.43%，主要系 2015 年销售量小幅下降导致期末库存商品同比增长所致；2016 年末，存货账面价值较 2015 年末减少 8,644.77 万元，下降 14.39%，主要原因为 2016 年标的公司的主营业务增长较快，产品供应量增加导致前期储备的原材料得到加工，以及加工完成后的库存商品陆续出售所致。

（5）可供出售金融资产

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的可供出售金融资产的期末余额分别为 12,694.20 万元、15,148.71 万元和 0.00 万元。报告期各期末，可供出售金融资产主要系对南亚科技的股权投资。

2012 年 8 月 31 日，北京矽成的下属公司 ICSI TW 与南亚科技签订股份认购协议，同时与南亚科技的子公司南亚塑胶签订股权转让协议。分别认购南亚科技私募补办公开发行股票（普通股）190,588,235 股以及南亚塑胶转售的南亚科技共计 486,000,000 元新台币的普通股。其中，ICSI TW 通过收购南亚塑胶转让的股份无限售安排，该部分股权已于 2014 年全部处置完毕。ICSI TW 直接认购的南亚科技的股份为私募补办公开发行股票（普通股），该部分新增股份自协议签署之日后 42 个月内无法公开上市交易，北京矽成将其划分为以成本计量的可供出售金融资产。2016 年，因为该部分股权锁定期届满，满足上市交易条件，标的公司开始处置其持有的股份，截至 2016 年末，该部分股权已经全部处置完成，期末不再持有南亚科技股份有限公司的股份。

（6）长期应收款

北京矽成的长期应收款主要系融资租赁设备款。2015 年末和 2016 年末，长期应收账款的账面价值分别为 38,675.79 万元和 49,896.06 万元。

2015 年，北京矽成的下属子公司 ISSI 和 ICSI TW 分别与力晶半导体公司（Powerchip Technology Corporation）签订系列设备融资租赁合同。根据合同规定，该系列融资租赁的收款期为 2019 年至 2021 年，因此报告期各期末，长期应收款的金额及其占总资产的比例逐渐增加，2015 年末和 2016 年末，该比例分别达 6.98%和 8.46%。截至 2016 年末，北京矽成资产负债表日后将收到的最低融资租赁收款额合计为 49,896.06 万元，较 2015 年末增加 11,220.27 万元，增幅为 29.01%。

（7）固定资产

北京矽成的固定资产主要系北京矽成及其下属子公司拥有的房屋及建筑物、机器设备和家具设备等资产。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的固定资产金额分别为 44,339.65 万元、40,004.12 和 30,784.70 万元。

报告期各期末，北京矽成的固定资产占资产的比重逐年降低，报告期内，固定资产占总资产的比例分别为 8.35%、7.21%和 5.11%。2015 年末北京矽成固定资产较 2014 年末减少 4,335.53 万元，主要系 2015 年计提折旧 8,792.72 万元所致；2016 年末较 2015 年末减少 9,219.43 万元，主要原因是 2016 年处置了位于台湾新竹的房产，以及当年计提固定资产折旧 7,132.62 万元。

报告期各期末，北京矽成的固定资产具体情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值			
房屋及建筑物	21,101.33	35,964.41	34,795.25
机器设备	53,658.27	48,981.37	45,731.47
家具设备	2,030.83	2,563.68	2,432.38
合计	76,790.44	87,509.47	82,959.10
二、累计折旧			
房屋及建筑物	6,089.01	12,697.39	9,449.48
机器设备	38,446.21	32,987.65	27,486.50

家具设备	1,470.52	1,820.30	1,683.47
合计	46,005.74	47,505.35	38,619.45
三、账面价值			
房屋及建筑物	15,012.32	23,267.02	25,345.77
机器设备	15,212.06	15,993.72	18,244.97
家具设备	560.31	743.38	748.91
合计	30,784.70	40,004.12	44,339.65

(8) 无形资产

2014年末、2015年末和2016年末，北京矽成的无形资产金额分别为73,707.04万元、69,929.53万元和66,886.03万元。标的公司的无形资产主要由通过前次收购ISSI 100%股权获得的工艺技术、商标、技术许可使用权和专有技术等构成。

报告期各期末，北京矽成的无形资产构成具体情况如下：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值			
产品开发支出	317.49	-	-
专有技术	693.70	649.36	611.90
商标	18,036.20	16,883.36	15,909.40
工艺技术	62,126.78	58,155.75	54,800.89
技术许可使用权	14,511.43	12,350.10	10,643.14
合计	95,685.60	88,038.58	81,965.33
二、累计摊销			
产品开发支出	14.94	-	-
专有技术	-	-	-
商标	-	-	-
工艺技术	23,319.22	15,706.16	7,390.06
技术许可使用权	4,078.01	2,402.89	868.23
合计	27,412.17	18,109.05	8,258.30
三、减值准备			
技术许可使用权	1,387.40	-	-
合计	1,387.40	-	-
四、账面价值			

产品开发支出	302.55	-	-
专有技术	693.70	649.36	611.90
商标	18,036.20	16,883.36	15,909.40
工艺技术	38,807.56	42,449.59	47,410.83
技术许可使用权	9,046.02	9,947.22	9,774.91
合计	66,886.03	69,929.53	73,707.04

2015 年末和 2016 年末，北京矽成的无形资产账面价值分别较上年末减少 3,777.51 万元和 3,043.50 万元，主要系工艺技术和技术许可使用权在报告期内计提摊销所致。2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成分别计提无形资产摊销 7,042.01 万元、8,963.53 万元和 7,736.23 万元。专有技术和商标因为使用年限不确定，因此报告期内未计提摊销，报告期内其金额的变动系因人民币对美元的汇率差异。报告期各期末，北京矽成的无形资产经测试不存在减值迹象，报告期内未计提减值准备。

（9）开发支出

自 2015 年 12 月 7 日北京矽成完成对 ISSI 的私有化收购后，标的公司按照中国企业会计准则的相关规定，对研发费用中满足《企业会计准则第 6 号——无形资产》第 9 条中规定条件的部分，予以资本化处理。2015 年和 2016 年，北京矽成分别确认符合资本化条件的开发支出 318.04 万元和 5,817.74 万元。对于开发支出中已经形成无形资产的部分，北京矽成将其计入“无形资产”的“产品开发支出”中并按照预计使用年限计提摊销。2016 年，开发支出中符合无形资产确认条件的共 304.49 万元，共计提摊销 14.33 万元。

（10）商誉

商誉为非同一控制下企业合并中，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成的商誉金额分别为 211,655.49 万元、224,612.86 万元和 239,950.02 万元，占报告期各期末总资产的比例分别为 39.86%、40.50%和 39.81%，系北京矽成通过全资子公司闪胜科技完成对 ISSI 100%股权收购溢价所致。

北京矽成的备考报表假设前次收购于 2014 年 1 月 1 日前已经完成，将前次收购的合并成本大于合并中取得的 ISSI 全部可辨认净资产公允价值份额的差额

确认为备考报表的商誉。报告期各期末，因人民币对美元的汇率差异，商誉金额有一定变动。报告期内，ISSI 经营状况良好且盈利能力稳定，北京矽成判断前次收购产生的商誉不存在减值迹象，无需计提减值。

（11）递延所得税资产

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成以抵消后净额列示的递延所得税资产分别为 11,126.27 万元、8,009.85 万元和 7,272.44 万元。递延所得税资产主要系报告期内标的公司的待弥补亏损、预提费用和资产减值准备所形成的可抵扣所得税暂时性差异所致。明细情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
资产减值准备	23.26	127.02	279.72
预提费用	3,850.94	2,119.71	8,192.40
待弥补亏损	8,194.85	13,962.58	2,654.16
小计	12,069.05	16,209.31	11,126.27
递延所得税资产和负债互抵金额	-4,796.61	-8,199.46	-
抵销后递延所得税资产余额	7,272.44	8,009.85	11,126.27

因 ISSI 的下属子公司历史期间形成的未弥补亏损是形成递延所得税资产的最主要原因。报告期各期末，待弥补亏损形成的递延所得税资产分别为 2,654.16 万元、13,962.58 万元和 8,194.85 万元。

北京矽成的备考合并报表以抵消后的净额列示递延所得税资产，因为同一纳税实体的递延所得税资产和负债互抵金额较大，因此报告期各期末的递延所得税资产占总资产的比例较小，分别为 2.10%、1.44%和 1.21%。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债						
应付账款	29,251.72	55.46%	29,354.05	39.90%	30,901.23	41.05%
预收款项	700.64	1.33%	853.91	1.16%	1,283.46	1.70%
应付职工薪酬	9,515.45	18.04%	10,962.16	14.90%	5,522.34	7.34%

应交税费	3,561.02	6.75%	5,843.91	7.94%	3,501.86	4.65%
其他应付款	1,836.11	3.48%	21,021.21	28.57%	18,291.03	24.30%
一年内到期的非流动负债	173.43	0.33%	-	-	2,744.37	3.65%
其他流动负债	4,478.51	8.49%	4,139.24	5.63%	4,024.23	5.35%
流动负债合计	49,516.87	93.88%	72,174.48	98.10%	66,268.53	88.02%
非流动负债						
长期借款	3,150.55	5.97%	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	79.51	0.15%	201.73	0.27%	2,419.19	3.21%
递延所得税负债	-	-	1,193.22	1.62%	6,598.42	8.76%
非流动负债合计	3,230.06	6.12%	1,394.96	1.90%	9,017.61	11.98%
负债合计	52,746.94	100.00%	73,569.43	100.00%	75,286.13	100.00%

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成负债总额分别为 75,286.13 万元、73,569.43 万元和 52,746.94 万元，相较于标的公司总资产规模，北京矽成负债比例较小。主要是有因为标的公司为轻资产公司，可用于抵押的固定资产较少，银行渠道的债权融资受到了一定程度的制约，因此通过债务融资的规模有限。

从负债结构来看，流动负债是北京矽成负债总额的主要构成。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成流动负债分别为 66,268.53 万元、72,174.48 万元和 49,516.87 万元，占负债总额的比例分别为 88.02%、98.10%和 93.88%。

北京矽成的负债主要由应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债以及递延所得税负债组成。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，上述六项负债合计占负债总额的比例分别为：91.44%、98.57%和 92.22%。主要负债情况具体分析如下：

（1）应付账款

应付账款主要系北京矽成依照终端客户的订货需求和经销商的订单情况，委托晶圆厂和封装测试厂商对其研发和设计的存储芯片进行生产以及封装测试所产生的应付材料采购款。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成应付账款分别为 30,901.23 万元、29,354.05 万元和 29,251.72 万元，占负债总额的比例分别为 41.05%、39.90%和 55.46%。

报告期各期末，标的公司的应付账款存在一定的波动性，2015 年末和 2016 年末，北京矽成的应付账款分别较上年末减少 1,547.18 万元和 102.33 万元，变动幅度分比为-5.01%和-0.35%，整体变动幅度较小。波动主要系因为标的公司采用 Fabless 经营模式，将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。因此，应付委外加工供应商的货款与销售量存在一定的关联性，随着报告期内营业收入的波动，应付账款期末余额也发生变动。

（2）应付职工薪酬

北京矽成的期末应付职工薪酬均为应付短期薪酬，包括工资、奖金、津贴和补助，社会保险费，短期带薪缺勤和短期利润分享计划等。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，北京矽成应付职工薪酬余额分别为 5,522.34 万元、10,962.16 万元和 9,515.45 万元。

2015 年末，北京矽成应付职工薪酬较 2014 年末增加 5,439.82 万元，增幅达 98.51%，主要系 2015 年计提的短期薪酬的金额大幅超出当年支付的金额所致。其中，因为北京矽成 2015 年前次私有化收购 ISSI 时，支付员工期权提前行权费用导致当年计提工资、奖金、津贴和补贴大幅增长，全年共计提 3.40 亿元，实际支付 2.82 亿元，加之外币折算的影响，导致北京矽成合并备考报表层面 2015 年末已计提尚未发放的工资、奖金和津贴累计增加 6,257.72 万元。

2016 年末，北京矽成应付职工薪酬较 2015 年末减少 1,446.71 万元，降幅为 13.20%，主要系标的公司 2016 年发放预提的工资、奖金、津贴和补贴超过当期计提的金额所致。

（3）应交税费

报告期各期末，北京矽成的应交税费均系应缴纳企业所得税。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成应交税费余额分别为 3,501.86 万元、5,843.91 万元和 3,561.02 万元，占总负债的比例分别为 4.65%、7.94%和 6.75%。

2015 年末，北京矽成应交税费较 2014 年末增加 2,342.04 万元，增幅达 66.88%，主要系 2015 年税前利润较 2014 年大幅增长 129.62%，导致应交企业所得税亦大幅增加所致。2016 年，因缴纳上一年末应交所得税金额较大，北京矽成应交所得税期末余额较 2015 年末减少 2,282.88 万元，降幅 39.06%。

（4）其他应付款

北京矽成的其他应付款主要为应付并购交易成本和关联方资金拆借等。2014年末、2015年末和2016年末，北京矽成其他应付款分别为18,291.03万元、21,021.21万元和1,836.11万元，占总负债的比例分别为24.30%、28.57%和3.48%。报告期各期末其他应付款明细情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
并购交易成本	-	562.78	18,149.00
租赁押金	2.58	78.24	141.79
应付服务费	2.26	57.79	0.24
关联方借款	1,831.27	20,322.40	-
合 计	1,836.11	21,021.21	18,291.03

2014年末和2015年末，北京矽成其他应付款账面期末余额较2016年末的金额较高。其中，2014年12月31日，应付并购交易成本金额为1.82亿元，主要系备考报表中假设北京矽成前次收购ISSI于2014年1月1日完成，实际于2015年发生的并购交易成本相应地假设于2014年1月1日之前发生。经调整后尚未支付的并购交易成本在“其他应付款”的“应付并购交易成本”科目中列示。2015年12月7日，前次收购完成，标的公司支付了大部分交易成本，导致2015年末“应付并购交易成本”余额大幅减少。

2015年12月31日，其他应付款主要系应付关联方借款2.03亿元。主要情况如下：

1) 2015年11月18日，标的公司与公司股东上海承裕、华创芯原和华清闪胜签署《借款协议》，按照协议约定的条款：上海承裕、华创芯原和华清闪胜分别按照各自持有借款人的股份比例向北京矽成提供借款用于补充流动资金，借款金额合计14,536.00万元。借款期限自借款日至2018年5月18日。借款年利率为4.75%。借款人约定在借款期限内一次性偿还本息给出借人。

2) 2015年11月26日，标的公司和股东屹唐投资签署《一般委托贷款借款合同》，屹唐投资委托北京工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向标的公司发放委托贷款5,688.00万元，用于补充流动资金。贷款期限自2015年11月27日至2018年11月27日，借款年利率为4.75%。借款人约定在借款期限内

一次性偿还本息给出借人。

2016 年 8 月，北京矽成偿还了大部分向上海承裕、屹唐投资、华创芯原和华清闪胜等关联方拆借的资金，截至 2016 年末，应付关联方借款本金共剩余 1,831.27 万元。

（5）其他流动负债

北京矽成的其他流动负债主要为预提经销商佣金、预提费用和预提律师费等。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，其他流动负债余额分别为 4,024.23 万元、4,139.24 万元和 4,478.51 万元，报告期各期末北京矽成的其他流动负债金额和波动均较小。

（6）长期借款

2014 年末和 2015 年末，标的公司合并报表层面长期借款余额为 0。2016 年末，北京矽成长期借款余额共计 3,150.55 万元，均系 2016 年新增抵押借款。2016 年 1 月 12 日，北京矽成下属全资子公司 ISSI 与美国西部银行（BANK OF THE WEST）签署商业贷款协议，约定 ISSI 的贷款融资额度上限为 500 万美元，借款期限自 2016 年 1 月 12 日至 2036 年 1 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 日，长期贷款中有 173.43 万元将于一年内到期，因此重分类为一年内到期的非流动负债。

（7）递延所得税负债

北京矽成的递延所得税负债主要系北京矽成前次收购 ISSI 100%股权导致存货、无形资产和固定资产等资产评估增值所致。报告期内，递延所得税负债明细情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
固定资产财税差异	6.44	1,815.68	75.54
待摊费用	134.59	1,323.19	-
并购估值增加产生的递延所得税负债	4,655.58	6,253.82	6,522.88
小计	4,796.61	9,392.68	6,598.42
递延所得税资产和负债互抵金额	-4,796.61	-8,199.46	-
抵销后递延所得税负债余额	-	1,193.22	6,598.42

2014 年末至 2016 年末，以抵消后净额列示的递延所得税负债分别为 6,598.42

万元、1,193.22 万元和 0 万元，占期末负债总额的比例分别为 8.76%、1.62%和 0.00%。其中，并购估值增加系最主要暂时性差异，报告期内因此产生的递延所得税负债分别为 6,522.88 万元、6,253.82 万元和 4,655.58 万元。

2015 年末和 2016 年末，北京矽成的递延所得税负债较上年末分别减少 5,027.52 万元和 1,193.22 万元，下降幅度分别为 80.82%和 100.00%。主要系报告期内因前次收购导致资产账面价值增加的存货相继被处置、无形资产以及固定资产逐年摊销或计提折旧所致。

（二）财务指标分析

1、偿债能力分析

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，北京矽成主要偿债能力指标如下：

财务指标	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度	2014 年 12 月 31 日/ 2014 年度
流动比率	4.04	2.15	2.65
速动比率	3.00	1.32	1.84
资产负债率	8.75%	13.27%	14.18%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA, 万元)	32,229.40	31,293.13	19,756.83
利息保障倍数	140.47	576.49	244.08

注：以上指标计算公式如下：

- 1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 2、速动比率=(期末流动资产-期末存货净额)/期末流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出-利息收入
- 5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

报告期各期末，北京矽成的资产负债率水平保持在较低水平，且呈逐年下降的趋势，表明标的公司长期偿债能力较强，这与其轻资产的经营特征一致。报告期内，北京矽成的流动比率和速动比率整体呈波动上升的趋势，且流动比率和速动比率的绝对值均保持在较高水平，表明其短期偿债能力有一定保障。

2015 年末，北京矽成的短期偿债指标较 2014 年末下降幅度较大，主要原因如下：（1）支付前次收购 ISSI 100%股权相关的费用金额较高，导致期末货币资金较 2014 年末减少 2.44 亿元，降幅达 30.19%；（2）主营业务收入的减少导致期

末应收账款也出现一定程度的下降。二者共同导致北京矽成 2015 年末的流动资产规模和短期偿债指标均较 2014 年有所下滑。

2016 年，北京矽成主营业务增长带动应收账款和经营活动现金净流入增加，同时因偿还大部分关联方借款并支付上年末应付职工薪酬，导致流动负债规模大幅下降，最终导致北京矽成期末各项偿债能力指标大幅改善。2016 年末，北京矽成流动比率和速动比率分别增长至 4.04 和 3.00，资产负债率进一步降至 8.75%，短期偿债能力和长期偿债能力均显著增强。

报告期内，北京矽成的息税折旧摊销前利润金额较高，2014 年至 2016 年分别为 19,756.83 万元、31,293.13 万元和 32,229.40 万元，主要系因为报告期内计提的固定资产折旧和无形资产摊销金额较大所致。此外，报告期内北京矽成银行借款较少，利息支出金额较低，2014 年至 2016 年分别为 80.95 万元、54.28 万元和 229.44 万元，因此报告期内利息保障倍数分别高为 244.08 倍、576.49 倍和 140.47 倍，这表明北京矽成的付息能力较强。

截至 2016 年 12 月 31 日，同行业上市公司偿债能力指标如下：

公司代码	公司简称	资产负债率(%)	流动比率(%)	速动比率(%)
300223	北京君正	3.28	42.48	38.35
300077	国民技术	10.03	7.43	6.92
300053	欧比特	-	-	-
300327	中颖电子	13.56	6.97	6.18
300139	晓程科技	-	-	-
300458	全志科技	14.48	6.63	5.95
002049	紫光国芯	26.66	3.85	2.93
603986	兆易创新	23.39	22.03	30.74
平均值		15.23	14.90	15.18
中值		14.02	7.20	6.55
北京矽成		8.75	4.04	3.00

数据来源：Wind 资讯

注：截至本报告书出具日，欧比特和晓程科技的 2016 年年报尚未披露，计算同行业平均值时剔除两家公司的影响

从上表可知，A 股同行业可比上市公司的资产负债率水平普遍较低，短期流

动性指标较高。整体而言，可比上市公司的偿债能力普遍较强，财务风险水平较低。主要系因为同行业可比上市公司大多以芯片的研发、设计和销售为主营业务，采用 Fabless 生产模式，即产品的制造、封装和测试均通过委外方式实现，自身只负责设计和销售工作，固定资产的金额和占比均通常很小，因此主要通过信用方式从银行取得借款，限制了贷款规模。

北京矽成的资产负债率略低于同行业上市公司平均水平，长期偿债能力相对较强。短期流动性指标虽稍低于同行业平均水平，但是整体而言流动偿债能力仍有保障。总体而言，标的公司偿债能力较强，与其经营模式相符。

2、营运能力分析

2015 年和 2016 年，北京矽成营运能力指标如下：

财务指标	2016 年度	2015 年度
总资产周转率（次/年）	0.33	0.36
应收账款周转率（次/年）	5.82	6.80
存货周转率（次/年）	2.27	2.22

最近两年，北京矽成的资产周转情况整体保持在相对稳定状态。2016 年，标的公司的总资产周转率和应收账款周转率较 2015 年均出现下降，主要系因为 2016 年北京矽成保持营业收入增长的同时，总资产规模以及应收账款规模涨幅更大所致。2016 年，因存货期末余额同比下降 14.70%，当年存货周转率较 2015 年小幅增长。

2016 年，同行业可比上市公司资产周转能力情况如下：

公司代码	公司简称	总资产周转率 （次/年）	应收账款周转率 （次/年）	存货周转率 （次/年）
300223	北京君正	0.10	9.28	0.88
300077	国民技术	0.22	1.84	2.80
300053	欧比特	-	-	-
300327	中颖电子	0.66	7.39	3.42
300139	晓程科技	-	-	-
300458	全志科技	0.59	20.34	3.93
002049	紫光国芯	0.33	1.62	1.69

603986	兆易创新	1.16	12.94	3.48
平均值		0.51	8.90	2.70
中值		0.46	8.34	3.11
北京矽成		0.33	5.82	2.27

数据来源：Wind 资讯

注：截至本报告书出具日，欧比特和晓程科技的 2016 年年报尚未披露，计算同行业平均值和中值时剔除两家公司的影响

由上表可知，同行业可比上市公司资产周转能力差异较大，北京矽成的营运能力指标略低于同行业中等水平，其中，总资产周转能力指标较低系因私有化收购 ISSI 形成较大商誉及公允价值增值所致；应收账款周转率及存货周转率指标较低主要系因为标的公司的产品主要面向汽车电子、工业控制和网络通信等专用领域，产品大多采用定制化设计，所以相对于标准化程度更高的通用领域产品提供商，整体周转率水平相对较低。

总体而言，北京矽成的营运能力较强，与其经营模式、产品特点以及所面向的市场领域相符。

四、标的公司盈利能力分析

依据中兴华会计师出具的《审计报告》（中兴华专字（2017）第 010161 号和第 010162 号），标的公司盈利能力分析如下（如无特别说明，本节有关财务数据均为合并备考口径，与北京矽成实际经营成果有一定的差异，提醒广大投资者注意）：

北京矽成 2014 年度、2015 年度及 2016 年的合并备考利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	213,639.22	193,575.52	203,759.90
其中：营业收入	213,639.22	193,575.52	203,759.90
二、营业总成本	198,737.54	185,672.16	202,713.31
其中：营业成本	135,226.97	126,562.41	145,409.09
销售费用	20,163.38	15,831.59	15,921.56
管理费用	35,683.85	40,302.60	37,674.99

财务费用	-263.29	-1,554.48	-162.58
资产减值损失	7,926.64	4,530.05	3,870.23
加：投资收益	2,261.64	5,910.49	4,914.36
三、营业利润	17,163.32	13,813.84	5,960.95
加：营业外收入	460.32	-	51.22
减：营业外支出		16.88	3.53
四、利润总额	17,623.64	13,796.96	6,008.64
减：所得税	3,336.39	7,654.91	4,283.07
五、净利润	14,287.25	6,142.05	1,725.56
减：少数股东损益	231.85	236.50	161.52
归属于母公司所有者的净利润	14,055.40	5,905.54	1,564.04

（一）营业收入分析

按业务类型分类，2014 年、2015 年和 2016 年营业收入结构如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	213,513.67	99.94%	193,163.25	99.79%	203,181.56	99.72%
其他业务收入	125.55	0.06%	412.26	0.21%	578.34	0.28%
合计	213,639.22	100.00%	193,575.52	100.00%	203,759.90	100.00%

报告期内，北京矽成的营业收入主要源于主营业务收入，即集成电路存储芯片（及其衍生产品）的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售。2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成主营业务收入分别为 203,181.56 万元、193,163.26 万元和 213,513.87 万元。北京矽成的其他业务收入为租金收入，报告期内租金业务金额及其占营业收入的比重很小。

1、主营业务收入分析

标的公司主营业务收入来自于存储芯片和模拟芯片收入。存储芯片是标的公司最主要的收入来源，报告期内，存储芯片收入占主营业务收入的比重分别为 97.68%、97.10%和 96.61%。标的公司主营业务收入构成如下：

产品分类	2016 年度	2015 年度	2014 年度

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
存储芯片	206,266.11	96.61%	187,552.91	97.10%	198,475.55	97.68%
模拟芯片	7,247.56	3.39%	5,610.34	2.90%	4,706.01	2.32%
主营业务收入合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

报告期内，由于存储芯片收入波动，标的公司主营业务收入呈现先下降后回升的态势，2015 年较 2014 年下降 4.93%，2016 年较 2015 年增长 10.54%。

2015 年，标的公司的主营业务收入较 2014 年减少 10,018.31 万元，降幅为 4.93%，主要系受两方面因素的影响：一方面，2015 年下半年，全球集成电路芯片市场尤其是 SRAM 和 FLASH 两类存储芯片市场景气度下滑；另一方面，标的公司根据市场需求变化以及客户需求，结合自身产品更新升级的路线，淘汰了技术相对落后、毛利率水平相对较低的存储芯片，在全球存储芯片需求下滑的背景下，导致标的公司营业收入同比小幅下滑。

2016 年，随着市场景气度的逐渐回升，以及同期人民币对美元汇率的贬值，北京矽成 2016 年主营业务收入较 2015 年增长 20,350.41 万元，增幅达 10.54%。其中，2016 年度美元对人民币的汇率中间价较 2015 年增长 6.82%，系导致 2016 年标的公司主营业务收入增幅较大的重要原因之一。

2、主营业务收入按产品类别分析

北京矽成的存储芯片产品包括 DRAM、SRAM 和 FLASH 等三类产品。报告期内，标的公司按产品类别分类的主营业务收入的构成如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	206,266.11	96.61%	187,552.91	97.10%	198,475.55	97.68%
DRAM	147,151.39	68.92%	132,699.78	68.70%	131,945.30	64.94%
SRAM	48,347.17	22.64%	44,977.27	23.28%	50,900.13	25.05%
FLASH	10,767.54	5.04%	9,875.86	5.11%	15,630.13	7.69%
模拟芯片	7,247.56	3.39%	5,610.34	2.90%	4,706.01	2.32%
主营业务收入	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

考虑到报告期内，北京矽成的主营业务主要通过 ISSI 等注册在境外的主要经营实体开展，ISSI 等境外经营实体根据其经营所处的主要经济环境确定记账本

位币。北京矽成的财务报表以人民币列示，其本身及境内子公司以人民币为记账本位币，同时将 ISSI 等境外经营实体的记账本位币先转换为美元编制合并财务报表，并再次转换为人民币报表。

报告期内，人民币对美元的汇率逐年贬值，2014 年至 2016 年，人民币对美元的年均汇率中间价分别为 1 美元=6.61428 元人民币，1 美元=6.2284 元人民币和 1 美元=6.6529 元人民币，2015 年和 2016 年的每单位美元兑人民币的年均汇率中间价分别较上一年度增长 6.12%和 6.82%。因此，原以美元计价的主营业务数据折算为以人民币计价后，期间经营状况的变动情况受汇率波动的影响较大。

剔除报告期内汇率变动的影响后，主营业务收入如下表所示：

单位：万美元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	31,003.93	96.61%	30,112.54	97.10%	32,310.27	97.68%
DRAM	22,118.38	68.92%	21,305.60	68.70%	21,479.67	64.94%
SRAM	7,267.08	22.64%	7,221.32	23.28%	8,286.14	25.05%
FLASH	1,618.47	5.04%	1,585.62	5.11%	2,544.46	7.69%
模拟芯片	1,089.38	3.39%	900.77	2.90%	766.10	2.32%
主营业务收入	32,093.32	100.00%	31,013.30	100.00%	33,076.38	16.28%

（1）总体分析

报告期内，DRAM 和 SRAM 两类随机处理存储芯片贡献了绝大部分的业务收入。报告期内，上述两类产品的营业收入合计分别为 182,845.43 万元、177,677.05 万元和 195,498.56 万元，占主营业务收入的比重合计达 89.99%、91.98%和 91.56%。

报告期内，标的公司存储芯片收入呈现先下降后增长的态势，2015 年收入较 2014 年下降 5.50%，主要是受 SRAM 和 FLASH 产品收入降低影响；随着行业景气度的回升，标的公司三类存储芯片产品收入均增长较快，导致 2016 年存储芯片收入较 2015 年增长 9.98%。标的公司模拟芯片收入虽然占比较小，但增速较快，2015 年和 2016 年分别较上年增长 19.22%和 29.18%，表现出较高的成长性。标的公司模拟芯片产品主要面向国内销售，随着中国汽车市场智能化程度的逐渐提升以及对高性能模拟芯片需求的增长，标的公司在中国大陆的汽车芯片

领域有望取得突破，从而进一步增加模拟芯片营业收入。

（2）DRAM 收入分析

DRAM（Dynamic Random Access Memory），即动态随机存取存储器，是目前市场上最为常见的一类系统内存芯片。DRAM 系列产品广泛应用于汽车电子、工业制造和消费类电子产品等领域。报告期内，北京矽成 DRAM 产品销售收入分别为 131,945.30 万元、132,699.78 万元和 147,151.39 万元，占主营业务的比重分别为 64.94%、68.70%和 68.92%，是北京矽成最主要的收入和盈利来源。标的公司 DRAM 产品主要分面向汽车电子、工业制造以及通讯等专用领域和面向移动等消费类电子领域的两类产品，其中又以面向专用领域的 DRAM 产品为最主要产品。剔除报告期内汇率变动的影响后，DRAM 产品收入明细情况如下：

单位：万美元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
专用领域 DRAM	19,434.32	87.87%	18,436.27	86.53%	19,160.21	89.20%
移动领域 DRAM	2,684.06	12.13%	2,869.32	13.47%	2,319.46	10.80%
DRAM 合计	22,118.38	100.00%	21,305.60	100.00%	21,479.67	100.00%

2015 年，北京矽成 DRAM 销售收入较 2014 年增加 754.48 万元，基本保持稳定增长态势。若剔除汇率因素，DRAM 产品收入同比下降 0.81%，主要系专用领域产品因需求减弱导致销售收入同比小幅下滑 3.86%所致。同期，面向移动领域的产品销售收入同比增长 23.71%，主要系公司通过产品结构调整，逐步淘汰技术相对落后、毛利率水平相对较低的移动消费型 DRAM 存储芯片所致。2015 年，面向移动领域的 DRAM 产品单位销售价格提升 0.40 美元/颗，在同期销量减少的同时，销售收入同比增加 549.86 万美元（折合人民币 3,424.77 万元）。

2016 年，北京矽成 DRAM 产品销售收入同比增加 14,451.61 万元，增幅达 10.71%。若剔除汇率因素，DRAM 产品收入增加同比增长 3.81%，主要是因为面向专用领域的产品销售收入同比增长 5.41%。专用领域 DRAM 产品需求提升导致当年产品销量同比增加 6.30%，进而导致专用领域的产品营业收入同比净增加 998.05 万美元（折合人民币 6,639.93 万元）。

整体而言，虽然报告期受到行业景气度下滑的一定影响，但依托其通过多年

运营所积累的技术研发优势和稳定的高质量客户群体，北京矽成在保持专用领域产品收入稳定增长的同时，积极拓展移动等消费电子领域业务，相关产品收入增速较快。

（3）SRAM 收入分析

SRAM（Static Random Access Memory），即静态随机存取存储器，是一种具有静止存取功能的内存，不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。报告期内，北京矽成 SRAM 收入主要源自于普通型 SRAM 产品和高速型 SRAM 存储芯片销售收入，SRAM 系列产品主要应用于汽车电子、工业制造、医疗以及通讯设备等领域。

报告期内，北京矽成 SRAM 产品销售收入分别为 50,900.13 万元、44,977.27 万元和 48,347.17 万元，占主营业务的比重分别为 25.05%、23.28%和 22.64%。

2015 年，SRAM 产品的销售收入较 2014 年减少 5,922.86 万元，下降比例为 11.64%。其中，普通型 SRAM 产品和高速型 SRAM 存储芯片两类产品的收入均呈现一定幅度的下滑，上述两类产品当年实现收入分别较上年同期减少 3,978.83 万元和 1,944.04 万元，降幅分别达 9.47%和 21.89%。

SRAM 系列产品营业收入下滑的主要原因系受 2015 年下半年全球集成电路市场尤其是 SRAM 芯片市场整体不景气影响。2015 年全球集成电路市场规模同比下降 2.0%，存储芯片市场规模整体下降 2.3%，其中下滑比例最大的两类细分产品市场分别为 NOR Flash 和 SRAM 市场，分别较 2014 年下滑 14.90%和 14.80%。

2016 年，随着市场需求的逐渐复苏，并受期间人民币汇率贬值的影响，北京矽成当年 SRAM 系列产品收入较 2015 年增长 7.49%，其中普通型 SRAM 产品和高速型 SRAM 存储芯片收入分别同比增长 6.10%和 15.14%。

（4）FLASH 系列产品收入

报告期内，北京矽成 FLASH 系列产品收入规模相对较小。北京矽成 FLASH 收入主要源自于 P-Flash 和 P-Fusion 两类等产品的销售收入以及授权收入，P-Flash 系列产品大多应用于汽车电子和工业制造领域，P-Fusion 产品（嵌入式闪存芯片）主要应用于消费类电子产品领域。2014 年、2015 年和 2016 年，收入分别为 15,630.13 万元、9,875.86 万元和 10,767.54 万元，占营业收入的比重分别

为 7.69%、5.11%和 5.04%，呈逐年下滑趋势。

2015 年，北京矽成 FLASH 销售收入较 2014 年下降 5,754.27 万元，同比降幅较大，达 36.82%。其中，P-Flash 产品相关的收入较 2014 年同期变动幅度较大，营业收入总额减少 5,274.32 万元，同比下降 47.73%，是 FLASH 收入下降的主要原因；P-Fusion 业务规模同比亦下降 10.48%。2015 年 FLASH 产品收入下滑主要是受 2015 年下半年全球集成电路芯片市场不景气的影响，2015 年全球存储芯片市场细分产品领域中下降幅度最大的为 NOR Flash 市场，较 2014 年下滑 14.90%。此外，根据市场需求变化以及客户需求，结合自身产品更新升级的路线，北京矽成淘汰了技术相对落后的 P-Flash 产品，不再取得相关产品销售收入。

2016 年，随着市场需求逐渐恢复，北京矽成的 FLASH 业务较 2015 年有所回升。2016 年收入较 2015 年增长 9.03%，其中 P-Flash 产品同比增长 18.61%。整体而言，随着前期投入研发的的新产品逐渐进入量产阶段，北京矽成的 FLASH 业务收入已经止住逐年下滑趋势，整体业务规模有望逐步扩大。

（5）ANALOG 系列产品收入

ANALOG 即模拟芯片。标的公司模拟芯片产品包括 LED 驱动芯片、功放驱动芯片和传感芯片等多种类型的芯片，主要应用于汽车电子和消费电子领域。标的公司的 ANALOG 业务由 Si En Cayman 运营，通过中国境内的经营实体矽恩微电子（厦门）有限公司，以及位于中国香港的 Enchida International Limited 开展，该系列产品主要面向中国市场。

报告期内，ANALOG 产品的收入规模以及占主营业务收入的比重均较小，2014 年、2015 年和 2016 年，该系列产品分别实现收入 4,706.01 万元、5,610.34 万元和 7,247.56 万元，2015 年、2016 年较上年增速分别为 19.22%和 29.18%，保持快速增长趋势，占营业收入的比例分别为 2.32%、2.90%和 3.39%，对标的公司主营业务收入的贡献不断提升。

目前，标的公司正致力于开拓中国的汽车电子市场，力争将公司研发的高净值 ANALOG 产品广泛应用于中国汽车厂商生产所需的 LED 驱动、汽车功放设备驱动和传感设备等产品。随着 ANALOG 业务的进一步拓展，其对标的公司业务的贡献将进一步提升。

3、主营业务收入按地区分布分析

2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成主营业务收入按地区分布情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
欧洲	61,153.30	28.64%	50,195.66	25.99%	49,030.25	24.13%
中国香港	44,785.32	20.98%	35,660.34	18.46%	36,593.76	18.01%
美国	27,142.77	12.71%	23,422.78	12.13%	23,887.58	11.76%
中国台湾	26,775.37	12.54%	24,979.63	12.93%	29,064.25	14.30%
中国（大陆）	17,164.10	8.04%	20,643.40	10.69%	25,303.98	12.45%
日本	14,526.20	6.80%	16,441.19	8.51%	13,264.30	6.53%
亚太其他地区	13,525.96	6.33%	13,132.94	6.80%	14,918.61	7.34%
韩国	7,224.42	3.38%	8,108.34	4.20%	10,073.29	4.96%
北美其他地区	1,123.54	0.53%	446.66	0.23%	732.73	0.36%
南美	92.69	0.04%	132.32	0.07%	312.82	0.15%
合计	213,513.67	100.00%	193,163.25	100.00%	203,181.56	100.00%

标的公司下属经营实体 ISSI 成立已逾 20 年，并已形成全球布局，主营业务覆盖了美国、欧洲、日本、中国、亚太等全球主要国家和地区。报告期内，标的公司主要收入来自于欧洲、美国、日本、中国香港、中国台湾等海外市场，来自中国大陆的收入占比相对较低。受益于近年来全球汽车市场的蓬勃发展以及越来越高的电子化程度，凭借自身产品在专用领域的良好性能及高可靠度，标的公司来自于欧洲、中国香港和美国的主要地区市场收入占比均得到一定程度的提升。

2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司在中国大陆实现的收入占主营业务收入的比重分别为 12.45%、10.69%和 8.04%，境内销售收入占比相对较低，也与中国在全球集成电路市场的地位不符。北京矽成的主要经营实体 ISSI 在私有化完成前，是一家面向全球市场开展业务的美国纳斯达克上市公司，产品海外销售网络发达。同期，标的公司对中国存储芯片市场的开发程度有限。自前次私有化完成后，标的公司已逐步加强中国大陆客户和渠道的拓展。本次重组完成后，北京矽成可以共享上市公司发达的国内销售网络、研发技术和符合中国国情的经营理念，进一步加强针对国内市场需求的研发投入，加快在国内市场的发展速度。

中国大陆正处于消费电子产品的后普及时期，在产品差异化及消费升级等概

念的带动下，新产品的出货仍将保持较高水平；同时，随着我国工业技术的进步、自有工业品牌的发展及新一轮工业自动化的背景下，各类集成电路产品将迎来较大的产品需求。此外在国家安全以及进口替代的国家战略推动下，作为国内厂商的标的公司在市场份额的拓展上将更为受益，随着标的公司在中国大陆业务的拓展，预计中国大陆的收入对主营业务收入的贡献将逐步提升。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

按业务类型分类，北京矽成 2014 年、2015 年和 2016 年的营业成本结构如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	135,216.09	99.99%	126,523.13	99.97%	145,356.70	99.96%
其他业务成本	10.88	0.01%	39.27	0.03%	52.39	0.04%
合计	135,226.97	100.00%	126,562.41	100.00%	145,409.09	100.00%

报告期内，标的公司的营业成本主要来自于主营业务成本。2014 年至 2016 年，主营业务成本分别为 145,356.70 万元、126,523.13 万元和 135,216.09 万元，占比分别为 99.96%、99.97%和 99.99%。

2015 年，北京矽成主营业务成本较 2014 年减少 18,833.57 万元，下降幅度达 12.96%，高于同期营业收入的下降比例，主营业务成本下降幅度较大主要系受标的公司合并备考报表调整的影响。

北京矽成前次私有化收购 ISSI 100%股权时，ISSI 的资产中存货部分的可辨认净资产公允价值较账面价值增长 1,661.20 万美元。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》第三章“非同一控制下的企业合并”第十五条的规定，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。前次收购完成后，北京矽成按照存货的收购价格调整其账面价值。

标的公司编制的备考报表中，假设前次收购于 2014 年年初已完成。因此，

北京矽成按照其实际经营实体的存货周转速度，将该部分存货 PPA 全部调整至 2014 年主营业务成本中，从而导致 2014 年的主营业务成本大幅增加约 1.02 亿元（1,661.20 万美元，按照 2014 年全年人民币兑换美元的平均汇率中间价折算），占当期主营业务成本的比例约 7.02%。

此外，SRAM 和 FLASH 产品因受 2015 年全球半导体存储芯片市场需求下降尤其是 SRAM 和 FLASH 产品市场需求下滑的影响，其收入下降幅度较大。与收入大幅下降趋势一致，标的公司 SRAM 产品成本同比减少 22.92%，FLASH 产品同比减少 35.78%。

2016 年，北京矽成主营业务成本较 2015 年增长 8,692.95 万元，增幅为 6.87%，主要系因为 2016 年人民币对美元汇率贬值所致。剔除期间汇率变动影响后，北京矽成 2016 年在主营业务收入增长约 3.48% 的情况下，主营业务成本仅增长 0.05%。

2、主营业务成本按产品类别分析

2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司按主要产品列示的主营业务成本的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	131,171.50	97.00%	123,271.84	97.43%	141,874.08	97.60%
DRAM	96,008.75	71.00%	91,147.84	72.04%	98,552.47	67.80%
SRAM	27,763.73	20.53%	25,784.90	20.38%	33,451.15	23.01%
FLASH	7,399.02	5.47%	6,339.10	5.01%	9,870.46	6.79%
模拟芯片	4,044.59	2.99%	3,251.30	2.57%	3,482.62	2.40%
主营业务成本	135,216.09	100.00%	126,523.13	100.00%	145,356.70	100.00%

同主营业务收入的构成情况一致，2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成的主营业务成本亦主要来自于 DRAM、SRAM 和 FLASH 等集成电路存储芯片以及 ANALOG 模拟芯片等其他类型芯片的研发设计、技术支持和销售。

除前次收购 ISSI 时存货账面价值增加导致 2014 年主营业务成本显著高于 2015 年主营业务成本的因素外，受当年全球集成电路市场景气度下降以及标的公司内部产品结构调整的影响，北京矽成 DRAM 和 SRAM、FLASH 等主要产品

的 2015 年的主营业务成本均较 2014 年出现一定幅度下滑，与主营业务收入的波动情况一致。

2016 年，北京矽成主营业务成本较 2015 年增长 8,692.95 万元，各主要产品线主营业务成本在主营业务收入增长的同时均保持增长趋势。同样剔除期间汇率变动影响后，最主要的产品线专用型 DRAM 存储芯片在主营业务收入增长约 5.47% 的情况下，主营业务成本同比仅增长 0.06%。

3、主营业务成本按地区分析

2014 年、2015 年和 2016 年，按地区分类的主营业务成本构成如下表：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
欧洲	37,153.94	27.48%	31,685.90	25.04%	32,437.07	22.32%
中国香港	32,458.61	24.00%	26,123.85	20.65%	28,388.12	19.53%
中国台湾	17,505.16	12.95%	17,758.72	14.04%	23,464.86	16.14%
美国	15,621.27	11.55%	13,704.36	10.83%	16,374.03	11.26%
日本	8,933.30	6.61%	11,334.09	8.96%	9,436.36	6.49%
中国（大陆）	8,875.28	6.56%	11,031.37	8.72%	15,282.25	10.51%
亚太其他地区	8,392.58	6.21%	8,368.96	6.61%	11,248.70	7.74%
韩国	5,471.65	4.05%	6,142.60	4.85%	7,817.12	5.38%
北美其他地区	739.28	0.55%	278.60	0.22%	684.94	0.47%
南美	65.01	0.05%	94.69	0.07%	223.24	0.15%
合计	135,216.09	100.00%	126,523.13	100.00%	145,356.70	100.00%

2014 年、2015 年和 2016 年度，北京矽成在中国大陆实现的主营业务收入占总收入的比重分别为 10.51%、8.72%和 6.56%，境内营业成本的占比低于境内营业收入的占比，可以看出标的公司的产品在中国大陆的成本相对较低。

（三）营业毛利及毛利率分析

1、营业毛利分析

按业务类型分类，公司 2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成的营业毛利构成如下表：

单位：万元

营业毛利	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	78,297.58	99.85%	66,640.12	99.44%	57,824.86	99.10%
其他业务毛利	114.67	0.15%	372.99	0.56%	525.95	0.90%
合计	78,412.25	100.00%	67,013.11	100.00%	58,350.81	100.00%

2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成营业毛利分别为 58,350.81 万元、67,013.11 万元和 78,412.25 万元，主营业务毛利贡献率始终保持在 99%以上。报告期内，北京矽成的主营业务毛利逐年增长。

如前所述，北京矽成的备考合并财务报表中，假设因前次私有化收购 ISSI 导致账面价值增值的存货全部在 2014 年完成处置完毕，并将增值部分全部计入 2014 年主营业务成本中，导致 2014 年主营业务成本显著增长，毛利水平较调整前下降幅度较大。因此，2015 年，北京矽成的主营业务毛利水平在主营业务收入规模小幅下降的情况下仍同比增长 8,815.26 万元，增幅达 15.24%。

2016 年，北京矽成主营业务毛利同比增长 17.49%，毛利润金额净增加 11,657.46 万元。主要系期间汇率变动和营业收入增长的影响。剔除期间汇率变动影响后，2016 年北京矽成在以美元计价的主营业务收入增长约 3.48%的情况下，主营业务成本仅同比增长 0.05%。加之美元兑人民币汇率的增值效应，共同导致 2016 年主营业务毛利水平较 2015 年大幅增长。

2、主营业务毛利分产品类别分析

2014 年、2015 年和 2016 年，按产品类别列示的主营业务毛利的构成如下表：

单位：万元

项目	2016 年		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	75,094.61	95.91%	64,281.07	96.46%	56,601.47	97.88%
DRAM	51,142.64	65.32%	41,551.94	62.35%	33,392.83	57.75%
SRAM	20,583.44	26.29%	19,192.37	28.80%	17,448.98	30.18%
FLASH	3,368.52	4.30%	3,536.77	5.31%	5,759.67	9.96%
模拟芯片	3,202.97	4.09%	2,359.04	3.54%	1,223.38	2.12%
主营业务毛利	78,297.58	100.00%	66,640.12	100.00%	57,824.86	100.00%

报告期内，标的主营业务毛利主要源于 DRAM、SRAM 以及 FLASH

三类集成电路存储芯片产品。报告期内，三类存储芯片产品的毛利润占主营业务毛利润总额的比重合计分别高达 97.88%、96.46%和 95.91%，与主营业务收入和成本的构成情况基本一致。

报告期内，DRAM 系列产品的主营业务毛利润占比逐年增长，与 DRAM 系列产品主营业务收入逐年增长的趋势一致。此外，因受前次私有化导致的存货 PPA 的影响，标的公司 2014 年主营业务成本较调整前大幅增加。2015 年，因未受备考报表调整的影响，标的公司 DRAM 系列产品的营业毛利同比增长 23.89%，远超营业收入的增长规模。

2016 年，同样剔除期间汇率变动影响后，最主要的产品线专用型 DRAM 存储芯片在主营业务收入增长约 5.47%的情况下，主营业务成本同比仅增长 0.06%。因此，在人民币对美元汇率同比贬值的放大效应下，2016 年 DRAM 系列产品的毛利水平较 2015 年进一步增长。

SRAM 和 FLASH 系列产品的主营业务毛利占比均呈逐年降低的趋势。其中，2015 年，两个系列的产品均受全球市场景气度下滑的影响，营业规模同比下滑。2015 年，SRAM 毛利较 2014 年实现增长亦主要系因为 2014 年主营业务毛利受备考报表调整的影响较调整前大幅下降所致。2016 年，随着人民币汇率的进一步贬值以及存储芯片市场景气度的回升，SRAM 系列产品的营业毛利同营业收入一样保持增长态势。同期，FLASH 产品的营业收入也同比增加 9.03%，但是因为收入增速不及主营业务成本的增速，毛利水平同比小幅下滑。

报告期内，标的公司的 ANOLOG 业务毛利润水平以及占主营业务毛利的比例逐年增长，与其收入的变动趋势一致，表明标的公司模拟芯片业务已经呈现逐步扩张的趋势。

3、主营业务毛利按地区分析

2014 年、2015 年和 2016 年，按地区分类的主营业务毛利构成如下表：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
欧洲	23,999.36	30.65%	18,509.76	27.78%	16,593.18	28.70%
中国香港	12,326.70	15.74%	9,536.49	14.31%	8,205.64	14.19%

美国	11,521.50	14.72%	9,718.42	14.58%	7,513.54	12.99%
中国台湾	9,270.21	11.84%	7,220.91	10.84%	5,599.39	9.68%
中国（大陆）	8,288.82	10.59%	9,612.03	14.42%	10,021.73	17.33%
日本	5,592.90	7.14%	5,107.10	7.66%	3,827.94	6.62%
亚太其他地区	5,133.38	6.56%	4,763.98	7.15%	3,669.91	6.35%
韩国	1,752.77	2.24%	1,965.74	2.95%	2,256.17	3.90%
北美其他地区	384.27	0.49%	168.06	0.25%	47.78	0.08%
南美	27.68	0.04%	37.63	0.06%	89.57	0.15%
合计	78,297.58	100.00%	66,640.12	100.00%	57,824.86	100.00%

同主营业务收入及成本的地区分布情况一致，标的公司的主营业务毛利润主要源于欧洲、中国香港、美国、中国台湾、日本和韩国以及亚太其他地区等海外市场的销售业务。中国大陆地区的营业毛利占比相对较低，且逐年递减，这与报告期内标的公司面向中国市场的直接销售规模逐年下降的趋势一致。

此外，标的公司报告期内在中国大陆地区的营业毛利占比显著高于该地区主营业务收入占比，表明标的公司的产品在中国大陆地区的毛利润贡献水平较其他地区相对更高。

4、毛利率分析

北京矽成 2014 年、2015 年和 2016 年毛利率情况如下表所示：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
存储芯片	36.41%	34.27%	28.52%
DRAM	34.76%	31.31%	25.31%
SRAM	42.57%	42.67%	34.28%
FLASH	31.28%	35.81%	36.85%
模拟芯片	44.19%	42.05%	26.00%
主营业务毛利率	36.67%	34.50%	28.46%
综合毛利率	36.70%	34.62%	28.64%

（1）报告期内毛利率保持较高水平

2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成的综合毛利率分别为 28.64%、34.62% 和 36.70%，其中，主营业务毛利率水平分别为 28.46%、34.50% 和 36.67%。

2014 年，北京矽成备考合并财务报表的主营业务成本中包含了因前次收购

产生的存货 PPA 部分，这导致营业成本大幅提升而经营利润大幅下降。若不考虑前次收购导致的存货 PPA 的影响，标的公司 2014 年主营业务成本减少 10,204.42 万元，主营业务毛利率还原为 33.48%。

整体而言，北京矽成的毛利率水平始终保持在较高水平，而且呈现逐年增长的态势。标的公司较高的毛利率水平主要得益于其较强的研发实力和议价能力：

1) 北京矽成作为一家专注于高性能存储芯片的研发设计、技术支持和销售的公司，在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念，在产品工艺上始终保持行业前沿。经过长期技术积累，北京矽成掌握了相对完整的自主知识产权，代表行业领先技术水平的专用领域存储芯片的研发成果亦逐渐显现。

2) 北京矽成的产品主要面向专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯等领域。凭借行业领先的研发技术，其产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。作为一家在全球存储芯片市场居于行业领先地位的前美国纳斯达克上市公司，北京矽成具有一定的议价能力。

（2）主营业务毛利率变动分析

2015 年度，标的公司毛利率较 2014 年增长幅度较大，主要系因为标的公司 2015 年备考合并报表中的主营业务毛利不受存货 PPA 摊销的影响，毛利率恢复至正常经营水平。如前所述，若不考虑存货 PPA 的影响，2014 年主营业务毛利率增至 33.48%。标的公司 2015 年毛利率水平同比净增加 1.02%，主要原因为：

1) DRAM、FLASH 等产品线尤其是 DRAM 产品线产品结构调整，产品毛利率提升；2) DRAM 产品收入在主营业务收入中的比重提高。

2016 年，标的公司毛利率为 36.67%，较 2015 年增加 2.08%，主要原因为，作为北京矽成最主要的产品线，DRAM 产品的毛利率水平从 2015 年的 31.31% 增至 34.76%，净增加 3.45%。因为 2016 年 DRAM 产品的收入占比高达 65.32%，而且报告期内呈逐年增长态势，所以 DRAM 毛利率提高带动北京矽成的主营业务毛利率同比增长。

（3）分产品毛利率分析

从产品类别来看，毛利率情况主要如下：

1) DRAM 系列产品的毛利率逐年稳定增长，除受 2014 年存货 PPA 分摊的影响外，还受标的公司产品结构调整的影响。如前所述，标的公司通过产品结构调整，逐步淘汰移动型 DRAM 存储芯片中技术相对落后、毛利率水平相对较低的产品，从而导致 DRAM 产品整体毛利率水平逐年提升。

2) SRAM 系列产品的毛利率平均水平较高，2015 年和 2016 年的毛利率分别为 42.67%和 42.57%，2014 年不考虑存货 PPA 分摊的影响，毛利率为 41.44%，较高的毛利率主要系因为 SRAM 产品在读写速度及功耗水平等方面较 DRAM 等存储芯片更具优势，而且多应用于 CPU 等对芯片性能要求更高的领域，产品技术含量以及定制化设计的需求较高，因此毛利率保持较高水平。

3) 报告期内 ANALOG 系列产品的毛利率增幅较大，其中：①2015 年，ANALOG 系列产品的毛利率水平较 2014 年增加 16.50%，主要系因为 2014 年存货 PPA 分摊导致毛利率较低。剔除存货 PPA 分摊的影响后，2014 年 ANALOG 产品的毛利率增值 36.62%；②2016 年，ANALOG 产品的毛利率水平进一步增至 44.19%，主要系因为标的公司为配合自身产品的更新升级，淘汰了技术相对落后、售价相对更低的模拟芯片产品，进而聚焦于面向中国以外的市场提供更多高净值模拟芯片所致。

（四）期间费用分析

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，标的公司的期间费用及占当期营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	20,163.38	9.44%	15,831.59	8.18%	15,921.56	7.81%
管理费用	35,683.85	16.70%	40,302.60	20.82%	37,674.99	18.49%
财务费用	-263.29	-0.12%	-1,554.48	-0.80%	-162.58	-0.08%
期间费用合计	55,583.93	26.02%	54,579.71	28.20%	53,433.98	26.22%

如上表所示，标的公司报告期内的期间费用逐年增长，剔除汇率影响后，基本保持稳定。2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成期间费用合计分别为 53,433.98

万元、54,579.71 万元和 55,583.93 万元，占当期营业收入的比重分别为 26.22%、28.20%和 26.02%。

最近三年，同行业可比上市公司期间费用率情况如下：

公司代码	公司简称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
300223	北京君正	69.65%	91.55%	74.97%
300077	国民技术	31.75%	35.38%	43.60%
300053	欧比特	-	20.86%	26.64%
300327	中颖电子	26.58%	27.46%	27.59%
300139	晓程科技	-	24.54%	16.47%
300458	全志科技	29.42%	22.83%	21.02%
002049	紫光国芯	21.10%	16.98%	13.21%
603986	兆易创新	14.53%	13.46%	15.20%
平均值		32.17%	31.63%	29.84%
中值		28.00%	23.69%	23.83%
北京矽成		26.02%	28.20%	26.22%

数据来源：Wind 资讯

注：截至本报告书出具日，欧比特和晓程科技的 2016 年年报尚未披露，计算同行业平均值和中值时剔除两家公司的影响

从上表可知，报告期内标的公司的期间费用率低于同行业可比上市公司的平均期间费用率，2014 年和 2015 年高于可比公司的期间费用率中值，2016 年在期间费用率同比下降的同时，未考虑欧比特和晓程科技的影响下，北京矽成的期间费用率略低于可比上市公司的中值水平。与同行业上市公司的对比情况表明，北京矽成对期间费用的控制情况良好，期间费用率处于同行业合理水平。

1、销售费用分析

标的公司的销售费用主要为销售人员的薪酬、佣金费、差旅费等。2014 年、2015 年和 2016 年，公司销售费用金额分别为 15,921.56 万元、15,831.59 万元和 20,163.38 万元，整体而言，北京矽成的销售收入变动趋势同主营业务的经营状况保持一致。同时，占营业收入的比例逐年上升，最近三年分别为 7.81%、8.18%和 9.44%。北京矽成的销售费用具体如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年

职工薪酬	10,978.14	8,406.95	8,290.99
交通费	596.67	573.63	675.56
专家咨询费	247.92	244.01	230.02
差旅费	874.50	810.12	861.64
广告费	55.90	39.38	62.32
折旧费	446.79	239.07	157.16
佣金费	3,790.49	3,295.55	3,785.88
样品费	412.62	525.99	317.80
其他	2,760.35	1,696.88	1,540.18
合 计	20,163.38	15,831.59	15,921.56

2015 年，标的公司的销售费用较 2014 年小幅减少 89.98 万元，其中与当期销售直接相关的佣金费和交通费同比分别减少 490.34 万元与 101.94 万元，销售费用的波动情况与 2015 年主营业务规模较 2014 年小幅下降的趋势一致。

2016 年，北京矽成的销售费用较 2015 年增长 27.36%。其中，销售人员的职工薪酬增幅较高，同比增长 30.58%，净增加 2,571.19 万元，除受 2016 年人民币汇率贬值以及主营业务小幅增长的影响外，2016 年北京矽成向员工发放共计 500 万美元的奖金，其中发放给销售人员的奖金共计 122.46 万美元，约合人民币 814.71 万元。此外，其他销售费用同比增长 1,063.47 万元，其他费用主要为与销售直接相关或分配给销售部门的设备相关费用。

2、管理费用分析

2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成管理费用金额分别为 37,674.99 万元、40,302.60 万元和 35,683.85 万元，管理费用占营业收入的比例分别为 18.49%、20.84%和 16.70%。

报告期内，北京矽成管理费用主要由研发费用、职工薪酬和专业服务费等构成。其中，研发费用占管理费用的比重最高，报告期内分别为 71.77%、65.89%和 69.67%。管理费用具体情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
研发费用	24,859.63	26,553.82	27,038.65
职工薪酬	7,533.18	6,297.85	5,065.88

专业服务费	1,024.91	4,895.00	3,111.61
折旧费	689.08	800.69	739.61
差旅费	238.72	290.29	335.02
保险费	165.45	318.59	255.75
印花税等税金	422.96	48.00	
其他	749.91	1,098.36	1,128.49
合 计	35,683.85	40,302.60	37,674.99

2015 年，北京矽成管理费用较 2014 年增加 2,627.61 万元，增幅为 6.97%，主要系专业服务费和管理人员薪酬增长较多所致。专业服务费主要系标的公司聘请中介机构的服务费以及前次私有化完成前 ISSI 作为美国上市公司支付的审计等管理费用。标的公司 2015 年专业服务费较 2014 年增加 1,783.39 万元，同比增长 57.31%，主要系北京矽成成为应对专利侵权诉讼支付相关的诉讼费所致。

2016 年，北京矽成管理费用较 2015 年同期减少 4,618.76 万元，下降幅度达 11.46%。其中研发费用和专业服务费同比分别减少 1,694.19 万元和 3,870.09 万元。主要原因系：（1）北京矽成完成前次收购后，自 2015 年 12 月 7 日起按照中国会计准则将研发支出中符合资本化条件的部分确认为开发支出。2016 年标的公司资本化的开发支出为 5,817.74 万元，导致 2016 年的研发费用同比大幅减少；（2）北京矽成完成对 ISSI 的私有化收购之后，ISSI 作为美国上市公司需要支出的管理费用不再发生，此外本期支付的应对专利侵权相关的诉讼费同比减少，因此 2016 年的专业服务费同比大幅降低至 1,024.91 万元。

3、财务费用分析

报告期内，财务费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出	229.44	54.28	80.95
减：利息收入	492.53	314.36	152.49
汇兑损益	-2.64	-1,296.28	-91.03
其他	2.43	1.88	-
合计	-263.29	-1,554.48	-162.58

2014 年至 2016 年，北京矽成财务费用分别为-162.58 万元、-1,554.48 万元

和-263.29 万元。报告期内，因为标的公司的银行存款金额较高，利息收入和汇兑收益超过利息支出，所以财务费用均为负数。

报告期内，北京矽成的汇兑损益占财务费用比重较高，主要系因为标的主要经营实体 ISSI、ISSI Cayman、ICSI TW 和 Enchida International Limited 均为境外注册的公司，主要经营地位于美国和中国台湾，境外经营实体及其各子公司均根据其经营所处的主要经济环境以其本国货币作为记账本位币，各实体报告期内的日常交易因受汇率的变动影响产生的汇兑损益计入财务费用。2015 年，受台币与美元汇率波动的影响，北京矽成共实现汇兑收益 1,259.65 万元。

（五）利润表其他项目分析

1、投资收益

2014 年、2015 年和 2016 年，标的公司实现的投资收益分别为 4,914.36 万元、5,910.49 万元和 2,261.64 万元。报告期内，北京矽成的投资收益主要通过处置持有的子公司或其他公司股权以及获得股利分红方式的方式取得。主要情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
处置子公司 Chingis 的投资收益	-	5,181.50	-
权益法核算的长期股权投资收益	-6.12	-34.50	-109.73
处置可供出售金融资产的收益	1,594.94	0.00	5,024.09
南亚科技分配的股利	672.82	763.49	
合计	2,261.64	5,910.49	4,914.36

2012 年 8 月 31 日，北京矽成的下属公司 ICSI TW 分别与南亚科技股份有限公司及其子公司南亚塑胶公司签订股份认购协议和股权转让协议，分别认购南亚科技私募补办公开发行股票（普通股）190,588,235 股以及南亚塑胶转售的南亚科技普通股共计 486,000,000 元新台币。2014 年和 2016 年，北京矽成因处置持有的南亚科技的股权分别获得投资收益 3,735.89 万元和 1,594.94 万元。标的公司因持有南亚科技的股权，于 2015 年和 2016 年分别获分配股利 763.46 万元和 672.82 万元。

此外，2014 年，标的公司将其持有的中芯国际全部剩余股权处置完毕，当

年因处置该部分股权获得投资收益 1,288.20 万元。2015 年，北京矽成因处置子公司 Chingis 的股权取得投资收益 5,181.50 万元。

2、资产减值损失

报告期内，北京矽成的资产减值损失主要为存货跌价损失和无形资产减值损失。2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成的资产减值损失为 3,870.23 万元、4,530.05 万元和 7,926.64 万元。其中，报告期内存货跌价损失金额较高，分别为 3,859.06 万元、4,529.62 万元和 6,596.06 万元。存货跌价准备的变动情况如下：

单位：万元

项目	原材料	在产品	库存商品	合计
2014 年 12 月 31 日	1,813.37	286.93	3,270.04	5,370.34
2015 年计提额	-	591.26	3,938.35	4,529.62
2015 年减少额	539.34	-	3,560.86	4,100.21
汇率折算差额	88.05	42.74	3.74	134.53
2015 年 12 月 31 日	1,362.08	920.93	3,651.27	5,934.28
2016 年计提额	1,066.53	-	5,529.53	6,596.06
2016 年减少额	-	152.81	4,380.89	4,533.71
汇率折算差额	138.55	56.36	418.10	613.01
2016 年 12 月 31 日	2,567.16	824.47	5,218.00	8,609.63

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。北京矽成的存货跌价准备相对谨慎，除已得到市场及销售部门明确反馈存货将被销售的情况，标的公司将期限超过一年的存货全部计提存货跌价准备。而且已经计提的存货跌价准备只在存货被销售被处置时转销，期间不予以转回。

报告期内，北京矽成计提的存货跌价损失逐年增加，除受期间人民币汇率贬值的影响外，主要变动原因还包括：1）为保证供应商产品供应的稳定性增加对预期将停产的产品采购；2）客户当期实际需求低于预期；3）产品需求不适用于预期销售领域等。

2016 年 12 月 12 日，北京矽成收到 Genusion 进入破产程序的正式书面通知。按照无形资产计提减值准备的相关规定，Genusion 进入破产程序，该谅解备忘录下约定的专利权、知识产权和产品许可合同预计无法再为 ISSI 带来经济利益流入，因此北京矽成计提全部相关无形资产的减值损失共计 200 万美元，约合人民币 1,330.58 万元。

3、营业外收入和支出

报告期内，标的公司营业外收入收支金额较小。

2014 年，营业外收入为 51.22 万元。2015 年，北京矽成无营业外收入。2016 年，北京矽成营业外收入为 460.32 万元，主要系处置位于台湾新竹的房产所产生的的固定资产处置利得，以及废料处置收益等。

2014 年和 2015 年，北京矽成因处置固定资产分别亏损 3.53 万元和 16.88 万元，均计入当年的非经常性损益中。2016 年，未发生营业外支出。

4、所得税费用

报告期内，标的公司的所得税费用情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	2014 年
当期所得税费用	3,792.21	9,943.68	3,226.09
递延所得税费用	-455.81	-2,288.76	1,056.98
合 计	3,336.39	7,654.91	4,283.07

报告期内，标的公司备考合并财务报表的所得税费用分别为 4,283.07 万元，7,654.91 万元和 3,336.39 万元，占当期税前利润总额的比重较高，主要系因为标的公司的子公司分布在美国和台湾等海外地区，不同地区的子公司所适用的所得税税率存在差异所致。

2014 年、2015 年和 2016 年度，按照中国境内企业法定所得税税率计算的所得税费用分别为 1,502.16 万元、3,449.24 万元和 4,405.91 万元。因子公司使用不同税率，报告期内对所得税费用调整金额分别为 3,013.59 万元，2,836.20 万元和 -3,297.46 万元，对标的公司的所得税费用影响较大。标的公司及重要子公司所在地主要税种及税率情况如下：

税 种	具体情况税率
（一）美国	
联邦税（Statutory federal income tax）	按应纳税所得额的35%计缴
州税（State income tax）	按应纳税所得额的10%计缴
（二）中国大陆	
增值税	应税商品和服务收入按17%、13%或6%的税率计算销项税；并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%或1%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%或15%计缴
（三）中国台湾	
企业所得税	按应纳税所得额的17%计缴
增值税	按应税收入的5%计缴
营利事业所得税	按未分配盈余的10%计缴
（四）开曼群岛	
企业所得税（Income Tax）	按应纳税所得额的0%计缴

除上表列示的所得税税率外，北京矽成的税收优惠及批文情况如下：

芯成半导体（上海）有限公司获得了证书编号为 JF2014310150155 的技术先进型服务企业证书，自 2015 年 1 月 14 日起至 2018 年 12 月 31 日止，享受高新技术产业的减免政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

矽恩微电子（厦门）有限公司获得了证书编号为 GR201535100052 的高新技术企业证书，有效期自 2015 年 10 月 12 日起三年，享受高新技术产业的减免政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

（六）非经常性损益分析

报告期内，北京矽成最近三年非经常性损益净额明细如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	93.39	-16.88	-3.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,594.94	-	5,024.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目	366.93	-	51.22
小计	2,055.27	-16.88	5,071.78
所得税影响额	349.40	-2.87	862.20
少数股东权益影响额（税后）	29.51	-0.24	72.83
归母非经常性损益净额	1,676.36	-13.77	4,136.75

2014 年度、2015 年度及 2016 年度，北京闪胜的非经常性损益分别 5,071.78 万元、-16.88 万元和 2,055.27 万元。报告期内，标的公司非经常性损益主要系处置可供出售金融资产取得的投资损益。2014 年和 2016 年，北京矽成的备考合并财务报表中，因处置南亚科技和中芯国际两家上市公司的股权，分别实现投资收益 5,024.09 万元和 1,594.94 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司不再持有上述两家上市公司的股权。上述非经常性损益项目为偶发项目，不具备持续性。

报告期内，北京矽成非经常性损益净额占同期净利润的比例如下表所示：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非经常性损益总额	2,055.27	-16.88	5,071.78
非经常性损益净额	1,705.87	-14.01	4,209.58
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,676.36	-13.77	4,136.75
归属于母公司所有者的净利润	14,055.40	5,905.54	1,564.04
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	12,379.03	5,919.32	-2,572.71
非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润比例	11.93%	-0.23%	264.49%

2014 年、2015 年和 2016 年，北京矽成非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 264.49%、-0.23%和 11.93%。报告期内，北京矽成的净利润主要来自于存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售等主营业务所产生的利润。除 2014 年北京矽成的备考合并利润表中因存货 PPA 的调整导致净利润水平较低外，报告期内非经常性损益占公司归属于母公司所有者净利润的比重较小，扣除非经常性损益不会对标的公司净利润的稳定性产生重大影响。

（七）净利润与净利率分析

标的公司最近三年的净利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
净利润	14,287.25	6,142.05	1,725.56
归属于母公司股东的净利润	14,055.40	5,905.54	1,564.04
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	12,379.03	5,919.32	-2,572.71
销售净利率	6.69%	3.17%	0.85%
归属于母公司股东的销售净利率	6.58%	3.05%	0.77%

报告期内，北京矽成备考合并财务报表净利润规模分别为 1,725.56 万元、6,142.05 万元和 14,287.25 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 1,564.04 万元、5,919.32 万元和 13,679.94 万元，均呈现逐年快速增长的态势。

2014 年，北京矽成实现净利润 1,725.56 万元，扣除因处置可供出售金融资产获得投资收益后，归属于母公司的净利润净额为-2,572.71 万元。主要系因为标的公司编制的备考报表中，假设前次收购于 2014 年年初即完成。北京矽成按照其实际经营实体的存货周转速度，将该部分存货 PPA 全部调整至 2014 年主营业务成本中，因而 2014 年的主营业务成本大幅增加约 1.02 亿元，最终导致标的公司 2014 年净利润水平较低，销售净利率和归属于母公司股东的净利率分别仅为 0.85%和 0.77%。

2015 年度，北京矽成备考合并报表的净利润水平较 2014 年增加 4,416.48 万元，增幅达 255.94%。该增长主要系因为前述标的公司的备考报表中根据北京矽成前次收购时存货购买价格增值情况调整 2014 年的主营业务成本所致。此外，北京矽成发生与前次私有化收购 ISSI 相关的所得税费用金额较大，受所得税费用调整的影响，北京矽成的净利率水平仍较低。虽然相较于 2014 年度，北京矽成的净利率指标大幅提升，但仍然处于相对较低的水平，2015 年销售净利率和归属于母公司股东的净利率分别为 3.17%和 3.05%。

2016 年，北京矽成的营业收入规模较 2015 年增幅大于营业成本的增幅，营业毛利率进一步提高。此外，按照中国会计准则的规定将研发支出中符合资本化条件的部分确认为开发支出，导致 2016 年的管理费用同比大幅减少。两者共同导致净利润亦较 2014 年和 2015 年同期大幅增加，销售净利率和归属于母公司股东的净利率指标分别增至 6.69%和 6.58%，整体盈利水平提升显著。

五、标的公司现金流量分析

报告期内，标的公司最近三年的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	17,903.55	-26,777.67	12,322.84
投资活动产生的现金流量净额	8,997.72	-507,266.15	-10,379.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,989.05	508,609.12	4,950.96
汇率变动对现金	1,865.51	1,044.92	-2,135.17
现金及现金等价物净增加	31,755.83	-24,389.78	4,759.20

（一）经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	218,442.49	201,019.36	201,138.91
收到的税费返还	-	1,231.18	1,272.28
收到其他与经营活动有关的现金	668.95	314.36	152.49
经营活动现金流入小计	219,111.44	202,564.90	202,563.69
购买商品、接受劳务支付的现金	147,078.54	139,971.51	138,156.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23,120.81	40,988.54	27,214.09
支付的各项税费	5,843.91	3,446.90	4,464.05
支付其他与经营活动有关的现金	25,164.64	44,935.62	20,405.92
经营活动现金流出小计	201,207.90	229,342.56	190,240.84
经营活动产生的现金流量净额	17,903.55	-26,777.67	12,322.84

报告期内，标的公司经营活动产生的现金流入主要是销售商品、提供服务收到的现金。2014 年、2015 年和 2016 年度销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入的比例分别达到 98.71%、103.85%和 102.25%，两者具有较强的相关性，北京矽成该比例保持较高水平表明其经营活动回款状况良好，营业收入增长转化为现金的能力较强。

2015 年，标的公司经营活动产生的现金流量净额为负数，与当年备考合并报表中的净利润水平差异较大，主要系备考合并财务报表的调整所致。

备考合并现金流量表中，2015 年，北京矽成完成前次收购 ISSI 100%股权并支付相关交易成本，本次收购中除现金对价等直接成本计入“并购支付给前股东

的现金”外，因支付前次收购相关的员工期权提前行权的费用，律师服务费等中介费用等分别计入“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”中，导致经营活动现金相关的现金流出同比大幅增加 39,101.72 万元，进而导致当年经营活动产生现金净流出 26,777.67 万元。

备考合并利润表中，系假设前次收购已于 2014 年初完成，相关交易成本和费用均在 2014 年前发生，未计入北京矽成 2015 年的损益中，导致 2015 年备考合并利润表的净利润水平与经营活动现金流差异较大。

此外，2015 年，北京矽成成为应对专利侵权诉讼所支付的诉讼费高达约 790 万美元，这导致当年支付的其他与经营活动相关的现金较 2014 年进一步增加。

2016 年，北京矽成销售商品、提供劳务收到的现金较 2015 年增加 17,423.13 万元。其次，因与前次收购 ISSI 相关的费用，以及诉讼相关的费用等大多已于 2015 年支付，导致 2016 年“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”分别较 2015 年减少 17,867.72 万元和 19,770.98 万元。基于上述原因，北京矽成 2016 年经营活动产生的现金流量净额同比增加 44,681.21 万元。

综上，报告期内北京矽成除受前次私有化收购 ISSI 导致 2015 年经营活动现金流出金额较大的影响外，经营活动产生的现金流量较为充裕，可以为公司发展提供所需资金的重要来源。

（二）投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收回投资收到的现金	16,743.65	1,319.77	3,618.20
取得投资收益收到的现金	672.82	763.49	4,914.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,851.41	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,032.09	-
投资活动现金流入小计	26,267.88	17,115.35	8,532.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,270.15	43,512.47	18,912.00
并购支付给前股东的现金	-	480,869.03	-

投资活动现金流出小计	17,270.15	524,381.50	18,912.00
投资活动产生的现金流量净额	8,997.72	-507,266.15	-10,379.44

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，标的公司投资活动产生的现金流量净额分别为-10,379.44 万元、-507,266.15 万元和 8,997.72 万元。2014 年和 2015 年，标的公司投资活动现金均呈现净流出状态，其中 2015 年投资活动现金流出金额为 524,381.50 万元，主要系标的公司当年完成对 ISSI 100%股权的收购，并于当年支付给原股东现金对价共计 480,869.03 万元所致，上述现金支出计入并购支付给前股东的现金。

（三）筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	19,200.00	494,192.67	7,736.05
取得借款收到的现金	11,122.55	20,724.00	-
筹资活动现金流入小计	30,322.55	514,916.67	7,736.05
偿还债务支付的现金	27,104.06	3,244.37	313.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229.44	3,063.18	2,471.28
筹资活动现金流出小计	27,333.50	6,307.55	2,785.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,989.05	508,609.12	4,950.96

最近三年，标的公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,950.96 万元、508,609.12 万元和 2,989.05 万元。

报告期内，标的公司筹资活动保持净流入状况，现金流入主要报告期内标的公司吸收投资所致。其中，2015 年度，标的公司获得原股东上海承裕、屹唐投资、华清闪胜和华创芯原的增资，公司注册资本由 1,000 万元增加至 50,000 万元，相关出资额于 2015 年 11 月 31 日全部实缴到位。2016 年，公司新增股东闪胜创芯，注册资本由 50,000.00 万元增加至 51,966.949 万元，增加的注册资本 1,966.949 万元全部由闪胜创芯认缴，2016 年 8 月 26 日，上述出资实缴到位。

六、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务相关指标的影响分析

（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响

1、本次交易对上市公司主营业务的影响

上市公司与标的公司均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。主要产品方面，本次交易前，上市公司主营产品以 NOR FLASH 等非易失性存储芯片为主，标的公司则以 DRAM 和 SRAM 等易失性存储芯片为主。本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。

报告期内，上市公司和标的公司均具有良好的盈利表现。根据半导体协会数据，2012 年以来兆易创新为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业。2016 年 8 月上市后，公司成为 A 股市场中少数的半导体存储行业上市公司之一，在我国本土电子产业中的存储芯片市场优势明显。

标的公司的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，标的公司积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次收购完成后，兆易创新将与北京矽成在现有的客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，借助彼此在国内和海外市场积累的研发实力和优势地位，实现上市公司业务上的有效整合。同时，通过存储芯片产品品类的扩充，以及产品适用领域逐渐迈入专用级应用市场，上市公司产品的市场占有率将迎来进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。

此外，本次交易收购北京矽成将为上市公司引进存储芯片研发设计领域的优秀研发人员以及国际化管理团队，为上市公司进一步快速发展和国际化纵深发展注入动力。本次交易完成后，上市公司与北京矽成将在员工激励、培训、管理等多方面相互形成正向反馈，提升上市公司和北京矽成的整体运营效率。

2、本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易中，上市公司编制了备考财务报表，即假设本次收购于 2015 年 1 月 1 日已经完成，北京矽成已经自 2015 年 1 月 1 日起成为上市公司公司控制的全资子公司。根据中兴华会计师出具的《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告书》（中兴华阅字（2017）第 010005 号），本次交易前后上市公司的盈利能力分析如下：

单位：万元

项目	2016 年度		
	交易前	交易后 (备考)	变动率
营业总收入	148,894.82	362,534.03	143.48%
营业收入	148,894.82	362,534.03	143.48%
营业总成本	132,755.60	331,493.14	149.70%
营业成本	109,109.04	244,336.01	123.94%
营业税金及附加	554.34	554.34	-
销售费用	5,275.25	25,438.63	382.23%
管理费用	18,826.42	54,510.27	189.54%
财务费用	-2,463.84	-2,727.13	10.69%
资产减值损失	1,454.39	9,381.03	545.02%
加：投资收益	67.30	2,328.94	3360.38%
营业利润	16,206.52	33,369.84	105.90%
加：营业外收入	2,628.49	3,088.81	17.51%
减：营业外支出	258.36	258.36	-
利润总额	18,576.65	36,200.29	94.87%
减：所得税	1,106.82	4,443.22	301.44%
净利润	17,469.83	31,757.08	81.78%
减：少数股东损益	-172.93	58.92	-134.07%
归属于母公司所有者的净利润	17,642.76	31,698.15	79.67%
项目	2015 年		
	交易前	交易后 (备考)	变动率
营业总收入	118,878.02	312,453.54	162.84%
营业收入	118,878.02	312,453.54	162.84%
营业总成本	102,605.71	288,277.87	180.96%
营业成本	84,800.27	211,362.68	149.25%

营业税金及附加	404.62	404.62	-
销售费用	3,824.52	19,656.11	413.95%
管理费用	14,163.05	54,465.65	284.56%
财务费用	-1,991.00	-3,545.48	78.08%
资产减值损失	1,404.25	5,934.30	322.60%
投资收益	36.38	5,946.87	16246.54%
营业利润	16,308.70	30,122.54	84.70%
加：营业外收入	1,896.13	1,896.13	-
减：营业外支出	80.34	97.23	21.02%
利润总额	18,124.48	31,921.44	76.12%
减：所得税	2,527.40	10,182.31	302.88%
净利润	15,597.09	21,739.13	39.38%
减：少数股东损益	-181.17	55.33	-130.54%
归属于母公司所有者的净利润	15,778.26	21,683.81	37.43%

本次交易前，2015 年度以及 2016 年度，兆易创新归属于母公司所有者净利润分别为 15,778.26 万元和 17,642.76 万元。本次交易完成后，公司经营规模和盈利能力均显著提升。2015 年和 2016 年，上市公司交易完成后营业收入分别较交易前增长 162.84%和 143.48%。交易完成后的利润总额较交易前同比增长 76.12%和 94.87%，净利润较本次交易完成前同比增长 39.38%和 81.78%。

上市公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，本次交易完成后，兆易创新将整合并购双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与标的资产相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。

3、本次交易对上市公司资产负债主要构成及财务安全性影响分析

根据瑞华会计师出具的上市公司 2015 年度和 2016 年度《审计报告》（瑞华审字[2016]01500512 号和瑞华审字[2017]01500195 号）、中兴华会计师出具的《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告书》（中兴华阅字（2017）第 010005 号），假设本次交易已于 2015 年 1 月 1 日完成，则本次交易后上市公司的财务状况和财务安全性分析如下：

(1) 交易前后资产结构分析

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日					
	交易前		交易后（备考）		变动情况	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产：						
货币资金	87,155.92	52.20	176,606.83	20.26	89,450.90	102.63
应收账款	10,314.48	6.18	51,535.00	5.91	41,220.53	399.64
预付款项	254.36	0.15	12,870.42	1.48	12,616.06	4959.88
其他应收款	2,542.50	1.52	2,844.34	0.33	301.84	11.87
存货	40,676.29	24.36	92,104.87	10.57	51,428.57	126.43
一年内到期的非流动资产	424.08	0.25	424.08	0.05	-	-
其他流动资产	2,145.55	1.29	7,039.02	0.81	4,893.47	228.07
流动资产合计	143,513.19	85.95	343,424.56	39.40	199,911.37	139.30
非流动资产：						
可供出售金融资产	8,622.09	5.16	8,622.09	0.99	-	-
长期应收款	-	-	49,896.06	5.72	49,896.06	-
长期股权投资	2,379.98	1.43	3,310.18	0.38	930.19	39.08
固定资产	7,552.76	4.52	38,337.46	4.40	30,784.70	407.60
在建工程	1,867.54	1.12	1,867.54	0.21	-	-
无形资产	518.93	0.31	67,404.96	7.73	66,886.03	12889.11
开发支出	-	-	6,088.44	0.70	6,088.44	-
商誉	383.00	0.23	342,186.45	39.26	341,803.44	89242.96
长期待摊费用	274.41	0.16	274.41	0.03	-	-
递延所得税资产	1,553.12	0.93	8,825.55	1.01	7,272.44	468.25
其他非流动资产	300.00	0.18	1,365.55	0.16	1,065.55	-
非流动资产	23,451.84	14.05	528,178.68	60.60	504,726.84	2152.18
资产总计	166,965.03	100.00	871,603.24	100.00	704,638.21	422.03
项目	2015 年 12 月 31 日					
	交易前		交易后（备考）		变动情况	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产：						
货币资金	41,974.87	46.65	98,424.17	13.19	56,449.30	134.48

应收账款	12,695.24	14.11	37,997.18	5.09	25,301.94	199.30
预付款项	497.15	0.55	8,499.31	1.14	8,002.16	1609.61
其他应收款	894.97	0.99	1,211.51	0.16	316.54	35.37
存货	21,976.43	24.42	82,049.77	10.99	60,073.34	273.35
其他流动资产	1,794.09	1.99	6,752.87	0.90	4,958.78	276.40
流动资产合计	79,832.75	88.72	234,934.81	31.48	155,102.06	194.28
非流动资产：						
可供出售金融资产	2,408.24	2.68	17,556.94	2.35	15,148.70	629.04
长期应收款	-	-	38,675.79	5.18	38,675.79	-
长期股权投资	-	-	876.71	0.12	876.71	-
固定资产	4,698.08	5.22	44,702.21	5.99	40,004.13	851.50
在建工程	32.37	0.04	32.37	0.00	-	-
无形资产	-	-	69,929.53	9.37	69,929.53	-
开发支出	-	-	318.04	0.04	318.04	-
商誉	145.00	0.16	326,611.29	43.76	326,466.29	225161.17
长期待摊费用	987.97	1.10	987.97	0.13	-	-
递延所得税资产	1,875.51	2.08	9,885.36	1.32	8,009.85	427.08%
其他非流动资产			1,874.93	0.25	1,874.93	-
非流动资产	10,147.18	11.28	511,451.14	68.52	501,303.96	4940.33
资产总计	89,979.92	100.00	746,385.95	100.00	656,406.03	729.50

根据上市公司备考合并资产负债表，截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，本次交易对上市公司资产总额的影响为备考口径上市公司资产总额较实际口径分别增加 656,406.03 万元和 704,638.21 万元，增长幅度分别为 729.50% 和 422.03%。

2015 年和 2016 年，因本次交易导致上市公司资产变动的主要科目有：（1）因本次收购北京矽成导致商誉分别增加 326,466.29 万元和 341,803.44 万元；（2）无形资产分别增加 69,929.53 万元和 66,886.03 万元；（3）货币资金分别增加 56,449.30 万元和 89,450.90 万元；（4）存货分别增加 60,073.34 万元和 51,428.57 万元；（5）固定资产分别增加 40,004.13 万元和 30,784.70 万元。

从资产结构来看，本次交易对上市公司资产结构有一定的影响。本期交易前，上市公司的资产以流动资产为主。本次交易完成后，因为新增商誉的金额较大，

导致上市公司的资产以非流动资产为主，2015 年末和 2016 年末，非流动资产占比分别为 68.52%和 60.60%。除商誉外，其他资产占总资产的变动较小，固定资产和在建工程等重资产占总资产的比重基本保持稳定，上市公司仍然是典型的“轻资产”公司。

（2）交易前后负债结构分析

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日					
	交易前		交易后（备考）		变动情况	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债						
应付账款	24,495.99	62.73	53,747.71	21.80	29,251.72	119.41
预收款项	2,256.83	5.78	2,957.47	1.20	700.64	31.05
应付职工薪酬	3,534.60	9.05	13,050.05	5.29	9,515.45	269.21
应交税费	576.51	1.48	4,137.53	1.68	3,561.02	617.69
其他应付款	749.79	1.92	157,347.24	63.82	156,597.45	20885.50
一年内到期的非流动负债	-	-	173.43	0.07	173.43	-
其他流动负债	-	-	4,478.51	1.82	4,478.51	-
流动负债合计	31,613.72	80.95	235,891.94	95.67	204,278.21	646.17
非流动负债						
长期借款	-	-	3,150.55	1.28	3,150.55	-
长期应付职工薪酬	-	-	79.51	0.03	79.51	-
递延所得税负债	27.49	0.07	27.49	0.01	-	-
递延收益	7,411.42	18.98	7,411.42	3.01	-	-
非流动负债合计	7,438.92	19.05	10,668.98	4.33	3,230.06	43.42
负债合计	39,052.64	100.00	246,560.92	100.00	207,508.28	531.36
项目	2015 年 12 月 31 日					
	交易前		交易后（备考）		变动情况	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债						
应付账款	17,767.21	53.98	47,121.26	18.04	29,354.05	165.21
预收款项	1,286.60	3.91	2,140.51	0.82	853.91	66.37
应付职工薪酬	3,459.45	10.51	14,421.61	5.52	10,962.16	316.88
应交税费	1,609.20	4.89	7,453.10	2.85	5,843.90	363.16

其他应付款	466.18	1.42	176,248.73	67.46	175,782.55	37707.01
其他流动负债	-		4,139.24	1.58	4,139.24	-
流动负债合计	24,588.64	74.70	251,524.46	96.28	226,935.82	922.93
非流动负债						
长期应付职工薪酬	-	-	201.73	0.08	201.73	-
递延所得税负债	-	-	1,193.22	0.46	1,193.22	-
递延收益-非流动负债	8,327.92	25.30	8,327.92	3.19	-	-
非流动负债合计	8,327.92	25.30	9,722.87	3.72	1,394.95	16.75
负债合计	32,916.56	100.00	261,247.34	100.00	228,330.78	693.67

根据备考合并负债表，截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，备考口径负债总额较实际口径分别增加 228,330.78 万元和 207,508.28 万元，增长幅度分别为 693.67%和 531.36%。负债总额增加主要由于其他应付款、应付账款以及应付职工薪酬增加所致。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次交易完成后备考报表口径的其他应付款较本次交易前增加 156,597.45 万元，变化率为 20,885.50%，其他应付款占负债总额的比例由 1.92%大幅增长至 63.82%。其他应付款增幅较大主要系因为上市公司的备考报表在不考虑募集配套资金的情况下，将本次重组需要支付的现金对价 154,761.34 万元计入“其他应付款”科目所致。

从负债结构来看，本次交易完成后，上市公司的负债仍以流动负债为主。因为本次交易导致上市公司其他应付款的增幅较大，所以本次交易前后，流动负债占总负债的比重进一步增大。2015 年末和 2016 年末，本次交易完成后的流动负债占比分别增至 96.28%和 95.67%。

（3）交易前后偿债能力指标分析

本次交易完成前后，上市公司偿债能力指标情况如下：

财务指标	2016 年 12 月 31 日		
	本次交易前	本次交易后	变动情况
流动比率	4.54	1.46	-3.08
速动比率	3.25	1.07	-2.19
资产负债率（合并报表）	23.39%	28.29%	4.90%
财务指标	2015 年 12 月 31 日		

	本次交易前	本次交易后	变动情况
流动比率	3.25	0.93	-2.31
速动比率	1.83	0.61	-1.22
资产负债率（合并报表）	36.58%	35.00%	-1.58%

不考虑配套融资的情况下，上市公司的备考报表中将本次交易需要支付的现金对价部分计入“其他应付款”科目，因而本次交易完成后上市公司的流动负债和负债总额均大幅增加，并导致 2015 年末和 2016 年末，本次交易完成后上市公司的流动比率和速动比率指标将较本次交易前有较大幅度的下降。

此外，2016 年末上市公司的资产负债率水平也将较交易前有所增长，本次交易前上市公司的资产负债率水平因 2016 年 8 月完成首次公开发行募集资金而大幅降至 23.39%，本次交易完成后该长期偿债能力指标增至 28.29%。

作为本次交易方案的一部分，上市公司拟在发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金共计 183,000.00 万元，其中 154,761.34 万元用于本次交易的现金对价。如果考虑配套融资的影响，上市公司交易完成后的流动负债规模将大幅减少，偿债能力将大幅提升。

鉴于标的公司流动负债规模相对更大的原因，本次交易完成后上市公司的短期偿债能力仍面临短期内下降的风险，但是公司的长期偿债能力将在本次交易后得到大幅改善，利用财务杠杆融资的空间将进一步增加。

整体而言，本次交易完成后，上市公司的偿债能力受到一定的负面影响，主要系上市公司 2015 年和 2016 年的备考合并报表中未考虑募集配套资金的影响。考虑配套融资的影响后，上市公司的长期偿债能力将大幅提升，短期偿债指标因标的公司的流动负债规模相对较大仍将面临下降的风险。

（4）财务安全性分析

本次交易安排考虑了上市公司重组后的财务安全性，本次重组完成后，虽然上市公司各项偿债指标有一定变动，但是均处于合理范围。上市公司总体上经营稳健，具有较强的盈利能力和资金管理能力，现金流量正常充足，偿债能力和抗风险能力处于合理水平，不存在到期应付债务无法支付的情形。

鉴于上市公司在资本市场拥有良好的融资渠道，可通过债权或股权融资等多

种形式筹集公司未来发展所需资金。截至本报告书出具日，上市公司及标的公司不存在因未决诉讼或仲裁、对外担保等事项而形成或有负债的情形，本次交易未对上市公司的财务安全性造成重大影响。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响分析

1、本次交易对标的资产原有销售渠道稳定性的影响

标的主要经营实体 ISSI 在前次私有化完成前为美国纳斯达克上市公司，是一家具有多年运营经验的成熟公司，已形成相对完整和稳定的海外销售渠道，确保标的公司原有销售渠道的稳定性是上市公司本次并购整合计划中的重要目标之一。本次重组完成后，公司将与北京矽成紧密合作，采取以下举措保持销售渠道的稳定：

（1）为保证北京矽成原有的销售渠道的稳定性，公司将实施有效的客户沟通机制以提升北京矽成主要客户对于并购后公司的信心及认可度。

（2）标的公司将进一步维系与原有客户间的业务及合作关系，确保现有业务合同的延续性，同时保证与经销商和直销客户的合作方式及商务条款维持现状。本次交易完成后，北京矽成现有的销售网络和销售组织架构和客户关系管理系统均将保持独立运营，除了未来可能与公司存在协同项目合作外，北京矽成的日常销售及运营将保持不变。

（3）本次交易完成后，北京矽成的原核心管理团队将予以保留。上市公司计划在运营管理上保持北京矽成现有的优秀国际化核心管理层团队，全面负责北京矽成的业务、研发生产、运营管理等，并在未来将可能通过设立股权激励计划等措施加强考核激励机制。

（4）重组完成后，公司与北京矽成将在研发、采购、销售等方面形成优势互补，通过互补销售网络、拓展新兴市场、联合研发新产品等方式实现收入协同效应；通过共享研发技术、采购与销售渠道等方式实现成本协同效应，从而提升北京矽成在存储及模拟芯片领域的竞争实力，进一步增强对销售渠道的吸引力。

2、本次交易对标的公司原有客户购买意向以及标的资产业绩的影响

上市公司作为国外公司对标的公司的收购预计不会影响北京矽成现有消费

者的购买意向，主要基于以下几个方面的原因：

（1）北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛应用于汽车电子、通信设备、工业制造以及消费电子等领域。因为专用领域市场客户对于产品质量要求较高，对于北京矽成股权变动的敏感性较弱，所以标的公司与该类客户基于长期合作建立起的关系相对稳固。

（2）标的公司与客户保持良好的合作关系以及紧密的沟通和联系。北京矽成作为本次交易的标的资产，在本次交易方案披露后，已积极主动地与现有客户开展有效沟通，向客户传达本次交易完成后公司未来仍将保持稳定经营的信息。包括本次并购后标的公司将继续维持现有业务合同及商业条款，保持管理层现有运营管理模式和销售网络的独立性，保持现有研发路径及方向不变等，以进一步稳定与客户关系。

（3）本次交易完成后，为保证北京矽成的持续经营能力，缩短跨国经营管理的磨合期并尽快实现协同效应，公司将继续保留北京矽成原管理层人员，以便将北京矽成顺利纳入公司体系。本次收购仅涉及北京矽成股东的变更，北京矽成管理团队得以保留，已有的业务合同及商业条款将维持现状。北京矽成将继续由原管理层人员独立运营管理，其现有的销售网络和销售组织架构均将保持独立，其日常研发、销售及运营亦将保持不变。

（4）本次收购有利于公司与标的公司的优势互补，产生良好的协同效应。本次收购完成后，兆易创新将与北京矽成在现有的客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，借助彼此在国内和海外市场积累的研发实力和优势地位，实现上市公司业务上的有效整合。交易完成后，凭借自身的研发优势和高质量的产品，标的公司有望同时借助上市公司在客户关系、销售渠道上的前期积累，进一步拓展中国大陆等亚太市场，吸引更多的中国境内及区域内的客户，并与之建立稳固的合作关系，进而提高标的公司的经营业绩。

（5）通常而言，在产品品质相当的情况下，相较于产品品类相对单一的公司，客户更愿意选择品类更加丰富的供应商。本次重组完成后，上市公司将由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商，上市公司和标的公司均得以更好地满足客户“一站式采购”的需求，进而增

强客户的购买意愿。

（6）标的公司于 2015 年 12 月完成前次私有化收购，也为国外公司对美国公司的并购，主要经营实体 ISSI 由一家纳斯达克上市公司转变为由上海承裕、屹唐投资等中国投资机构 100%持股的私有化公司。前次股权转让完成后，北京矽成的主要经营实体的日常研发、销售以及运营均未受到不利影响，与主要客户的合作关系稳固，标的公司的经营业绩在前次私有化收购完成后保持稳健增长的良好态势。

（7）根据标的公司和上市公司各自销售渠道所对应的客户市场，参考两者历史销售经验和目前销售情况，并未发生相关产品被相关国家或地区勒令市场禁入或行业禁入的情况。

综上，公司作为国外公司对标的资产的收购预计不会影响北京矽成现有消费者的购买意向，亦不会对标的资产业绩产生不利影响。

3、本次交易对公司员工稳定性的影响

（1）本次交易完成后，标的公司管理层及核心技术人员变动情况

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》，本次交易仅涉及标的公司股东变动，不涉及标的公司及其下属企业聘用人员劳动关系的调整变更。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，仍将继续相对独立运行，上市公司将保留标的公司及其下属经营实体的核心管理团队，且将采取措施努力保证标的公司未来主要管理层、核心技术人员的稳定性。。

标的公司下属经营实体高度重视其管理层及核心技术人员的稳定性，自 1988 年 ISSI 设立至今，其管理层和各产品研发团队核心成员的流动性较低，具备较强的团队凝聚力。自公司股票因本次交易停牌日起，截至本报告书出具日，标的公司未出现管理层和核心技术人员的流失情形。

截至本报告书出具日，标的公司下属经营实体管理层及核心技术人员尚未就继续履职及期限出具承诺。根据《购买资产协议》，为保障上市公司及标的公司的利益，交易对方及标的公司将尽合理努力促使标的公司及其下属企业核心管理人员承诺在业绩承诺期满前不主动离职。上市公司将督促上述承诺的及时出具及后续履行。

综上所述，本次交易完成后，标的公司继续相对独立运行，上市公司将保留标的公司及其下属经营实体的核心管理团队，且将采取措施努力保证标的公司未来主要管理层、核心技术人员的稳定性。同时，交易对方及标的公司承诺，将尽合理努力促使标的公司及其下属企业核心管理人员承诺在业绩承诺期满前不主动离职。上市公司将督促上述承诺的及时出具及后续履行。

（2）标的公司员工已经签订竞业禁止协议

根据标的公司下属经营实体与员工签订的《保密信息和发明转让协议》，ISSI 及其下属企业的员工须在就职期间履行以下承诺：1、未经 ISSI 董事会授权，不向任何个人或实体透露保密信息。该等保密信息包括专利信息、技术数据、商业秘密或专有技术等；2、不会从事任何其他与 ISSI 新参与或已经参与的业务直接相关的工作，职业，咨询或其他业务活动的工作；3、如果与 ISSI 的雇佣关系终止，终止后的 12 个月内，将不会直接或间接招揽，诱导，招聘，鼓励任何 ISSI 员工离职或带走此类员工，或企图为自己或任何其他个人或实体招揽，诱导，招聘，鼓励或带走 ISSI 员工。

因此，标的公司下属经营实体管理层及核心技术人员已经签订竞业禁止相关协议。

（3）标的公司员工流失的具体影响及具体措施

标的公司北京矽成作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成标的公司拥有行业领先地位的重要保障。目前，北京矽成拥有高素质的稳定团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。若标的公司的管理层及核心技术人员出现人员流失情形，则可能降低公司的经营管理效率，阻碍公司客户渠道的维护和拓展，削弱公司的芯片研发设计能力，提高研发成本，延长研发周期，从而对公司竞争力造成负面影响。

基于未来标的公司稳定经营以及标的公司股东利润承诺实现之需要，上市公司及交易对方协商采取了一系列措施，以保障标的公司经营团队核心人员未来数年内的稳定性，并充分激励标的的经营团队核心人员发挥主观能动性，推动标的公司芯片研发设计业务加速发展。相关措施具体如下：

1) 本次交易不改变标的公司现有主要管理人员和员工结构

根据上市公司与交易对方达成的《购买资产协议》，本次交易不涉及标的公司及其下属企业聘用人员劳动关系的调整变更，以保证北京矽成经营管理团队的稳定性。本次交易后，北京矽成继续存续并独立运营，上市公司仍将保留北京矽成核心管理团队，以保证其后续经营的稳定性。

2) 标的公司具备规范成熟的人力资源管理机制，历史期核心人员稳定

标的公司下属经营实体 ISSI 于 1995 年在美国纳斯达克上市，具有规范成熟的人力资源管理机制，在员工的激励、沟通等方面具有较为完善的制度支撑。

员工的激励方面，标的公司对其核心人员实行具有市场竞争力的薪酬制度和奖励制度。其中，ISSI 于 2007 年开始实施股权激励计划，包括股票期权、股票增值权、限制性股票和红股等多种方式。ISSI 私有化收购完成后，由于其股票不具有二级市场交易价格，ISSI 将剩余未实施的股权激励计划金额全部转化为现金激励计划。截至 2016 年 9 月 30 日，北京矽成下属经营实体 ISSI 实施中的现金激励计划总额达到 1,260 万美元，将根据员工的在职时间及表现分期实施。

员工的沟通方面，标的公司一贯保持决策和执行层面顺畅的沟通交流、高效的工作效率、强烈的团队精神为理念的管理风格，保障了其核心管理团队在历史以及未来维持持续稳定的团队结构。

上述规范成熟的人力资源管理机制，能够有效保证标的公司核心人员稳定性。

3) 交易完成后交易对方和标的公司将促使管理层和核心技术人员做出长期服务承诺

根据上市公司与交易对方达成的《购买资产协议》，为保障上市公司及标的公司的利益，交易对方和标的公司将尽合理努力促使标的公司及其下属企业核心管理人员承诺在业绩承诺期满前不主动离职。该等承诺将进一步降低标的公司管理层和核心技术人员在业绩承诺期内的流失风险。上市公司将督促上述承诺的及时出具及后续履行。

4) 本次交易完成后上市公司将促进标的公司管理团队与人员的整合

人力资源是上市公司与标的公司核心竞争力的体现之一，优秀的管理、技术及销售人才是企业正常运作至关重要和不可替代的因素。

本次交易完成后，北京矽成将作为上市公司的全资子公司继续存续并独立运营，上市公司将在保持和优化北京矽成原有的组织结构和各部门的职能基础上，增强双方员工的渗透融合，致力通过与北京矽成的经营管理层和骨干员工进行充分沟通，通过各类有效激励措施促使该等员工继续履行服务的承诺。该等员工将作为上市公司员工共同参与公司未来推出的各类激励计划。

上市公司计划未来将给予北京矽成管理层在日常管理中充分的自由度，以激发其主观能动性，努力完成既定目标。同时，公司将通过董事会和股东会的周期性监督、决策机制，对北京矽成战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。

上市公司将通过制定和实施有效的企业文化整合计划，提倡相互尊重、理解各自的文化背景，促进团队成员在交流、组织、决策时具备全球化思维和视角，进而形成相互包容，相互信任的企业文化基础。另外，上市公司将谨慎地制定公司层面的沟通机制和有针对性的培训计划，确保降低误解风险，提高各级员工相互理解的能力，并保证在组织中各类信息的顺畅沟通和传达。

5) 本次交易将进一步优化标的公司基本面，增强人才吸引力

标的公司为全球领先的 DRAM、SRAM 设计厂商，其 DRAM 和 SRAM 产品收入分别在全球市场位居第八位和第二位，发展态势良好。本次交易为同行业产业并购，上市公司与标的公司在产品类型、销售区域、销售客户、技术研发等多方面都有较强的协同效应。交易完成后，将使双方在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升持续盈利能力，从而增强人才吸引力，保障员工稳定性。

6) 交易完成后上市公司将继续加大优秀人才引进及培养力度，充实行业管理人员和核心技术人员储备

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的思想，集成电路企业需要加强与境外研发机构的合作，加大针对海外优秀企业家和高素质技术、管理团队的引进力度，完善鼓励创新创造的分配激励机制，以此扩大国际合作、整合国际资

源、拓展国际市场，实现我国集成电路产业的跨越式发展。

上市公司从事存储芯片设计业务，对存储芯片设计业务的运营和研发理解深刻，已经培养及引进一批经验丰富的行业管理和研发人才。上市公司将始终秉承以人才为企业核心竞争力的发展导向，在交易完成后继续培养和引进存储芯片研发设计领域的高端管理和研发人才，以保证在出现人才流失风险的情形下，能有合适的人员替代，保持公司日常经营的稳定性。

4、本次交易的整合计划

（1）业务及资产的整合

本次收购完成后，上市公司将与标的公司共享客户和渠道资源，借助彼此在国内和海外市场积累的研发优势和竞争优势，进一步扩大公司产品市场占有率，实现在业务和资产上的有效整合。

一方面，标的公司的实际经营实体 ISSI 的前身为美国纳斯达克上市公司，经过 20 余年的发展，ISSI 积累了大量的客户资源并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。本次交易完成后，标的公司在海外市场的竞争优势将有助于上市公司进一步拓展海外存储芯片市场，整合海外优质客户资源，扩大产品市场占有率，将公司打造成为全球化的集成电路存储设备及衍生产品的研发设计、技术支持和销售经营平台。

另一方面，北京闪胜于 2016 年 8 月完成首次公开发行股票并上市，成为 A 股市场中少数的半导体存储行业上市公司之一，在我国本土集成电路存储芯片市场的优势明显。本次交易完成后，上市公司将持续为标的公司开拓中国大陆市场提供渠道、人员和技术等多方面的支持，帮助标的公司进一步提升亚太市场的占有率。

（2）人员的整合

上市公司和标的公司均为以芯片研发设计为主营业务的公司，人才优势是公司的核心竞争力之一，为保持标的公司经营活动的连贯性与核心竞争力，本次交易完成后，上市公司将采取措施努力保证标的公司未来主要管理层、核心技术人员的稳定性。

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》，本次交易仅涉及标的公司股东变动，不涉及标的公司及其下属企业聘用人员劳动关系的调整变更。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，仍将继续相对独立运行，上市公司将保留标的公司及其下属经营实体的核心管理团队，并采取措施努力保证标的公司未来主要管理层、核心技术人员稳定性。随着上市公司与标的公司人员、团队的深度整合，上市公司在集成电路存储芯片领域的知名度和业务规模将不断提升，也将吸引更多全球顶尖的行业精英加入公司。

（3）治理结构的整合

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，在本次交易前已经建立健全了相关法人治理结构的基本架构，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，其仍将以独立法人主体的形式存在。公司将保持北京矽成现有组织架构及管理层基本不变，各业务及管理部门将继续保持高效运转。上市公司层面，公司将继续依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，进一步健全法人治理结构，完善公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平，维护股东和广大投资者的利益。

（4）财务体系的整合

本次交易完成后，上市公司将把标的公司纳入上市公司统一财务管理体系之中。标的公司将参照上市公司财务核算原则，完善现有的财务管理制度。未来上市公司将根据业务发展不同阶段的实际需求，在保证财务稳健的前提下，积极利用多种方式筹措资金，优化资本结构，提高股东回报率，促进上市公司与北京矽成的稳健经营和良性发展。

（5）企业文化的整合

本次交易完成后，公司将加强与标的公司之间的战略沟通和文化整合，相互吸收对方在内部管理、员工福利、团队建设方面的良好经验，加强企业文化的宣传和贯彻，使北京矽成的管理层和核心人员更好地了解上市公司的企业文化，促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多角度的交流，融入上市公司

体系，营造良好的企业文化氛围，增强企业的凝聚力，共同追求让员工、客户、股东满意的企业使命。

5、本次交易后上市公司的发展计划

（1）技术和产品研发计划

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，上市公司计划在交易当年和未来两年继续加大技术投入，提升包括北京矽成在内的公司整体在技术研发、新产品开发等方面的综合实力，同时通过外部引进与自主培养相结合的方式加强技术人才队伍的建设。主要技术和产品研发计划如下：

a、NOR Flash 技术及产品改造

公司在原有 NOR Flash 的基础上，开发并完善 90nm、65nm 和 45nm 工艺节点的 NOR Flash，丰富公司的 NOR Flash 产品线，同时建设相应的芯片研发实验室，配置用于产品升级改造的相关研发设备。

b、NAND Flash 技术开发、应用及产业化

开发 3X/2X nm 及更先进制程的 NAND Flash 产品，设计开发功能和性能强大的 NAND Flash 系列芯片，及 NAND Flash 综合应用解决方案，服务中低容量快闪存储器芯片市场需求,同时瞄准 eMMC、SSD 等应用市场，满足智能化产品和大容量市场需求。

c、通用 MCU 芯片研发及产业化

在现有产品线基础上，进一步丰富产品种类，开发各种应用方案，完善各种软件算法；同时开发 55nm 及更先进工艺节点的通用 MCU 芯片，显著降低 MCU 芯片的制造成本和动态功耗，扩大芯片的应用领域，同时围绕 MCU 芯片在不同应用领域需求，开发相应的接口软件程序。

d、建设研发中心

在公司现有技术部门的基础上，建设研发中心、增加相关研发设备、储备相关基础技术，主要建设包括新型非易失性存储芯片实验室、下一代 NAND Flash 存储芯片实验室、下一代存储芯片测试技术实验室在内的三个主要实验室，用于研究下一代存储芯片前沿技术，缩小与国际一流厂商的技术差距。

e、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存(4G-16G)解决方案开发项目

该项目系本次发行股份募集配套资金主要用途之一，项目将基于标的公司原有 DRAM、SRAM、FLASH 等存储芯片技术的基础，主要面向下游以智能手机、平板电脑等移动智能终端为代表的通信和消费类市场，有利于公司借助标的公司切入 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存解决方案领域。项目主要建设内容为基于 28nm Nand Flash 闪存的 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存(4G-16G)解决方案，通过本项目，开发实现支持 TLC 和 MLC NAND Flash 的兼容 eMMC5.1 协议嵌入式存储方案。

（2）人力资源计划

首先，本次重组完成后，公司将采取措施维持标的公司主要管理团队和核心技术人员稳定性。其次，上市公司将加强对企业现有员工的持续培训，通过岗位培训和外出交流等多种方式，保证公司员工队伍的稳定和能力持续提升。再次，公司将通过社会招聘、校企合作等多种方式从外部引进高水平技术专家和管理人才。最后，对公司人力资源进行有效配置，完善和加强对人才激励机制的建设，特别是关键管理岗位和技术岗位的薪酬体制和激励机制，为员工提供多样化的发展空间和成长机会，努力促进员工和企业的共同成长，吸引和鼓励优秀人才为公司长期服务。

（3）市场营销计划

本次重组完成后，公司将持续开拓海外市场，通过标的公司在海外市场积累的优质客户资源和良好的销售渠道，更深入地切入欧美及台湾、香港等亚太地区市场。通过境内境外市场的拓展，巩固和增强公司的市场地位。并结合新开发产品，实现公司产品在智能手机、平板电脑、汽车电子等高端应用领域的渗透。

公司将在直销和经销相结合的销售模式基础上，进一步深化上市公司及标的公司各销售片区的市场开发和售后服务工作，加大产品宣传和市场信息收集力度，提升销售服务能力和品牌影响力。

在充分利用标的公司的销售渠道和海外销售团队的同时，公司将进一步加强市场拓展力度并扩大销售队伍，细化营销管理，优化整个营销网络系统的资金流、物流与信息流，使公司更及时地了解市场动态，高效率地管理企业的营销资

源，提高企业的服务能力、客户满意度和市场美誉度。

（4）市场融资计划

公司在本次交易完成后，将重点做好前次首次公开发行发行和本次配套资金募集的资金投资项目的建设，努力创造良好的经营业绩。同时，公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提下，运用多种方式进行市场融资，以满足业务发展的需要。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

1、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次交易前后，上市公司主要财务指标情况如下：

项目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度		2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考)	本次交易前	本次交易后 (备考)
资产总额（万元）	166,965.03	871,603.24	89,979.92	746,385.95
归属上市公司股东所有者权益（万元）	127,853.57	623,092.23	57,127.89	483,628.07
营业收入（万元）	148,894.82	362,534.03	118,878.02	312,453.54
利润总额（万元）	18,576.65	36,200.29	18,124.48	31,921.44
归属母公司所有者的净利润（万元）	17,642.76	31,698.15	15,778.26	21,683.81
资产负债率	23.39%	28.29%	36.58%	35.00%
毛利率	26.72%	32.60%	28.67%	32.35%
每股收益	1.81	2.40	1.89	1.89

从财务状况来看，本次交易完成后，上市公司资产总额、净资产均大幅增加。不考虑配套融资的情况下，本次交易支付现金对价部分计入“其他应付款”中，交易完成后，上市公司截至 2016 年 12 月 31 日的资产负债率有所提高提升。

从盈利能力来看，本次交易完成后，上市公司的经营规模增长显著，营业收入和利润总额均大幅上升。同时，毛利率等盈利指标也进一步增长。

2、本次交易对每股收益的影响

根据中兴华会计师出具的上市公司备考审阅报告，假设兆易创新于 2015 年初已完成本次重组，本次交易对兆易创新扣除非经常性损益后归属于母公司股

东的每股收益影响情况如下：

项目	2016 年		2015 年	
	交易前	交易后	交易前	交易后
每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89
稀释每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89

注：每股收益计算中不考虑配套募集资金发行股份的影响。分子为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分母为加权平均股本数。

2015 年，本次交易完成前后的每股收益指标基本保持不变。2016 年，随着标的公司主营业务收入的 growth 以及期间费用率的同比下降，在人民币汇率贬值的放大效应下，本次交易完成后上市公司的每股收益指标较本次交易前以及 2015 年同比均得到较大提升。综上，本次交易有利于提高上市公司的每股收益，保护投资者利益。

（四）本次交易对上市公司的其他影响

1、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，其未来的资本性支出计划将纳入上市公司未来的年度计划、发展规划中统筹考虑。为实现顺利整合或业务的进一步发展，可能需要新增与标的公司相关的资本性支出，上市公司将按照《公司章程》履行必要的决策和信息披露程序。

2、职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及标的公司的职工安置方案。

3、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易成本主要包括与本次交易相关的税费以及聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构的费用，本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，对上市公司的现金流和净利润均不构成重大影响。

第十章 财务会计信息

一、北京矽成最近三年合并备考财务报告

（一）北京矽成最近三年备考合并财务报表审计情况

中兴华会计师对北京矽成编制的 2014 年、2015 年和 2016 年的备考合并财务报表及附注进行了审计，并出具了中兴华专字（2017）第 010161 号和 010162 号标准无保留意见审计报告。

（二）北京矽成备考合并财务报表

北京矽成经审计的 2014 年、2015 年和 2016 年备考合并财务报表如下：

1、备考合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	894,509,042.37	564,493,010.00	808,614,958.18
应收账款	412,205,280.62	253,019,455.12	316,570,289.38
预付款项	126,160,578.86	80,021,561.38	52,623,846.69
其他应收款	3,018,394.04	3,165,402.72	3,896,554.72
存货	514,285,719.07	600,733,449.14	539,113,638.34
其他流动资产	48,934,664.22	49,587,772.50	38,425,502.66
流动资产合计	1,999,113,679.18	1,551,020,650.86	1,759,244,789.97
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	151,487,051.51	126,941,959.26
长期应收款	498,960,609.66	386,757,926.38	-
长期股权投资	9,301,930.41	8,767,126.24	8,600,340.17
固定资产	307,846,953.36	400,041,247.52	443,396,514.62
无形资产	668,860,290.98	699,295,260.16	737,070,374.14
开发支出	60,884,356.37	3,180,383.46	-
商誉	2,399,500,153.16	2,246,128,613.89	2,116,554,913.82
递延所得税资产	72,724,375.20	80,098,471.58	111,262,747.11
其他非流动资产	10,655,460.92	18,749,263.49	7,310,913.89

非流动资产合计	4,028,734,130.06	3,994,505,344.23	3,551,137,763.01
资产总计	6,027,847,809.24	5,545,525,995.09	5,310,382,552.98
流动负债：			
应付账款	292,517,223.91	293,540,486.66	309,012,326.98
预收款项	7,006,370.00	8,539,084.00	12,834,602.50
应付职工薪酬	95,154,482.65	109,621,591.52	55,223,385.68
应交税费	35,610,236.25	58,439,055.80	35,018,645.38
其他应付款	18,361,126.24	210,212,118.92	182,910,270.65
一年内到期的非流动负债	1,734,250.00	-	27,443,715.00
其他流动负债	44,785,056.95	41,392,446.69	40,242,343.90
流动负债合计	495,168,746.00	721,744,783.59	662,685,290.09
非流动负债：			
长期借款	31,505,544.02	-	-
长期应付职工薪酬	795,070.38	2,017,321.26	24,191,894.83
递延所得税负债	-	11,932,232.34	65,984,157.45
非流动负债合计	32,300,614.40	13,949,553.60	90,176,052.28
负债合计	527,469,360.40	735,694,337.19	752,861,342.37
所有者权益			
归属于母公司所有者权益合计	5,481,465,731.14	4,794,080,937.59	4,544,436,022.82
少数股东权益	18,912,717.70	15,750,720.31	13,085,187.79
所有者权益合计	5,500,378,448.84	4,809,831,657.90	4,557,521,210.61
负债和所有者权益总计	6,027,847,809.24	5,545,525,995.09	5,310,382,552.98

2、备考合并利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	2,136,392,161.28	1,935,755,154.47	2,037,598,991.27
其中：营业收入	2,136,392,161.28	1,935,755,154.47	2,037,598,991.27
二、营业总成本	1,987,375,394.35	1,856,721,607.55	2,027,133,095.55
其中：营业成本	1,352,269,691.44	1,265,624,060.42	1,454,090,935.04
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	201,633,764.69	158,315,850.24	159,215,649.01
管理费用	356,838,463.40	403,026,026.90	376,749,940.55
财务费用	-2,632,914.71	-15,544,816.09	-1,625,753.45

资产减值损失	79,266,389.53	45,300,486.08	38,702,324.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	22,616,407.14	59,104,875.16	49,143,622.42
三、营业利润	171,633,174.07	138,138,422.08	59,609,518.14
加：营业外收入	4,603,241.30	-	512,192.81
其中：非流动资产处置利得	933,914.14	-	-
减：营业外支出	-	168,845.70	35,314.96
其中：非流动资产处置损失	-	168,845.70	35,314.96
四、利润总额	176,236,415.37	137,969,576.38	60,086,395.99
减：所得税费用	33,363,916.19	76,549,121.05	42,830,749.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,872,499.18	61,420,455.33	17,255,646.70
归属于母公司所有者的净利润	140,553,956.88	59,055,444.65	15,640,440.44
少数股东损益	2,318,542.30	2,365,010.68	1,615,206.26

3、备考合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,184,424,910.79	2,010,193,584.13	2,011,389,131.80
收到的税费返还	-	12,311,790.39	12,722,807.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,689,519.68	3,143,579.51	1,524,913.24
经营活动现金流入小计	2,191,114,430.47	2,025,648,954.03	2,025,636,852.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,785,403.40	1,399,715,064.90	1,381,567,829.37
支付给职工以及为职工支付的现金	231,208,133.91	409,885,352.91	272,140,864.48
支付的各项税费	58,439,055.80	34,468,992.38	44,640,532.31
支付其他与经营活动有关的现金	251,646,367.75	449,356,202.36	204,059,219.29
经营活动现金流出小计	2,012,078,960.86	2,293,425,612.55	1,902,408,445.45
经营活动产生的现金流量净额	179,035,469.61	-267,776,658.52	123,228,407.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	167,436,494.42	13,197,668.18	36,181,994.99
取得投资收益收到的现金	6,728,190.87	7,634,928.43	49,143,622.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,514,064.74	-	-
处置子公司及其他营业单位收到	-	150,320,908.04	-

的现金净额			
投资活动现金流入小计	262,678,750.03	171,153,504.65	85,325,617.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,701,514.68	435,124,718.85	189,119,968.44
并购支付给前股东的现金	-	4,808,690,299.00	-
投资活动现金流出小计	172,701,514.68	5,243,815,017.85	189,119,968.44
投资活动产生的现金流量净额	89,977,235.35	-5,072,661,513.20	-103,794,351.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	4,941,926,729.82	77,360,512.79
取得借款收到的现金	111,225,500.00	207,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	303,225,500.00	5,149,166,729.82	77,360,512.79
偿还债务支付的现金	271,040,592.62	32,443,715.00	3,138,159.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,294,427.21	30,631,833.89	24,712,773.11
筹资活动现金流出小计	273,335,019.83	63,075,548.89	27,850,933.06
筹资活动产生的现金流量净额	29,890,480.17	5,086,091,180.93	49,509,579.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,655,133.51	10,449,158.38	-21,351,673.83
五、现金及现金等价物净增加额	317,558,318.64	-243,897,832.41	47,591,962.11
加：期初现金及现金等价物余额	556,045,401.35	799,943,233.76	752,351,271.65
六、期末现金及现金等价物余额	873,603,719.99	556,045,401.35	799,943,233.76

二、上市公司备考合并财务报告

（一）兆易创新最近两年备考合并财务报表审阅情况

中兴华会计师对北京矽成编制的 2015 年和 2016 年的备考合并财务报表及附注进行了审阅，并出具了中兴华阅字（2017）第 010005 号审阅报告。

（二）兆易创新备考合并财务报表

兆易创新经审阅的 2015 年和 2016 年备考合并财务报表如下：

1、备考合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,766,068,266.18	984,241,682.38

应收账款	515,350,035.13	379,971,834.62
预付款项	128,704,202.97	84,993,055.90
其他应收款	28,443,387.72	12,115,107.81
存货	921,048,668.13	820,497,708.97
一年内到期的非流动资产	4,240,819.31	
其他流动资产	70,390,207.76	67,528,721.20
流动资产合计	3,434,245,587.20	2,349,348,110.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,220,903.85	175,569,431.11
长期应收款	498,960,609.66	386,757,926.38
长期股权投资	33,101,756.46	8,767,126.24
固定资产	383,374,577.61	447,022,061.18
在建工程	18,675,399.40	323,700.00
无形资产	674,049,635.11	699,295,260.16
开发支出	60,884,356.37	3,180,383.46
商誉	3,421,864,454.72	3,266,112,915.45
长期待摊费用	2,744,120.60	9,879,716.16
递延所得税资产	88,255,547.73	98,853,581.19
其他非流动资产	13,655,460.92	18,749,263.49
非流动资产合计	5,281,786,822.43	5,114,511,364.82
资产总计	8,716,032,409.63	7,463,859,475.70
流动负债：		
应付账款	537,477,121.08	471,212,633.83
预收款项	29,574,700.33	21,405,080.26
应付职工薪酬	130,500,529.21	144,216,098.26
应交税费	41,375,305.96	74,531,023.77
其他应付款	1,573,472,404.13	1,762,487,319.44
一年内到期的非流动负债	1,734,250.00	-
其他流动负债	44,785,056.95	41,392,446.69
流动负债合计	2,358,919,367.66	2,515,244,602.25
非流动负债：		
长期借款	31,505,544.02	-
长期应付职工薪酬	795,070.38	2,017,321.26

递延所得税负债	274,947.44	11,932,232.34
递延收益	74,114,206.33	83,279,180.27
非流动负债合计	106,689,768.17	97,228,733.87
负债合计	2,465,609,135.83	2,612,473,336.12
所有者权益：		
归属于母公司所有者权益合计	6,230,922,314.44	4,836,280,748.15
少数股东权益	19,500,959.36	15,105,391.43
所有者权益合计	6,250,423,273.80	4,851,386,139.58
负债和所有者权益总计	8,716,032,409.63	7,463,859,475.70

2、备考合并利润表

单位：元

项目	2016 年	2015 年度
一、营业总收入	3,625,340,333.30	3,124,535,374.25
其中：营业收入	3,625,340,333.30	3,124,535,374.25
二、营业总成本	3,314,822,588.34	2,882,778,687.08
其中：营业成本	2,443,360,077.02	2,113,626,762.02
营业税金及附加	5,543,352.44	4,046,173.02
销售费用	254,386,295.42	196,561,093.72
管理费用	545,102,706.11	544,656,497.29
财务费用	-27,271,300.89	-35,454,841.74
资产减值损失	93,810,279.73	59,343,002.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	23,289,438.93	59,468,697.08
三、营业利润	333,698,362.40	301,225,384.25
加：营业外收入	30,888,145.39	18,961,272.96
其中：非流动资产处置利得	933,914.14	
减：营业外支出	2,583,592.43	972,251.82
其中：非流动资产处置损失	1,316,727.78	335,783.18
四、利润总额	362,002,915.37	319,214,405.39
减：所得税费用	44,432,151.85	101,823,080.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,570,763.51	217,391,324.78
归属于母公司所有者的净利润	316,981,543.94	216,838,051.83
少数股东损益	589,219.57	553,272.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-

七、综合收益总额	317,570,763.51	217,391,324.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,981,543.94	216,838,051.83
归属于少数股东的综合收益总额	589,219.57	553,272.95

三、ISSI 最近三年财务数据

（一）ISSI 主要财务数据的编制基础

报告期内，ISSI 未经审计财务报表系按照美国会计准则（US GAAP）编制，其中 ISSI 2016 年未经审计财务报表系模拟合并财务报表。

鉴于标的公司北京矽成在前次私有化收购 ISSI 100%股权后，于 2016 年第四季度进行了集团内的架构调整。调整前的架构为闪胜科技通过 ISSI 持有其下属子公司股权。调整后的新架构中，原由 ISSI 直接持有的 Si En Cayman 及其下属子公司和 ISSI Cayman 及其下属子公司，由闪胜科技直接持有。

在整个架构调整前后，ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 始终受同一控制方——北京矽成半导体有限公司所控制，且始终由其 100%的控股子公司闪胜科技持有。相应地，在调整前的 ISSI 层面，与调整后在 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 的层面，可以认为是受同一方控制的持续经营下的合并会计方式披露其同口径经营业绩。

为保持与本次重组预案中的披露口径一致，以下披露的 ISSI 主要财务数据为北京矽成架构调整完成后编制的 ISSI、Si En Cayman、ISSI Cayman 层面 2016 年的备考合并的财务信息，包括合并相加的备考资产负债表、备考利润表。上述公司间余额、交易及上述公司内部交易产生的未实现利润已经在相应的财务信息中抵消。

（二）报告期内 ISSI 主要财务数据

报告期内，按照美国会计准则（US GAAP）编制的 ISSI 未经审计的财务报表数据如下：

1、资产负债表

2014 年 12 月 31 日，2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，ISSI 的主要财务状况如下表所示：

单位：万美元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	12,860.36	8,471.41	13,214.82
应收账款	5,942.13	3,896.44	5,173.56
存货	7,413.66	10,730.52	8,810.49
预付账款及其他流动资产	2,554.36	2,044.70	1,551.66
流动资产合计	28,770.51	25,143.07	28,750.53
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	2,332.87	1,021.50
长期应收款	7,192.74	5,955.99	-
长期股权投资	134.09	135.01	140.55
固定资产	4,437.75	6,160.55	5,734.98
无形资产	11,608.59	13,235.66	2,072.03
商誉	32,049.23	32,049.23	917.75
递延所得税资产	1,045.25	1,233.50	1,053.94
其他非流动资产	153.60	288.73	119.48
非流动资产合计	56,621.27	61,391.53	11,060.24
资产合计	85,391.77	86,534.61	39,810.77
流动负债			
短期借款	-	59,605.70	-
应付账款	4,216.77	4,520.46	5,050.05
预收款项	101.00	131.50	209.75
应付职工薪酬	1,368.83	1,688.15	1,036.20
应交税费	513.34	899.95	572.29
应付利息	72.53	20.16	-
其他应付款及其他流动负债	670.97	649.48	1,129.34
流动负债合计	6,943.44	67,515.39	7,997.62
非流动负债：			
长期借款	40,709.53	-	-
长期应付职工薪酬	11.46	31.07	395.36

递延所得税负债	173.58	406.64	93.06
非流动负债合计	40,894.58	437.70	488.42
负债合计	47,838.01	67,953.10	8,486.04
所有者权益：			
股本	38,405.82	18,653.40	0.31
资本公积	6,522.07	6,522.07	36,838.24
其他综合收益	166.53	57.21	-753.31
未分配利润	-7,668.65	-6,893.72	-4,974.36
归属于母公司股东权益合计	37,281.13	18,338.95	31,110.88
少数股东权益	272.64	242.56	213.85
股东权益合计	37,553.76	18,581.51	31,324.73
负债和所有者权益合计	85,391.77	86,534.61	39,810.77

注：ISSI 最近三年财务报表未经审计

2、利润表

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，ISSI 的主要经营状况以及利润构成情况如下表所示：

单位：万美元

利润表项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	32,112.19	31,079.49	33,170.52
二、营业总成本	32,950.76	34,272.29	30,950.04
减：营业成本	21,805.38	19,494.21	20,860.94
销售费用	3,530.77	3,043.76	2,775.91
管理费用	6,113.45	11,236.91	6,709.61
财务费用	309.71	-229.92	-26.47
资产减值损失	1,191.46	727.32	630.04
加：投资收益	339.95	948.96	800.02
三、营业利润	-498.62	-2,243.84	3,020.51
加：营业外收入	69.19	-	-
减：营业外成本	-	2.71	0.57
四、利润总额	-429.43	-2,246.55	3,019.93

所得税费用	455.29	-365.17	892.07
五、净利润	-884.72	-1,881.39	2,127.86
归属于母公司所有者的净利润	-919.57	-1,919.36	2,101.57
少数股东损益	34.85	37.97	26.29

注：ISSI 最近三年财务报表未经审计

报告期内，标的公司的净利润主要来源于 DRAM、SRAM、FLASH 和 ANALOG 等存储和模拟芯片的研发、设计和销售等主营业务。最近三年，标的公司的主营业务毛利润分别为 12,309.59 万美元、11,585.28 万美元和 10,306.82 万美元，毛利率水平分别为 37.11%、37.28%和 32.10%。

2015 年，ISSI 净利润较 2014 年下降幅度较大，主要系因为：（1）2015 年支付给员工激励计划的管理费用较 2014 年支付的相关激励费用增加 2,444.75 万美元；（2）2015 年因前次收购 ISSI 100%股权交易中产生的一次性咨询费、服务费等合计约 2,053.61 万美元。

2016 年，ISSI 净利润水平为-740.08 万美元，主要系北京矽成前次私有化收购 ISSI 完成后，ISSI 报表按照美国会计准则按照公允价值对存货计价，存货账面价值增值 1,661.20 万美元，该部分存货 PPA 实际自 2015 年 12 月 7 日开始处置，并于 2016 年全部处置完毕，导致 2016 年主营成本成本大幅增加。

（二）经营状况主要差异分析

报告期内，标的公司备考合并财务报表的利润总额折算为美元分别为 978.16 万美元、2,215.17 万美元和 2,649.02 万美元，相较于 ISSI 实际报表的税前利润总额，差异分别为-2,041.77 万美元、4,461.72 万美元和 3,078.45 万元。

对于 ISSI 报告期内未经审计的主要财务数据与标的公司备考合并财务报表中利润总额的主要差异，分析如下：

单位：万美元

调整事项	事项描述	影响科目 注 1	对合并备考财务报表的影响金额		
			2016 年度	2015 年度	2014 年度
存货 PPA	编制标的公司备考合并财务报表时，假设 2014 年 1 月 1 日完成前次收购 ISSI	主营业务成本	-1,479.36	-181.84	1,661.20

	100%股权。存货可辨认公允价值于账面成本之增值部分确认模拟完成收购日，生产销售的过程中所确认的销售成本在 2014 年损益中体现				
固定资产及无形资产 PPA	备考合并财务报表中假设 2014 年 1 月 1 日已完成前次收购，因前次收购产生的固定资产及无形资产 PPA 在收购完成后进行折旧或摊销，需对 2014 和 2015 年 12 月 7 日之前的期间进行补充计提	主营业务成本/管理费用	-	1,020.38	1,126.98
关联方借款	ISSI 向母公司借款于 2016 年产生的借款利息，该利息为 ISSI 的利息支出，在 ISSI 损益表中体现。在北京矽成备考合并报表层面，该内部借款利息进行了合并抵消	财务费用	-454.00	-	-
前次收购相关费用	假设 2014 年 1 月 1 日已完成前次收购，前次收购 ISSI 100%股权交易中产生的一次性咨询费、服务费等计入 2014 年 1 月 1 日之前的期间	管理费用	-	-2,053.61	-
股权激励提前行权	前次收购完成前，ISSI 实施了员工激励计划，该计划相关的部分员工激励费用计入 2014 年和 2015 年的期间费用。因为在编制备考合并报表时，假设 2014 年 1 月 1 日前次收购已经完成。所以假设前次合并基准日之前的员工激励费用在 2014 年 1 月 1 日之前已全部发生	管理费用/销售费用	-	-3,191.20	-746.45
研发支出资本化	在美国会计准则下，对于研发费用进行费用化处理，而在中国会计准则下对符合资本化条件的研发支出进行资本化处理。备考合并财务报表中，对前次收购完成后研发支出中满足资本化条件的部分，进行资本化会计调整	研发费用	-828.70	-48.98	-
其他调整因素对税前利润的影响金额合计 ^{注2}			316.39	6.47	-0.04
税前利润差异合计 ^{注3}			3,078.45	4,461.72	-2,041.77

注 1: 影响金额指标的公司备考合并财务报表的相关科目高于 ISSI 原始报表中相关科目的金额, 因为相关科目均为成本/费用类科目, 影响金额为负数表示相关调整事项对税前利润影响金额为正。

注 2: 其他调整因素对税前利润的影响金额合计指除上述调整外, 其他导致税前利润变动的因素调整金额合计。

注 3: 税前利润差异合计指备考合并财务报表中的税前利润总额高于 ISSI 实际报表的金额, 符号为正表示备考合并财务报表的税前利润金额高于 ISSI 实际报表的税前利润。

1、2016 年, ISSI 的利润总额比标的公司合并备考报表中的利润总额低约 3,078.45 万美元, 主要基于以下原因:

(1) ISSI 的实际财务报表采用符合美国会计准则规定的“下推会计”的处理方法——“一个会计主体在其单独的财务报表中, 根据购买该主体有投票表决权股份的交易, 重新确立合并和报表的基础。这一交易导致该主体发行在外有表决权股份的所有权发生重大变革。”也就是将原来由收购公司在合并时对所获得净资产的公允价值, 调整下推到被收购子公司的会计报表中。

2015 年 12 月 7 日, 北京矽成完成对 ISSI 的全资收购后, ISSI 报表中含有因前次收购时可辨认公允价值相对于账面成本的增值部分, 即无形资产、固定资产和存货的 PPA。其中, 存货 PPA 部分实际于前次收购完成后, 主要是 2016 年随着存货的周转逐渐确认为当期营业成本。

由于标的公司在编制备考报表时, 假设前次收购已于 2014 年 1 月 1 日完成, 该存货可辨认公允价值较账面成本之增值部分确认在 2014 年 1 月 1 日模拟完成收购日, 其存货周转过程中所确认的营业成本均假设于 2014 年损益表中体现。这导致 2016 年北京矽成备考报表较 ISSI 实际报表的主营业务成本低 1,479.36 万美元, 利润总额高 1,479.36 万美元。

(2) 由于在美国会计准则下, 对于研发费用进行费用化处理, 而在中国会计准则下对符合资本化条件的研发支出进行资本化处理。故在美国准则下, ISSI 将当年符合资本化条件的研发费用金额 828.70 万美元亦计入当期损益表。所以 ISSI 报表的利润总额低于北京矽成备考报表 828.70 万美元。

(3) ISSI 之母公司闪胜科技在当期实现利息收入 454.00 万美元, 主要为 ISSI 向母公司借款于当年产生的借款利息, 该利息为 ISSI 的利息支出, 在 ISSI 损益表中体现。在北京矽成备考合并报表层面, 该内部借款利息进行了合并抵消。所以 ISSI 报表的利润总额低于北京矽成备考报表 454.00 万美元。

2、2015 年 12 月 31 日，ISSI 报表的利润总额比北京矽成备考财务报表低约 4,461.72 万美元，主要基于以下原因：

（1）前次收购 ISSI 100%股权交易中产生的一次性咨询费、服务费等合计约 2,053.61 万美元；标的公司合并备考报表的编制基础之一是假设 2014 年 1 月 1 日已完成前次收购，该系列一次性费用计入 2014 年 1 月 1 日之前的期间。所以导致当年 ISSI 报表的利润低于备考报表 2,053.61 万美元。

（2）如前所述，在编制备考报表时，假设 2014 年 1 月 1 日已完成前次收购，所以 2015 年备考报表体现了由于购买日确定的固定资产及无形资产的公允价值于账面价值之增值部分的当年摊销而造成的减少利润的影响，当年共计 1,020.38 万美元。所以导致 2015 年 ISSI 报表的利润总额高于备考报表 1,020.38 万美元。

（3）在备考报表编制时，假设 2014 年 1 月 1 日完成收购，该存货可辨认公允价值于账面成本之增值部分确认在 2014 年 1 月 1 日模拟完成收购日，其存货生产销售的过程中所确认的销售成本于 2014 年损益表中体现。而 ISSI 报表中，增值额中 181.84 万美元于 2015 年结转销售成本，所以 ISSI 报表的利润总额低于北京矽成备考报表 181.84 万美元。

（4）如前所述，在美国会计准则下，ISSI 当年符合中国会计准则规定下资本化条件的研发费用共计 48.98 万美元全部计入当期损益中。因此，ISSI 报表的利润总额低于北京矽成备考报表 48.98 万美元。

（5）前次收购完成前，ISSI 实施了员工激励计划，该计划相关的部分员工激励费用计入 2014 年和 2015 年的期间费用。因为在编制备考合并报表时，假设 2014 年 1 月 1 日前次收购已经完成。所以假设前次合并基准日之前的员工激励费用在 2014 年 1 月 1 日之前已全部发生，该事项导致 2015 年 ISSI 报表的利润总额低于备考报表 3,191.20 万美元。

3、2014 年 12 月 31 日，ISSI 报表的利润总额比北京矽成备考财务报表高约 2,041.77 万美元，主要基于以下原因：

（1）在编制备考报表时，假设 2014 年 1 月 1 日完成收购，该存货可辨认公允价值于账面成本之增值部分确认在 2014 年 1 月 1 日模拟完成收购日，其存货生产销售的过程中所确认的销售成本计入 2014 年损益中体现，所以 ISSI 报表的

利润总额高于备考报表 1,661.20 万美元。

（2）在编制备考报表时，假设 2014 年 1 月 1 日完成收购，固定资产及无形资产可辨认公允价值于账面成本部分的摊销金额 1,126.98 万美元，导致 2014 年 ISSI 报表的利润总额高于备考报表 1,126.98 万美元。

（3）ISSI 在被北京矽成收购前有员工激励计划，涉及 2014 年和 2015 年的员工费用。在编制备考报表时，假设 2014 年 1 月 1 日完成收购，在实际收购日之前的员工激励费用模拟编制在 2014 年 1 月 1 日之前已全部发生。所以导致 2014 年 ISSI 报表的利润总额低于备考报表 746.45 万美元。

第十一章 同业竞争与关联交易

一、报告期内交易标的关联交易情况

（一）北京矽成的关联方

1、截至 2016 年 12 月 31 日，存在控制关系的关联方包括：

（1）北京矽成的控股股东和实际控制人，本次交易前北京矽成无控股股东、无实际控制人。

（2）北京矽成子公司，子公司情况请参见本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（一）标的公司概况和历史沿革”。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，不存在控制关系的关联方情况如下：

报告期内，其他关联方如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	投资方
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	投资方
北京华创芯原科技有限公司	投资方
北京华清闪胜科技有限公司	原投资方
上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	投资方
烟台民和志威投资中心	投资方
潘建岳	董事长
芦永忠	董事长
李学勉(Shueh-Mien (Jimmy) Lee)	董事
武平	董事
张建勋（注）	董事
刘越	董事
韩光宇(Kong Yeu Han)	董事
蔚成	独立董事
彭介平	独立董事
陈亦工	独立董事
马龙滨	监事

许伟	总经理
John Cobb	首席财务官

注：根据 2016 年 11 月 1 日在台湾新竹办公室召开的第四届第四次股东会议，决议通过免去石振东的董事职务，推荐张建勋担任董事。

（二）报告期内的关联交易

根据中兴华会计师出具的中兴华专字（2017）第 010161 号和中兴华专字（2017）第 010162 号《审计报告》，标的公司北京矽成 2014 年、2015 年和 2016 年发生的关联交易情况如下：

1、关联方资金拆借

报告期内，北京矽成与关联方之间的资金拆借情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	拆借金额	起始日	到期日
拆入资金				
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	8,216.00	2015/11/18	2018/5/18
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	5,688.00	2015/11/27	2018/11/27
3	北京华创芯原科技有限公司	3,160.00	2015/11/18	2018/5/18
4	北京华清闪胜科技有限公司	3,160.00	2015/11/18	2018/5/18
5	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	265.36	2016/12/23	2017/12/23
6	烟台民和志威投资中心	15.85	2016/12/27	2017/12/27
合 计		20,505.20	-	-

上述关联方资金拆借中，前四笔均发生于 2015 年 11 月，系标的公司前次私有化收购 ISSI 100%股权时，为筹集支付员工期权提前行权的资金而向公司股东发生的资金拆借。2015 年 11 月 18 日，标的公司与公司股东上海承裕、华创芯原和华清闪胜签署《借款协议》，按照协议约定的条款：上海承裕、华创芯原和华清闪胜分别按照各自持有借款人的股份比例向北京矽成提供借款用于补充流动资金，借款金额合计 14,536.00 万元。借款期限自借款日至 2018 年 5 月 18 日。

2015 年 11 月 26 日，标的公司和股东屹唐投资签署《一般委托贷款借款合同》，屹唐投资委托北京工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向标的公司发放委托贷款 5,688.00 万元，用于补充流动资金。贷款期限自 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。

2016 年 12 月 27 日，北京矽成召开第四届第六次股东会会议，全体股东一致同意：股东华清闪胜将其持有的北京矽成 10.10% 的股权转让给屹唐投资，将其持有的北京矽成 4.09% 的股权转让给上海承裕，并将其持有的北京矽成 0.85% 的股权转让给民和志威。当日，华清闪胜分别与屹唐投资、上海承裕和民和志威签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

2016 年 12 月 23 日和 2016 年 12 月 27 日，上海闪胜分别向本次股权转让的受让方上海承裕和民和志威按照股权比例新增借款 2,653,584.00 元和 158,460.00 元，用于偿还华清闪胜尚未偿还的 2,672,268.00 元借款本金和利息，借款期限均为一年。截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成已偿还全部向华清闪胜拆借的关联方借款。

上述全部六笔关联方借款的年利率均为 4.75%，借款人约定在借款期限内一次性偿还本息给出借人。截至 2016 年 12 月 31 日，北京矽成已归还上述关联方资金拆借的本金共计人民币 18,752.40 万元。

2、其他关联方交易

除上述已披露的关联方资金拆借外，报告期内，北京矽成未与关联方发生发生任何购销商品、提供和接受劳务、关联租赁、关联担保等其他关联交易。

（三）关联往来余额

1、应付关联方款项

报告期各期末，北京矽成应付关联方款项如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2016 年末	2015 年末
其他应付款	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	1,011.56	8,257.19
	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	522.40	5,713.52
	北京华创芯原科技有限公司	281.47	3,175.84
	北京华清闪胜科技有限公司	-	3,175.84
	烟台民和志威投资中心	15.85	-
	合 计	1,831.27	20,322.40

2、其他关联往来账户

除上述其他应付款中涉及应付五家股东的借款外，报告期内，北京矽成的关联交易未对其他资产负债表科目产生影响。

（四）报告期内北京矽成关联交易的必要性和公允性分析

2015 年 11 月，北京矽成向股东拆借的四笔关联方借款系北京矽成前次私有化收购 ISSI 100%股权时，为支付员工期权提前行权的现金收购对价而向股东拆借的资金。鉴于北京矽成成为控股型公司，自身未开展业务，因此自有货币资金有限。为不影响实际经营实体 ISSI 美国的正常运转，本次现金支付通过向标的公司股东拆借资金的方式有利于维持标的公司日常经营所需的流动资金供应稳定，保障日常经营的连贯性。因此，北京矽成上述关联方资金拆借具有必要性。

2016 年 12 月，因标的公司发生股权转让，原股东华清闪胜不再作为标的公司股东，为偿还华清闪胜按照持股比例向北京矽成提供的借款剩余的本息，标的公司通过子公司上海闪胜向本次股权转让受让方按照新增持股比例借款。该笔借款系签前述四笔关联方借款的延续性操作，有利于保障公司现有股东权益和义务的一致性。因此，上述两笔关联方资金拆借也具有必要性。

上述关联方资金拆借的年利率率为 4.75%，经查阅，同期金融机构 3 年期人民币贷款基准利率为 4.75%，因此上述关联方资金拆借的定价公允，不会损害标的公司的利益。

二、本次交易构成关联交易

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，上海承裕、屹唐投资在本次交易完成后将成为上市公司持股比例 5%以上股东，且上述事项预计在十二个月内完成；发行股份募集配套资金的交易对方中，名建致真系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理朱一明控制的企业。

由上述，根据《重组管理办法》、《上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。针对本次关联交易，上市公司聘请了境内审计、评估机构，对交易资产进行审计、评估，并遵守国家相关法律、法规及有关关联交易程序的要求履行了公司内部决策程序以及必要的信息披露义务，按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》等相关法律、法规的有关规定，对本次关联交易进行合理的定价和公平地交易。

三、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争情况

本次交易并未导致兆易创新控股股东和实际控制人发生变更，朱一明仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，北京矽成旗下的存储芯片业务将整体注入上市公司。目前，朱一明未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及标的公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及标的公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争的问题。

本次交易完成后，为从根本上避免和消除控股股东及实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东及实际控制人朱一明作出承诺避免同业竞争。此外，本次交易完成后，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，也作出承诺避免同业竞争。

四、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易情况

本次交易前，上市公司与北京矽成及其股东之间不存在关联关系，亦不存在关联交易。本次交易完成后，标的资产北京矽成将作为上市公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围，标的公司股东上海承裕及屹唐投资将成为上市公司持股比例 5%以上股东，上市公司将新增关联方。

本次交易完成后，上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人、本次交易新增关联方和上市公司的关联交易，朱一明、上海承裕及屹唐投资分别就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

五、本次交易完成后，规范关联交易及避免同业竞争的措施

（一）规范关联方交易承诺

为了进一步规范并减少本次重组完成后上市公司的关联交易及保持关联交易的公允性，保护上市公司利益，上市公司控股股东、实际控制人朱一明，和交易对方上海承裕和屹唐投资分别签署了避免或减少关联交易的承诺，承诺本次交易完成后，其控制的企业将尽量避免或减少与上市公司之间发生关联交易。

朱一明主要承诺内容如下：

1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与兆易创新及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与兆易创新及其控制企业的关联交易损害兆易创新及其他股东的合法权益。

3、在持有上市公司股份期间，不利用控股股东地位及影响谋求兆易创新及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与兆易创新及其控制企业达成交易的优先权利。

4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

除非本承诺人不再作为兆易创新的控股股东及实际控制人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给兆易创新或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

上海承裕和屹唐投资主要承诺内容如下：

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，本承诺人

作为本次重组项下的交易对方，特此承诺如下：

1、本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与兆易创新及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与兆易创新及其控制企业的关联交易损害兆易创新及其他股东的合法权益。

3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位及影响谋求兆易创新及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。

4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

除非本承诺人不再持有上市公司 5%以上股份，本承诺始终有效。若因违反上述承诺而给兆易创新或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

（二）避免同业竞争承诺

本次交易并未导致兆易创新控股股东和实际控制人发生变更，朱一明仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，北京矽成旗下的存储芯片业务将整体注入上市公司。目前，朱一明未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后不存在同业竞争的问题。

本次交易完成后，为从根本上避免和消除控股股东及实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东及

实际控制人朱一明作出承诺：

1、本承诺人目前未直接或间接地从事任何与兆易创新及标的公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。

2、本承诺人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与兆易创新及标的公司相同或类似的业务，以避免与兆易创新及标的公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

3、如果本承诺人有同兆易创新或标的公司主营业务相同或类似的业务机会（以下简称“业务机会”），应立即通知兆易创新，并尽其最大努力，按兆易创新可接受的合理条款与条件向兆易创新提供上述业务机会。无论兆易创新是否放弃该业务机会，本承诺人均不会自行从事、发展、经营该等业务。

4、本承诺人保证，本承诺人全资拥有或拥有 50%股权以上子公司（兆易创新及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺。本承诺人将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

5、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本承诺人不再作为兆易创新的实际控制人；

（2）兆易创新股票终止在上海证券交易所上市。

同时，为了保障兆易创新的合法权益，交易对方上海承裕和屹唐投资及其实际控制人特就避免与兆易创新同业竞争事宜作出不可撤销的承诺如下：

为了保障兆易创新及标的公司的合法权益，本承诺人特就避免与兆易创新同业竞争事宜作出承诺如下：

为保障上市公司及标的公司的利益，本次交易完成后，本承诺人承诺，于三年业绩承诺期内（本承诺人持有上市公司股份低于 5%的，承诺自本承诺人持股比例首次低于 5%之日即终止）：

1、不以任何方式直接或间接地控制从事与上市公司、标的公司现有主营业务（简称“现有业务”）相同业务活动的任何实体。

2、亦不会在标的公司及其下属公司招揽标的公司的雇员（含在《发行股份

及支付现金购买资产协议》生效日之前 12 个月内曾与标的公司签订劳动合同的人员）、不会唆使任何标的公司的高级管理人员和核心技术人员离开标的公司。若发生此种行为，则上市公司有权在不超过本承诺人因此种行为所获利金额的限额内要求本承诺人支付赔偿。本承诺人将尽合理努力促使标的公司核心管理人员一并作出以上承诺（核心管理人员不竞争相应期限为其在标的公司任职期间及其离职后两年内）。

3、在现有业务之外，未来上市公司、标的公司从事新的主营业务（简称“新业务”，即以上市公司在指定信息披露媒体上披露的为准，该等业务占上市公司合并报表营业收入的 5%或以上），本承诺人亦将不会以任何方式直接或间接的控制从事新业务的实体，但在上市公司披露某项业务已构成其新业务前本承诺人已从事的新业务不受此限。

为本条之目的，“现有业务”是指存储芯片、微处理器及其衍生产品的研发、技术支持和销售；“控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力，但是以财务投资为目的的进行投资活动，不论持股比例是否超过 50%，亦不论是否向被投资公司委派或提名董事，不直接或间接参与被投资公司业务经营及管理，均不视为控制。

尽管有上述承诺，在《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之前，本承诺人已经进行的投资不受上述限制。

第十二章 风险因素

一、本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本次交易的审计及评估报告出具后，兆易创新再次召开董事会审议通过本次交易方案；兆易创新股东大会审议通过本次交易方案；中国证监会核准本次交易事项；通过 CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会审查等。其中，CFIUS 的国家安全审查及台湾投审会审查为本次交易交割的前提条件。

截至本报告书出具日，上述审批事项尚未完成。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意本次交易的审批风险。

（二）交易的终止风险

公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止本次交易的风险。

2017 年 2 月 13 日，上市公司与上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威以及北京矽成签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议有效期限自签署之日起 10 个月届满，除非各方协商一致同意延长前述期限。

此外，如有权监管机构对协议的内容和履行提出异议从而导致协议的重要原则条款无法得以履行以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则经各方书面协商一致后发行股份及支付现金购买资产协议可以终止或解除。在本次交易过程中，交易各方可能需根据中国证监会等监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

综上，提请投资者注意本次交易可能终止的风险。

（三）上市公司股票停牌前价格波动异常的风险

根据中国证监会 128 号文第五条规定，公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证电子指数（代码：950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）波动情况进行了自查比较。公司 A 股股票股价在上述期间内上涨幅度为 431.41%，扣除上证电子指数下跌 3.53% 因素后，波动幅度为 434.94%；扣除上证综指下跌 3.26% 因素后，波动幅度为 434.67%。综上，剔除大盘因素后，公司股价在公司因本次重大资产重组事宜停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%，达到 128 号文第五条的相关标准。（详情参见本报告书“第九章 其他重要事项”之“三、公司停牌前股价存在异常波动的说明”和“第九章 其他重要事项”之“四、相关人员买卖上市公司股票的自查情况”）。

尽管上市公司已按照相关法律法规的要求，在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理。上述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。

（四）标的公司业绩承诺不能达标的风险

根据上市公司与业绩承诺方上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 29,900.00 万元、44,200.00 万元和 57,200.00 万元。

经上市公司与业绩承诺方协商一致，标的公司业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为实际净利润数。在计算实际净利润数时，不考虑：1、标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；2、标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

在标的公司业绩承诺期的每一年度《专项审核报告》出具后，若标的资产在盈利补偿期间内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数低于承诺净利润累计数的 90%，业绩承诺方应对上市公司进行补偿。

上述业绩承诺系交易对方基于标的公司目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。因此本次交易存在承诺期内标的公司实现的实际净利润达不到承诺净利润的风险。

（五）业绩补偿不足的风险

根据上市公司与本次交易业绩承诺方上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，双方约定若标的公司在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数达到承诺净利润累计数的 90%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿。同时，在计算标的公司在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数时，不考虑：1、标的公司因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；2、标的公司因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

此外，在充分考虑业绩承诺方对目标公司未来经营的作用、未来承担的业绩补偿责任和风险、标的公司对上市公司的战略意义等因素的基础上，上市公司与业绩承诺方约定了业绩补偿的最高限额，即业绩承诺方业绩补偿总额以标的资产交易作价的 50%为限，如有超出部分，业绩承诺方无需进一步补偿。若标的公司在承诺期间累计实现的净利润低于承诺净利润数的 90%，则各业绩承诺方在向上市公司支付其最高限额的补偿后，无须再对上市公司进行额外的股票或现金补偿。

提请投资者关注相关业绩补偿不足的风险。

（六）收购整合风险

在发展过程中，上市公司已建立了高效的管理体系和经营管理团队。本次交易完成后，公司的资产、业务规模和范围都将有较大幅度的增长，企业规模增长对企业经营管理提出更高的要求。

本次收购属于对同行业优质资产的整合，上市公司对于标的公司所处行业的特点和发展规律有深入了解，积累了大量发展经验。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，上市公司与标的公司仍需在企

业文化、团队管理、销售渠道、客户资源等方面进行进一步的融合。但是，本次交易完成后，上市公司能否对标的公司实施有效整合，以及本次交易能否充分发挥协同效应，均存在不确定性，进而可能影响本次收购的最终效果。

本次交易完成后，标的公司北京矽成在管理经营、销售扩展、产品研发领域等方面将继续保持其独立性，现有的管理团队、销售组织架构、研发技术人员将不会因本次重组而发生变化。鉴于标的公司在经历前次私有化收购后，经营业绩仍保持稳健增长的良好态势，同时继续保持与原主要客户之间的稳定合作关系和紧密联系，未影响消费者的购买意向。本次重组因受标的公司被上市公司收购的影响而导致客户购买意向降低的可能性较小。但是，考虑到标的公司的主要经营活动在美国和台湾等境外地区开展，主要客户亦广泛分布于欧美及亚太地区，不排除本次收购本次交易会影影响部分客户消费意向，从而导致对标的公司未来经营业绩产生不利影响的可能性，提请投资者关注相关风险。

（七）募集配套资金未能实施或者募集金额低于预期的风险

本次交易中，本公司拟向名建致真等不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 183,000.00 万元，其中 154,761.00 万元用于支付标的资产现金对价，20,000.00 万元用于 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目的建设，剩余募集配套资金用于支付本次交易相关的中介费用。

受标的资产经营情况、财务状况变化、监管机构政策以及资本市场影响，若本次募集配套资金金额不足乃至募集失败，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决本次收购交易标的的现金对价、本次交易相关的中介费用及拟筹建项目所需资金需求。若公司以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式筹集所需资金，将给公司带来一定的财务风险和融资风险，提请投资者注意相关风险。

（八）商誉减值风险

本次交易属于非同一控制下的企业合并，上市公司对本次合并成本与评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。本次交易，标的公司的交易作价为 650,000.00 万元，相较于北京矽成截至 2016 年末归属于母公司股

东权益增加 101,853.43 万元。考虑标的公司因前次收购 ISSI 100%股权产生商誉 239,950.02 万元。本次交易完成后，上市公司因本次交易导致合并资产负债表中商誉新增金额较高，达 341,803.44 万元。

根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失，进而对公司未来利润产生不利影响，提请广大投资者注意。

（九）本次交易后上市公司每股收益摊薄的风险

本次交易完成后，上市公司最近一期备考报表的每股收益均较交易前的每股收益指标得到增厚。如本报告书重大事项提示之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”中所测算，本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后的每股收益为 2.28 元/股，较 2017 年重组完成前的每股收益增加 0.77 元/股，增幅达 51.18%，重组后上市公司盈利能力将显著增强。交易完成后，不存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

但是，鉴于前述测算的假设条件依赖于对上市公司和标的公司所处行业的发展前景及自身经营状况的判断，存在实际实现的盈利水平与假设条件存在较大差异的可能性，且本次重组的最终完成时间也存在不确定性，因此本次重大资产重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险。提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

（十）上市公司净资产收益率面临被摊薄的风险

本次交易完成前，上市公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的加权平均净资产收益率分别为 25.78%、31.92%和 21.18%。因为上市公司报告期各期末的净资产规模相对较小，所以净资产收益率水平保持较高水平。本次交易完成后，上市公司的净资产将在现有基础上出现较大幅度的增加。虽然标的公司的盈利能力较强，本次交易完成后上市公司的盈利能力将显著提升。但是因为标的公司的净资产规模较大，报告期内标的公司的净资产收益率低于上市公司的水平。

本次交易完成后，若上市公司经营业绩未能有与净资产规模同等幅度的增长，未来一定期间内上市公司的净资产收益率将面临被摊薄的风险，提请投资者注意。

二、标的资产相关风险

（一）行业周期性风险

标的公司北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片的研发和销售，属于集成电路产业的上游环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。全球范围内，集成电路产业规模一直保持稳步增长趋势，随着新的技术进步导致旧技术产品逐渐淘汰，作为集成电路行业不断地追求新技术发展的特征，使产品周期时间越来越短，由此产生了集成电路行业特有的周期性波动特点，且行业周期性波动的频率要较经济周期更为频繁，在经济周期的上行或下行过程中，都可能出现相反的集成电路产业周期。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则标的公司的经营业绩可能受到负面影响，提请投资者注意行业周期性波动的风险。

（二）人才流失风险

标的公司北京矽成作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成标的公司拥有行业领先地位的重要保障。目前，北京矽成拥有高素质的稳定管理设计团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素，本次交易方案向标的公司管理团队和核心技术人员提供了较为合适的激励机制，然而随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，若没有跟进相适应的激励机制，则管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面可能出现下降，或产生人员流失、经营运作不利、盈利水平下滑等不利影响，提请投资者注意相关风险。

根据《购买资产协议》，上市公司、交易对方及标的公司已就标的公司及其下属公司管理层履约期限形成具体安排，但截至本报告书出具日，相关方尚未就标的公司核心技术人员长期服务的履约期限形成具体安排，该事项将在本次交易获得中国证监会审批通过、本次交易具体实施之前确定。若届时无法及时

明确上述安排，则本次交易完成后，标的公司及其下属企业核心技术人员将没有明确履约期限，上市公司可能面临核心技术人员流失风险。提请投资者注意相关风险。

（三）供应商风险

标的公司北京矽成采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，作为集成电路设计领域内通常采用的经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中，由供应商的供货所产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障标的公司的采购需求，存在不确定的风险。同时随着行业中晶圆代工厂和封装测试厂在不同产品中产能的切换，以及产线的升级，或带来的标的公司采购单价的变动，若代工服务的采购单价上升，会对标的公司的毛利率造成下滑的影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆代工生产和封装测试厂向标的公司的正常供货。提请投资者注意相关风险。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。我国政府目前已通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，陆续颁布了一系列法律法规及政策，拟从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业企业的发展。2015 年颁布的《中国制造 2025》中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点照顾的领域。政府对集成电路产

业的支持政策为我国各类型的高新科技集成电路企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响，提请投资者注意相关风险。

（五）标的公司股权及资产质押风险

截至本报告书出具日，上海承裕、华创芯原所持有的标的公司股权存在质押情形，具体为上海承裕持有的 43.173% 标的公司股权中 39.087% 的股权质押予亦庄国投，华创芯原持有的标的公司 15.034% 股权，全部质押予亦庄国投。上海承裕和华创芯原已分别作出承诺，将在本次交易申报文件提交中国证监会之前解除相应质押，确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍。亦庄国投亦出具《关于解除标的资产质押的说明与承诺函》，承诺将积极与上海承裕及华创芯原进行磋商及达成有关担保措施等方案，同意在此基础上，不晚于上市公司将本次交易申报文件提交中国证监会之前（如相关监管部门有其他时间要求的，从其要求）解除前述股权质押，并依法办理完成质押解除登记手续。

因亦庄国投为上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原私有化收购 ISSI 交易的并购贷款提供连带责任保证，北京矽成将上海闪胜 100% 股权质押予亦庄国投以提供反担保。截至本报告书出具日，上述股权质押尚未解除。根据北京矽成的说明，其承诺于本次交易申报文件提交中国证监会前解除前述股权质押。

在上海承裕、华创芯原与亦庄国投相关方协商一致且相关承诺得到切实履行的情况下，上述股权及资产质押不会对本次重组的实施构成障碍。但如出质人与质权人无法就解除质押事宜协商一致，或相关方未能正常履行相关承诺，则上述质押存在无法及时解除的风险。

（六）标的资产的估值风险

根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100% 股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100% 股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元，截至本次评估基准日 2016 年 9 月 30 日的北京矽成归属于母公司净资产账面值 527,046.21 万元，评估增值 53,812.26 万元，增值率 10.21%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照估值的相关规定，勤勉、尽责，但由于评估和估值工作是基于一定的假设前提，如未来情况较预期发生较大变化，可能存在资产估值与实际情况不符的风险。此外，预估值可能与最终评估或估值结果存在一定差异，本次交易标的资产最终作价也将以评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，经交易双方协商确定。提请投资者注意相关估值风险。

（七）标的资产交易定价较评估值存在溢价的风险

本次交易中，拟购买资产的交易价格以中联评估采用收益法对标的公司进行评估的评估值为依据，由交易各方协商确定。根据中联评估出具的《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 483 号），北京矽成 100%股权截至评估基准日的评估值为 580,858.47 万元，而交易对方最终协商确定标的资产的交易价格为 650,000.00 万元，相比收益法评估后的 100%股权价值 580,858.47 万元溢价 69,141.53 万元，增值率 11.90%。

本次交易作价相较于评估值存在溢价，系交易双方综合考虑了本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，具体考虑如下：

1、汇率变动

北京矽成 100%股权按照收益法评估的归属于母公司股东权益价值为 86,983.51 万美元，按照本次评估基准日 2016 年 9 月 30 日人民币的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.6778 元折算，得出评估基准日被评估企业股东权益价值为 580,858.47 万人民币。

2、协同效应

兆易创新和北京矽成同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售区域、销售客户、技术研发等多方面都有较强的协同效应。通过本次重组，上市公司将快速由单一的 Flash 产品提供商转变为 DRAM 和 SRAM 以及 Flash 全品类存储芯片提供商，销售区域扩充至欧美、亚太等全球主要国家和地区。

就上市公司层面，在产品销售协同方面，本次重组将优化上市公司的销售渠道及客户结构。整合后，凭借上市公司和标的公司在不同行业领域的市场优

势，上市公司的 FLASH 类非易失性存储芯片产品中包括了 Serial NOR Flash、Serial NAND Flash、SLC (ONFi) NAND、eMMC5.1 等优势产品，将通过北京矽成已建立的客户群体获得在专用领域的市场开拓机会和收入增长，为产品的市场占有率提供更大的提升空间。

在销售费用协同方面，上市公司原有产品销售业务覆盖范围主要以国内消费电子市场为主，重组后，上市公司可以共享北京矽成凭借多年来在全球存储芯片市场不断的开拓下积累的全球销售网络，在海外销售网络获得高速、有效的和海外客户对接的机会。同时销售渠道整合共享后，上市公司在海外聘请销售人员、开拓销售渠道的费用将会得到一定程度的降低。

就本次交易对上市公司产品销售和销售费用的协同效应，以及对标的公司的负协同效应，中联评估出具了《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司股权所涉及的协同效应估值报告》（中联评咨字[2017]第 494 号）。根据该报告，北京兆易创新科技股份有限公司与北京矽成半导体有限公司于 2016 年 9 月 30 日估值基准日时点可辨认的协同效应投资价值的估值区间为 24,037.35 万元~54,425.49 万元。

本次交易标的资产作价相对评估值的溢价综合考虑了本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响。但是，该等协同效应投资价值能否顺利体现并覆盖本次交易的相应溢价存在不确定性，提请投资者充分关注由此带来的风险。

（八）外汇风险

标的公司下属实际经营主体大多注册在境外，主要经营活动也在境外开展，日常经营活动中涉及美元、台币、欧元等外币，而且境外的子公司根据其经营所处的主要经济环境以其本国货币作为记账本位币。一方面，各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给标的公司未来运营带来汇兑风险；另一方面，随着人民币日趋国际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对美元等货币的汇率变化将导致标的公司及上市公司合并财务报表的外币折算风险。

（九）标的公司编制备考财务报表相关风险

本次交易前，北京矽成作为投资性主体，除持有上海闪胜及其下属子公司的

股权外，自身未开展经营活动。2015 年 12 月 7 日，标的公司通过下属全资子公司闪胜科技收购了 ISSI 全部已发行股票，并开始将其纳入合并财务报表，本次收购前后北京矽成的主要资产负债、利润构成均发生了重大变化。因此，标的公司假设北京矽成及其下属子公司上海闪胜和闪胜科技等均已于 2014 年 1 月 1 日设立完成并完成了对 ISSI 的全资收购，在此基础上编制了标的公司备考财务报告。

鉴于标的公司的备考合并财务报表，并非北京矽成实际经营情况的反映，如 2015 年度北京矽成实际仅承担 2015 年 12 月开始合并 ISSI 财务报表之后的经营业绩。此外，由于备考合并财务报表的编制基础具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，也未完全真实反映收购 ISSI 已于 2014 年 1 月 1 日完成的情况下标的公司于 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2014 至 2016 年度的合并经营成果，提请广大投资者注意。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策的调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易相关的内外部审批工作尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。公司提醒投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

（二）其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

第十三章 其他重要事项

一、交易完成后上市公司资金、资产占用与担保情况

本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。

二、上市公司负债情况

本次交易对上市公司负债结构的影响见“第九章 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务相关指标的影响分析”之“（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“3、本次交易对上市公司资产负债主要构成及财务安全性影响分析”。

三、上市公司最近十二个月内资产交易情况

截至本报告书出具日，除本次交易外，公司在最近 12 个月内无其他重大资产购买、出售等资产交易行为。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等中国证监会规定及《公司章程》，本公司在本次交易前已建立健全了相关法人治理结构的基本架构，包括股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、独立董事、总经理，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

本次交易完成后，本公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

五、公司停牌前股价存在异常波动的说明

公司股票于 2016 年 9 月 19 日起开始停牌，并于 2016 年 10 月 10 日起进入重大资产重组停牌程序。

根据中国证监会 128 号文第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影

响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证电子指数（代码：950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：

日期	兆易创新价格 (元/股)	上证电子指数 (点)	上证综指 (点)
2016 年 8 月 18 日	33.49	5,797.78	3,104.11
2016 年 9 月 14 日	177.97	5,593.19	3,002.85
涨跌幅	431.41%	-3.53%	-3.26%

注：由于兆易创新股票上市交易仅 20 个交易日，因此将兆易创新股票停牌前第 20 个交易日的收盘价作为计算波动幅度的基数。

公司 A 股股票股价在上述期间内上涨幅度为 431.41%，扣除上证电子指数下跌 3.53%因素后，波动幅度为 434.94%；扣除上证综指下跌 3.26%因素后，波动幅度为 434.67%。

综上，剔除大盘因素后，公司股价在公司因本次重大资产重组事宜停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%，达到 128 号文第五条的相关标准。

本次交易，公司已采取了相关保密措施，包括公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。

根据本次重组相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内人员买卖公司股票的情况，相关人员已出具声明和承诺（详情参见“第九章 其他重要事项”之“四、相关人员买卖上市公司股票的自查情况”）。

尽管上市公司已按照相关法律法规的要求，在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理。上述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。

六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况

中国证监会 128 号文、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》以及上交所的相关要求，上市公司自 2016 年 9 月 19 日停牌后，进行内幕信息知情人登记及自查工作，并向上交所上报了内幕信息知情人名单。

按照相关规定，自查期间为本次交易停牌前 6 个月至重大资产重组报告书披露之前一日。鉴于公司股票于 2016 年 8 月 18 日完成首次公开发行并上市，因此本次自查期间为公司股票首次公开发行日至报告书披露之前一交易日，即 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 4 月 12 日。本次自查的范围包括：公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；本次收购的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其他知情人员；本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员；以及前述所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）。

根据自查范围内人员出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司截至 2017 年 3 月 23 日的查询结果：

（一）自查结果

本次自查结果如下：

姓名	日期	买入/卖出	数量（股）	持股余额
吕大龙（北京华清闪胜科技有限公司之执行董事）	2016 年 9 月 13 日	买入	200 股	200 股
吕大龙（北京华清闪胜科技有限公司之执行董事）	2017 年 3 月 16 日	卖出	200 股	0 股
国泰君安证券股份有限公司	2016 年 8 月 18 日	IPO 中签	512 股	512 股
国泰君安证券股份有限公司	2016 年 8 月 23 日	买入	1,100 股	1,612 股
国泰君安证券股份有限公司	2016 年 9 月 13 日	卖出	1,612 股	0 股

（二）自查情况说明

自查期间，吕大龙、国泰君安证券股份有限公司有买卖公司股票的情况，具体情况如下：

（1）吕大龙有买卖兆易创新股票的情况，但其并未参与上市公司本次重大资产重组的筹划或决策，其买卖行为与本次重大资产重组也不存在任何关联关系；吕大龙本人及其直系亲属更无泄漏有关信息或者建议他人买卖兆易创新股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。吕大龙承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

吕大龙出具了《关于买卖北京兆易创新科技股份有限公司股票情况的说明》，声明其买卖兆易创新股票主要是基于对兆易创新股票的价值判断，其本人未参与兆易创新公告所述的重大资产事项的筹划、制订、论证、决策，在兆易创新停牌前均不知悉兆易创新公告所述的资产重组的任何事项，未利用内幕信息买卖兆易创新股票。上述股票买卖系其本人的正常证券投资行为。

此外，北京华清闪胜科技有限公司于 2016 年 12 月通过股权转让退出上市公司本次重大资产重组的标的公司，即不再作为交易对方参与本次重大资产重组；此后，北京华清闪胜科技有限公司或吕大龙不再参与或获悉本次重大资产重组的任何信息或消息。

（2）国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 8 月 13 日中签兆易创新股票 512 股，并于 8 月 23 日追加买入 1,100 股，上述股票全部于 9 月 13 日全部卖出。国泰君安证券承诺上述买卖兆易创新股票的行为属于自营部门的投资行为，在买卖该股票前未获悉兆易创新重大资产重组的任何信息，因此不涉及内幕交易、操纵市场等扰乱金融秩序的行为。国泰君安证券对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于买卖北京兆易创新科技股份有限公司股票情况的说明》，声明其买卖兆易创新股票行为系证券衍生品部门结合一定的投资策略与对兆易创新股票价值分析后的综合决策，是其作出的独立判断与投资决策，与兆易创新本次重大资产重组不存在关联关系。

除上述情况外，本次重大资产重组核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。就上述买卖公司股票的行为，相关人员和机构未

参与公司本次重大资产重组筹划，不属于利用内幕消息以直接或间接方式买卖公司股票的情形，亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。

七、利润分配政策与股东回报计划

为完善和健全上市公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件的规定，本公司第一届董事会第十次会议与2014年度第二次股东大会审议通过了首次公开发行上市完成后适用的《公司股东分红回报三年规划》的议案。本次交易后，本公司将严格按照《公司章程》以及《公司股东分红回报三年规划》实施股利分配，具体内容如下：

（一）发行后公司股利分配政策

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、现金分红的条件及最低比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，且当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

4、分配股票股利的条件及最低比例

当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分

配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

5、差异化现金分配政策

（1）如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（2）股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

（3）公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

6、利润分配预案

（1）利润分配预案提交董事会审议前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划

安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

（3）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

7、利润分配应履行的审议程序

（1）利润分配需履行的决策程序：利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

8、利润分配政策调整

（1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

（3）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

（二）重组完成后股利分配计划

1、股东回报规划制定考虑因素

应着眼于公司长远和可持续发展，有利于公司全体股东利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则

充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、公司本次重组完成后股东分红回报的计划

公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司在公布定期报告的同时，董事会应提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布，且应提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

6、公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

八、关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明

公司根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，对以下主体进行了核查：

（一）上市公司、交易对方、标的资产方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；

（二）上市公司董事、监事、高级管理人员；

（三）上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；

（四）交易对方、标的资产方的董事、监事、高级管理人员；

（五）为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员。

经自查，上述主体不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内也未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。故本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务

上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《重组管理办法》等相关法律、法规的规定对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，上市公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本报告书在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易聘请国泰君安作为上市公司独立财务顾问出具独立财务顾问报告，聘请金杜律师出具法律意见书，聘请具有证券业务资格的中联评估进行评估并出具相关报告，聘请具有证券业务资格的中兴华会计师进行审计并出具相关报告。根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（三）网络投票安排

公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，以充分保护中小股东行使股东权利。在本次重组完成后，公司将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立性的原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作。

（四）资产定价公允性

标的资产北京矽成 100%股权于 2016 年 9 月 30 日的评估值为 580,858.47 万元，与标的资产归属于母公司所有者权益的账面值为 527,046.21 万元相比，增值率为 10.21%。经交易双方友好协商，参考上述评估值，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，交易价格确定为 650,000.00 万元。交易各方以标的资产最终的评估值作为确定标的资产交易价格的依据，并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，资产作价公允、合理，不会损害上市公司及全体股东的利益。

（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、备考审阅报告反映的每股收益变化情况

根据中兴华会计师出具的上市公司备考审阅报告，假设兆易创新于 2015 年初已完成本次重组，本次交易对兆易创新的每股收益影响情况如下：

项目	2016 年		2015 年	
	交易前	交易后	交易前	交易后
每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89
稀释每股收益（元/股）	1.81	2.40	1.89	1.89

注：每股收益计算中不考虑配套募集资金发行股份的影响。分子为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分母为加权平均股本数。

2015 年，本次交易完成前后的每股收益指标基本保持不变。2016 年，随着标的公司主营业务收入的 growth 以及期间费用率的同比下降，在人民币汇率贬值的放大效应下，本次交易完成后上市公司的每股收益指标较本次交易前以及 2015

年同比均得到较大提升。

2、本次重组对上市公司预期每股收益的影响

本次重大资产重组中，上市公司发行股份购买资产拟向上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯及民和志威发行股份数量为 31,284,816 股，不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本规模将由目前的 100,000,000 股增加至 131,284,816 股。

基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本次重大资产重组在 2017 年完成）主要财务指标，关于测算过程的主要假设说明如下：

（1）以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（2）假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），本次重大资产重组最终完成时间以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）假设宏观经济环境、集成电路芯片行业的情况没有发生重大不利变化；

（4）不考虑配套融资发行股份的数量，假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为 31,284,816 股，未扣除本次重组相关的发行及中介费用的影响；

（5）根据北京矽成未来经营期的净现金流量的预测结果表，标的公司 2017 年预测净利润为 3,378.11 万美元，按照评估基准日（2016 年 9 月 30 日）人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币 22,558.35 万元。假设以该预测净利润作为标的公司 2017 年扣非后净利润指标进行测算；

（6）根据上市公司 2016 年度报告财务数据，假设上市公司 2017 年度经营业绩与 2016 年度的实际经营数据相同；上述测算不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

（7）假设 2016 年、2017 年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

（8）公司经营环境未发生重大不利变化；

（9）不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响。

经测算，公司本次重大资产重组前后每股收益指标具体影响如下：

项目	2016 年	2017 年	
		重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)
发行在外的普通股加权平均数 (万股)	8,333.33	10,000.00	11,564.24
扣除非经常性损益后归属于母 公司净利润(单位:万元)	15,073.94	15,073.94	26,353.11
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(单位:元/股)	1.81	1.51	2.28
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益(单位:元/股)	1.81	1.51	2.28

基于上述假定，2017 年上市公司重组完成前扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2016 年减少 0.30 元/股，主要系上市公司于 2016 年 8 月完成首次公开发行股票并上市，IPO 完成后上市公司 2016 年末的股本由年初的 7,500 万股增加至 10,000 万股导致 2016 年发行在外的普通股加权平均数较小所致。

本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较发行前增长 11,279.18 万元，上市公司 2017 年扣除非经常性损益后的每股收益为 2.28 元/股，较 2017 年重组完成前的每股收益增加 0.77 元/股，增幅达 51.18%，重组后上市公司盈利能力将显著增强。

综上，本次交易完成后，不存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。

3、上市公司填补摊薄即期回报并增强公司持续回报能力的具体措施

在前述假设条件下，本次重大资产重组不会摊薄上市公司即期回报。若因经营环境等的变化导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

（1）加强收购整合，提升盈利能力

本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司对标的资产的整合，力争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。上市公司将帮助标的企业尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。

（2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

（3）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

（4）加强募集资金的管理和运用

本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合独立财务顾问和保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集

资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

4、公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司本次重组关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（1）全体董事、高级管理人员承诺

本次重大资产重组完成后，全体公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1. 本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；

2. 本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；

3. 本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4. 本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

5. 本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。”

（2）公司控股股东、实际控制人承诺

公司的控股股东和实际控制人朱一明先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

第十四章 本次交易的有关中介机构情况

一、独立财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

传真：021-38676888

经办人：吴同欣、张宁、黄央、张希滕、秦浩楷、刘岩、陈浩、郑明龙

二、法律顾问

名称：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：王玲

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

电话：010-58785888

传真：010-58785566

经办人：焦福刚、宋彦妍

三、审计机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

电话：010-68364878

传真：010-68364875

经办人：傅虎、张爱国

四、评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4

电话：010-88000066

传真：010-88000006

经办人：李业强、张帆

第十五章 本次交易相关各方的声明

一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

_____ 朱一明	_____ 罗 苗	_____ 李 军
_____ 舒清明	_____ 王志伟	_____ 周 宁
_____ 陈武朝	_____ 李 华	_____ 王志华

全体监事（签字）：

_____ 田 雨	_____ 王 林	_____ 徐文娟

全体非董事高级管理人员（签字）

_____ 何 卫	_____ 李 红

北京兆易创新科技股份有限公司

2017 年 月 日

二、独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

朱健

部门负责人：_____

杨晓涛

内核负责人：_____

许业荣

项目主办人：_____

黄 央

张希朦

项目协办人：_____

秦浩楷

国泰君安证券股份有限公司

2017 年 月 日

三、法律顾问声明

本所及本所经办律师同意《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

王 玲

经办律师签字：

焦福刚

宋彦妍

北京市金杜律师事务所

2017 年 月 日

四、审计机构声明

本所及本所经办注册会计师同意《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本所出具的审计报告及与审计报告相关的报告内容，且所引用内容已经本所及本所经办注册会计师审阅，确认《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

李尊农

签字注册会计师：

傅虎

张爱国

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 月 日

五、评估机构声明

本公司及本公司签字资产评估师同意《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本公司出具的评估数据，且所引用评估数据已经本公司及本公司签字资产评估师审阅，确认《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人或授权代表：

胡智

签字资产评估师：

李业强

张帆

中联资产评估集团有限公司

2017年 月 日

第十六章 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、兆易创新第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十二次会议决议；

2、兆易创新独立董事就本次交易出具的独立意见；

3、交易对方关于本次交易的内部决议；

4、兆易创新与发行股份购买资产之交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》；

5、兆易创新与发行股份募集配套资金之交易对方签署的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》；

6、兆易创新与上海承裕、屹唐投资、华创芯原和闪胜创芯签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；

7、中兴华会计师出具的中兴华阅字（2017）第 010005 号《北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审阅报告书》；

8、中兴华会计师出具的中兴华专字（2017）第 010161 号《北京矽成半导体有限公司 2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度备考合并财务报表审计报告》和中兴华专字（2017）第 010162 号《北京矽成半导体有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并财务报表审计报告》；

9、中联资产评估出具的中联评报字[2017]第 483 号《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司 100%股权项目资产评估报告》；

10、金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》；

11、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财

务顾问报告》；

12、其它与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件；

（一）北京兆易创新科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 23 层

电话：86-10-82881768

传真：86-10-82881768

联系人：李红

（二）国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

电话：021-38674985

传真：021-38674585

联系人：黄央、张希朦

（本页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之签署页）

北京兆易创新科技股份有限公司

2017 年 月 日